

本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

GENORI

臻宝科技

重庆臻宝科技股份有限公司

Chongqing Genori Technology Co., Ltd.

（重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号）

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书

（注册稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

一、发行人上市的目的

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。公司主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。公司已量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅超厚材料和陶瓷造粒粉体等半导体材料，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，并不断突破关键半导体材料制备技术和表面处理技术、拓展核心零部件产品品类，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

通过本次上市，公司可以加大关键原材料的自主研发投入，拓展关键半导体零部件产品体系，提升公司核心竞争力和品牌影响力，加速国内半导体零部件的国产化突围，填补国内半导体材料及零部件领域技术空白，解决先进制程集成电路制造零部件的卡脖子问题，助力国产供应链体系的完善和自主可控，保障集成电路制造行业的稳定可持续发展。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、取消前监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将主要投资于集成电路和显示面板设备精密零部件及材料生产基地项目、臻宝科技研发中心建设项目和上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目。通过本次募投项目的实施，公司将扩大硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等零部件产品的产能，提高产线生产效率，加速公司石墨、碳化硅等关键材料及半导体静电卡盘、氮化铝加热器等新型零部件产品的研发与应用，完善公司“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务优势，推动公司技术创新，促进国内先进工艺半导体零部件行业国产化水平的提升。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

半导体作为信息技术产业的核心载体，是驱动新质生产力的关键引擎，是人工智能产业的核心基础，是国民经济的基础性、先导性和战略性产业。半导体设备零部件的精度、可靠性、稳定性决定了设备和制造工艺的稳定性，直接影响半导体芯片的性能、良率和成本。零部件的国产化是突破“卡脖子”技术的关键，零部件国产替代进程加速，将为半导体设备行业提供更稳定的供应链支持，推动中国半导体产业的自主可控和可持续发展。

报告期内，公司持续深耕集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积等关键环节半导体设备零部件，依托于大直径单晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅材料、陶瓷造粒粉体等关键半导体材料技术突破和曲面硅上部电极、石英气体分配盘、超纯碳化硅环等核心零部件产品品类拓展，建立了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，与客户建立了深度协同合作机制，有效支持客户工艺升级需求。

公司已成为一家专注于为集成电路及显示面板客户提供制造设备真空腔体内的核心零部件研发、制造和销售的创新企业，与客户 3、客户 4、客户 1、客户 2 等集成电路制造厂商，京东方、华星光电、天马微电子等国内主流显示面板厂商和英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等国际集成电路制造厂商建立了长期

稳定的合作关系，营业收入、净利润呈现持续增长趋势。

近年来人工智能和算力芯片的快速发展，带动先进制程芯片和存储芯片需求快速增长，先进制程工艺和 3D 堆叠工艺中刻蚀层数和高深宽比等刻蚀难度要求进一步增加，带动刻蚀设备及刻蚀用零部件等关键设备和零部件的使用需求大幅提高。面对日新月异的技术发展和持续攀升的设备零部件市场需求，公司将继续深耕半导体设备零部件及关键原材料、表面处理领域，加大技术开发和产业化布局，不断拓展产品线，为客户提供“原材料+零部件+表面处理”整体解决方案，协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链，力争成为具有核心竞争力，国内领先、世界一流的中国半导体零部件整体解决方案智造者。

董事长：



王兵

重庆臻宝科技股份有限公司



发行概况

发行股票类型：	人民币普通股（A）股
发行股数、股东公开发售股数（如有）：	本次拟发行股份不超过 3,882.26 万股（含 3,882.26 万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准），公司股东不公开发售股份
每股面值：	1.00 元
每股发行价格：	【】 元
预计发行日期：	【】 年 【】 月 【】 日
拟上市的交易所和板块：	上海证券交易所科创板
发行后总股本：	不超过 15,529.03 万股
保荐人（主承销商）：	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：	【】 年 【】 月 【】 日

目录

发行人声明	1
致投资者声明	2
一、发行人上市的目的.....	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....	2
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	3
四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....	3
发行概况	5
目录.....	6
第一节 释义	11
一、一般术语.....	11
二、专业术语.....	15
第二节 概览	18
一、重大事项提示.....	18
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	21
三、本次发行概况.....	21
四、发行人主营业务经营情况.....	23
五、发行人符合科创板定位的说明.....	26
六、发行人主要财务数据及财务指标.....	26
七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况.....	27
八、发行人选择的上市标准.....	28
九、发行人治理结构的特殊安排及其他重要事项.....	28
十、发行人募集资金运用与未来发展规划.....	28
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	29
第三节 风险因素	30
一、与发行人相关的风险.....	30
二、与行业相关的风险.....	35

三、其他风险.....	37
第四节 发行人基本情况	38
一、基本情况.....	38
二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.....	38
三、发行人报告期内的重大资产重组情况.....	44
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况	44
五、发行人的股权结构.....	44
六、发行人子公司、参股公司及分公司情况.....	45
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人	51
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.....	59
九、发行人协议控制架构的情况.....	59
十、发行人股本情况.....	59
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	67
十二、发行人员工持股计划.....	81
十三、发行人员工及其社会保障情况.....	82
第五节 业务与技术	38
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.....	86
二、行业基本情况.....	117
三、公司销售情况和主要客户.....	161
四、公司采购情况和主要供应商.....	164
五、主要资产情况.....	168
六、公司的技术与研发情况.....	180
七、环境保护和安全生产情况.....	193
八、发行人境外经营情况.....	195
第六节 财务会计信息与管理层分析	196
一、财务报表.....	196
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	203
三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平.....	204

四、重要会计政策及会计估计.....	205
五、重要的会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	222
六、非经常性损益.....	225
七、发行人适用的税种、税率及主要税收优惠政策.....	226
八、主要财务指标.....	228
九、影响发行人报告期及未来经营能力或财务状况的因素.....	230
十、盈利能力分析.....	232
十一、资产质量分析.....	261
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.....	288
十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.....	293
十四、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项.....	294
十五、盈利预测.....	294
十六、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况.....	294
第七节 募集资金运用与未来发展规划	296
一、募集资金使用管理制度.....	296
二、募集资金运用基本情况.....	296
三、募集资金投资项目可行性分析.....	297
四、募集资金投资项目具体情况.....	301
五、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系.....	310
六、募集资金运用对公司财务状况、经营成果及独立性的影响.....	310
七、未来发展与规划.....	311
第八节 公司治理与独立性	313
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.....	313
二、发行人内部控制情况.....	313
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.....	314
四、发行人报告期内资金占用及担保情况.....	315

五、发行人独立经营情况.....	315
六、同业竞争.....	317
七、关联方及关联交易.....	320
第九节 投资者保护	313
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	330
二、股利分配政策.....	330
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.....	332
第十节 其他重要事项	333
一、重大合同.....	333
二、发行人对外担保有关情况.....	336
三、重大诉讼或仲裁事项.....	337
第十一节 声明	338
一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	338
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	341
三、保荐人（主承销商）声明.....	342
四、发行人律师声明.....	345
五、审计机构声明.....	346
六、资产评估机构声明.....	347
七、验资机构声明.....	348
第十二节 附件	349
一、本招股说明书的备查文件.....	349
附件一：与投资者保护相关的承诺	350
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及 股东持股及减持意向等承诺.....	350
二、关于稳定股价的措施和承诺.....	356
三、关于股份回购和股份买回的承诺函.....	360
四、对欺诈发行上市的股份回购承诺.....	362
五、利润分配政策的承诺.....	362

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....	363
七、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺.....	366
八、关于未能履行承诺约束措施的承诺.....	368
九、关于信息披露的相关承诺.....	372
十、关于避免同业竞争的承诺.....	374
十一、其他承诺事项.....	375
附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况	379
一、信息披露和投资者关系.....	379
二、利润分配政策决策程序.....	380
三、股东投票机制的建立情况.....	380
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运 行情况说明	382
一、股东大会制度的运行情况.....	382
二、董事会制度的建立健全及运行情况.....	382
三、取消监事会前监事会制度的建立健全及运行情况.....	384
四、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	384
附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况	386
附件五：募集资金具体运用情况	387
一、半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目.....	387
二、臻宝科技研发中心建设项目.....	387
三、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目.....	388
附件六：子公司、参股公司简要情况	389
附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件 承诺事项的履行情况	390
一、核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施.....	390
二、核心技术人员已触发履行条件承诺事项的履行情况.....	390

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

一、一般术语

公司、本公司、臻宝科技、发行人、股份公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司
臻宝有限	指	重庆臻宝实业有限公司，公司曾用名
本次发行、本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市
A 股	指	境内上市人民币普通股
重庆臻芯合伙	指	重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，为发行人的员工持股平台
重庆臻宝合伙	指	重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东，为发行人的员工持股平台
重庆科芯	指	重庆科芯智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
天津显智链	指	天津显智链投资中心（有限合伙），系发行人股东
加格咨询	指	加格（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东，原天津显智新投资中心（有限合伙）
元禾璞华	指	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
聚源振芯	指	苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
华虹虹芯	指	上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
石溪舜创	指	余姚石溪舜创创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
国正多泽	指	合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
集成电路二期基金	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，系发行人股东
长存基金	指	长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），系发行人股东
中证投资	指	中信证券投资有限公司，系发行人股东
苏州厚望	指	苏州厚望新能创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海浦宸	指	上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
半导体二期	指	上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
重庆渝富	指	重庆渝富益华钧芯壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
闻芯投资	指	闻芯一期（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

湖北芯洁	指	湖北芯洁电子科技有限公司，系发行人全资子公司
重庆芯洁	指	重庆芯洁科技有限公司，系发行人全资子公司
臻宝半导体	指	重庆臻宝半导体材料有限公司，系发行人全资子公司
上海臻宝	指	上海臻宝电子科技有限公司，系发行人全资子公司
上海升芯	指	上海升芯电子有限公司，系发行人全资子公司
新加坡臻宝	指	GENORI SINGAPORE PTE. LTD.，系发行人全资子公司
臻宝技术	指	上海臻宝技术有限公司，系发行人全资子公司
杭州分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司杭州分公司， 已注销
合肥分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司合肥分公司
深圳分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司深圳分公司
武汉分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司武汉分公司
上海分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司上海分公司
成都分公司	指	重庆臻宝科技股份有限公司成都分公司
马绍尔 ZHENBAO	指	ZHENBAO TECHNOLOGY CO., LTD.，系实际控制人曾控制的公司
马绍尔 SKYHITEK	指	SKYHITEK（HONGKONG）LIMITED，系实际控制人曾控制的公司
香港 SKYTECH	指	SKYTECH（HONGKONG）LIMITED，系实际控制人曾控制的公司
上海贯轶	指	上海贯轶电子科技有限公司，系实际控制人曾控制的公司
长江存储	指	长江存储控股股份有限公司 及其合并范围内的企业
武汉新芯	指	武汉新芯集成电路制造有限公司，现已更名为武汉新芯集成电路股份有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司及其合并范围内的企业
长鑫科技	指	长鑫科技集团股份有限公司及其关联公司，包括但不限于长鑫集电（北京）存储技术有限公司、长鑫新桥存储技术有限公司等
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司及其合并范围内的企业
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司及其合并范围内的企业
粤芯半导体	指	粤芯半导体技术股份有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
华润微电子	指	华润微电子有限公司及其合并范围内的企业
英特尔（大连）	指	英特尔半导体存储技术（大连）有限公司，2025年3月已变更为SK海力士全资子公司，2025年9月已更名为爱思开海力士半导体存储技术（大连）有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司（证券代码 UMC.N）及其下属公司，总部位于中国台湾
格罗方德	指	GLOBAL FOUNDRIES Inc.（证券代码 GFS.O）及其下属公司，总部位于

		于美国
德州仪器	指	Texas Instruments Inc.及其下属公司，包括德州仪器半导体制造（成都）有限公司等
TEL、东京电子	指	Tokyo Electron Limited 及其下属公司，包括但不限于东电光电半导体设备（昆山）有限公司、东电电子（上海）有限公司等
惠科股份	指	惠科股份有限公司及其合并范围内的企业
TCL 华星光电、华星光电	指	TCL 华星光电技术有限公司及其合并范围内的企业
天马微电子	指	天马微电子股份有限公司及其关联公司，包括但不限于厦门天马显示科技有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
彩虹光电	指	咸阳彩虹光电科技有限公司
盾源聚芯	指	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司及其控制的子公司
菲利华	指	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司及其控制的上海菲利华石英创科技有限公司等子公司
CSN	指	CSN Co., Ltd.
Crest	指	CREST Co.
SINWON	指	SINWON TECHNOLOGY CO.,
易芯半导体	指	安徽易芯半导体有限公司
太平洋石英	指	江苏太平洋石英股份有限公司
连云港黑石	指	连云港黑石新材料有限公司
Visiontech	指	Visiontech Co., Ltd.
霈泽材料	指	哈尔滨霈泽材料科技有限公司
SK Enpulse	指	原 SKC Solmics Co., Ltd., 2023 年更名为 SK Enpulse Co., Ltd.
Hana	指	HANA Materials Inc.
Silfex	指	Silfex, Inc.
三菱材料	指	Mitsubishi Materials Corporation
Worldex	指	Worldex Industry & Trading Co., Ltd.
浙江泓芯	指	浙江泓芯半导体有限公司，现已更名为浙江泓芯新材料股份有限公司
凯德石英	指	北京凯德石英股份有限公司
珂玛科技	指	苏州珂玛材料科技股份有限公司
富创精密	指	沈阳富创精密设备股份有限公司
卡贝尼	指	上海卡贝尼精密陶瓷有限公司
KoMiCo	指	KoMiCo Ltd.

世禾科技	指	世禾科技股份有限公司
富乐德	指	安徽富乐德科技发展股份有限公司
芜湖通潮	指	芜湖通潮精密机械股份有限公司
合肥微睿	指	合肥微睿光电科技股份有限公司
神工股份	指	锦州神工半导体股份有限公司
直接供应商	指	直接向集成电路制造企业供应零部件的厂商，属于一级供应商
间接供应商	指	与设备厂合作，生产的零部件通过设备厂间接供应给集成电路制造企业的厂商，属于二级供应商
《招股说明书》	指	公司为本次发行上市所编制的《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中信证券、保荐人、主承销商	指	中信证券股份有限公司
天健、天健会计师、发行人会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
弗若斯特沙利文	指	Frost & Sullivan，弗若斯特沙利文咨询公司，第三方市场调研机构
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《证券期货法律适用意见第 17 号》	指	《<首次公开发行股票注册管理办法>第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书>第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 17 号》
《上市公司章程指引》	指	《上市公司章程指引》
《上市公司股东大会规则》	指	《上市公司股东大会规则》
《上市公司治理准则》	指	《上市公司治理准则》
《公司章程》	指	发行人及其前身制定并不时修订的公司章程，另有说明的除外
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，意指人民币元、人民币万元、人民币亿元

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

二、专业术语

泛半导体	指	半导体、显示面板、LED 等行业的统称，如无特别说明，本招股说明书中系指半导体、显示面板、LED 等行业
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体器件根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）定义可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业
集成电路	指	Integrated Circuit，缩写为 IC，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
显示面板	指	一种用于将电信号转换为可视图像的显示装置，是电子设备中用于呈现视觉内容、实现信息交互的核心部件
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器
TFT	指	Thin Film Transistor，薄膜晶体管阵列，系在玻璃基底形成的半导体阵列，为平板探测器的像素单元
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件
Micro LED	指	LED 芯片尺寸小于 75 μ m 的 LED 显示屏
Mini LED	指	LED 芯片尺寸在 75-300 μ m 的 LED 显示屏
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光、广视角、高对比度、较低耗电、极高反应速度等优点
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light Emitting Diode，有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体，具有自发光性、广视角、高对比、反应速度快等优点
世代线	指	按照生产显示屏使用的玻璃基板尺寸大小划分，G4.5、G6、G8.5、G10.5 中的“G”是 generation 的缩写，数字对应玻璃基板的尺寸，玻璃基板尺寸越大，其世代线代数越高，经济切割显示屏的最大尺寸也越大，生产效益越高，显示屏的质量与世代线无直接关系
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆
晶圆厂	指	通过一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商，如英特尔、三星、台积电、中芯国际等
工艺节点、制程	指	晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准
先进制程、先进工艺	指	晶体管中栅极的宽度（也称制程）；宽度越窄，晶体管就越小，电流通过时的损耗越低，性能也越高，制造工艺也更复杂；先进制程指当下时点芯片制造最小的工艺制程
光刻	指	利用光学-化学反应原理将电路图形传递到光掩模上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术
刻蚀、Etch	指	用化学或物理方法有选择地在硅表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造的关键步骤

薄膜沉积	指	半导体制造中任何在硅片衬底上沉积一层膜的工艺；这层膜可以是导体、绝缘物质或者半导体材料；沉积膜可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅以及金属
CVD	指	Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积
热处理	指	是芯片制造不可或缺的重要工艺之一，具体包括氧化、扩散和退火等在高温环境下的加工工艺
摩尔定律	指	集成电路上所集成的晶体管数量，每隔 18 个月就提升一倍，相应的性能增强一倍，成本随之下降一半
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，指制造厂商按照设计厂商提供的图纸和参数进行加工制造的模式
静电卡盘、ESC、E-CHUCK	指	Electrostatic Chuck，利用静电吸附原理夹持固定被吸附物的夹具，适用于真空及等离子体环境，主要作用是吸附硅片、玻璃或其他掩模类物品并使吸附物保持较好的平坦度，可抑制吸附物在工艺中的变形，还能调节吸附物的温度，在半导体、平板显示、光学等领域中有广泛应用；半导体领域的静电卡盘包括有机涂层路线、熔射路线和层压技术路线等类别，主要用于刻蚀和部分薄膜沉积设备，起到固定和支持晶片，避免工艺过程中出现移动或者错位的重要功能
PICP	指	Plane Inductively Coupled Plasma 平面电感耦合等离子体
硅片	指	Silicon Wafer，半导体级硅片，通常也叫晶圆，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造，按其直径尺寸主要分为 4 英寸、6 英寸、8 英寸和 12 英寸
单晶硅	指	硅（Si）的单晶体，也称硅单晶，是以高纯度多晶硅为原料，在单晶硅生长炉中熔化后生长而成的具有基本完整点阵结构的晶体材料
多晶硅	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，是生产单晶硅棒的直接原料，也可作为硅部件、太阳能电池片的原材料
硅材料	指	使用多晶硅料，通过直拉法或者铸锭法生产出来的单晶硅或者多晶硅材料
石英玻璃	指	由二氧化硅（SiO ₂ ）单一组分构成的特种工业玻璃（属无机非金属材料），具有硬度大、耐高温、膨胀系数低、耐酸性（除氢氟酸、热磷酸外）、透光性能好、耐热震性、化学稳定性和电绝缘性能良好等特性；按生产工艺的不同，石英玻璃通过用天然结晶石英（水晶或纯的硅石）经高温熔化，或使用硅化物经化学气相沉积制作而成。经化学气相沉积制作而成的石英称为“合成石英”；石英玻璃材料及制品被广泛用于半导体、光通讯、航空航天、太阳能等领域
火加工	指	一种通过高温消除石英制品应力瑕疵，提升表面光洁度的关键工艺，广泛应用于半导体、光学、光通信、化工、医疗器械和航空航天等领域
石英砂	指	一种主要矿物成分是 SiO ₂ 的非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业；工业上将石英砂常分为普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂及硅微粉等
原粉	指	陶瓷的重要原材料之一，为粉末形态，在烧结过程中发生熔融，晶体排布发生显著变化，最终形成固态陶瓷
造粒粉	指	将粒径微小的原粉与有机物、烧结助剂等混合，团聚后形成粒径更大的颗粒；造粒粉的外观仍然是粉状，但具有非常好的流动性，且易于

		加工为陶瓷生坯
熔射粉	指	熔射过程使用的陶瓷粉料，用于制造部件表面涂层，通常使用氧化铝、碳化硅、氧化锆、氧化钇、氟化钇和氟氧化钇等粉末
添加剂	指	陶瓷粉末加工过程中所掺入的其他有机物、无机物材料，起到辅助后续制造加工过程作用，或达到改善特定的物理、化学特性目的
mm	指	毫米， 10^{-3} 米
μm	指	微米， 10^{-6} 米
nm	指	纳米， 10^{-9} 米

特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的；本招股说明书披露的第三方数据非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。

（一）市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

随着全球半导体和显示面板行业的快速发展，半导体和显示面板设备零部件的需求不断增加，吸引了越来越多的市场参与者。新加入者通过跨行新设、并购重组和上游原材料企业往下延伸等方式参与该市场。

目前，半导体和显示面板设备零部件市场主要由美国、日本、韩国等境外同行业公司占据主导地位。公司与境外同行公司在技术实力、产业规模和品牌声誉等方面仍然存在一定的差距。同时，随着半导体和显示面板设备零部件领域国产替代进程的不断加速，未来将有更多国产零部件厂商加入市场竞争。如果公司未来无法持续提升研发实力、产品性能和客户服务能力以应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

（二）半导体行业被美国等发达国家进一步制裁的风险

近年来，随着美国芯片法案等贸易限制政策不断加码，地缘政治不确定性持续加剧，全球半导体供应链不稳定性显著提升，集成电路行业已逐步成为中美技术竞争的焦点。公司主要从事设备零部件制造及表面处理服务，主要客户为国内集成电路制造企业。如果未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，采取限制国内晶圆厂购买先进半导体设备、停止关键设备维修保养服务或者停供需定期更换的“卡脖子”设备零部件等措施，国内先进制程芯片的稳定生产、工艺升级及产能扩张将受到影响。公司半导体行业主要客户是国内先进制程集成电路制造企业，则公司也可能面临下游终端订单需求下降等风险，从而对公司经营发展产生一定的不

利影响。

（三）无法跟随技术升级迭代的风险

半导体及显示面板设备零部件行业属于技术密集型行业，芯片制程和显示面板技术在不断升级，且集成电路和显示面板制造企业也在不断提升工艺效率及产品良率，公司必须紧跟集成电路和显示面板制造企业的需求，不断提高工艺水平以及产品性能。若公司产品研发不能及时满足客户需求，不能紧跟客户产品的更新迭代，则公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

（四）客户集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大客户的销售收入占比分别为 74.59%、72.80%和 **69.27%**，呈逐年下降趋势，但客户集中度仍较高，主要原因为半导体和显示面板行业的技术和资本密集度较高，下游集成电路制造和显示面板制造企业呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况出现恶化、或由于半导体和显示面板行业景气度下降导致客户资本性支出和产能利用率下降，进而导致其向公司下达的订单量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户并转化为收入，亦可能对公司经营业绩产生不利影响。

（五）毛利率波动风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 42.45%、47.81%和 **49.85%**。其中半导体行业产品毛利率分别为 54.07%、56.57%和 **55.67%**，显示面板行业产品毛利率分别为 22.92%、25.04%和 **24.74%**。报告期内，半导体行业产品毛利率整体较高，主要受益于国内巨额的半导体投资、国产化率不断提升和国内厂商在先进工艺领域的快速迭代。显示面板行业产品毛利率较半导体行业产品毛利率偏低，主要受显示面板行业国产化程度较高、国内供应链配套已较为成熟和行业发展速度下降等影响。如果未来行业竞争加剧、下游市场需求减少、产品价格下降和原材料价格上涨，或公司无法有效控制产品成本，可能导致公司毛利率波动，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

（六）应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 18,257.43 万元、22,326.01 万元和 **30,565.22 万元**，占当期营业收入的比例分别为 36.06%、35.19%和 **35.23%**。报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.23、3.13 和 **3.28**，应收账款周转率**整体相对稳定**。未来，公司应收账款金额或将随着公司经营规模的进一步扩大而增加，存在应收账款周转率下降、营运资金占用增加的风险。如果未来公司应收账款回款情况不理想或因半导体和显示面板行业景气度下降等原因导致主要客户自身发生重大经营困难而导致公司无法及时收回货款，将对公司生产经营产生不利影响。

（七）本次发行相关主体作出的重要承诺

控股股东、实际控制人王兵及其一致行动人承诺：公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月。前述“届时所持股份”分别指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

除上述承诺外，本公司提示投资者阅读本公司、股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况等事项。详见本招股说明书“附件一：与投资者保护相关的承诺”及“附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件承诺事项的履行情况”。

（八）本次发行后公司的利润分配政策

本公司提示投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）发行人本次发行后的股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	重庆臻宝科技股份有限公司	成立日期	2016 年 2 月 25 日
注册资本	11,646.77 万元人民币	法定代表人	王兵
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号	主要生产经营地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号
控股股东	王兵	实际控制人	王兵
行业分类	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）下的“电子专用材料制造”（代码：C3985）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京市中伦律师事务所	其他承销机构	无
审计机构/验资机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	重庆坤元资产评估有限公司
保荐人（主承销商）会计师	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所		
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股说明书签署日，保荐人中信证券股份有限公司全资子公司中信证券投资有限公司持有发行人 1.13%的股份，通过发行人股东长存基金、上海浦宸间接合计持有发行人不超过 0.06%的股份。除此外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系	
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		不适用	

三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次拟公开发行股数不超过	占发行后总	不低于 25.00%

	3,882.26 万股(含 3,882.26 万股, 且不低于本次发行后公司总股本的 25%, 以中国证监会同意注册后的数量为准)	股本的比例	
其中: 发行新股数量	本次拟公开发行股数不超过 3,882.26 万股(含 3,882.26 万股, 且不低于本次发行后公司总股本的 25%, 以中国证监会同意注册后的数量为准)	占发行后总股本的比例	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本的比例	无
发行后总股本	不超过 15,529.03 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算）		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）		
发行方式	本次发行将采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的发行方式或者中国证监会等监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。本次申请首次公开发行股票可以选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%		
发行对象	发行对象为符合证监会、上交所规定的资格的询价对象和符合投资者适当性要求且在上交所开立科创板账户的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目		
	臻宝科技研发中心建设项目		
	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、发行手续费用及其他【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司高级管理人员、员工拟参与战略配售，认购本次公开发行的新股，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件		

（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、产品和服务及其用途

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。公司主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。公司已量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅超厚材料和陶瓷造粒粉体等半导体材料，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，并不断突破关键半导体材料制备技术和表面处理技术、拓展核心零部件产品品类，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、半导体行业	65,564.98	77.54%	45,687.11	72.21%	31,864.14	63.15%
零部件产品	61,313.59	72.51%	43,064.36	68.07%	30,541.94	60.53%
表面处理服务	2,970.91	3.51%	1,998.97	3.16%	930.56	1.84%
其他	1,280.48	1.51%	623.78	0.99%	391.63	0.78%
二、显示面板行业	18,916.73	22.37%	17,203.95	27.19%	18,083.52	35.84%
表面处理服务	13,622.17	16.11%	12,766.38	20.18%	13,943.35	27.63%
零部件产品	5,288.21	6.25%	4,430.15	7.00%	4,093.37	8.11%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	6.35	0.01%	7.41	0.01%	46.81	0.09%
三、其他行业	75.19	0.09%	377.66	0.60%	513.48	1.02%
合计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

（二）所需主要原材料及重要供应商

报告期内，公司采购的原材料主要包括硅材料、石英材料、碳化硅材料、陶瓷材料、熔射粉和工程塑料等原材料，以及辅料辅材等。报告期内公司向重要供应商的采购情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、公司采购情况和主要供应商”。

（三）主要生产模式、销售方式和渠道及重要客户

在零部件生产方面，公司主要采取“以销定产”的生产模式，也会根据市场行情做适当备货。公司在汇总销售需求和备货需求后由生产部门和销售部门结合库存、产能情况决定产量需求，由生产部门制定生产计划并进行生产排产，并跟进生产进度，确保按期完工。在表面处理服务方面，公司根据客户订单及预计订单安排作业计划。

公司主要以直销模式与集成电路和显示面板制造企业进行合作，为客户提供零部件产品以及表面处理服务。报告期内，公司重要客户主要有客户 3、客户 4、客户 1、客户 2、京东方、华星光电和惠科股份等行业内知名企业。

公司主要经营模式详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（三）公司主要经营模式”。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司是国内少数同时掌握大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积碳化硅等半导体材料制备技术和硅、石英、陶瓷等硬脆材料零部件高精密加工和高致密涂层制备等表面处理技术的企业，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

公司系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、重庆市先进智能工厂、重庆博士后工作站、重庆市技术创新示范企业和重庆企业技术中心等。报告期内，公司积极承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，并协同行业龙头客户开发超厚曲面硅上部电极、氧化钼陶瓷零部件、碳化硅零部件等设备零部件，助力等离子体刻蚀和薄膜沉积等生产设备的关键零部件自主可控，保障供应链安全，推动国内制造业转型升级。

半导体设备零部件方面，公司突破了微深孔加工、曲面加工等多项技术难题，实现了碱性刻蚀曲面硅上部电极等零部件的自主可控，阶段性突破了高致密涂层制备等表面处理技术，在碳化硅零部件、半导体静电卡盘等关键精密零部件和高致密涂层制备等表面处理技术等领域持续加大研发投入。公司的半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，与客户 3、客户 4、客户 1、客户 2 等国内前十大集成电路制造企业建立了稳定的业务合作关系，并成功拓展了英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等海外客户。根据弗若斯特沙利文数据，2024 年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司在硅零部件市场排名第一，收入市场份额 4.5%，在石英零部件市场排名第一，收入市场份额为 8.8%。

显示面板设备零部件及表面处理方面，公司突破了熔射再生等核心工艺，实现 AMOLED PVD 双极静电卡盘的自主可控，并通过自主设计电极棒、优化涂层结构，实现在 4.5KV 高电压领域涂层耐压性的技术突破。公司的显示面板零部件及表面处理服务已应用于 G10.5-G11 超大世代线 LCD、6G AMOLED 产线中的刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等设备，与京东方、华星光电和惠科股份等国内前五大显示面板企业建立了稳定的业务合作关系，成功拓展了东京电子（上海）等海外客户。根据弗若斯特沙利文数据，2023 年半导体及显示面板设备零部件非金属零部件提供商中，公司市场排名第二，收入市场份额为 1.9%，2023 年半导体及显示面板设备零部件表面处理服务本土服务提供商中，公司市场排名第四，市场份额为 2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。

五、发行人符合科创板定位的说明

公司符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》等有关规定对行业领域及对科创属性相关指标的要求，主要包括：

（一）公司符合行业领域要求

公司所属 行业领域	☒ 新一代信息技术	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）下的“电子专用材料制造”（代码：C3985）； 根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

（二）公司符合科创属性要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥8,000 万元	☒ 是 ☐ 否	2023-2025 年，公司研发投入分别为 2,701.63 万元、5,119.27 万元和 6,116.94 万元，累计占比为 6.94%，最近三年研发投入金额累计超过 8,000 万元
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员占比 14.16%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7 项	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 61 项，均被应用于公司主营业务，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	☒ 是 ☐ 否	2025 年，公司营业收入为 86,758.17 万元，最近一年营业收入大于 3 亿元

六、发行人主要财务数据及财务指标

项目	2025 年度 /2025-12-31	2024 年度 /2024-12-31	2023 年度 /2023-12-31
资产总额（万元）	161,867.62	127,166.16	102,386.45
归属于母公司所有者权益（万元）	121,026.94	97,067.84	81,116.55
资产负债率（母公司）（%）	22.80	17.57	17.37
营业收入（万元）	86,758.17	63,450.10	50,635.63

项目	2025 年度 /2025-12-31	2024 年度 /2024-12-31	2023 年度 /2023-12-31
净利润（万元）	22,593.08	15,185.69	10,939.41
归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,593.08	15,185.69	10,939.41
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	22,100.95	14,514.26	10,510.63
基本每股收益（元）	1.94	1.30	1.07
稀释每股收益（元）	1.94	1.30	1.07
加权平均净资产收益率（%）	20.73	17.06	24.78
经营活动产生的现金流量净额（万元）	25,896.71	20,631.92	7,769.80
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入比例（%）	7.05	8.07	5.34

七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况

（一）财务报告审计基准日后主要经营情况

公司财务报告审计截止日为**2025 年 12 月 31 日**，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，产业政策、税收政策、行业发展周期等未发生重大变化；公司主营业务、经营模式及竞争趋势等未发生重大变化；公司主要原材料的采购、主要产品的销售情形未出现重大不利变化；公司主要客户、供应商、高级管理人员和核心技术人员均保持稳定；公司未出现对经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2026 年 1-3 月财务数据预计情况

基于目前的经营状况和市场环境，发行人预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（预计）	2025 年 1-3 月	变动比例
营业收入	18,000.00-22,000.00	16,523.37	8.94%-33.14%
归属于母公司股东的净利润	3,300.00-3,900.00	3,096.04	6.59%-25.97%
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	3,000.00-3,500.00	2,721.58	10.23%-28.60%

2026 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入较上年同期增长 8.94%至 33.14%，主要系受益于集成电路行业的快速发展所致。2026 年一季度，全球集成电路行业在

2025 年高增长基数上延续高景气发展，市场对全年的增长预期普遍乐观。SIA 预测 2026 年全球半导体销售额将突破 1 万亿美元，步入万亿级市场规模。同时，中国半导体市场在人工智能应用落地与国产替代进程加速的驱动下增长势头强劲，产业链各环节景气度同步攀升。下游市场的持续扩张以及国产替代需求的迫切性，拉动了公司所处上游半导体核心零部件与表面处理服务的需求，为公司一季度及全年业务增长提供支撑。

公司 2026 年 1-3 月业绩预计情况是管理层结合目前的市场环境和自身经营状况，在最佳估计假设的基础上编制，所依据的各种假设具有不确定性，并且相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

八、发行人选择的上市标准

公司 **2024 年度和 2025 年度**归属母公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为 14,514.26 万元和 **22,100.95 万元**，**2025 年**的营业收入为 **86,758.17 万元**；公司本次发行前最后一轮市场化融资完成于 2023 年 12 月，投后估值为 26.65 亿元，预计公司市值不低于人民币 10 亿元。

因此，根据《科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”之规定。

九、发行人治理结构的特殊安排及其他重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人治理结构不涉及特殊安排及其他重要事项。

十、发行人募集资金运用与未来发展规划

公司本次拟公开发行不超过 3,882.26 万股人民币普通股（A 股），全部用于与公司主营业务相关的项目。

本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入 金额(万元)	项目代码
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06	2401-500107-04-02-432138/2212-500107-04-01-194336
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56	2401-500107-04-05-894367
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68	2411-310115-04-01-716502
合计		128,336.42	119,752.30	-

如公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分可由董事会根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者由公司通过自筹资金方式解决。若实际募集资金净额满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行前期投入；待募集资金到位后，公司将用募集资金置换前期投入该等项目的自筹资金。

公司未来发展规划主要包括继续在半导体和显示面板等离子体刻蚀和薄膜沉积等设备的关键零部件上着力于推动自主可控，在已有的设备零部件产品及表面处理服务的基础上，加大研发投入，不断扩大产品品类，并向上游材料产业投入研发，促进公司向材料及零部件综合解决方案厂商发展，助力半导体设备的关键零部件自主可控，保障供应链安全，推动国内制造业转型升级。

本次募集资金运用及未来发展规划详细情况请详见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人及本次发行产生重大不利影响。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、无法跟随技术升级迭代的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

2、技术人才流失与核心技术泄密的风险

随着市场需求的不断增长与行业竞争的日益激烈，半导体及显示面板设备零部件行业对技术人才的需求不断提升，公司需长期维持技术人才充足、队伍稳定以保持市场竞争力。若无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。

同时，随着半导体和显示面板行业技术壁垒的不断提高，核心技术对于公司保持和提升竞争力至关重要。自成立以来，公司高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因技术人才流失、员工工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而导致公司竞争力下降。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

2、新产品开发及客户验证不及预期的风险

随着业务能力和市场声誉的提升，公司积极开拓国内外集成电路制造企业、国内外设备厂商等客户。业务开拓过程中，公司新产品需要在客户处进行上机验证，

验证通过后方可获得客户订单。若公司新产品、新客户开发不及预期、或新产品在客户处验证进度不及预期，导致公司新产品未能获得足够的订单，可能对公司持续经营产生不利影响。

3、生产经营合规风险

公司阳极氧化业务涉及硫酸等多种危险化学品的购买及使用，对生产人员的规范操作和技术水平要求较高。同时，表面处理环节还会产生多种含铝、氟化物等成分的废水、粉尘及固体废弃物。报告期内，公司严格遵守国家及所在地方的环保和安全生产法律法规进行生产，按照法律法规和地方政府的相关要求对污染物处理后进行排放。若公司由于污染物排放不达标造成环境污染，或在生产经营中出现安全事故，可能受到相关部门的行政处罚，对公司生产经营造成不利影响。

4、经营场所租赁的风险

报告期内，公司的生产经营场所主要通过租赁方式取得。虽然公司已签署了长期的租赁协议，对租赁场所拥有优先租赁权、优先购买权，对经营场所的租赁处于持续稳定状态，但不排除出现租赁合同不能继续履行、到期无法续租或租金大幅上涨、租赁过程中发生出租方违约等情形。如果发生上述情形，则公司可能因需要搬迁而产生额外费用，在短期内亦可能会影响公司正常经营。

5、知识产权风险

公司所处的半导体和显示面板行业为技术密集型行业，知识产权及技术 Know-How 保护对公司的发展至关重要。**截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 116 项专利，其中发明专利 61 项，在申请发明专利 50 项。**如未来公司的知识产权及技术 Know-How 被他人不当利用，或出现泄密，或发生知识产权纠纷，则公司可能因此承担一定的法律和经营风险，从而对公司的研发、生产产生一定的影响，并影响公司的正常经营。

6、经营规模扩大带来的管理风险

报告期内，随着公司业务不断发展，公司收入规模、资产规模持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出

更高的要求，公司在战略规划、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，对研发、采购、生产、销售等资源配置提出了更高的要求。如果公司的组织模式和管理制度未能随着公司规模扩张及时调整完善，管理水平无法适应公司的快速发展，将使公司在一定程度上面临规模扩张导致的管理风险，对未来业务的发展造成不利影响。

7、实际控制人及其一致行动人不当控制的风险

本次发行前，公司实际控制人王兵直接持有公司 5,162.50 万股股份，占公司股本总额的 44.33%，并通过重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙控制公司 12.88%的股份。夏冰为王兵配偶，直接持有公司 3.01%的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙间接持有公司 1.80%的股份，王喜才为王兵哥哥，直接持有公司 0.24%的股份，王凤英为王兵姐姐，通过重庆臻芯合伙间接持有公司 1.85%的股份，前述三人及员工持股平台为公司实际控制人王兵的一致行动人。假设本次公开发行股份 3,882.26 万股，本次发行完成后，王兵及其一致行动人合计控制公司的表决权比例为 45.34%，仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、生产和经营决策等进行控制，如果控制不当将会损害公司及公司其他股东的利益。

8、租赁物业存在产权瑕疵或租赁合同未备案的风险

公司租赁物业中，由于施工方施工方案变更的原因，实际建造时一处污水处理站、一处污水处理池及一处生产厂房增加了部分面积，上述未按照施工方案施工的不动产暂时无法办理不动产产权证明。公司在签署租赁协议时，亦未明确在租赁合同中约定承租上述不动产，但在生产经营中实际会使用部分污水处理设备，亦会使用厂房作为设备间。此外，公司及附属公司部分非用作主要生产经营场所的不动产未办理租赁备案。

如若将来公司租赁的瑕疵房产被有权机构要求拆除、搬迁或因租赁合同未备案导致无法续租，则会对公司的正常经营产生一定的影响。

9、产品与服务质量风险

由于集成电路及显示面板制造设备零部件及其表面处理技术的高度复杂性，公

公司及客户的检测程序可能无法完全识别潜在质量问题。若客户在使用过程中发现缺陷，可能导致客户产生经济损失，进而引发诉讼或赔偿。此外，质量问题可能损害公司声誉，导致客户流失及市场拓展受阻。如若公司服务出现上述质量问题，将可能对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。

10、验收时间不可控的风险

公司完成显示面板设备零部件的表面处理并送到客户现场后，何时上机运行并获得客户验收确认主要受客户的生产计划、设备保养周期、备品备件情况等多种因素影响，从设备部件送达到验收确认的间隔期限变动较大，且不受公司控制。如果客户的上机验收周期延长，公司的收入确认时间也将有所延迟；同时，公司可能存在上机验收不通过、收款时间延后和存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

11、部分原材料采购自境外的风险

公司生产所需的原材料主要包括硅材料、石英材料、碳化硅材料、陶瓷材料、熔射粉和工程塑料等，其中报告期内陶瓷、工程塑料、碳化硅等部分原材料及零部件存在向境外供应商采购的情况。虽然公司已与相关供应商建立了长期、稳定的合作关系，但若未来出现地缘政治动荡、全球贸易摩擦及其他不可抗力，公司境外采购可能出现交货延迟、供应受限或成本上涨的情况，则公司正常生产经营可能会受到不利影响。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

2、存货跌价风险

公司存货由原材料、在产品、库存商品、低值易耗品及发出商品组成，其中以原材料、库存商品、发出商品为主。报告期各期末，公司存货账面价值分别为10,289.71万元、11,932.33万元和**15,936.99万元**，占流动资产的比例分别为16.62%、

16.03%和 18.21%，公司存货规模呈现逐年增长的趋势。公司根据现有销售订单、销售预测备货，如果未来行业供需关系、产品销售价格等发生重大不利变化，或客户需求因宏观经济形势、行业竞争态势、技术更新换代、客户自身经营状况等诸多因素而发生波动，公司可能面临存货跌价风险，进而影响公司的盈利水平。

3、毛利率波动风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

4、税收优惠风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税和研发费用加计扣除的税收优惠；**2025年度，臻宝半导体享受高新技术企业所得税和研发费用加计扣除的税收优惠**；报告期内，重庆芯洁、臻宝半导体符合西部地区鼓励类产业目录界定的产业范围，享受西部大开发企业所得税优惠政策；上海臻宝 **2023年度至2025年度**属于小型微利企业，享受小微企业所得税优惠政策；湖北芯洁 **2023年度至2024年度**属于小型微利企业，享受小微企业所得税优惠政策；上海升芯 **2023年度至2025年度**属于小型微利企业，享受小微企业所得税优惠政策。若未来公司或子公司无法继续取得高新技术企业资质、不再符合西部地区鼓励类产业企业税收优惠条件或小型微利企业所得税优惠政策，或者相关优惠政策发生变化，则可能导致公司或子公司无法继续享受相关税收优惠政策，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）募集资金投资项目风险

1、募投项目未能按期完成或不能达到预期收益的风险

本次募投项目涉及现有产能扩建、新产品拓展和技术研发等内容，对公司的技术、组织和管理提出了较高的要求。本次募投项目主要以当前国家政策导向和市场发展趋势为基础，结合公司目前业务经验积累的研发技术而做出，然而随着半导体及显示面板设备零部件行业的快速发展，如果我国宏观经济形势、半导体产业发展情况和产品技术路线出现重大变化，则募集资金投资项目将面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。

2、新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

本次发行的募集资金投资项目实施后公司将新增固定资产投资 102,051.69 万元，预计稳定达产后每年新增折旧摊销费用峰值达 7,397.18 万元，在稳定达产前将导致公司生产成本和费用增加。如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致募集资金投资项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将大幅提升公司经营风险，对公司经营业绩产生不利影响。

3、募投项目新增产能的消化风险

报告期内，公司总体产品的产能利用率分别为 97.49%、103.79%和 105.78%。公司本次发行募集资金拟运用于半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目、臻宝科技研发中心建设项目。

上述项目新增生产规模结合了公司对半导体及泛半导体精密零部件及上下游领域开拓情况的预估，尽管公司本次募集资金投向系经过充分的可行性论证和市场分析而确定，但如果未来市场需求发生重大不利变化，或公司对新市场开拓不力，将有可能导致订单需求不足，进而导致部分生产设备闲置、人员冗余，公司存在产能不能及时消化的风险。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

（二）半导体行业被美国等发达国家进一步制裁的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”。

（三）产业政策变化风险

公司是一家专业从事半导体及显示面板设备零部件及材料的研发、生产与销售的高新技术企业，下游客户是集成电路和显示面板制造企业。发行人业务发展情况与半导体及显示面板制造行业的发展情况紧密相关，而该等行业的发展及国产化的推进受国家政策和财政补贴因素影响较大。若未来国家对于半导体及显示面板制造

行业不能持续出台相关政策，将可能对公司业绩产生不利影响。

（四）主要原材料价格波动风险

公司采购的主要原材料包括硅材料、石英材料、碳化硅材料、陶瓷材料、熔射粉和工程塑料等，以及辅料辅材。原材料价格的波动直接影响公司产品的成本及毛利率水平。公司生产所需的上述原材料虽然具有稳定的来源，但价格容易受到宏观环境、经济周期、市场需求和汇率等因素的影响出现较大波动。未来若原材料市场价格持续出现大幅上涨，或公司难以将原材料价格上涨传导至客户端，可能导致公司营业成本上升，对公司业绩产生不利影响。

（五）宏观经济及行业波动风险

公司的产品主要应用于集成电路和显示面板制造行业，下游行业景气度与宏观经济周期存在一定的关联性，客户对公司的产品需求亦直接受到集成电路、显示面板制造及终端应用市场的影响。在宏观经济形势向好时，消费及投资活动上升，集成电路和显示面板的市场需求增加，带动下游客户产销量增加，公司产品需求增加；在宏观经济形势低迷时，消费者购买力下降，投资活动减少，集成电路和显示面板的市场需求减少，从而使下游客户产销量相应减少，公司产品需求减少。

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致人工智能、5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子和物联网领域等终端市场需求下降，集成电路制造企业产能将过剩，产能利用率下降，从而影响客户对公司产品的需求，对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响甚至业绩下滑。

（六）国际贸易政策风险

报告期内，公司部分产品销往海外，主要出口地区包括新加坡、泰国、日本等；公司主要显示面板类客户的下游销售覆盖美洲、欧洲等市场。各国政治经济变动可能引发贸易政策调整，如美国宣布自 2025 年 2 月起分阶段实施关税加征政策，并在 4 月进一步上调部分中国商品的进口关税。若国际贸易环境持续恶化，公司及客户可能面临关税成本上升而无法完全转嫁的风险，终端客户的采购意愿也可能因成本增加而降低，公司及客户的出口利润率可能受到挤压；若客户因成本压力削减订单，

将对公司业绩造成不利影响。

三、其他风险

（一）发行失败风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。同时，在中国证监会同意注册决定的有效期内，按照市场化询价结果确定的发行价格，可能存在因公司预计发行后总市值不满足在本招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，而导致发行失败的风险。

（二）前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。

第四节 发行人基本情况

一、基本情况

项目	基本情况
注册名称（中文）：	重庆臻宝科技股份有限公司
注册名称（英文）：	Chongqing Genori Technology Co., Ltd.
注册资本：	11,646.77 万元人民币
法定代表人：	王兵
成立日期：	2016 年 2 月 25 日
股份公司成立日期：	2023 年 1 月 5 日
住所：	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号
邮政编码：	401326
联系电话：	023-6863 6693
传真号码：	023-6863 6693
互联网网址：	www.genori.com.cn
电子邮箱：	ir@genori.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的负责人及联系方式：	董事会秘书：张静 办公电话：023-6863 6693

二、发行人的设立及股本和股东的变化情况

发行人的设立情况和报告期初以来的股本、股东变化情况具体如下：

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	具体变动
1	2016 年 2 月	有限公司设立	3,000.00	王兵现金出资 2,970.00 万元、夏冰现金出资 30.00 万元，成立臻宝有限
2	2023 年 1 月	股份公司设立	9,520.59	2022 年 11 月 18 日，臻宝有限召开股东会，同意公司以截止 2022 年 8 月 31 日经审计后的公司净资产 25,193.50 万元，其中 9,520.59 万元折为变更后的股份有限公司股本共计 9,520.59 万股，每股面值人民币 1 元，公司注册资本为人民币 9,520.59 万元，净资产超过注册资本的部分人民币 15,672.91 万元计入资本公积，变

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	具体变动
				更后的股份公司名称为“重庆臻宝科技股份有限公司”。2022年11月18日，臻宝科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更为股份公司的相关议案。2023年1月5日，臻宝科技取得由重庆市九龙坡区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》
3	2023年3月	报告期内第一次增资	10,401.24	元禾璞华认缴人民币 214.21 万元；聚源振芯认缴人民币 214.21 万元；华虹虹芯认缴人民币 174.54 万元；石溪舜创认缴人民币 119.01 万元；叶冈认缴人民币 75.37 万元；国正多泽认缴人民币 55.54 万元；王喜才认缴人民币 27.77 万元
4	2023年12月	报告期内第二次增资	11,646.77	集成电路二期基金认缴人民币 458.88 万元；长存基金认缴人民币 262.22 万元；中证投资认缴人民币 131.11 万元；苏州厚望认缴人民币 131.11 万元；上海浦宸认缴人民币 131.11 万元；半导体二期认缴人民币 43.70 万元；重庆渝富认缴人民币 43.70 万元；闻芯投资认缴人民币 43.70 万元

（一）有限公司的设立情况

2016年2月24日，王兵、夏冰签署《重庆臻宝实业有限公司章程》，约定共同出资设立臻宝有限，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中王兵现金出资 2,970.00 万元、夏冰现金出资 30.00 万元。

2023年9月15日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-36号），对上述出资情况进行了审验、确认。

臻宝有限于 2016 年 2 月 25 日取得由重庆市工商行政管理局九龙坡分局核发的《企业法人营业执照》，臻宝有限设立时各股东具体出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王兵	2,970.00	99.00
2	夏冰	30.00	1.00
合计		3,000.00	100.00

（二）股份公司的设立情况

2022年8月31日，臻宝有限股东会作出决议，同意臻宝有限整体变更为股份有限公司，并授权董事会设立股份公司筹备委员会的相关事项。

2022年11月11日，天健会计师出具《股改审计报告》（天健审〔2022〕8-534号），确认截至2022年8月31日，臻宝有限经审计的净资产为25,193.50万元。同日，重庆坤元资产评估有限公司出具《股改评估报告》（重坤元评〔2022〕040号），确认截至2022年8月31日，臻宝有限的净资产评估价值为32,219.32万元，评估增值额为7,025.82万元，增值率为27.89%。

2022年11月18日，臻宝有限股东会作出决议，同意臻宝有限整体变更为股份有限公司，拟更名为“重庆臻宝科技股份有限公司”。臻宝有限全体股东同意作为发起人，以2022年8月31日为基准日，将臻宝有限经审计的净资产值中9,520.59万元折合成股份公司股本9,520.59万元，其余15,672.91万元计入资本公积；每股面值1.00元，共计9,520.59万股，由股份公司9名发起人按照各自在臻宝有限的出资比例持有相应数额的股份。同日，全体发起人共同签署了《重庆臻宝科技股份有限公司发起人协议》。同日，臻宝有限召开创立大会暨二〇二二年第一次临时股东大会，选举产生了公司董事会、监事会的成员，并审议通过了相关公司制度。

2022年12月8日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-46号），审验截至2022年11月18日，发行人已将臻宝有限截至2022年8月31日经审计的净资产25,193.50万元折合成股份公司股本，共计折合股本9,520.59万股，每股面值1元人民币，共计股本人民币9,520.59万元；剩余净资产15,672.91万元计入资本公积。

2023年1月5日，臻宝科技取得由重庆市九龙坡区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。公司整体变更为股份公司后的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王兵	5,162.50	54.22
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	12.58

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
3	重庆科芯	1,089.71	11.45
4	杨璐	787.50	8.27
5	天津显智链	524.37	5.51
6	夏冰	350.00	3.68
7	重庆臻宝合伙	302.00	3.17
8	杨海斌	57.35	0.60
9	加格咨询	49.16	0.52
合计		9,520.59	100.00

（三）报告期内的股本和股东变化情况

1、报告期初公司股权结构

报告期初，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王兵	5,162.50	54.22
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	12.58
3	重庆科芯	1,089.71	11.45
4	杨璐	787.50	8.27
5	天津显智链	524.37	5.51
6	夏冰	350.00	3.68
7	重庆臻宝合伙	302.00	3.17
8	杨海斌	57.35	0.60
9	加格咨询	49.16	0.52
合计		9,520.59	100.00

2、报告期内的股本和股东变化具体情况

报告期内，公司的股本及股东变化情况具体如下：

（1）2023年3月，第一次增资

2023年3月3日，臻宝科技召开股东会，一致同意将注册资本由9,520.59万元变更为10,401.24万元，其中元禾璞华认缴人民币214.21万元，聚源振芯认缴人民

币 214.21 万元，华虹虹芯认缴人民币 174.54 万元，石溪舜创认缴人民币 119.01 万元，叶冈认缴人民币 75.37 万元，国正多泽认缴人民币 55.54 万元，王喜才认缴人民币 27.77 万元，并通过新的《公司章程》。

2023 年 9 月 15 日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-42 号），对上述增资情况进行了审验、确认。

臻宝科技于 2023 年 4 月 13 日取得由重庆市九龙坡区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，臻宝科技股权结构变更如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王兵	5,162.50	49.63
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	11.52
3	重庆科芯	1,089.71	10.48
4	杨璐	787.50	7.57
5	天津显智链	524.37	5.04
6	夏冰	350.00	3.36
7	重庆臻宝合伙	302.00	2.90
8	元禾璞华	214.21	2.06
9	聚源振芯	214.21	2.06
10	华虹虹芯	174.54	1.68
11	石溪舜创	119.01	1.14
12	叶冈	75.37	0.72
13	杨海斌	57.35	0.55
14	国正多泽	55.54	0.53
15	加格咨询	49.16	0.47
16	王喜才	27.77	0.27
合计		10,401.24	100.00

（2）2023 年 12 月，第二次增资

2023 年 12 月 14 日，臻宝科技召开股东会，一致同意将注册资本由 10,401.24 万元变更为 11,646.77 万元，其中集成电路二期基金认缴人民币 458.88 万元，长存基金认缴人民币 262.22 万元，中证投资认缴人民币 131.11 万元，苏州厚望认缴人民

币 131.11 万元，上海浦宸认缴人民币 131.11 万元，半导体二期认缴人民币 43.70 万元，重庆渝富认缴人民币 43.70 万元，闻芯投资认缴人民币 43.70 万元，并通过新的《公司章程》。

2023 年 12 月 31 日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-54 号），对上述增资情况进行了审验、确认。

臻宝科技于 2023 年 12 月 26 日取得由重庆市九龙坡区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，臻宝科技股权结构变更如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王兵	5,162.50	44.33
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	10.29
3	重庆科芯	1,089.71	9.36
4	杨璐	787.50	6.76
5	天津显智链	524.37	4.50
6	集成电路二期基金	458.88	3.94
7	夏冰	350.00	3.01
8	重庆臻宝合伙	302.00	2.59
9	长存基金	262.22	2.25
10	元禾璞华	214.21	1.84
11	聚源振芯	214.21	1.84
12	华虹虹芯	174.54	1.50
13	中证投资	131.11	1.13
14	苏州厚望	131.11	1.13
15	上海浦宸	131.11	1.13
16	石溪舜创	119.01	1.02
17	叶冈	75.37	0.65
18	杨海斌	57.35	0.49
19	国正多泽	55.54	0.48
20	加格咨询	49.16	0.42
21	半导体二期	43.70	0.38
22	重庆渝富	43.70	0.38

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
23	闻芯投资	43.70	0.38
24	王喜才	27.77	0.24
合计		11,646.77	100.00

报告期内，公司历次股本及股东变化过程中，均履行了相应的内部审议程序。

三、发行人报告期内的重大资产重组情况

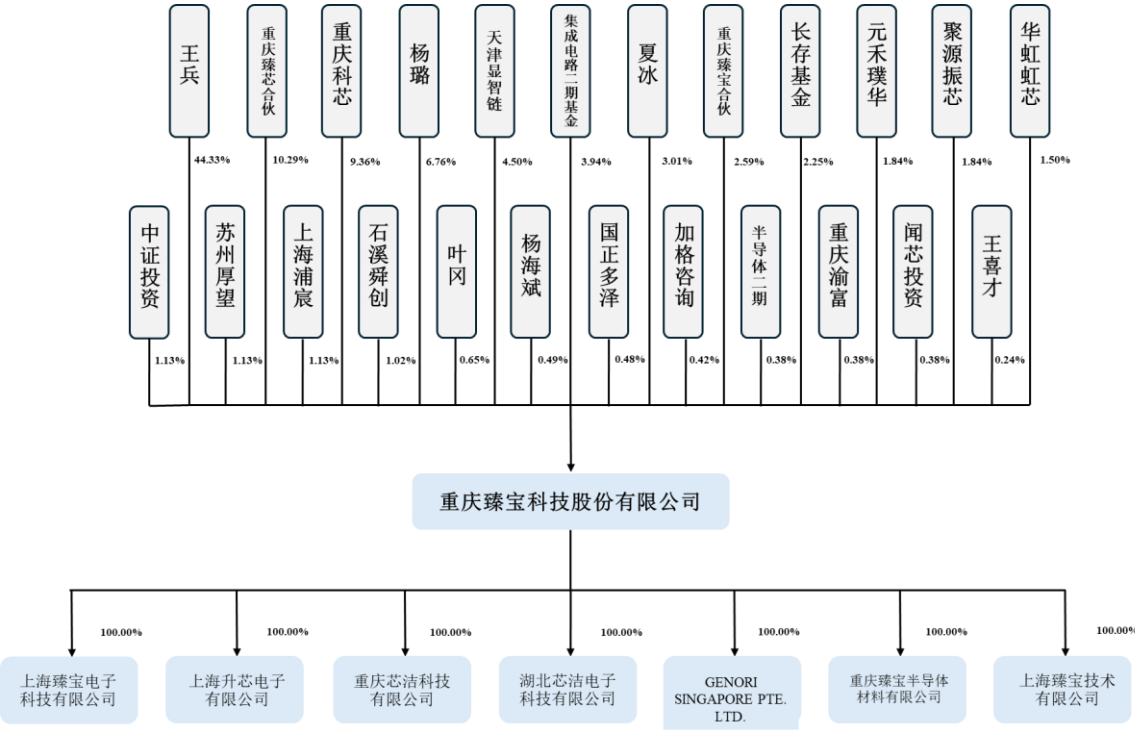
报告期内，发行人不存在重大资产重组的情况。

四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

公司自设立以来，不存在在其他证券市场上市/挂牌情况。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人、各股东对公司的持股情况，以及公司对下属企业的持股情况如下：



截至本招股说明书签署日，公司各股东的持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股份比例（%）
1	王兵	5,162.50	44.33
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	10.29
3	重庆科芯	1,089.71	9.36
4	杨璐	787.50	6.76
5	天津显智链	524.37	4.50
6	集成电路二期基金	458.88	3.94
7	夏冰	350.00	3.01
8	重庆臻宝合伙	302.00	2.59
9	长存基金	262.22	2.25
10	元禾璞华	214.21	1.84
11	聚源振芯	214.21	1.84
12	华虹虹芯	174.54	1.50
13	中证投资	131.11	1.13
14	苏州厚望	131.11	1.13
15	上海浦宸	131.11	1.13
16	石溪舜创	119.01	1.02
17	叶冈	75.37	0.65
18	杨海斌	57.35	0.49
19	国正多泽	55.54	0.48
20	加格咨询	49.16	0.42
21	半导体二期	43.70	0.38
22	重庆渝富	43.70	0.38
23	闻芯投资	43.70	0.38
24	王喜才	27.77	0.24
合计		11,646.77	100.00

六、发行人子公司、参股公司及分公司情况

截至报告期末，公司共有 7 家全资子公司，无参股公司，6 家分公司（含公司子公司之分公司）。具体情况如下：

（一）子公司

1、上海臻宝

公司名称	上海臻宝电子科技有限公司
成立日期	2010 年 4 月 22 日
注册资本	100.00 万元
实收资本	100.00 万元
注册地址	上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢部分 645 室
主要经营场所地址	中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 2 幢 1-2 层
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	产品销售
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

上海臻宝最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	911.65	652.68	1,159.53	106.29

2、上海升芯

公司名称	上海升芯电子有限公司
成立日期	2012 年 11 月 7 日
注册资本	100.00 万元
实收资本	100.00 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 160 号 3 幢 2 层 214 部位
主要经营场所地址	中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 2 幢 1-2 层
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	产品销售
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

上海升芯最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	1,575.72	1,233.02	1,679.94	-1.13

3、重庆芯洁

公司名称	重庆芯洁科技有限公司
成立日期	2018 年 6 月 5 日
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	1,000.00 万元
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇西彭园区 D40 标准厂房 5 号楼
主要经营场所地址	重庆市九龙坡区西彭镇西彭园区 D40 标准厂房 5 号楼
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	表面处理技术开发和服务
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

重庆芯洁最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	5,015.86	3,392.57	3,636.29	-235.70

4、湖北芯洁

公司名称	湖北芯洁电子科技有限公司
成立日期	2019 年 11 月 21 日
注册资本	1,500.00 万元
实收资本	1,500.00 万元
注册地址	湖北省黄冈市黄州区华海大道特 1 号
主要经营场所地址	湖北省黄冈市黄州区华海大道特 1 号
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	表面处理技术开发和服务
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

湖北芯洁最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	5,647.65	2,333.13	3,879.46	554.31

5、新加坡臻宝

公司名称	GENORI SINGAPORE PTE. LTD.
成立日期	2021 年 6 月 17 日
注册资本	68.37 万新加坡元
实收资本	68.37 万新加坡元
注册地址	8 UBI ROAD 2, #05-08, ZERVEX, SINGAPORE
主要经营场所地址	8 UBI ROAD 2, #05-08, ZERVEX, SINGAPORE
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	半导体行业零部件的海外销售
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

新加坡臻宝最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万新加坡元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	145.67	8.39	90.10	-25.42

6、臻宝半导体

公司名称	重庆臻宝半导体材料有限公司
成立日期	2022 年 9 月 8 日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	5,000.00 万元
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢
主要经营场所地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 1 幢
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	半导体材料及零部件研发及生产
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

臻宝半导体最近一年的财务数据如下（经天健会计师事务所审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	55,897.35	14,028.69	28,844.22	8,755.08

7、臻宝技术

公司名称	上海臻宝技术有限公司
成立日期	2024 年 1 月 8 日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	4,000.00 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 2 幢 1-2 层
主要经营场所地址	中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568 号 2 幢 1-2 层
股权结构	臻宝科技持有 100%股权
主营业务	技术研发
在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的组成部分

臻宝技术最近一年的财务数据如下（经天健会计师审计）：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年度/2025 年 12 月 31 日	4,670.30	3,096.10	20.29	-835.76

（二）分公司

1、合肥分公司

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝科技股份有限公司合肥分公司
统一社会信用代码	91340111MA8R13GNX9
成立日期	2023 年 9 月 15 日
负责人	冯铁军
经营场所	安徽省合肥市包河区芜湖路万达广场 6 号写字楼 2106 室
经营范围	一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、深圳分公司

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝科技股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码	91440300MACYU6472R
成立日期	2023 年 9 月 18 日
负责人	朱仁兵
经营场所	深圳市龙华区龙华街道三联社区和平路 155 号金鑫时代大厦 710
经营范围	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

3、武汉分公司

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码	91420100MACXFFDA6B
成立日期	2023 年 9 月 19 日
负责人	冯铁军
经营场所	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 780 号光谷新汇 1 号地块 17 层 1134 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子专用设备销售,电子专用材料销售,电气设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、上海分公司

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝科技股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码	91310113MAD038BD5U
成立日期	2023 年 9 月 28 日
负责人	夏冰
经营场所	上海市宝山区蕴川路 5475 号 4 幢部分 S331 室
经营范围	一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、成都分公司

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝科技股份有限公司成都分公司
统一社会信用代码	91510124MAD173GY8U
成立日期	2023 年 10 月 9 日
负责人	陆雄
经营场所	成都市郫都区德源街道（菁蓉镇）胜利北街 121 号-116 室 A109
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、湖北芯洁武汉分公司

项目	基本情况
公司名称	湖北芯洁电子科技有限公司武汉分公司
统一社会信用代码	91420100MAEN1W5326
成立日期	2025 年 6 月 20 日
负责人	冯铁军
经营场所	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 780 号光谷新汇 1 号地块 6 层（7）办公号
经营范围	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子专用材料销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

（一）控股股东、实际控制人基本情况

王兵先生为公司控股股东及实际控制人。截至本招股说明书签署日，王兵直接持有公司 44.33%的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙分别控制公司 10.29%、2.59%的股份，合计控制公司 57.20%的表决权。公司的实际控制人报告期内未发生变更。

夏冰女士为王兵配偶，直接持有公司 3.01%的股份，并通过员工持股平台重庆臻芯合伙间接持有公司 1.80%的股份；王喜才先生为王兵哥哥，直接持有公司 0.24%

的股份；王凤英女士为王兵姐姐，通过重庆臻芯合伙间接持有公司 1.85%的股份；重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙为王兵控制的公司员工持股平台，分别持有公司 10.29%、2.59%的股份。上述人员及员工持股平台均为公司实际控制人王兵的一致行动人。

王兵先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3101131980*****，毕业于华东交通大学机电一体化专业，获学士学位。2002 年 7 月至 2003 年 7 月，任职于上海耀华玻璃钢有限公司，任销售工程师；2003 年 8 月至 2004 年 1 月，自主创业；2004 年 2 月至 2006 年 8 月，任职于上海霜融国际贸易有限公司，任半导体设备工程师和销售工程师；2006 年 9 月至 2012 年 2 月，任职于上海盛永国际贸易有限公司，任半导体及显示面板零部件销售经理；2012 年 2 月至 2016 年 1 月，任职于上海臻宝，任总经理；2016 年 2 月至 2022 年 11 月，任职于臻宝有限，历任执行董事、董事长、总经理；2018 年 6 月至今，兼任重庆芯洁执行董事、经理；2019 年 11 月至今，兼任湖北芯洁执行董事、经理；2021 年 4 月至今，兼任上海臻宝执行董事、总经理；2022 年 7 月至今，兼任上海升芯执行董事、总经理；2022 年 9 月至今，兼任臻宝半导体执行董事、经理；2022 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

夏冰女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3703051981*****，毕业于华东交通大学，获学士学位。2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任职于中国建筑科学研究院有限公司上海分公司（曾用名：“中国建筑科学研究院上海分院”），任软件测试职员；2005 年 4 月至 2006 年 6 月，任职于光明乳业股份有限公司，任项目专员；2006 年 6 月至 2018 年 2 月，任职于富士胶片商务设备（上海）有限公司（曾用名：上海富士施乐有限公司、上海富士施乐复印机有限公司），任市场主任；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，历任上海臻宝总经理、执行董事；2020 年 9 月至今，任职于上海升芯，任副总经理；2025 年 2 月至今，任公司效率工程部总监。

王喜才先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3101131976*****，毕业于南华大学，获学士学位。1996 年 8 月至 1999 年 6 月，

任职于上海市虹口区牙病防治所，任口腔执业医师；1999年6月至今，任职于上海市静安区牙病防治所（原闸北区牙病防治所），任口腔执业医师；2020年6月至今，任职于上海乐牙口腔门诊部有限责任公司，兼任业务院长。

王凤英女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3101131973*****，毕业于淮北市信息科技中等职业学校，中专学历。1993年10月至2001年7月，任职于上海金山轴承总厂，担任职员；2003年7月至2006年3月，自由职业；2006年4月至2010年2月，任职于上海永久麟龙摩托车有限公司，担任职员；2010年5月至今，任职于上海升芯，历任销售支持科及行政科副经理。

重庆臻芯合伙为公司员工持股平台，基本信息如下：

项目	基本情况
公司名称	重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年11月15日
出资额	1,198.00 万元人民币
主要经营场所地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号6幢
主营业务及其与发行人主营业务的关系	重庆臻芯合伙系发行人员工持股平台，与公司的主营业务没有关联

截至报告期末，重庆臻芯合伙的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
1	王兵	普通合伙人	343.14	28.64%
2	王凤英	有限合伙人	215.00	17.95%
3	夏冰	有限合伙人	210.00	17.53%
4	杨璐	有限合伙人	155.00	12.94%
5	杨佐东	有限合伙人	140.00	11.69%
6	陈立航	有限合伙人	24.00	2.00%
7	张静	有限合伙人	24.00	2.00%
8	陆雄	有限合伙人	18.00	1.50%
9	冯铁军	有限合伙人	18.00	1.50%
10	杨宏文	有限合伙人	9.00	0.75%
11	雷琪	有限合伙人	3.15	0.26%

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
12	孙逸	有限合伙人	3.15	0.26%
13	葛凯伦	有限合伙人	3.15	0.26%
14	孙豫军	有限合伙人	2.25	0.19%
15	汪子莘	有限合伙人	2.25	0.19%
16	吴金路	有限合伙人	2.25	0.19%
17	桂华南	有限合伙人	2.25	0.19%
18	杨璇	有限合伙人	2.25	0.19%
19	周诗璇	有限合伙人	2.25	0.19%
20	向燚	有限合伙人	1.58	0.13%
21	汤云海	有限合伙人	1.58	0.13%
22	曹俊	有限合伙人	1.00	0.08%
23	刘雪娇	有限合伙人	1.00	0.08%
24	魏航	有限合伙人	1.00	0.08%
25	张琳	有限合伙人	1.00	0.08%
26	田柳南	有限合伙人	1.00	0.08%
27	肖新来	有限合伙人	1.00	0.08%
28	曾文厚	有限合伙人	1.00	0.08%
29	郑洋	有限合伙人	1.00	0.08%
30	秦铭君	有限合伙人	1.00	0.08%
31	蒲道华	有限合伙人	0.80	0.07%
32	张杨	有限合伙人	0.80	0.07%
33	杨耀贵	有限合伙人	0.80	0.07%
34	陈双	有限合伙人	0.80	0.07%
35	何旭	有限合伙人	0.80	0.07%
36	秦松林	有限合伙人	0.80	0.07%
37	杨波	有限合伙人	0.40	0.03%
38	白竹煜	有限合伙人	0.35	0.03%
39	许红豆	有限合伙人	0.30	0.03%
40	陈虹利	有限合伙人	0.26	0.02%
41	陈成	有限合伙人	0.25	0.02%

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
42	郭潇遥	有限合伙人	0.15	0.01%
43	程焱	有限合伙人	0.15	0.01%
44	杨光	有限合伙人	0.10	0.01%
合计			1,198.00	100.00%

重庆臻宝合伙为公司员工持股平台，基本信息如下：

项目	基本情况
公司名称	重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91500107MA615KYC5G
成立时间	2020年9月24日
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王兵
主要经营场所地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号6幢
经营范围	一般项目：企业总部管理,企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至报告期末，重庆臻宝合伙出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
1	王兵	普通合伙人	87.42	28.95%
2	蒋晓钧	有限合伙人	24.00	7.95%
3	陈仕超	有限合伙人	18.00	5.96%
4	郑宣	有限合伙人	16.80	5.56%
5	李建	有限合伙人	12.00	3.97%
6	李相烈	有限合伙人	9.00	2.98%
7	朱仁兵	有限合伙人	9.00	2.98%
8	陈立	有限合伙人	9.00	2.98%
9	陈莉	有限合伙人	9.00	2.98%
10	杨翠红	有限合伙人	9.00	2.98%
11	曾德强	有限合伙人	8.40	2.78%
12	梁晓飞	有限合伙人	6.30	2.09%
13	何桥	有限合伙人	6.30	2.09%
14	王文彬	有限合伙人	4.50	1.49%

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
15	刘利莹	有限合伙人	4.50	1.49%
16	梁俱梅	有限合伙人	4.50	1.49%
17	薛翔	有限合伙人	4.50	1.49%
18	黄俊杰	有限合伙人	3.15	1.04%
19	王智华	有限合伙人	3.15	1.04%
20	何涛	有限合伙人	3.15	1.04%
21	朱红军	有限合伙人	2.50	0.83%
22	王燕清	有限合伙人	2.50	0.83%
23	吴李花	有限合伙人	2.50	0.83%
24	周文	有限合伙人	2.50	0.83%
25	胡杨	有限合伙人	2.50	0.83%
26	龚汉远	有限合伙人	2.50	0.83%
27	吴昊	有限合伙人	2.50	0.83%
28	郭朋飞	有限合伙人	2.50	0.83%
29	李今梅	有限合伙人	2.50	0.83%
30	刘宏	有限合伙人	2.50	0.83%
31	胡飞	有限合伙人	2.50	0.83%
32	邓海滨	有限合伙人	2.50	0.83%
33	李杰	有限合伙人	2.50	0.83%
34	王家安	有限合伙人	2.25	0.75%
35	黄鑫	有限合伙人	2.25	0.75%
36	张林凤	有限合伙人	2.25	0.75%
37	李后祥	有限合伙人	2.25	0.75%
38	黄公勇	有限合伙人	2.25	0.75%
39	叶力	有限合伙人	1.30	0.43%
40	张杰	有限合伙人	1.28	0.42%
41	方国建	有限合伙人	1.00	0.33%
42	肖永宝	有限合伙人	1.00	0.33%
43	王廷波	有限合伙人	1.00	0.33%
44	陈东	有限合伙人	1.00	0.33%

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
合计			302.00	100.00%

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形，上述情形产生的原因及对发行人可能产生的影响

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接和间接持有的本公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）控股股东和实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

（四）持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，除实际控制人外，其他持有公司 5%以上股份的股东包括重庆臻芯合伙、重庆科芯及其一致行动人杨海斌、杨璐。上述股东的基本情况如下：

1、重庆臻芯合伙

截至本招股说明书签署日，重庆臻芯合伙持有公司 10.29%的股份，基本信息详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、重庆科芯及其一致行动人杨海斌

截至本招股说明书签署日，重庆科芯持有公司 9.36%的股份，杨海斌持有公司 0.49%的股份，双方于 2025 年 9 月签订了《一致行动协议》并成为一致行动人，重

庆科芯及杨海斌基本信息如下：

（1）重庆科芯

项目	基本情况
公司名称	重庆科芯智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 10 月 19 日
出资额	10,000.00 万元
主要经营场所地址	重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号附 4 号 20-1
主营业务及其与发行人主营业务的关系	重庆科芯主营业务系投资，与公司的主营业务没有关联

截至报告期末，重庆科芯的出资结构情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类别	出资额（万元）	出资占比
1	重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	150.38	1.50%
2	重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,090.23	60.90%
3	重庆御隆创域股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,759.40	37.59%
合计			10,000.00	100.00%

（2）杨海斌

杨海斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3205251979****，毕业于上海财经大学，获硕士学位。2003 年 9 月至 2008 年 5 月，任职于安永华明会计师事务所上海分所，历任审计员、高级审计员；2008 年 5 月至 2009 年 10 月，任职于融信景亿咨询（北京）有限公司（原华盈融信咨询（北京）有限公司），任投资银行部副总裁；2009 年 11 月至 2017 年 7 月，任职于平安信托有限责任公司，历任 PE 投资事业部投资经理、投资副总监 VP、投资高级副总监 SVP（消费团队投资总监）；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任职于平安资本有限责任公司，担任 PE 投资事业部投资高级副总监 SVP（消费团队投资总监）；2018 年 5 月至今，任职于重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（原重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司），历任首席风险官、副总经理；2018 年 5 月至今，兼任顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司监事；2019 年 8 月至今，兼任镇

江大白鲸海洋世界有限公司董事。

3、杨璐

杨璐女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，获学士学位。2002 年 1 月至 2008 年 3 月，任职于招商银行股份有限公司重庆科园路支行（曾用名：“招商银行股份有限公司重庆高新区支行”），任客户经理；2008 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于兴业银行股份有限公司重庆科园路支行（曾用名：“兴业银行重庆高新支行”），历任科长、行长助理；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，任职于华夏银行股份有限公司重庆高新支行，任副行长；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，待业；2020 年 12 月至 2022 年 11 月，任臻宝有限董事；2022 年 11 月至今，任公司董事。

八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

九、发行人协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构的情况。

十、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本为 11,646.77 万股，公司本次拟向社会公众发行不超过 3,882.26 万人民币普通股，不低于发行后总股本的 25.00%。本次发行不涉及转让老股。本次发行前后，公司股本结构如下：

序号	股东	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
1	王兵	5,162.50	44.33	5,162.50	33.24
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	10.29	1,198.00	7.71
3	重庆科芯	1,089.71	9.36	1,089.71	7.02
4	杨璐	787.50	6.76	787.50	5.07

序号	股东	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
5	天津显智链	524.37	4.50	524.37	3.38
6	集成电路二期基金	458.88	3.94	458.88	2.95
7	夏冰	350.00	3.01	350.00	2.25
8	重庆臻宝合伙	302.00	2.59	302.00	1.94
9	长存基金	262.22	2.25	262.22	1.69
10	元禾璞华	214.21	1.84	214.21	1.38
11	聚源振芯	214.21	1.84	214.21	1.38
12	华虹虹芯	174.54	1.50	174.54	1.12
13	中证投资	131.11	1.13	131.11	0.84
14	苏州厚望	131.11	1.13	131.11	0.84
15	上海浦宸	131.11	1.13	131.11	0.84
16	石溪舜创	119.01	1.02	119.01	0.77
17	叶冈	75.37	0.65	75.37	0.49
18	杨海斌	57.35	0.49	57.35	0.37
19	国正多泽	55.54	0.48	55.54	0.36
20	加格咨询	49.16	0.42	49.16	0.32
21	半导体二期	43.70	0.38	43.70	0.28
22	重庆渝富	43.70	0.38	43.70	0.28
23	闻芯投资	43.70	0.38	43.70	0.28
24	王喜才	27.77	0.24	27.77	0.18
25	本次公开发行股份	-	-	3,882.26	25.00
合计		11,646.77	100.00	15,529.03	100.00

（二）前十大股东持股情况

截至本招股说明书签署日，发行人前十大股东的直接持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王兵	5,162.50	44.33
2	重庆臻芯合伙	1,198.00	10.29
3	重庆科芯	1,089.71	9.36

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
4	杨璐	787.50	6.76
5	天津显智链	524.37	4.50
6	集成电路二期基金	458.88	3.94
7	夏冰	350.00	3.01
8	重庆臻宝合伙	302.00	2.59
9	长存基金	262.22	2.25
10	元禾璞华	214.21	1.84
10	聚源振芯	214.21	1.84
合计		10,563.60	90.70

注：元禾璞华与聚源振芯持股数量相同，并列为发行人第十大股东

（三）本次发行前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，公司共有 6 名自然人股东，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	任职
1	王兵	5,162.50	44.33	董事长、总经理
2	杨璐	787.50	6.76	董事
3	夏冰	350.00	3.01	上海升芯副总经理、公司效率工程部总监
4	叶冈	75.37	0.65	-
5	杨海斌	57.35	0.49	-
6	王喜才	27.77	0.24	-
合计		6,460.49	55.48	-

（四）国有股东及外资股东持股情况

1、国有股东持股情况

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）之规定，公司股东集成电路二期基金为国有股东。财政部出具了《财政部关于确认国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司相关投资项目国有股权管理方案的函》（财建函[2024]9 号），确认集成电路二期基金为国有股东（SS），所持有的臻宝科技 458.88 万股（持股比例 3.94%）股份性质为国有法人股。

除上述外，截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他国有股东持股情况。

2、外资股东持股情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在外资股东持股情况。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在申报前十二个月新增股东的情况。

（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：

股东名称	直接持股比例（%）	股东间的关联关系
王兵	44.33	1、发行人直接股东夏冰为王兵配偶，王喜才为王兵兄弟；发行人间接股东王凤英为王兵姐姐；重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙为王兵控制的发行人员工持股平台，前述三人及员工持股平台为王兵的一致行动人； 2、王兵、夏冰、王凤英、杨璐分别持有重庆臻芯合伙 28.64% 、17.53%、17.95%及 12.94%的出资额； 3、王兵持有重庆臻宝合伙 28.95% 的出资额
夏冰	3.01	
王喜才	0.24	
重庆臻芯合伙	10.29	
重庆臻宝合伙	2.59	
杨璐	6.76	
重庆科芯	9.36	1、杨海斌通过持有顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司 20%的权益，间接持有重庆科芯执行事务合伙人重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司股份，系重庆科芯的间接权益持有人； 2、杨海斌、重庆科芯于 2025 年 9 月签署《一致行动协议》，为一致行动人； 3、重庆渝富的有限合伙人重庆渝富控股集团有限公司通过重庆科技创新投资集团有限公司间接持有重庆科芯的出资份额，系重庆科芯的间接权益持有人
杨海斌	0.49	
重庆渝富	0.38	
天津显智链	4.50	加格咨询 持有天津显智链投资管理中心（有限合伙）45.00%的出资份额，天津显智链投资管理中心（有限合伙）持有天津显智链 0.13%的出资份额并担任其执行事务合伙人
加格咨询	0.42	
国正多泽	0.48	国正多泽的有限合伙人北京石溪清流私募基金管理有限公司通过石溪澜润（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持有石溪舜创 1.25%的份额
石溪舜创	1.02	
集成电路二期基金	3.94	1、集成电路二期基金为长存基金及华虹虹芯的间接权益持有人； 2、中证投资持有长存基金 2.45%的份额，为其有限合
长存基金	2.25	

股东名称	直接持股比例（%）	股东间的关联关系
华虹虹芯	1.50	伙人，同时间接持有上海浦宸的份额
中证投资	1.13	
上海浦宸	1.13	

除上述关联关系外，本次发行前公司各股东间不存在其他关联关系。

（七）股东私募投资基金备案情况

截至本招股说明书出具日，公司共有 24 名股东，其中自然人股东 6 名，非自然人股东 18 名，非自然人股东中有 14 名股东属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金/私募基金管理人，其备案情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案情况		基金管理人登记情况		
		备案编码	备案日期	基金管理人	登记编号	登记时间
1	重庆科芯	SNC391	2020-11-10	重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司	P1064112	2017-08-07
2	天津显智链	SJX911	2020-03-31	北京芯动能投资管理有限公司	P1025879	2015-10-30
3	元禾璞华	SNU333	2021-02-01	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	P1071690	2020-12-28
4	聚源振芯	SVX983	2022-07-07	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	P1003853	2014-06-04
5	华虹虹芯	SSZ628	2021-11-19	上海国方私募基金管理有限公司	P1065092	2017-09-28
6	石溪舜创	SZM584	2023-03-08	北京石溪清流投资有限公司	P1068420	2018-06-19
7	国正多泽	SXQ219	2022-11-17	合肥产投国正创业投资有限公司	P1067950	2018-04-12
8	集成电路二期基金	SJU890	2020-03-12	华芯投资管理有限责任公司	P1009674	2015-03-25
9	长存基金	SABY22	2023-11-15	湖北国芯产业投资管理有限责任公司	P1062935	2017-05-31
10	苏州厚望	SADL71	2023-11-22	元禾厚望（苏州）私募基金管理有限公司	P1066725	2018-01-09

序号	股东名称	私募基金备案情况		基金管理人登记情况		
		备案编码	备案日期	基金管理人	登记编号	登记时间
11	上海浦宸	SABA07	2023-09-18	上海国盛资本管理有限公司	P1068692	2018-07-17
12	半导体二期	SB2172	2023-06-27	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司	P1068757	2018-07-25
13	重庆渝富	STJ381	2021-12-22	重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司	P1004104	2014-07-22
14	闻芯投资	SZC695	2023-01-19	嘉兴厚熙投资管理有限公司	P1068902	2018-08-27

公司其余股东不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金/私募基金管理人，无需办理私募投资基金备案/私募基金管理人登记备案手续。

（八）发行人股东公开发售股份情况

截至本招股说明书签署日，公司本次发行不涉及股东公开发售股份的情况。

（九）公司历史上签署过的对赌条款以及解除情况

公司股东曾与公司实际控制人王兵存在对赌约定/安排，不存在以公司作为回购义务主体的对赌安排，具体情况如下：

1、实际控制人与重庆科芯、杨海斌之间的对赌安排

重庆科芯、杨海斌（以下合称“Pre-A 轮股东”）于 2020 年 11 月就增资入股公司事宜与王兵及各相关方签订了《投资协议》《关于回售权之协议书》，根据前述协议：1）若触发回售情形，Pre-A 轮股东有权要求实际控制人王兵收购其所持的发行人股（份）权；2）若王兵指定具有履约能力的第三人代为履行上述义务，则在王兵为该等第三人履行回购当轮投资者持有的发行人股（份）权并向当轮投资者支付相应股（份）权转让对价款（其金额等于股（份）权出售价款）的义务提供连带保证担保的前提下，当轮投资者应给予配合；3）为实现发行人上市之目的，各方同意届时根据法律、法规和规范性文件的规定以当轮投资者认可的方式合理处理前述协议项下当轮投资者的权利条款，以使发行人符合上市之监管要求。

2、实际控制人与天津显智链、加格咨询之间的对赌安排

天津显智链、**加格咨询**（以下合称“A轮股东”）于2022年2月就增资入股公司事宜与王兵、发行人及各相关方分别签订了《增资协议之补充协议》《关于回售权之协议书》，根据前述协议：1）若触发回售情形，A轮股东有权要求实际控制人王兵收购其所持发行人的股（份）权；2）若王兵指定具有履约能力的第三人代为履行上述义务，则在王兵为该等第三人履行购买当轮投资者持有的发行人股（份）权并向当轮投资者支付相应股（份）权转让对价款（其金额等于股（份）权出售价款）的义务提供连带保证担保的前提下，当轮投资者应给予配合；3）该协议已就前述对赌回购约定了附有自动恢复条款的终止约定。

3、实际控制人与元禾璞华、聚源振芯、华虹虹芯、石溪舜创、叶冈、国正多泽、王喜才之间的对赌安排

元禾璞华、聚源振芯、华虹虹芯、石溪舜创、叶冈、国正多泽、王喜才于2023年3月就增资入股公司事宜与王兵、发行人签订了《增资补充安排单行协议》，根据该协议：1）若触发回售情形，B轮股东有权要求实际控制人王兵收购其所持发行人的股份；2）若王兵指定具有履约能力的第三人代为履行上述义务，则在王兵为该等第三人履行购买当轮投资者持有的发行人股份并向当轮投资者支付相应股份转让对价款（其金额等于股份出售价款）的义务提供连带保证担保的前提下，当轮投资者应给予配合；3）如届时有多方（包括但不限于享有回售权利的重庆科芯、杨海斌、天津显智链、**加格咨询**、B轮投资者及公司后续股权融资引入的新投资人），向王兵发起回购诉求但王兵不足以向要求回售的全部权利人全额支付其适用的股权出售价款，则要求回售的全部权利人各自可获得价款应按其届时各自有权获得的股份出售价款和逾期利息（如有）金额总额之间的相对比例进行分配；4）未经当轮投资者书面同意，王兵和发行人不会赋予任何现有股东、新投资人任何可优先于现有股东或当轮投资者进行回售的权利，亦不会另行给予新投资人或现有股东任何与该协议约定相冲突的承诺或约定；5）该协议已就前述对赌回购约定了附有自动恢复条款的终止约定。

4、实际控制人与集成电路二期基金、长存基金、中证投资、上海浦宸、重庆渝富、半导体二期、苏州厚望及闻芯投资之间的对赌安排

集成电路二期基金、长存基金、中证投资、上海浦宸、重庆渝富、半导体二期、苏州厚望及闻芯投资（以下合称“Pre-IPO 轮股东”）于 2023 年 12 月就增资入股公司事宜与王兵、发行人及其附属公司、其他相关方签订了《Pre-IPO 轮股东协议》，根据该协议：1）若触发回售情形，Pre-A 轮股东、A 轮股东、B 轮股东及 Pre-IPO 轮股东（以下合称或单称“该等投资者”）均有权要求实际控制人王兵收购其所持发行人的股份；2）若王兵指定具有履约能力的第三人代为履行上述义务，且经该等投资者事先的书面同意，在王兵为该等第三人履行签署相关股权转让协议或减资协议等转让或回购文件并无条件全额支付回购价款的义务提供连带保证担保的前提下，该等投资者应给予配合；3）如届时存在多名投资方（包括但不限于该等投资者及公司后续融资引入的新投资方）根据协议请求回购但王兵在协议约定期间内不足以支付全部回购价款时，则各投资方可分配的回购价款，应按其届时各自有权获得的回购价款及逾期利息（如有）之和与王兵应支付的回购价款总额之间的相对比例进行分配。为免疑义，对于各投资方未取得的剩余回购价款部分，应由王兵继续履行支付义务，并按照协议约定计算逾期利息；4）未经各投资方事先的书面同意，王兵不会赋予现有各投资方，且在臻宝科技未来融资过程中，不会赋予新投资者，任何可能优先于现有各投资方进行回购的权利，亦不会另行给予该等新投资方或现有各投资方任何与前述相冲突的承诺或约定；5）为免疑义，现有股东及公司同意，自《Pre-IPO 轮股东协议》生效之日起，任何之前公司两个或多个股东之间先前达成任何有关公司的协议（包括但不限于历次投资文件）中与《Pre-IPO 轮股东协议》约定不一致的内容应立即终止并由《Pre-IPO 轮股东协议》约定内容所取代。

5、相关对赌协议终止的签署情况

2025 年 5 月 20 日，发行人全体股东、发行人及其附属公司签署了《关于重庆臻宝科技股份有限公司之股东协议之补充协议》，各方约定股东协议项下投资方特别权利相关条款于臻宝科技递交的首次公开发行股票并上市申请获得正式受理之日起自始自动终止，同时亦约定所终止的股东协议项下投资方特别权利相关条款将在

下列事项较早发生的一项发生之日自动恢复其完全效力，并视同该等约定从未失效：

（i）公司决议暂停或放弃首次公开发行或撤回或撤销首次公开发行的申请；（ii）公司的首次公开发行申请被中国证监会或证券交易所或证券监管机构撤回、退回、撤销、终止审查、不予批准或不予注册；（iii）公司未能于受理日起三十六（36）个月内完成合格上市。

2026 年 1 月 26 日，发行人全体股东、发行人及其附属公司签署了《关于重庆臻宝科技股份有限公司之股东协议之补充协议（二）》，各方约定，股东协议项下投资方特别权利相关条款于臻宝科技在向目标交易所递交的首次公开发行股票并上市申请获得正式受理之日起自始自动终止。上述协议已将投资方特别权利自动恢复条款的内容予以明确删除，因此投资方享有的特别权利均已不可撤销地终止，且不存在任何附条件或自动恢复的约定安排。

除上述情况外，发行人实际控制人与发行人股东之间不存在其他对赌协议等特殊权利安排。

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介

1、董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成。董事会成员基本情况如下：

姓名	职务	本届任职期间	提名/委派来源
王兵	董事长、董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
杨佐东	董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
张静	董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
薛锋	董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	重庆科芯
杨璐	董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	杨璐
刘子钊	董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	集成电路二期基金
LIANSHENG CAO（曹炼生）	独立董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
张金若	独立董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵

姓名	职务	本届任职期间	提名/委派来源
龙莉	独立董事	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵

（1）王兵

王兵先生，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）杨佐东

杨佐东先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获硕士学位。2002 年 6 月至 2018 年 7 月，任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，历任工程师、设备科长、工艺科长、干法刻蚀部门经理、FE（Fab Enhancement）部门经理（总监级）；2018 年 7 月至 2022 年 11 月，任臻宝有限首席运营官；2020 年 12 月至 2022 年 11 月，任臻宝有限董事；2022 年 11 月至今，任公司董事、副总经理、首席运营官。

（3）张静

张静女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学，获学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，任职于宗申产业集团重庆动力产品销售有限公司（曾用名：“重庆宗申集团摩托车销售有限责任公司”），任会计；2005 年 9 月至 2007 年 8 月，任职于汉斯.安海（中国）重庆有限公司，任会计；2007 年 8 月至 2008 年 9 月，任职于重庆英凯美医疗器械有限公司，任会计；2008 年 10 月至 2019 年 5 月，历任宗申派姆重庆氢能源有限公司、重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆宗申天润地产有限公司及宗申产业集团有限公司总账、财务经理、财务部长、加拿大项目财务负责人等多项职务；2019 年 5 月至 2022 年 11 月，任臻宝有限财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 11 月，任臻宝有限董事、财务总监；2022 年 11 月至今，任公司董事、财务负责人；2023 年 12 月至今，任公司董事会秘书。

（4）薛锋

薛锋先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，

获硕士学位。2003年9月至2006年11月，任职于重庆市渝北区人民法院，历任办公室科员、民二庭书记员、助理审判员、研究室副主任；2006年11月至2012年12月，任职于重庆市人民政府法制办公室，历任综合协调处副主任科员、主任科员、执法监督处副处长；2012年12月至2016年12月，任职于重庆药品交易所股份有限公司，历任机构会员部临时负责人、部长、发展战略研究部部长、董事会秘书、医药发展交流中心临时党支部负责人；2016年2月至2018年1月，任职于重庆易网医药发展有限公司，兼任副总经理；2018年1月至2018年4月，任职于重庆物流金融服务（集团）股份有限公司（曾用名：“重庆物流金融服务股份有限公司”），任董事会办公室主任；2018年5月至今，任职于重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司（曾用名：“重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司”），历任副总经理、职工代表董事；2021年12月至2022年11月，任臻宝有限董事；2022年11月至今，任公司董事。

（5）杨璐

杨璐女士，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（四）持有发行人5%以上股份的股东”。

（6）刘子钊

刘子钊先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获硕士学位。2018年7月至2019年7月，任职于中信建投资本管理有限公司，任投资经理；2019年8月至2021年7月，任职于阳光资产管理股份有限公司，任投资经理；2021年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部经理、投资四部经理、业务三部高级主管；2025年6月至今，任职于西安航天民芯科技有限公司，任董事；2025年6月至今，任职于上海九同方技术有限公司，任董事；**2025年10月至今，任职于中国电子工程设计院股份有限公司，任董事；2024年1月至今，任公司董事。**

（7）LIANSHENG CAO（曹炼生）

LIANSHENG CAO（曹炼生）先生，1950年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，毕业于中国科学院研究生院（现中国科学院大学）、美国密西根州立大学，均获硕士学位。1987年8月至1989年1月，任职于Hayakawa Institute of Technology，任软件开发工程师；1989年1月至1992年2月，任职于VIAM Manufacturing, Inc.任资深软件工程师兼IT部门经理；1992年2月至1996年12月，任职于Andersen Consulting，任资深系统分析师；1996年7月至2004年8月，任职于C&A Enterprises Corp.,任执行总裁（CEO）；1997年1月至2000年9月，任职于PerSè Software, Inc.,任资深软件架构师兼资深经理；2000年10月至2002年2月，任职于Lightspeed, Inc.,任资深软件架构师兼总监；2002年3月至2004年8月，任职于上海市外国投资促进中心美国洛杉矶代表处，任副主任；2004年9月至2010年6月，任职于中微半导体设备（上海）有限公司，任执行长特别顾问后兼任公共关系部执行总监；2010年6月至2011年4月，任职于理想能源设备（上海）有限公司，任执行长特别顾问、战略与事务管理部执行总监兼执行委员会委员；2011年4月至2022年5月，任职于中微半导体设备（上海）股份有限公司，历任中国事业部总经理（副总裁级）、公共关系及市场部副总裁；2017年1月至2020年1月，任职于上海微电子装备（集团）股份有限公司（曾用名为：上海微电子装备股份有限公司），任独立董事；2020年6月至今，任职于新疆大全新能源股份有限公司，任独立董事；2022年9月至2023年10月，任职于上海强华实业股份有限公司，任副总裁；2023年6月至今，任职于上海煜涵半导体科技有限公司，任董事总经理、监事；2023年11月至2025年5月，任职于上海芯迦涵科技有限公司，任董事；2023年12月至今，任公司独立董事。

（8）张金若

张金若先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，获博士学位。2008年6月至今，任职于重庆大学经济与工商管理学院，历任讲师、副教授、教授、会计学系主任、教工党支部书记；2020年10月至今，任重庆农村商业银行股份有限公司外部监事；2021年8月至2024年6月，任重庆钢铁股份有限公

司独立董事；任厦门大学会计发展研究中心兼职教授；**2025 年 12 月至今，任重庆三圣实业股份有限公司独立董事**；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

（9）龙莉

龙莉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，获硕士学位。2007 年 7 月至 2019 年 8 月，任职于重庆依斯特律师事务所，任律师合伙人；2019 年 8 月至今，任职于重庆德琅律师事务所，任律师合伙人、主任；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、取消监事会前在任监事会成员

截至取消监事会前，公司监事会由 3 名监事组成，公司取消监事会前在任监事的基本情况如下表所示：

姓名	职位	本届任职期间	提名/委派来源
龚汉远	监事会主席，非职工代表监事	自 2022 年 11 月至取消监事会	王兵
陈莉	非职工代表监事	自 2023 年 3 月至取消监事会	王兵
郭丽丽	职工代表监事	自 2022 年 11 月至取消监事会	职工代表大会

（1）龚汉远

龚汉远先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，获学士学位。2014 年 7 月至 2015 年 2 月，任职于深圳农产品集团股份有限公司，任职员（管理培训生）；2015 年 4 月至 2016 年 2 月，任职于天津聚龙嘉华投资集团有限公司，任总裁秘书；2016 年 3 月至 2016 年 9 月，待业；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任职于臻宝有限，任采购专员；2018 年 10 月至今，任职于重庆芯洁，历任资深销售工程师、总经理助理、销售支持科资深主管、SEMI 西南营销项目组资深主管；2022 年 11 月至取消监事会，任公司监事会主席。

（2）陈莉

陈莉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，获硕士学位。2005 年 7 月至 2006 年 9 月，任职于东莞宣得电子有限公司，任采购专员；2006 年 9 月至 2012 年 1 月，任职于实盈电子（东莞）有限公司，历任采购专

员、采购经理、资材部经理；2012 年 2 月至 2018 年 7 月，任职于重庆市旭宝科技有限公司，历任资材部经理、总经理助理；2018 年 10 月至 2020 年 5 月，任职于重庆浩义成塑胶科技有限公司，任总经理助理；2020 年 5 月至今，任职于重庆芯洁，历任采购经理、管理支持中心副总监、交付履行部副总监；**2020 年 9 月至今，任职于重庆创升鑫电子科技有限公司，任监事**；2023 年 3 月至取消监事会，任公司监事。

（3）郭丽丽

郭丽丽女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，本科学历。2013 年 7 月至 2018 年 3 月，任职于广州市昊志机电股份有限公司，任人事专员；2018 年 3 月至 2019 年 10 月，待业；2019 年 10 月至 2021 年 3 月，任职于重庆梅安森科技股份有限公司，任人事专员；2021 年 3 月至今，历任臻宝有限及臻宝科技招聘专员、组织与人才发展部资深专员；2022 年 11 月至取消监事会，任公司职工代表监事。

2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为 3 名，为张金若、龙莉、杨璐，由张金若担任召集人。前述董事的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

3、高级管理人员

公司的高级管理人员基本情况如下表所示：

姓名	职位	本届任职期间	提名/委派来源
王兵	总经理	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
杨佐东	副总经理	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
蒋晓钧	副总经理	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵
张静	财务负责人、董事会秘书	自 2025 年 12 月至 2028 年 12 月	王兵

（1）王兵

王兵先生，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）杨佐东

杨佐东先生，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

（3）蒋晓钧

蒋晓钧先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京市中国科学院化学研究所，获硕士学位。1997 年 9 月至 1998 年 5 月，任职于重庆兵器工业部第 59 研究所，任研究人员；2001 年 7 月至 2020 年 9 月，任职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，任资深技术经理；2020 年 9 月至 2021 年 1 月，任职于昕原半导体（上海）有限公司，任研发中心 ETCH 部门经理；2021 年 1 月至 2023 年 8 月，任职于海思技术有限公司（曾用名：上海海思技术有限公司），任技术专家 A，20 级；2023 年 12 月至今，任公司副总经理、PBG 产品事业群总经理。

（4）张静

张静女士，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

4、核心技术人员

公司现有 5 名核心技术人员，基本情况如下：

（1）杨佐东

杨佐东先生，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管

理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

（2）蒋晓钧

蒋晓钧先生，其个人情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“3、高级管理人员”。

（3）陈立航

陈立航先生，1972 年出生，中国国籍，中国香港永久居民，毕业于日本名古屋大学，获博士学位。1996 年 8 月至 2010 年 3 月，任职于漠泰科技股份有限公司，历任品保课长、光电半导体专案产品技术襄理、光电半导体专案技术服务经理；2010 年 4 月至 2010 年 9 月，待业备考；2010 年 10 月至 2017 年 3 月，就读于日本名古屋大学，兼任研究助理，取得材料物理量子理工专业博士学位；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，任职于国立中兴大学，任博士后研究员；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，任职于南京弘洁半导体科技有限公司，任副总经理；2025 年 3 月至今，任职于上海大学材料科学与工程学院，任兼职教授；2021 年 1 月至今，历任公司研发副总裁、陶瓷造粒研发项目组负责人。

（4）王文彬

王文彬先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，获学士学位。2016 年 7 月至 2016 年 9 月，任职于浙江仙琚制药股份有限公司，任研究员；2016 年 10 月至今，历任公司工程师、技术品质主管、研发经理、制造工程部及技术部负责人。

（5）曾德强

曾德强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获硕士学位。2001 年 8 月至 2003 年 6 月，任职于江苏扬州晶来集团，任技术/工艺工程师；2003 年 6 月至 2005 年 5 月，任职于扬州晶石高科技有限公司，任光刻和刻蚀工序生产及工艺主管；2005 年 6 月至 2018 年 3 月，任职于中芯国际集成电路（上海）有限公司，任制程工程师、前段制程经理、资深制程经理；2018 年 5 月至

2022 年 5 月，任职于北京屹唐半导体科技有限公司，任资深制程经理；2022 年 7 月至 2024 年 8 月，任职于海思技术有限公司，任技术专家 A；2024 年 9 月至今，任公司研发资深总监。

（二）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况

1、公司与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议

截至本招股说明书签署日，公司（或其子企业）与除独立董事、外部董事外的全体董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员签署了劳动合同和保密协议（含竞业限制义务条款），与王兵、杨佐东、蒋晓钧、张静、杨璐、龚汉远、陈莉、陈立航、王文彬及曾德强签署了股权激励协议，并与独立董事、外部董事签署了聘任协议及保密协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。

除上述协议外，公司的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订其他协议。

2、上述协议的履行情况

截至本招股说明书签署日，相关董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行合同及协议约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。

（三）近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职变动情况及原因

1、董事的任职变动情况及原因

近两年内，公司董事未发生重大变动，具体变动情况及原因如下：

日期	变更前	变更后	变动原因
2024 年 1 月	王兵、杨佐东、张静、薛锋、杨璐、LIANSHENG CAO（曹炼生）、张金若、龙莉	王兵、杨佐东、张静、薛锋、杨璐、刘子钊、LIANSHENG CAO（曹炼生）、张金若、龙莉	为完善公司治理结构而新增董事

2、取消监事会前在任监事的任职变动情况

近两年内，公司取消监事会前在任监事未发生重大变动。

3、高级管理人员的任职变动情况

近两年内，公司高级管理人员未发生重大变动。

4、核心技术人员的任职变动情况

近两年内，公司核心技术人员未发生重大变动，具体变动情况及原因如下：

日期	变更前	变更后	变动原因
2024 年 9 月	杨佐东、蒋晓钧、陈立航、王文彬	杨佐东、蒋晓钧、陈立航、王文彬、曾德强	公司因业务发展需要新增核心技术人员

5、最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化

公司最近两年内的董事、高级管理人员以及核心技术人员的变动事宜符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。上述变动不会对公司的法人治理结构、经营管理层的稳定性及经营政策的延续性产生重大不利影响。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员的主要兼职情况（在发行人及其子公司的任职除外）如下：

姓名	本公司担任职务	兼职单位名称	兼职职务
王兵	董事长、总经理	重庆臻芯合伙	执行事务合伙人
		重庆臻宝合伙	执行事务合伙人
薛锋	董事	重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司	副总经理、职工代表董事
刘子钊	董事	华芯投资管理有限责任公司	业务三部高级主管
		西安航天民芯科技有限公司	董事
		上海九同方技术有限公司	董事
		中国电子工程设计院股份有限公司	董事
LIANSHENG CAO(曹炼生)	独立董事	新疆大全新能源股份有限公司(688303.SH)	独立董事

姓名	本公司担任职务	兼职单位名称	兼职职务
		上海煜涵半导体科技有限公司	监事
		上海芯迦涵科技有限公司	董事
张金若	独立董事	重庆大学经济与工商管理学院	教授、会计学系主任、教工党支部书记
		重庆农村商业银行股份有限公司（601077.SH）	外部监事
		厦门大学会计发展研究中心	兼职教授
		重庆三圣实业股份有限公司	独立董事
龙莉	独立董事	重庆德琅律师事务所	律师合伙人、主任
		重庆依斯特投资有限公司	监事
陈莉	取消监事会前在任监事	重庆创升鑫电子科技有限公司	监事

注：经查询公开信息，龙莉目前仍在重庆依斯特投资有限公司担任监事。经与龙莉确认，其反馈系因误用其身份信息所致，仍在沟通相关变更事宜

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员除上述表格中披露的兼职情况外，无在其他单位任职的情形。公司与公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其核心技术人员的兼职单位的关联关系，详见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联交易”。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除发行人、子公司及员工持股平台外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的其他主要对外投资情况如下：

姓名	现任职务	其他对外投资公司/企业	持股/出资比例	注册资本（万元）
薛锋	董事	顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司	15.00%	1,000.00
LIANSHENG CAO（曹炼生）	独立董事	上海栎东企业管理中心（有限合伙）	12.50%	800.00
龙莉	独立董事	重庆非子法律顾问有限公司	1.00%	100.00
陈莉	取消监事会前在任监事	重庆创升鑫电子科技有限公司	40.00%	100.00
		香港浩義成贸易有限公司	100.00%	1.00（港元）

截至本招股说明书签署日，本公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人

员及核心技术人员的上述对外投资与本公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

公司建立了完善的薪酬制度，在公司担任具体经营管理职务的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资及奖金组成。其中基本工资及社保福利由劳动合同进行约定；奖金视公司当年度业绩情况进行确定。

公司于2023年12月14日召开的第一届董事会第七次会议建立了董事会薪酬与考核委员会。根据相关议事规则，薪酬与考核委员会的主要职责权限包括制定董事、高级管理人员的薪酬制度和薪酬标准，审议公司重大薪酬福利政策等。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。

独立董事享有固定数额的独立董事津贴，公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于确认公司独立董事2023年度津贴及制定2024年度津贴方案的议案》；未在公司担任具体经营管理职务的外部董事不在公司领取薪酬。

公司现任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员 2025年在公司领取的税前薪酬金额如下：

姓名	现任职务	2025 年度税前薪酬（万元）
王兵	董事长、总经理	226.48
杨佐东	董事、副总经理、核心技术人员	232.65
张静	董事、财务负责人、董事会秘书	101.87
薛锋	董事	-
杨璐	董事	-
刘子钊	董事	-
LIANSHENG CAO （曹炼生）	独立董事	8.00
张金若	独立董事	8.00
龙莉	独立董事	8.00

姓名	现任职务	2025 年度税前薪酬（万元）
龚汉远	取消监事会前在任监事会主席	24.15
陈莉	取消监事会前在任监事	54.83
郭丽丽	取消监事会前在任职工监事	15.12
蒋晓钧	副总经理、核心技术人员	192.20
陈立航	核心技术人员	80.56
王文彬	核心技术人员	57.66
曾德强	核心技术人员	163.58
合计		1,173.12

2023 年、2024 年及 2025 年，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占各期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额	1,173.12	892.21	623.91
利润总额	26,469.52	17,038.07	12,720.68
占比	4.43%	5.24%	4.90%

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况

1、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员在发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：

姓名	职位	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	合计持股比例（%）
王兵	董事长、总经理	44.33	3.70	48.03
杨佐东	董事、副总经理、核心技术人员	-	1.20	1.20
张静	董事、财务负责人、董事会秘书	-	0.21	0.21
薛锋	董事	-	-	-
杨璐	董事	6.76	1.33	8.09

姓名	职位	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	合计持股比例（%）
刘子钊	董事	-	-	-
LIANSHENG CAO（曹炼生）	独立董事	-	-	-
张金若	独立董事	-	-	-
龙莉	独立董事	-	-	-
蒋晓钧	副总经理、核心技术人员	-	0.21	0.21
龚汉远	取消监事会前在任监事会主席	-	0.02	0.02
陈莉	取消监事会前在任监事	-	0.08	0.08
郭丽丽	取消监事会前在任职工监事	-	-	-
陈立航	核心技术人员	-	0.21	0.21
王文彬	核心技术人员	-	0.04	0.04
曾德强	核心技术人员	-	0.07	0.07

截至本招股说明书签署日，上述股份不存在质押或冻结情况，也不存在任何权属争议。

2、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况

截至本招股说明书签署日，实际控制人王兵配偶夏冰直接持有公司股份 350.00 万股，占比 3.01%，通过重庆臻芯合伙间接持有公司股份 210.00 万股，占比 1.80%，合计占比 4.81%；王兵姐姐王凤英通过重庆臻芯合伙间接持有公司股份 215.00 万股，占比 1.85%；王兵哥哥王喜才直接持有公司股份 27.77 万股，占比 0.24%。

截至本招股说明书签署日，上述股份不存在质押或冻结情况，也不存在任何权属争议。除上述持股情况外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在持有公司股份的情形。

（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的配偶关系及亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员

及核心技术人员之间不存在配偶关系及亲属关系。

（九）董事、监事、高级管理人员的任职资格情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员符合《证券法》《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形，不存在因违反相关法律法规而受到刑事处罚或曾经涉及刑事诉讼的情形。

（十）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

十二、发行人员工持股计划

（一）股权激励相关安排

公司为了加强对核心员工的激励，设置了两家员工持股平台重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙。两家员工持股平台通过增资的方式持有公司股权，历次内部股权转让履行了相应程序。

截至本招股说明书签署日，重庆臻芯合伙、重庆臻宝合伙分别持有公司 10.29%、2.59%的股份，具体信息详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”。

（二）股权激励对公司的影响

1、对公司经营情况的影响

通过实施股权激励，公司进一步健全了激励机制，充分调动了公司员工的工作积极性，对公司经营情况产生了有利影响。

2、对公司财务情况的影响

针对报告期内的股权激励，公司已根据《企业会计准则》及相关解释文件进行了会计处理。公司于 2023 年度、2024 年度及 **2025 年度**分别确认了股份支付费用 441.57 万元、765.87 万元及 **1,366.78** 万元，增加了当期费用、减少了当期营业利润及净利润。

3、对公司控制权变化的影响

股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

（三）上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，股权激励计划已实施完毕，不存在未授予或未行权的情况，不涉及上市后的行权安排。

十三、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工人数及结构

1、员工人数及变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 **2025 年 12 月 31 日**，公司员工人数分别为 779 人、854 人及 **1,024** 人。

2、员工专业结构

报告期末，公司员工的专业构成情况如下表：

类别	2025 年 12 月 31 日	
	员工数量（人）	占比
管理人员	90	8.79%

类别	2025 年 12 月 31 日	
	员工数量（人）	占比
生产人员	739	72.17%
销售人员	50	4.88%
研发人员	145	14.16%
总计	1,024	100.00%

3、员工受教育程度

报告期末，公司员工的受教育程度情况如下表：

类别	2025 年 12 月 31 日	
	员工数量（人）	占比
硕士及以上	90	8.79%
本科	263	25.68%
大专	269	26.27%
大专以下	402	39.26%
合计	1,024	100.00%

4、年龄结构

报告期末，公司员工的年龄情况如下表：

类别	2025 年 12 月 31 日	
	员工数量（人）	占比
30 岁及以下	456	44.53%
31 岁至 40 岁	436	42.58%
41 岁至 50 岁	104	10.16%
51 岁及以上	28	2.73%
合计	1,024	100.00%

（二）员工社会保障情况

报告期各期末，公司未缴纳社会保险的人数及具体原因如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
新入职员工尚未办理	9	3	6

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
外籍员工及境外子公司员工	3	5	6
中国港澳台居民	-	-	1
退休返聘	2	2	3
员工自愿放弃或自行异地缴纳	-	-	-
合计	14	10	16

报告期各期末，公司未缴纳住房公积金的人数及具体原因如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
新入职员工尚未办理	8	3	7
外籍员工及境外子公司员工	3	5	6
中国港澳台居民	-	-	1
退休返聘	2	2	3
员工自愿放弃或自行异地缴纳	-	-	-
合计	13	10	17

报告期内，发行人及下属子公司存在少量员工未参加社会保险、住房公积金的情况，主要系：1、新入职员工尚未办理完毕缴纳手续。由于新入职员工尚在办理社会保险或公积金账户转移手续，办理完成后方可进行社会保险、住房公积金的缴纳；或部分月末入职的员工入职日期晚于公司当月社保、公积金统一缴纳日期，公司于次月起为其缴纳社保、公积金；2、外籍员工及境外子公司员工无需缴纳；3、发行人及附属公司报告期内存在未缴纳少部分中国港澳台员工的社保的情况，截至 2024 年末，发行人已进行整改，为中国港澳台员工缴纳社保；发行人及附属公司无需为中国港澳台员工缴纳公积金；4、退休返聘人员无需缴纳社会保险、住房公积金；5、部分员工自愿放弃公司为其缴纳社会保险、住房公积金。

发行人及相关下属子公司已取得当地社保及住房公积金主管部门出具的证明文件，确认发行人及该等子公司报告期内不存在因违反相关法律、法规行为而受到行政处罚的记录。此外，发行人的实际控制人王兵出具承诺，“若公司、子公司及其他分支机构因未为职工缴存或足额缴纳社会保险费、住房公积金被有关政府部门或司法机关、仲裁机构认定需要补缴以及因此受到处罚或遭受民事索赔的，本人愿意

无条件连带承担补缴义务以及公司、子公司及其他分支机构因此而遭受的任何罚款或损失。在公司、子公司及其他分支机构必须先行支付相关费用的情况下，实际控制人将给予全额补偿，以确保公司、子公司及其他分支机构（如存在此种情况）不会因此遭受任何损失。”

（三）劳务派遣用工情况

报告期内，公司以劳务派遣的形式招聘了部分岗位的人员，用于公司产品运送到客户现场后的搬运工作及公司员工食堂的相关工作。报告期各期末的劳务派遣人数分别为 64、63 及 **53** 人。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司劳务派遣用工人数未超过用工总量 10%。

（四）劳务外包情况

报告期内，公司存在劳务外包用工的情形，劳务外包的内容主要为保安、保洁等物业管理类工作。**报告期各期间公司劳务外包费用均为 160.51 万元。**

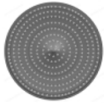
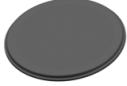
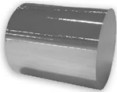
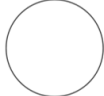
第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）主营业务的基本情况

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案。公司主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。公司已量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积高纯碳化硅超厚材料和陶瓷造粒粉体等半导体材料，形成“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，并不断突破关键半导体材料制备技术和表面处理技术、拓展核心零部件产品品类，向客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

图：“原材料+零部件”业务矩阵

类别	代表性零部件产品				代表性原材料	
硅						
	曲面硅上部电极	硅上部电极	硅环		大直径单晶硅棒	多晶硅棒
石英						
	石英环	石英气体分配盘	石英盘	石英喷嘴	石英窗	
陶瓷						
	静电卡盘	陶瓷板	陶瓷杆	陶瓷筒	氧化铝陶瓷造粒粉	氧化钪陶瓷造粒粉
碳化硅						
	聚焦环	支撑环	嵌入环	接地环	化学气相沉积碳化硅	

注：上图仅列示公司部分代表性产品

设备零部件是集成电路和显示面板制造产业不可或缺的基础关键支撑，零部件

的性能、质量和精度直接决定了生产设备的可靠性和稳定性，集成电路和显示面板制造设备零部件的本土化供应成为主要的“卡脖子”突破口。公司紧扣国家产业政策和科技创新发展战略，深耕设备零部件领域，已与国内主要集成电路制造厂商和显示面板制造厂商建立了长期稳定的合作关系，助力客户制造工艺与设备零部件升级。公司业务已覆盖客户 3、客户 4 等国内主流存储芯片制造厂商，客户 1、客户 2、晶合集成、华润微电子、芯联集成、武汉新芯、积塔半导体和粤芯半导体等国内主流集成电路制造厂商，京东方、华星光电、天马微电子、惠科股份和彩虹光电等国内主流显示面板厂商，通过零部件的自主可控保障先进制程产线的供应链安全。同时，公司已进入英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等国际集成电路制造厂商供应链，具备一定的国际竞争力。

零部件产品方面，公司已量产曲面硅上部电极、石英气体分配盘、高纯碳化硅环等核心零部件产品，并批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位；并已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的自主可控。

原材料制造方面，公司已量产用于硅零部件生产的大直径单晶硅棒、用于高纯碳化硅零部件生产的化学气相沉积碳化硅材料和用于陶瓷零部件生产的氧化铝、氧化钼陶瓷造粒粉，持续推进高致密陶瓷涂层制备工艺的迭代开发。公司原材料的自主生产提升了产品质量和客制化零部件的研发生产能力，保障了公司供应链的稳定。

表面处理方面，在集成电路制造领域，公司表面处理服务已供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造和存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造。在显示面板领域，公司表面处理服务已供应于 G10.5-G11 超大世代和 AMOLED 等显示面板高端工艺产线。

公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒拉制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和

微深孔刻蚀等精密加工技术；在精密清洗、阳极氧化和熔射再生等表面处理环节，阶段性突破了高致密涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司还自主开发了加工刻蚀液、加工工具和装置，是国内少数实现集成电路先进制程设备和高世代、高电压显示面板制造设备非金属零部件多品类供应、规模化量产的企业之一。

公司系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、重庆市先进智能工厂、重庆博士后工作站、重庆市技术创新示范企业和重庆市企业技术中心。报告期内，公司积极牵头承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，协助行业龙头客户推进重点攻关项目国产化研发，助力国产供应链体系的完善和自主可控，保障集成电路制造行业的稳定可持续发展。公司已建立较为完整的知识产权体系，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 145 名研发人员和 116 项专利，其中发明专利 61 项，在申请发明专利 50 项。

（二）主要产品及服务的基本情况

集成电路和显示面板制造设备真空腔内零部件长期处于高功率、高电压、强腐蚀等严苛反应环境中，在设备使用过程中会出现损耗、污染等情形，因此需要定期更换或进行表面处理以提升零部件性能和质量，保障芯片和显示面板生产的性能和良率。公司紧扣国家产业政策和科技创新发展战略，坚持面向经济主战场、面向国家先进产业链自主可控，深耕集成电路和显示面板产业链“卡脖子”领域，在等离子体刻蚀和薄膜沉积等生产设备核心零部件领域着力推动自主可控和科技创新。

公司零部件产品及表面处理服务的具体情况和应用环节如下：

1、半导体设备零部件产品

（1）半导体设备零部件介绍

报告期内，公司半导体设备零部件产品主要应用于等离子体刻蚀和薄膜沉积等设备的真空工艺腔体内，对产品精密度、表面洁净度和耐用性的要求较高，且部分零部件与晶圆直接接触，其产品质量直接影响设备稳定性和晶圆良率，是集成电路制造中的关键精密零部件。

公司的代表性半导体设备零部件产品情况具体如下：

代表性产品	图示	主要应用工艺	所处设备位置	功能
曲面硅上部电极		半导体等离子体刻蚀工艺	工艺腔体内	实现硅气体分配盘多角度曲面均匀结构，更加精准地控制等离子体的分布特征
硅上部电极				是工艺气体进入反应腔体的通道，控制刻蚀设备工艺气体分布的均匀性
硅环				保证晶圆边缘的刻蚀均匀性，起到聚集等离子体的作用
石英环				在刻蚀机腔体中起到支撑、保护和聚集等离子体的作用
石英盘				安装在腔体顶部，和静电卡盘形成等离子体的反应空间
石英喷嘴				搭配石英盘使用，是工艺气体进入反应腔体的通道，控制刻蚀设备工艺气体分布的均匀性
石英气体分配盘				是工艺气体进入反应腔体的通道，控制刻蚀设备工艺气体分布的均匀性
石英窗				工艺腔体视窗和光学信号通道
碳化硅环				保证晶圆边缘的刻蚀均匀性，起到聚集等离子体的作用，具备更强的耐腐蚀性
塑料固定座				固定硅气体分配盘
塑料导热垫圈				导热散热作用，保持硅气体分配盘工艺温度的稳定性

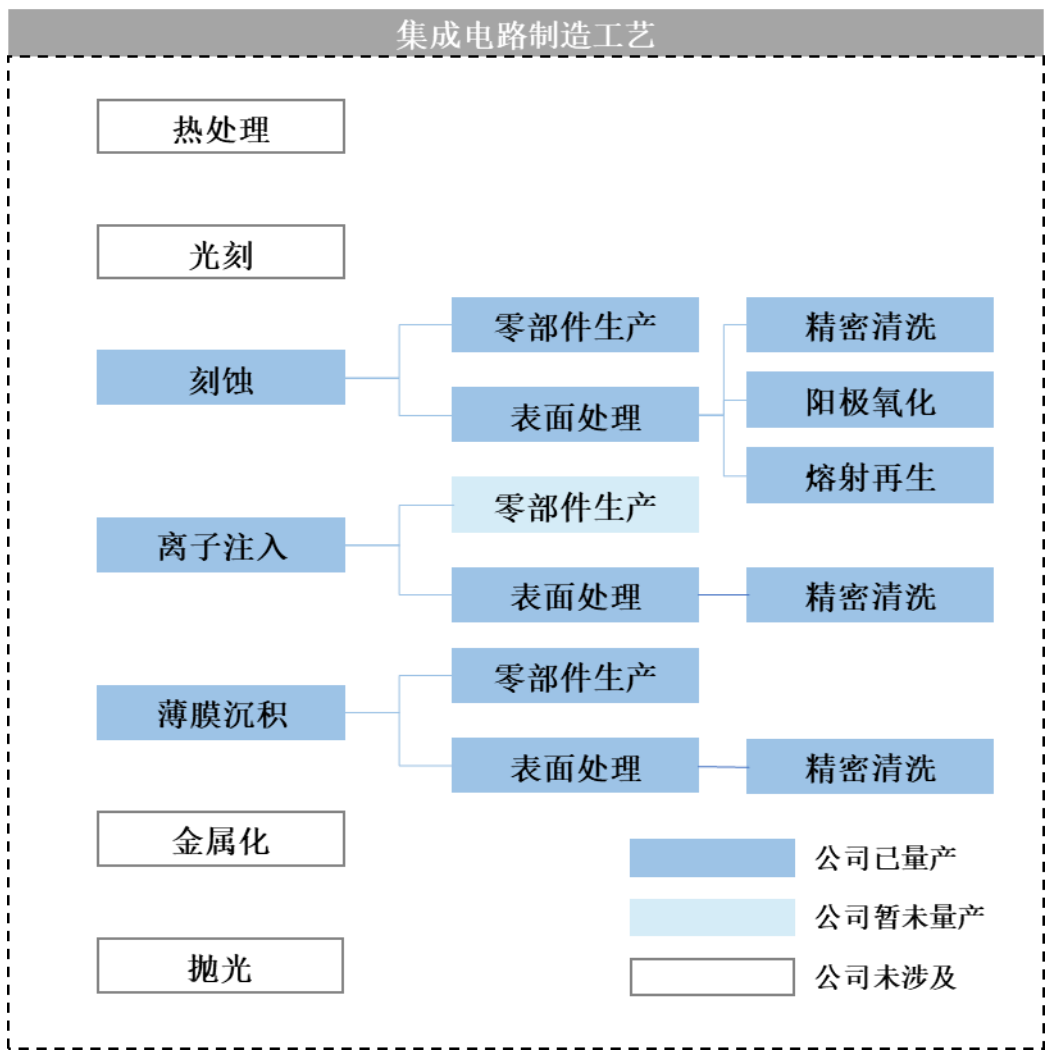
（2）半导体设备零部件的应用领域

1）公司产品及服务在集成电路制造流程中的应用环节

受光刻机光波长的物理限制，当逻辑芯片制程向 14nm/7nm 及以下技术节点演

进时，必须采用多重曝光与多重刻蚀工艺组合的技术方案，才能实现更小线宽的特征尺寸加工。根据 SEMI 统计数据显示，20nm 工艺需要的刻蚀步骤约为 50 次，而 10nm 和 7nm 工艺所需刻蚀步骤超过 100 次。此外，随着存储芯片堆叠层数从 1XX 层向 2XX/3XX 层以上演进，高深宽比刻蚀工艺的应用频次显著增加，更高堆叠层数的制造工艺亦对刻蚀速率、刻蚀精度和刻蚀稳定性提出了更为严苛的要求。在人工智能大浪潮下，高性能 CPU、GPU 和 HBM 存储芯片不仅大幅提升了对刻蚀设备的技术要求和市场需求量，也进一步提高了对相关核心零部件的技术要求。

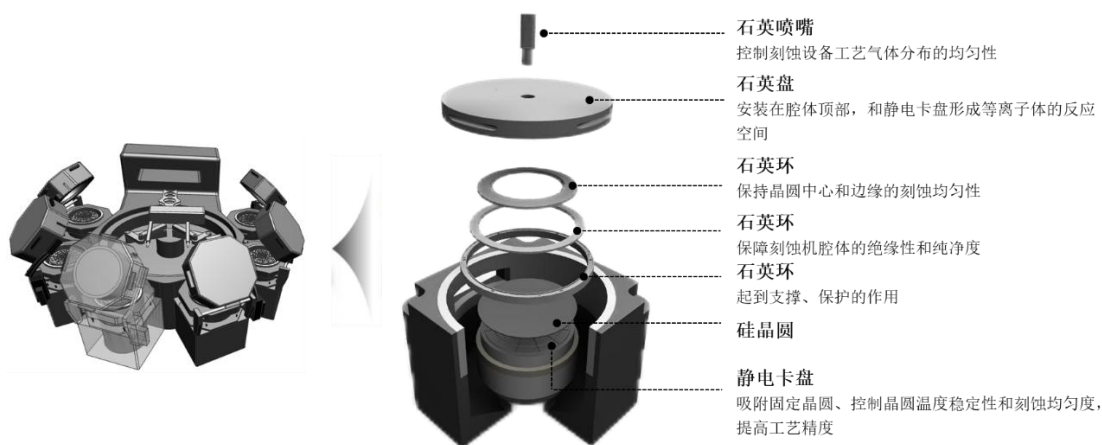
公司产品和表面处理服务在集成电路制造流程中主要应用于如下环节：



2) 公司主要产品在半导体设备中的典型应用情况

①电感耦合等离子体刻蚀设备（ICP）

图：公司主要产品在半导体 ICP 刻蚀设备反应腔内的应用情况

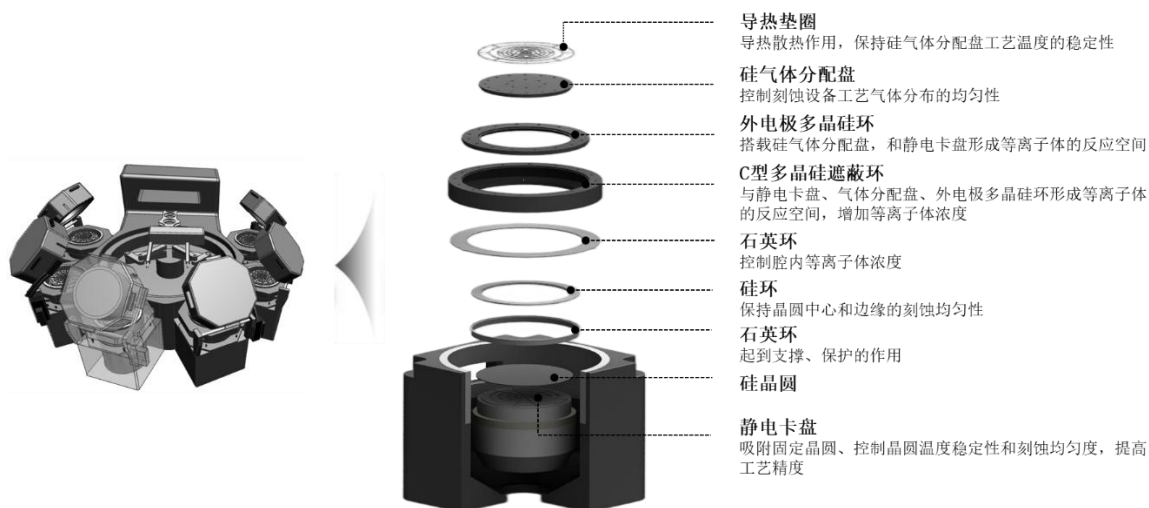


注 1：图示为概念性示意图，不代表实际空间分布

注 2：仅列示代表性产品，部分产品正在研发中

②电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）

图：公司主要产品在半导体 CCP 刻蚀设备反应腔内的应用情况



注 1：图示为概念性示意图，不代表实际空间分布

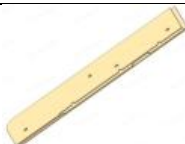
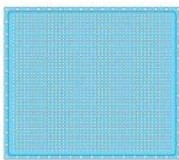
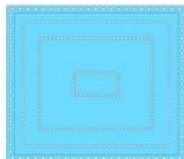
注 2：仅列示代表性产品，部分产品正在研发中

2、显示面板设备零部件产品

(1) 显示面板设备零部件产品介绍

报告期内，公司用于显示面板设备的零部件产品主要应用于等离子体刻蚀和化学气相沉积设备的工艺腔体内，其中部分零部件直接与玻璃基板接触，是显示面板制造中关键精密零部件。

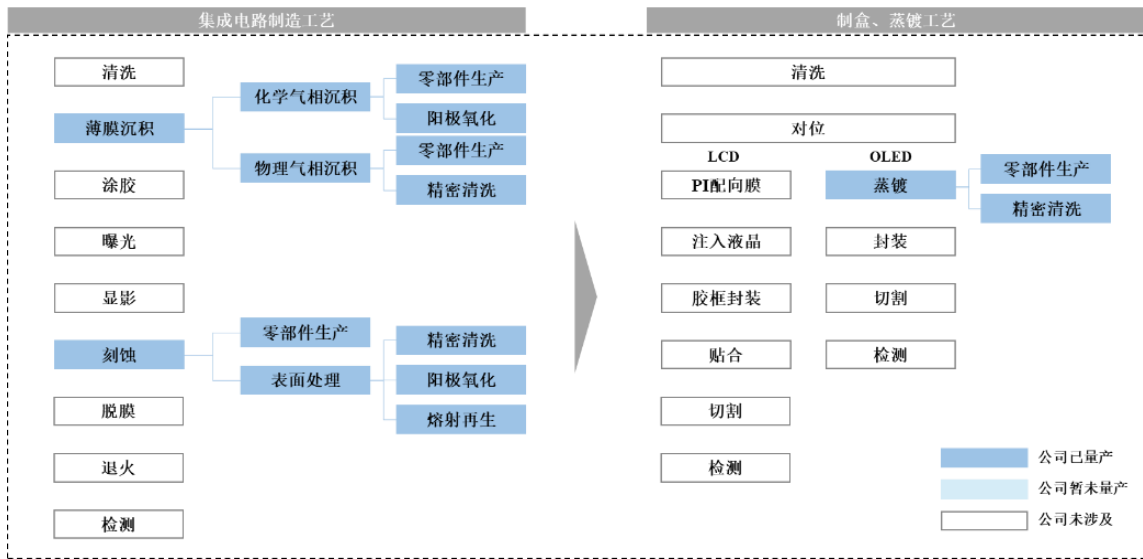
公司的代表性显示面板设备零部件产品的具体情况如下：

代表性产品	图示	主要应用工艺	所处设备位置	功能
陶瓷筒		显示面板化学气相沉积	工艺腔体内	陶瓷筒和陶瓷杆组合，控制玻璃基板在腔体内升降，起承重基板作用
陶瓷杆				
陶瓷板		显示面板等离子体刻蚀、化学气相沉积等		隔离、保护工艺腔体及零部件
上部电极		显示面板等离子体刻蚀		在铝合金结构上进行阳极氧化和熔射再生，控制工艺气体均匀地进入反应腔体
静电卡盘				在金属母材上进行钨和氧化铝涂层，是玻璃基板的载体，起到承载、吸附和控制玻璃基板温度的作用
壁板		面板显示等离子体刻蚀	工艺腔体内	隔离、保护工艺腔体及零部件

(2) 显示面板设备零部件的应用领域

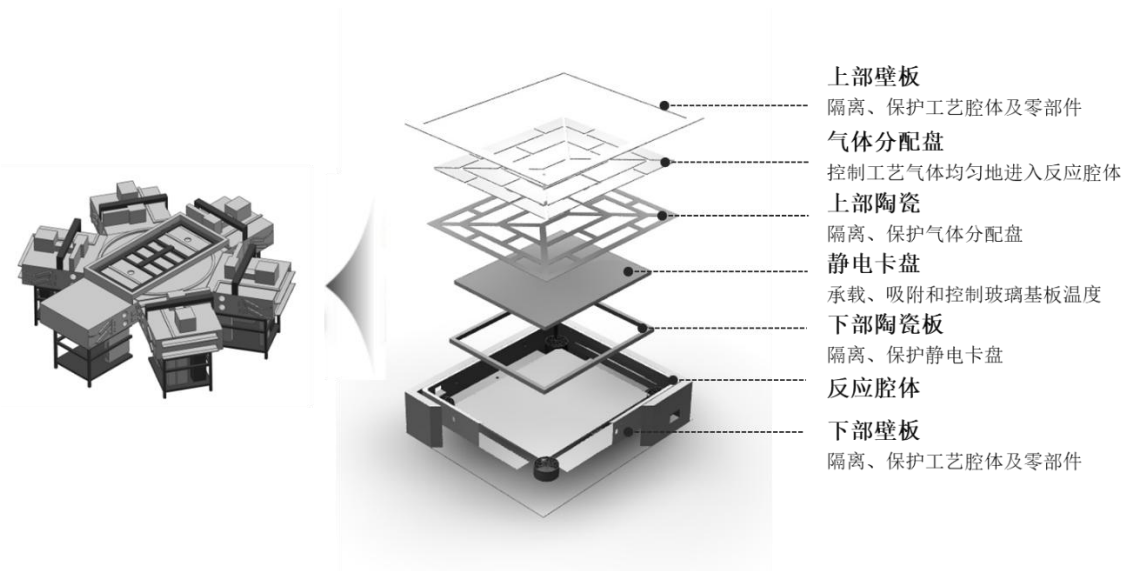
1) 公司产品及服务在显示面板制造流程中的应用环节

公司产品及表面处理服务已在京东方、华星光电、天马微电子、惠科股份和彩虹光电等国内主流显示面板厂实现稳定供应，公司产品和表面处理服务在显示面板制造流程中主要应用于如下工艺环节：



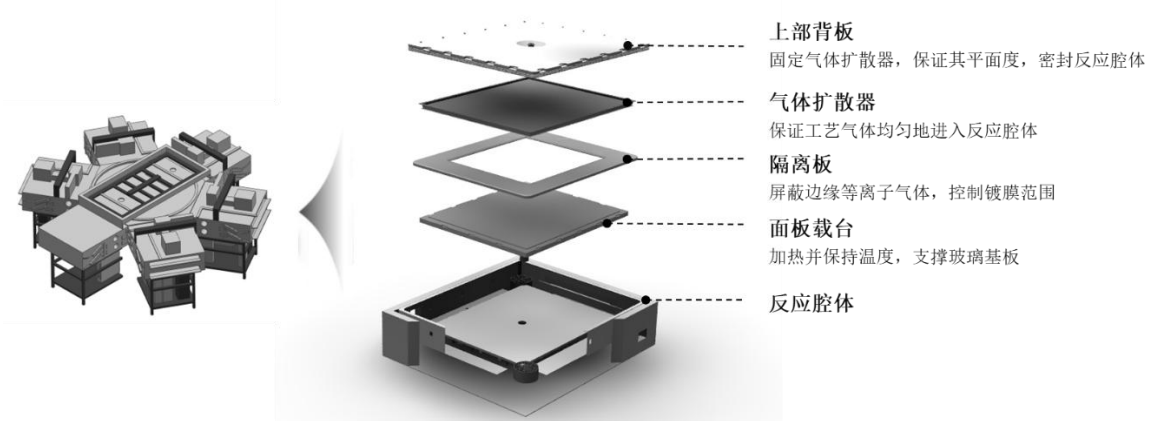
2) 公司主要产品在显示面板设备中的典型应用情况

图：公司主要产品在显示面板等离子体刻蚀设备反应腔内的应用情况



注 1：图示为概念性示意图，不代表实际空间分布

图：公司主要产品在显示面板薄膜沉积设备反应腔内的应用情况



注 1：图示为概念性示意图，不代表实际空间分布

3、表面处理服务

集成电路和显示面板设备零部件在极端工艺环境（如高功率、强腐蚀性等离子体）中易受污染与损耗，表面处理技术可以提升零部件性能与使用寿命，例如通过精密清洗去除零部件表面颗粒物、通过阳极氧化提高耐腐蚀性和通过熔射再生修复零部件缺陷。随着先进工艺制程和 3D 堆叠工艺的发展，集成电路行业表面处理技术要求大幅提高，公司依托面板行业积累的表面处理技术和高强度的研发投入，半导体设备零部件表面处理业务规模持续增长。

公司表面处理服务主要包括精密清洗、阳极氧化和熔射再生，并在高致密涂层制备技术领域实现了阶段性突破，提升了腔体内零部件的耐腐蚀性和使用寿命，增强了在先进制程工艺环境下的稳定性，成功拓展了国内集成电路制造行业头部客户的表面处理业务，巩固了在国内集成电路和显示面板设备零部件领域的市场地位。

公司表面处理服务在显示面板和集成电路制造领域的具体应用情况如下：

业务类型	功能与作用	设备零部件应用工艺		图示
精密清洗	通过物理、化学等方式去除零部件在工艺腔体内使用过程中产生的污染物	显示面板	刻蚀、薄膜沉积、蒸镀	
		半导体	刻蚀、薄膜沉积	

业务类型		功能与作用	设备零部件应用工艺		图示
阳极氧化		铝合金在相应的电解液和特定的工艺条件下，外加电流使其表面形成氧化膜，提高部件耐电压性及耐腐蚀性	显示面板	薄膜沉积、刻蚀	
			半导体	刻蚀	
熔射再生	等离子熔射	使用熔射方式将氧化铝、氧化钇等材料以涂层的形式涂覆到零部件表面，以提高其耐腐蚀性、绝缘电性	显示面板	刻蚀、薄膜沉积	
			半导体	刻蚀	
	电弧铝熔射	在零部件表面覆盖铝层，改善部件表面状态、延长部件使用寿命	显示面板	薄膜沉积	
			半导体		

4、半导体原材料业务

公司原材料包括大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积碳化硅、氧化铝陶瓷造粒粉和氧化钇陶瓷造粒粉等关键半导体材料，主要用于硅零部件、碳化硅零部件和陶瓷零部件等核心零部件的生产。公司通过原材料的自主研发生产，满足了先进工艺客户对硅材料和碳化硅材料的定制化要求，保证了自身供应链安全性和稳定性。

公司主要原材料业务的具体情况如下：

材料名称	应用环节	图示
硅棒（单晶、多晶）	用于硅气体分配盘、硅环等硅零部件的生产，主要应用于等离子体刻蚀设备等	
化学气相沉积碳化硅	用于碳化硅环等零部件的生产，主要应用于等离子体刻蚀设备等	
陶瓷造粒粉	用于陶瓷零部件的生产，主要应用于等离子体刻蚀设备、薄膜沉积设备等	

5、公司重点在研产品与技术

（1）半导体静电卡盘（ESC）

半导体静电卡盘是刻蚀、薄膜沉积等设备真空腔体内的关键零部件，通过静电力固定晶圆并实现分区精准控温，直接决定晶圆加工均匀性和良率。目前全球静电卡盘市场主要由美系、日系和韩系制造商主导，包括美国 AMAT/Lam、日本

Shinko/TOTO 和韩国 MiCo/LK 等，国产化率极低，国内尚无稳定量产企业。根据 QY Research 数据，2022-2028 年全球静电卡盘市场销售额将由 17.9 亿美元增加至 24.1 亿美元。

（2）氮化铝陶瓷加热器

陶瓷加热器是半导体薄膜沉积等设备中的重要部件，具有高精度控温与快速升降温能力。该部件与晶圆直接接触，起到承载晶圆、控制温度均匀性和稳定性的功能，优化材料沉积或刻蚀均匀度，提升晶圆良率，是半导体薄膜沉积设备中的关键零部件。目前氮化铝陶瓷加热器市场主要由日系制造商主导，包括日本 NGK/NTK、Sumitomo Electric 等国际企业，相比之下，国内该领域的产业化程度较低，国产化率不足 10%，具备稳定量产能力的企业较少。根据 QY Research 调研显示，2023 年全球半导体陶瓷加热器市场规模大约为 14.28 亿美元，预计 2030 年将达到 21.56 亿美元，2024-2030 期间年复合增长率（CAGR）为 6.2%。

（3）碳化硅气体分配盘

碳化硅气体分配盘是刻蚀工艺气体进入反应腔体的通道，用以控制刻蚀工艺气体分布的均匀性，直接影响工艺精度和晶圆良率。碳化硅气体分配盘导热性好，抗等离子体腐蚀能力比硅和石英强，使用寿命是硅气体分配盘的 2-4 倍，提高了等离子体刻蚀设备的工作在线率。全球碳化硅气体分配盘主要由日系、韩系制造商主导，国内尚无稳定量产企业。根据 QYR 的统计及预测，2023 年全球刻蚀设备用气体分配盘（含硅、金属、碳化硅材质）市场销售额达到了 9.44 亿美元，预计 2030 年将达到 15.44 亿美元，年复合增长率为 7.0%，其中碳化硅气体分配盘的比例有望持续上升。

（4）高致密涂层技术（GD Coating）

高致密涂层技术可以提高先进制程反应环境中零部件的耐等离子腐蚀能力，从而减少污染颗粒物的产生，延长零部件使用寿命和提升设备使用效率。随着半导体制造工艺向先进制程节点演进，刻蚀真空反应腔体内的设备零部件需要承受更高能量的等离子体轰击，因此刻蚀工艺对污染颗粒物的管控要求显著提升。目前等离子

熔射等涂层技术的孔隙率可以达到 1-3%，而高致密涂层技术的目标是将孔隙率控制在趋近于 0 的水平。目前，高致密涂层技术主要被日韩企业垄断，国内尚未实现稳定量产。

6、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、半导体行业	65,564.98	77.54%	45,687.11	72.21%	31,864.14	63.15%
零部件产品	61,313.59	72.51%	43,064.36	68.07%	30,541.94	60.53%
表面处理服务	2,970.91	3.51%	1,998.97	3.16%	930.56	1.84%
其他	1,280.48	1.51%	623.78	0.99%	391.63	0.78%
二、显示面板行业	18,916.73	22.37%	17,203.95	27.19%	18,083.52	35.84%
表面处理服务	13,622.17	16.11%	12,766.38	20.18%	13,943.35	27.63%
零部件产品	5,288.21	6.25%	4,430.15	7.00%	4,093.37	8.11%
其他	6.35	0.01%	7.41	0.01%	46.81	0.09%
三、其他行业	75.19	0.09%	377.66	0.60%	513.48	1.02%
合计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 50,461.13 万元、63,268.72 万元和 **84,556.89 万元**。主营业务收入主要来源于半导体行业及显示面板行业的产品及服务收入，主要产品包括石英零部件、硅零部件、工程塑料零部件、碳化硅零部件和陶瓷零部件等，以及前述设备核心零部件表面处理服务。

（三）公司主要经营模式

公司自成立以来，专注于为集成电路及显示面板等客户提供设备真空腔内零部件及表面处理服务，建立了完整高效、相互协同的采购、生产、销售和研发流程。公司以技术创新为驱动力，持续深耕等离子体刻蚀、薄膜沉积等关键环节半导体设备零部件和显示面板等离子刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等关键环节显示面板制造设备零部件领域，致力于打造“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，向客户提供

真空腔体内的多品类零部件整体解决方案。

依托于大直径单晶硅棒、化学气相沉积碳化硅、陶瓷粉体等关键半导体材料技术突破和曲面硅上部电极、石英气体分配盘、超纯碳化硅环等核心零部件产品品类拓展，公司致力于支撑国内先进制程集成电路制造厂商和显示面板企业的研发和生产，助力国产集成电路和显示面板供应链的自主可控和可持续发展。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

（1）直接采购

公司制定了严格的合格供应商准入制度，主要采用以销定采模式，通过询价、比价、议价方式在合格供应商名录中确定供应商。公司采购部负责企业日常经营所需物料、耗材和设备的采购。

（2）外协加工采购

报告期内，公司外协主要包括机加工外协和表面处理外协。当产能不足时，公司将部分产品的机加工工序和表面处理工序委托外协供应商完成。报告期内，公司外协加工占采购总额的比例较小，不存在将主要生产环节委外加工的情况。

（3）成品采购

为满足客户的一站式零部件需求，公司在自主生产核心产品的同时，亦向合格供应商采购部分零部件成品，以完善产品组合、提升供应链效率，确保及时响应客户多样化需求。

2、生产模式

公司业务具有“多品种、小批量”的特点，主要系相关设备零部件种类繁多、工艺复杂所致。

在零部件生产方面，公司主要采取“以销定产”的生产模式，也会根据市场行情做适当备货。公司在汇总销售需求和备货需求后由生产部门和销售部门结合库存、产能情况决定产量需求，由生产部门制定生产计划并进行生产排产，并跟进生产进

度，确保按期完工。

针对部分研发试产成功但客户需求量尚未打开的产品，或因产能不足、原材料受限等原因，公司采用 OEM 模式进行生产，后续根据需求、产能或原材料供应等情况再自建产能进行生产，即公司向 OEM 供应商发送产品图纸、技术参数要求，OEM 供应商根据采购订单的要求进行生产、质检和交货。

在表面处理业务方面，公司根据客户订单及预计订单安排作业计划。一般来说，单批次处理零部件数量从几十件到几百件不等，并根据零部件特征和客户需求差异，选择精密清洗、阳极氧化和熔射再生中的一种或多种方式组合处理。

3、销售模式

公司下游客户主要为集成电路和显示面板制造企业。公司通过多渠道掌握行业发展动态和客户需求，通过展会、一对一拜访等形式推介公司产品与服务。在对公司资质、实力和经验等多维度考察后，客户将公司纳入其供应商名录。产品经客户测试通过后，公司与客户通过价格谈判或电子竞价等方式签订订单并开展合作。

公司以直销模式为主，直接与集成电路和显示面板制造企业合作。公司在重庆、成都、上海、武汉、北京、深圳、合肥和新加坡等地组建了办事处或销售团队，由销售部门面向终端客户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务，客户直接向公司询价并下订单。公司依托已建立的重庆和湖北两个生产基地，实现对国内主要集成电路和显示面板制造区域的覆盖。

4、研发模式

公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，形成了科学的研发体系和规范的研发流程。公司积极引入半导体材料、物理化学、微电子、机械等专业人才，开展半导体材料、产品工艺、精密制造以及化学表面处理技术等研发，协助客户在现有设备上进行新工艺开发。公司的研发流程主要包括：研发项目立项、执行、验收与结题三个阶段。

公司市场部门和研发部门通过对集成电路和显示面板领域零部件痛点和工艺演进趋势进行深入调研，结合行业现有技术水平及下游市场发展趋势，确定研发方向、

技术路线和规格参数，进行生产工艺的研发。公司及时了解客户诉求，协助客户提高生产效率和产品良率，保障客户新技术、新工艺需求的落实。

5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

目前行业内存在两种经营模式：一是直接配套模式，即零部件企业直接与集成电路制造厂商或显示面板厂商合作，是其一级供应商或直接供应商；二是间接配套模式，即零部件企业与设备厂商合作，通过设备厂商间接配套集成电路制造厂商或显示面板厂商，是其二级供应商或间接供应商。

在间接配套模式下，零部件企业通常根据设备厂商的需求和图纸来研发或生产相应零部件。该模式下设备厂商通常要求零部件厂商签署排他性协议，且该模式下零部件产品的知识产权主要由设备厂商掌握。受限于排他性协议约定和设备厂商的知识产权限制，相关零部件产品仅可向该设备厂商供应，由其向集成电路制造厂商供货，无法直接向集成电路制造厂商销售或者需要向设备厂商缴纳授权费用。另外，设备厂商通常针对不同类型设备零部件（例如硅零部件、石英零部件、金属零部件）会分别选取多家 OEM 供应商，因此间接供应商产品类型普遍相对单一。

在半导体刻蚀设备领域，泛林（Lam）、东京电子（TEL）和应用材料（AMAT）的全球市场占有率达到 90%以上；在薄膜沉积设备领域，泛林（Lam）、东京电子（TEL）、应用材料（AMAT）和先晶半导体（ASMI）的全球市场占有率达到 80%以上。上述设备厂商不仅向中国集成电路制造企业供应高端设备，还持续提供核心零部件及表面处理服务。尽管近年来国内设备厂商在技术研发和市场拓展方面取得显著进展，但外资品牌在先进制程领域仍占据主导地位。目前，中国在先进半导体设备采购方面正面临欧美日等国的出口限制，后续核心零部件的供应也面临断供风险。与此同时，国内集成电路制造企业在工艺升级方面也受到制约，在先进设备采购受限的情况下，不得不在现有设备上通过优化零部件的结构、升级零部件的性能等方式来适配新工艺开发需求，例如，在极紫外（EUV）光刻机获取受限的情况下，国内集成电路制造厂商基于深紫外（DUV）光刻平台成功开发出 N+1 和 N+2 工艺节点技术。

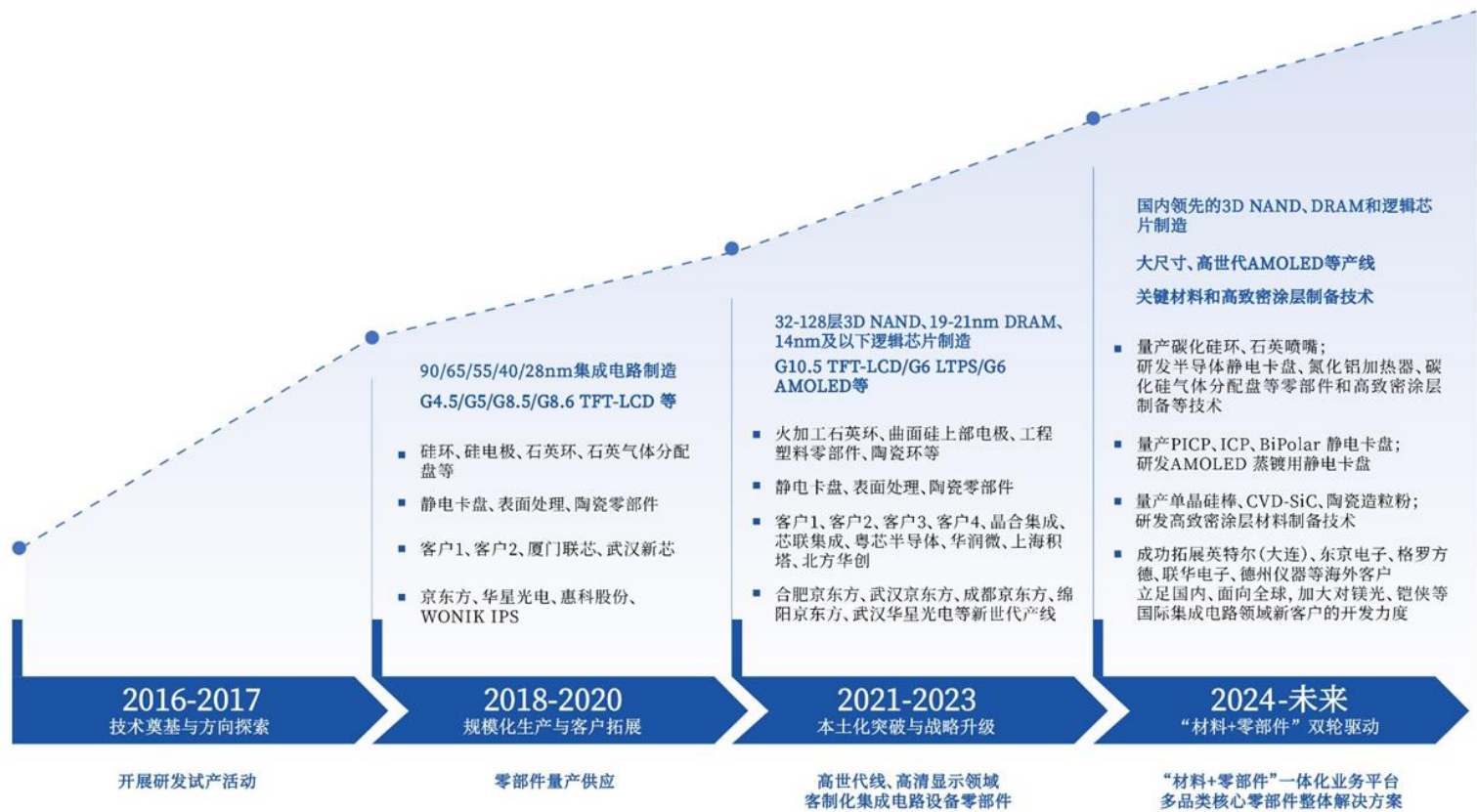
公司选择直接配套的经营模式，主要原因是：（1）硅、石英、碳化硅和陶瓷等零部件产品主要应用于刻蚀、薄膜沉积和蒸镀设备反应腔内，属于消耗性零部件，更换周期短，最大需求方是集成电路和显示面板制造厂商；（2）直接向国内集成电路和显示面板制造厂商供应零部件，可以避免国外设备厂商对上述制造厂商可能的断供风险，保障客户供应链安全；（3）该业务模式使公司拥有自主知识产权和产品设计能力，具备提供真空反应腔体内的关键半导体材料和零部件整体解决方案的能力；（4）公司可以对终端制造客户的多元化需求作出迅速反应，能够有效配合集成电路制造厂商在现有设备基础上的新工艺开发需求。

综上，公司结合主要产品和服务特点、自身发展历史、竞争优劣势以及国家产业政策、宏观背景和同行业竞争对手等因素，形成了目前的经营模式，符合自身发展及行业特点，符合自主可控的行业发展趋势。报告期内，上述因素并未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

6、公司成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司设立以来即专注于集成电路及显示面板刻蚀、薄膜沉积和蒸镀设备真空腔内零部件及零部件表面处理服务，自主研发成熟制程等离子体刻蚀设备零部件，及 TFT LCD 显示面板用下部电极。公司逐步拓展集成电路先进制程等离子体刻蚀、薄膜沉积设备零部件，及显示面板高世代线、AMOLED 电极产品及表面处理服务。公司坚持“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台的定位，持续加大先进世代产线、先进制程领域的设备零部件和表面处理技术的研发投入，立足国内面向全球持续拓展国际集成电路领域新客户。公司自成立以来主要经营模式未发生变化。

图：公司成立以来主要业务及代表性产品发展历程



7、公司主要业务经营情况及核心技术产业化情况

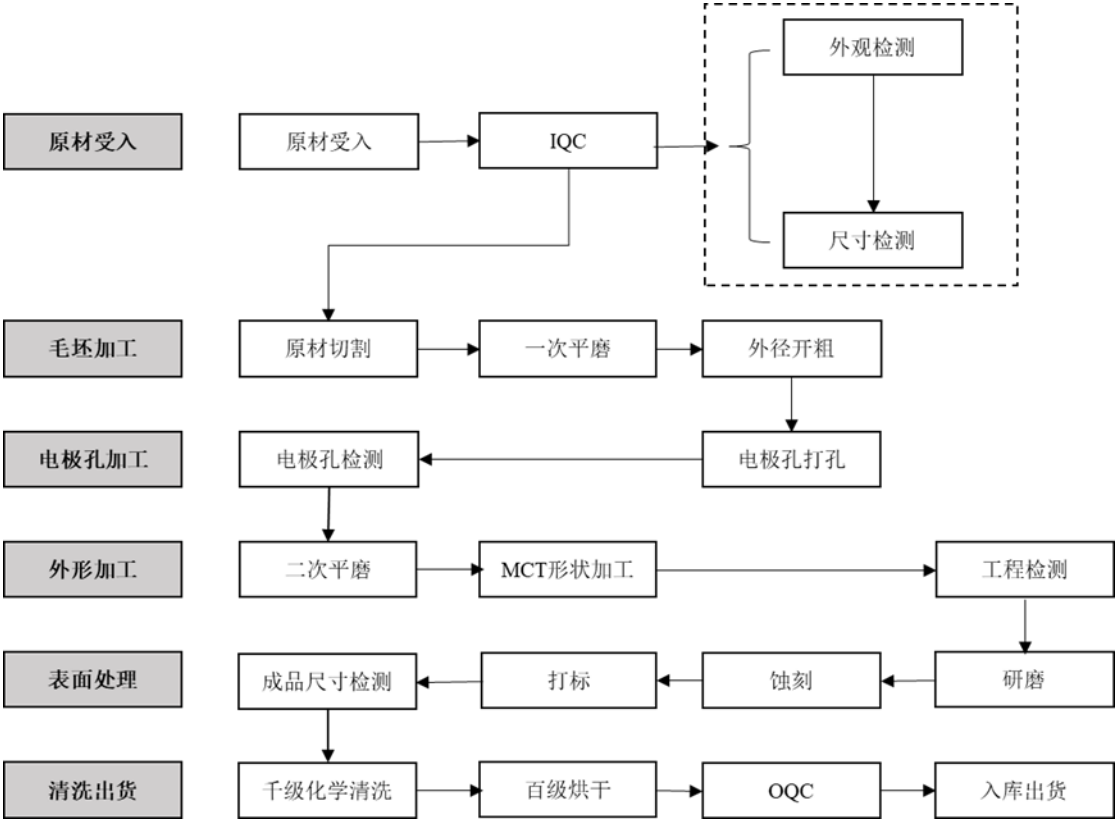
报告期内的主要经营和财务数据详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”。公司的核心技术广泛应用于集成电路及显示面板设备零部件产品的生产及表面处理服务，报告期内公司核心技术产生的收入分别为 40,551.38 万元、55,458.26 万元和 **77,740.79 万元**，占各期主营业务收入的比例为 80.36%、87.66% 和 **91.94%**。

（四）公司主要产品或服务的流程

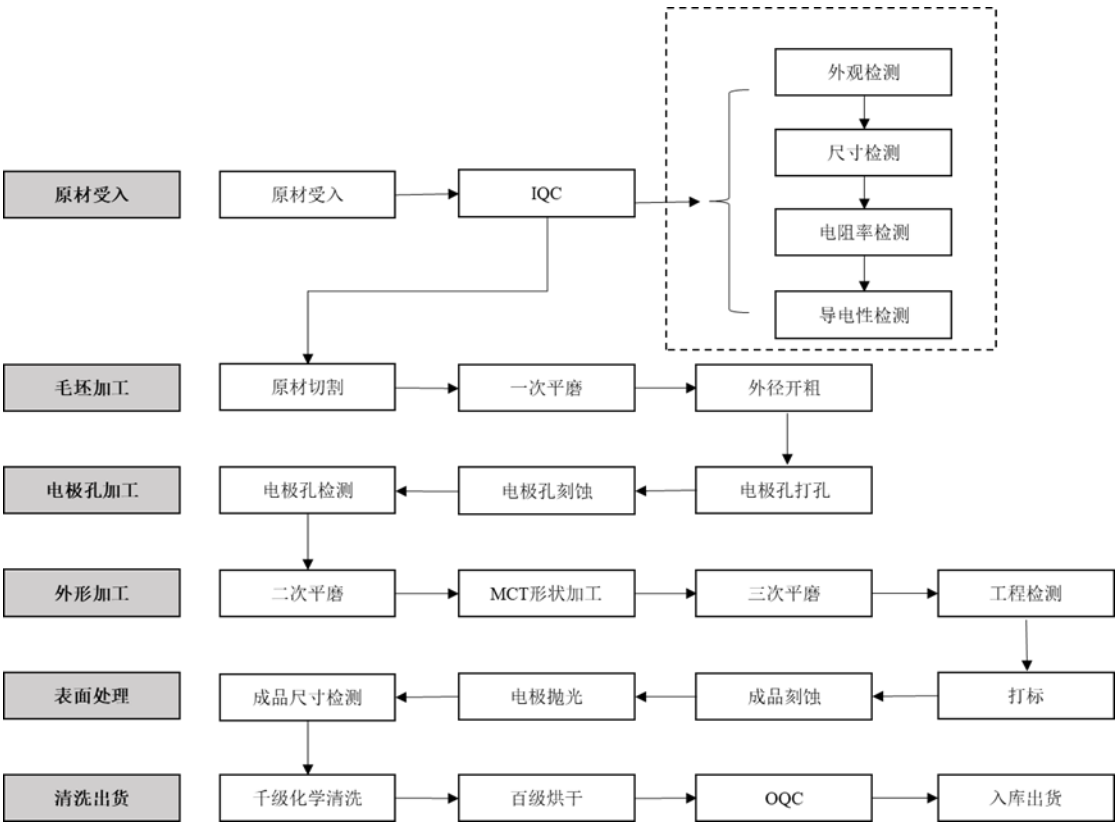
1、零部件生产制造

公司零部件的工艺流程主要包括原材受入、毛坯加工、精加工、表面处理和质量检测等步骤，具体产品的工艺流程图如下：

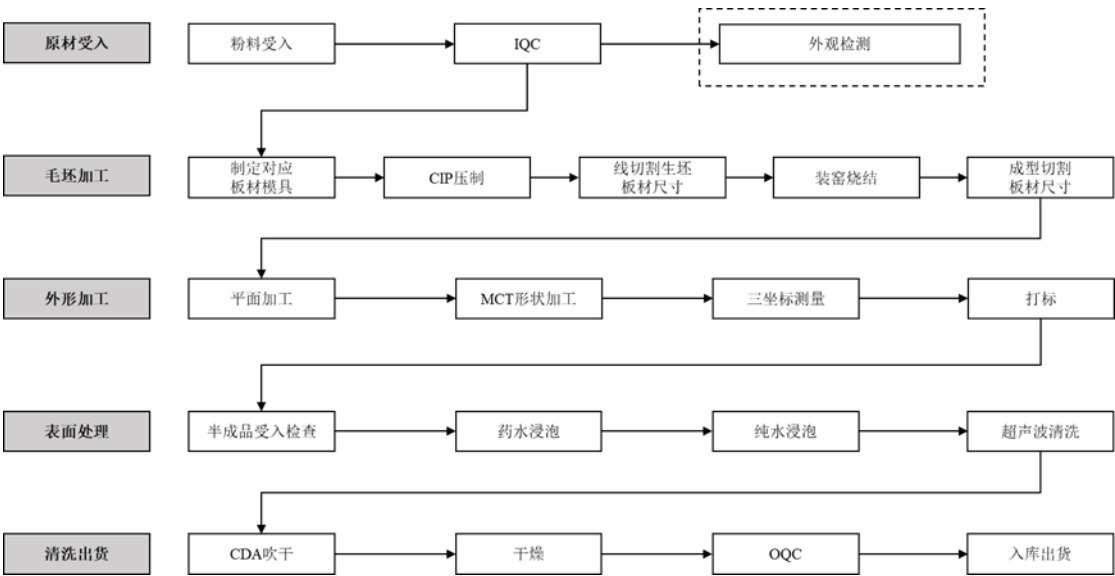
(1) 石英零部件（以石英气体分配盘为例）



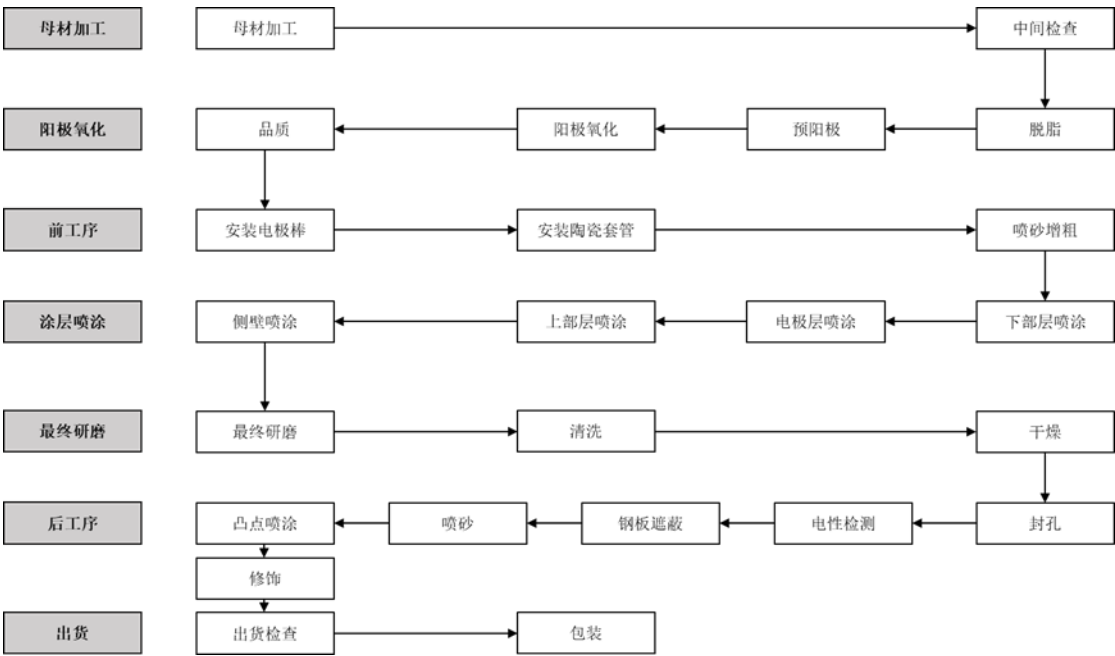
(2) 硅零部件（以硅上部电极为例）



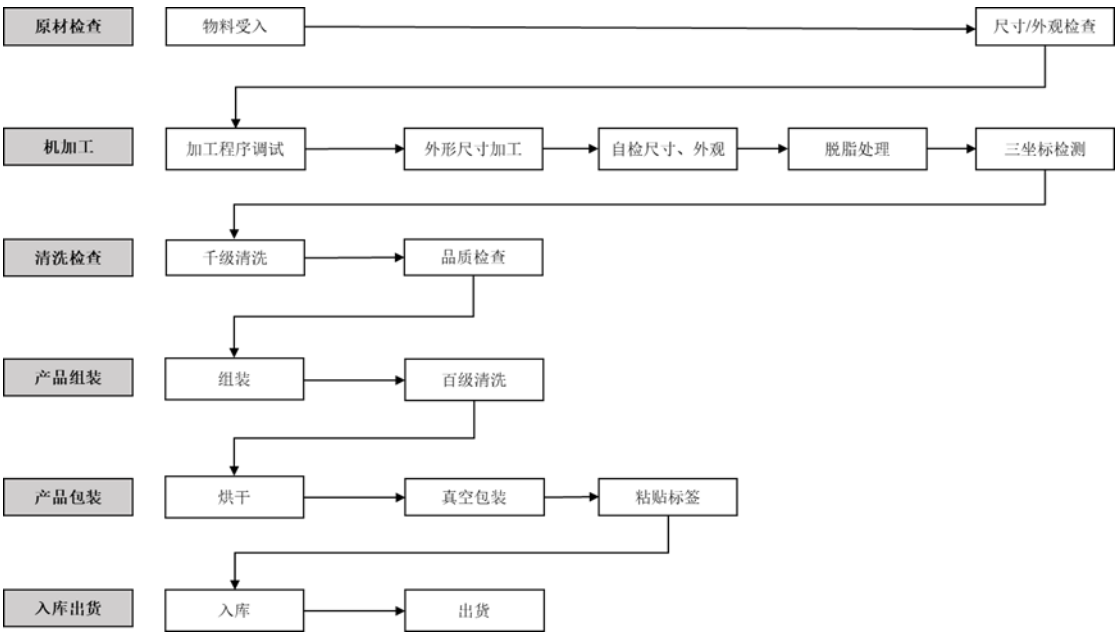
(3) 陶瓷零部件（以陶瓷板为例）



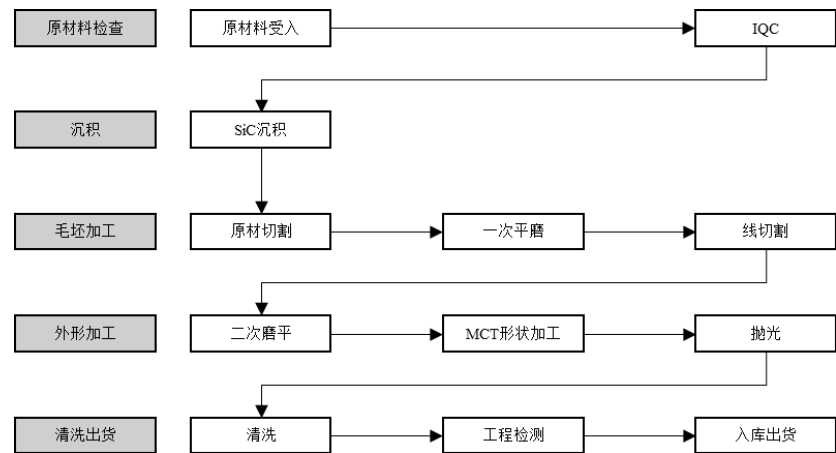
(4) 陶瓷零部件（以显示面板静电卡盘为例）



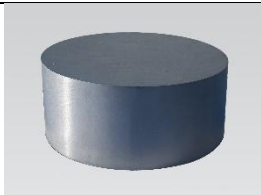
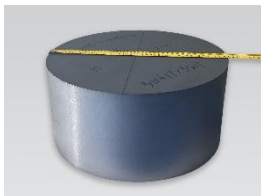
(5) 工程塑料零部件（以塑料固定座为例）

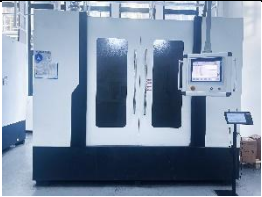


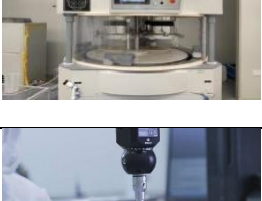
(6) 碳化硅零部件（以碳化硅环为例）

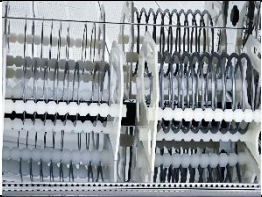
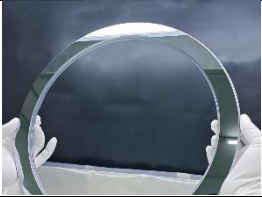


公司对零部件生产全流程进行质量控制，零部件主要生产工序的作用与质量控制流程如下：

工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
1	原 材 受 入	原材受入	-	对整体外包装进行目视检查，确保无外力影响破坏	外 包 装 无 破 损，堆 放 合 理，货 物 规 格、型 号 和 数 量 100%准确
2		IQC 外观检测		原材进行整体光线照射，进行宏观检查	原 材 外 部 无 明 显 缺 口 裂 纹
		IQC 尺寸检测		使用校正游标卡尺和卷尺对材料内外径、高度进行多点采集数据并计算尺寸	内 外 径 和 高 度 尺 寸 应 符 合 出 货 要 求，正 负 余 量 应 控 制 在 公 差 尺 寸 以 内
		IQC 电阻率检测		原材进行表面清洁处理，使用电阻仪在标准环境下对硅材料头端、中端和尾端进行多点正负极测试	原 材 电 阻 率 值 应 符 合 出 货 要 求，电 阻 率 值 稳 定，电 阻 率 正 负 波 动 在

工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
					10%以内
		IQC 导电性检测		原材进行表面处理后使用导电仪在标准环境下对硅材料头端、中端和尾端进行多点测试，鉴别 P/N 类型	原材导电类型应符合出货要求，测试结果稳定，重掺结果符合要求
3	毛坯加工	原材切割		利用金刚石切割线将原材切割成片，为下一工序提供符合尺寸的坯料	尺寸控制，外观检测
4		一次平磨		利用平磨机对坯料上下两个面进行平磨，使上下面达到一定厚度要求	尺寸控制，平行度、平面度控制，外观检测
5		外径开粗		使用外形加工设备 MCT 对产品外径或局部进行加工，加工出一定的基准位置，为后续加工提供加工基准	尺寸控制，外观检测
6	电极加工	电极孔打孔		利用高速钻孔设备对片材进行打孔，达到工艺要求	尺寸控制，外观检测，小孔微观检测
7		电极孔刻蚀		利用特定刻蚀设备和刻蚀液对电极通孔进行刻蚀，去除打孔造成的小孔孔壁破碎层，防止破碎层对客户工艺造成影响	尺寸控制、外观检测，小孔微观检测
8		电极孔检测		对刻蚀后的电极孔进行检测，防止因刻蚀量不足等造成电极孔尺寸不符合要求	尺寸控制，外观检测，小孔微观检测

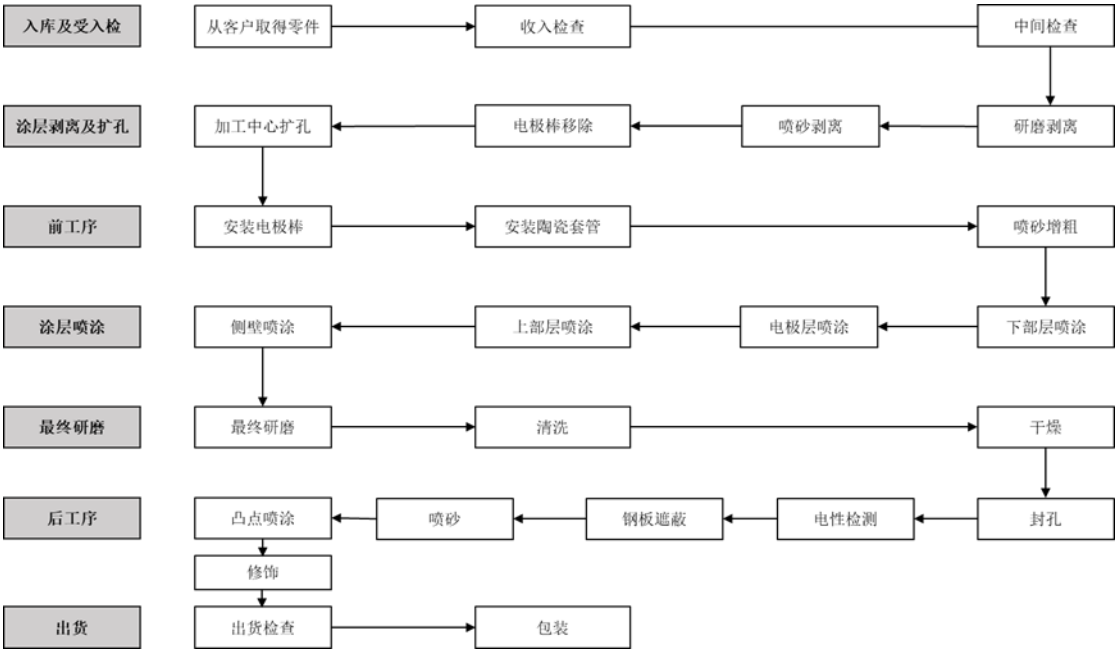
工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
9	外形加工	二次平磨		利用平磨设备对硅片上下面进行平磨，使上下面平行度和平面度达到要求，为后续测量和形状加工做准备	尺寸控制，外观检测
10		形状加工		使用机床、刀具等对二次平磨后的产品进行外型加工	尺寸控制，表面粗糙度控制，外观检测
11		三次平磨		根据工艺要求，利用平磨设备使上下面平行度和平面度达到要求	尺寸控制，外观检测
12		工程检测		根据图纸要求，对产品进行产品外观、尺寸进行检测，对产成品进行有效质量管控	尺寸控制，表面粗糙度控制，外观检测
13	表面处理	打标		对产品进行刻号	刻号和SOP序列号一致
14		成品刻蚀		利用特定刻蚀设备和刻蚀液对整个产品进行刻蚀，去除残留的杂质，改变产品的表面微观状态	尺寸控制、刻蚀时间控制、外观检测
15		电极抛光		对产品的上下或局部位置进行抛光处理，控制表面粗糙度	尺寸控制，外观检测（达到抛光面光洁度、粗糙度要求）
16		成品尺寸检测		根据图纸要求，对产品外观、尺寸进行检测，对产成品进行有效质量管控	尺寸控制，表面粗糙度控制，外观检测

工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
17	清洗出货	千级化学清洗		对整个产品进行脱脂、化学浸泡、纯水冲淋等清洗	溶液浓度，清洗时间等
18		百级烘干		将产品吹干后放入烘箱进行高温烘干，去除表面水分	产品干燥无水分残留
19		OQC		终检，检查外观是否存在裂纹、缺口、划伤等缺陷	产品无裂纹、缺口、划伤、脏污等缺陷
20		入库出货	-	-	-

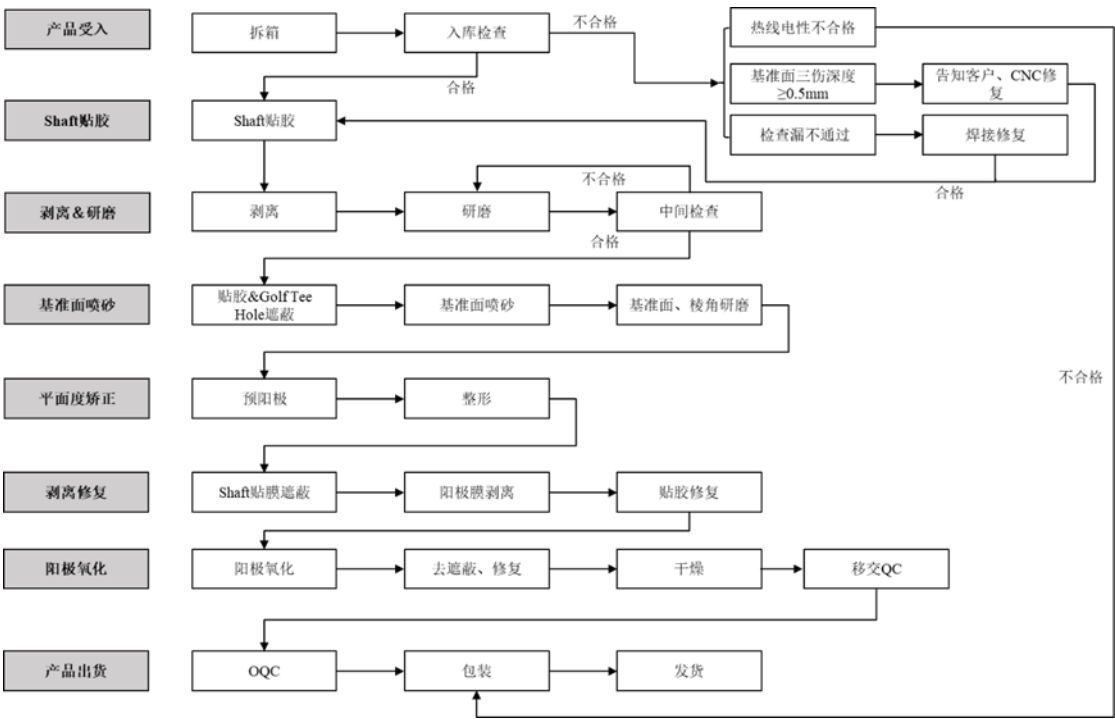
注：本表以硅零部件生产工序为例

2、零部件表面处理服务

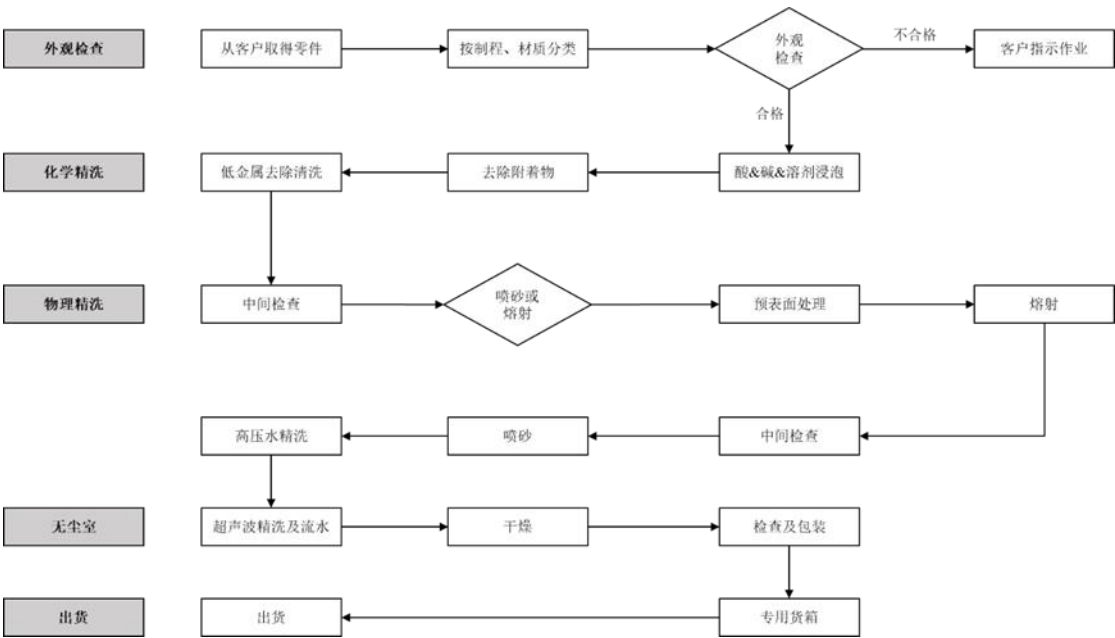
（1）熔射再生（以显示面板静电卡盘熔射再生为例）



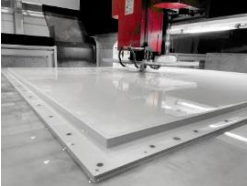
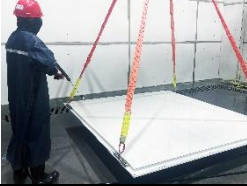
(2) 阳极氧化（以加热基座阳极氧化为例）

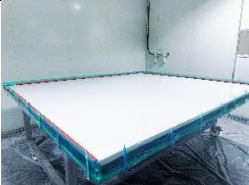
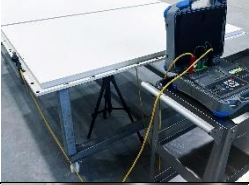
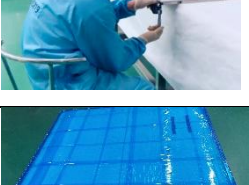


(3) 精密清洗（以陶瓷零部件精密清洗为例）



公司对表面处理服务生产全流程进行质量控制，表面处理服务主要生产工序的作用与质量控制流程如下：

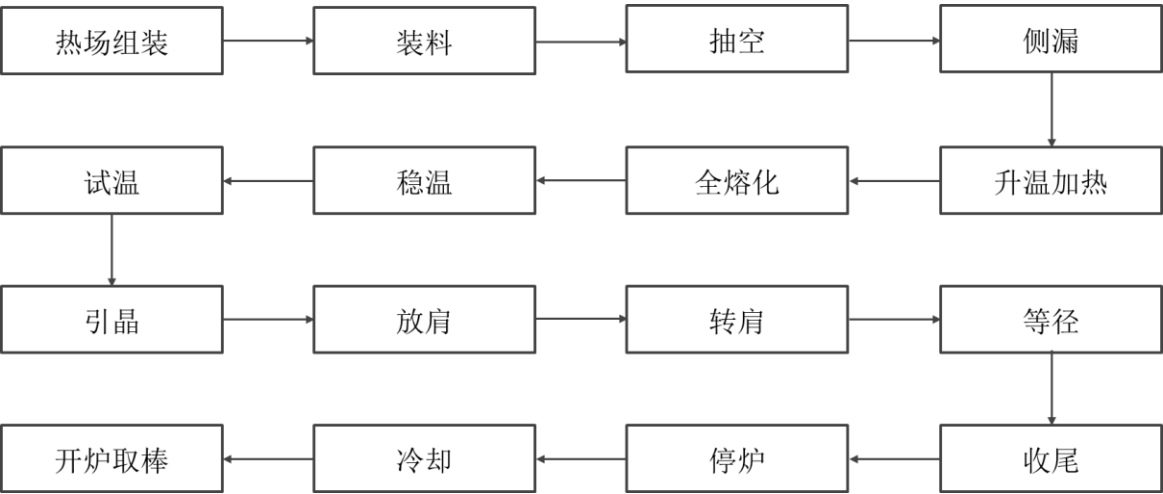
工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
1	入库及入查	从客户取得零件	-	对整体外包装进行目视检查，确保无外力影响破坏	外包装无破损，堆放合理，货物规格、型号和数量100%准确
2		受入检查			
3		中间检查			
4	涂层剥离及扩孔	研磨剥离		通过机械研磨剥离涂层	表面涂层应完全剥离，无明显残留；金属母材的平面度和粗糙度达到要求
5		喷砂剥离		通过压缩空气和砂材的冲击力将涂层剥离	
6		电极棒移除		将电极棒从静电卡盘中取出	
7		加工中心扩孔		通过编程控制加工中心的刀具路径，使用合适的刀具对电极孔等进行扩孔加工	
8	前工序	安装电极棒		将静电卡盘的电极棒装配到指定位置	陶瓷套管与母材孔壁之间的间隙控制，安装电极棒和陶瓷套管与母材表面之间的高低差控制
9		安装陶瓷套管		将静电卡盘的陶瓷套管装配到指定位置	
10		喷砂增粗		在母材表面用喷砂的方式形成需要的粗糙度，保证后续涂层喷涂作业的粘附力	
11	涂层喷涂	下部层喷涂		使用等离子喷涂设备将熔射粉按照各层的要求均匀喷涂在母材的表面	喷涂厚度，厚度偏差，表面无未熔点和其他杂质，无明显缺陷
12		电极层喷涂			
13		上部层喷涂			
14		侧壁喷涂			
15	最终研磨	最终研磨		将喷涂完的静电卡盘按照最终外观尺寸规格和形貌要求进行最终的研磨加工	需满足产品最终的尺寸规格和平坦度，外观无裂纹或污染
16		清洗		将研磨后的静电卡盘进行清洗，去除表面和孔内的粉渣及研磨油后进行干燥	表面无油污，孔内无粉渣
17		干燥			

工序序号	流程步骤	生产工序	工艺过程图示	工序描述与作用	质量控制
18	后 工 序	封孔		对静电卡盘上部绝缘层和下部绝缘层内部细小的空隙使用封孔剂进行封孔，提高绝缘层的绝缘阻抗	封孔后的静电卡盘绝缘电阻达到要求，孔内无封孔剂残留
19		电性检测		测试静电卡盘的介电性能，满足客户工艺要求	通电检测
20		钢板遮蔽		使用定制的穿孔钢板遮蔽静电卡盘表面	遮蔽后的钢板无鼓包，无缝隙
21		喷砂		对遮蔽好的静电卡盘表面进行喷砂，有孔部位被打到喷砂粉而形成需要的粗糙度	钢板遮蔽穿孔部位需达到一定的粗糙度要求，以保证后续凸点喷涂的粘附力
22		凸点喷涂		使用等离子喷涂设备将熔射粉喷涂到静电卡盘表面，之后将钢板从静电卡盘表面取下，遮蔽钢板穿孔部位被喷涂粉末形成凸点	需控制凸点的高度，形貌是否有异常，是否有凸点脱落情况
23		修饰		对静电卡盘的表面边角和螺丝孔进行修饰，去除毛边或对涂层进行倒角	孔位边缘涂层无凸起，无不规则毛边等
24	出 货	出货检查		整体检查静电卡盘的表面尺寸规格，绝缘阻抗，外观	尺寸在规格内，绝缘阻抗和耐电压性能满足要求，外观无凹坑，裂纹或凸起
25		包装		使用双层包装膜进行真空包装并放入静电卡盘专用周转箱进行打包	内部放干燥剂防潮，表面防尘防雨

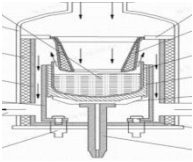
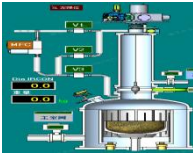
注：本表以静电卡盘熔射再生服务工序为例

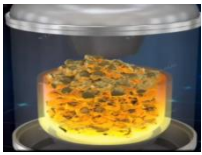
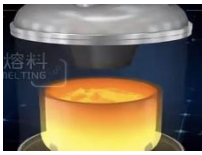
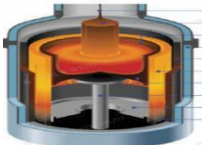
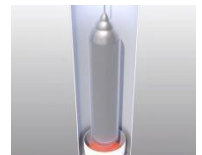
3、原材料制造

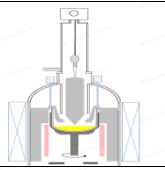
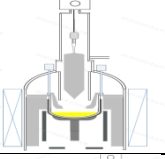
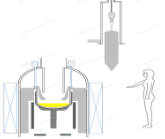
以单晶硅棒为例，公司原材料的制造流程如下：



公司对原材料业务生产全流程进行质量控制，原材料业务主要生产工序的作用与质量控制流程如下：

序号	生产工序	工艺过程图示	工艺描述与作用	质量控制
1	热场组装		将石墨件和固化毡按顺序依次从底部往上进行逐步安装，使其整套热场安装完成	安装过程中检查各部件连接时松紧度适中，部件与部件之间的间距保证在安全数据内控制
2	装料		将硅料按照大小料搭配装入石英坩埚内，依次一层一层向上填充硅料，使石英坩埚内硅料整体填充度要有均匀性	装料时严禁硅料与石英坩埚发生碰撞或冲击力，硅料禁止超出石英坩埚内壁以外
3	抽空		装完料后将炉体上部合炉，打开主真空泵进行抽空，抽空过程反复冲入 2-3 次氩气增加真空效率，直至真空到达安全极限值	抽空合炉时用酒精将密封圈连接擦拭干净，检查是否有破损，避免抽空时有泄漏的可能性
4	侧漏		炉体真空度达到测漏数值范围后，关闭阀门及主真空泵，记载好关闭后的炉体真空度数值，计时 5-10min 看泄漏率是否合格	等检测 5-10min 后漏率数值，检查是否在合格范围内，如合格即可正常开炉，如不合格则检查漏点

序号	生产工序	工艺过程图示	工艺描述与作用	质量控制
5	升温加热		测漏完成后重新开启主真空泵及阀门，再开启上部氩气阀门向炉体内通入工艺要求流量氩气，开启主/副加热开关进行升温加热	加热过程中随时观察功率、电流、电压，及电阻是否有异常，结合观察炉内状态是否有异常
6	全熔化		通过升温使炉内加热器温度逐步上升，将石英坩埚内所有固体硅料慢慢熔化为液体，达到全熔液体状态即可	通过坩埚旋转和升降调整，观察是否有固体硅料挂边现象，以及观察炉内状态确认坩埚底部硅料全熔化完
7	稳温		硅料全熔后将加热功率逐步降低至引晶功率状态，坩埚/晶体旋转速度慢慢加快至工艺匹配速度，坩埚逐步分阶段性上升至待引晶坩埚位	硅料全熔后禁止快速将坩埚上升至引晶坩埚位，观察温度下降数值结合炉内液体状态，逐步上升坩埚位
8	试温		待炉内整体温度稳定后，将籽晶缓慢下降插入液体表面 1-2mm，观察光圈状态判断温度是否合适	试温时籽晶插入液体少量，接触到硅液体直至熔接出光圈，光圈圆润饱满即可
9	引晶		待籽晶试温光圈稳定后进入自动引晶状态进行引晶至工艺要求长度即可，从籽晶直径慢慢缩小至细晶直径均匀拉制目标长度	引晶过程中严控细晶直径大小在 4-6mm 区间，不宜过大或过小，有效排除位错产生
10	放肩		引晶完成后进入放肩生长过程，通过降温调节工艺控制结合晶上升速度调节，使晶体直径生长至目标直径大小	放肩过程主要管控放肩角度形态及晶线状态，直径生长控制达到目标直径
11	转肩		肩部直径到达目标直径后，将由横向生长状态通过晶升/坩升速度调节结合工艺温度控制转成竖向生长状态	将晶体转至目标直径持续控制，维持竖向生长状态
12	等径		将晶体保持目标直径拉制和晶线状态监测，通过晶升/坩升速度及温度等工艺调节控制，使晶体保持目标直径竖向圆柱体生长至目标长度	控制晶体直径均匀生长至目标长度，整个生长过程晶线需保持与晶体一致生长状态
13	收尾		待晶体拉制至目标长度时，调整晶升/坩升速度及温度等工艺调节将晶体直径缓慢缩小至圆锥体形状	收尾长度应保持在一个等径直径尺寸范围，收尾缩小直径时密切观察和及时工艺调整，维持整个过程不脱离液体生长

序号	生产工序	工艺过程图示	工艺描述与作用	质量控制
14	停炉		收尾完成后把晶转/坩转降低转速，将晶体上升 50mm 左右，再将坩下降 50mm 左右，关闭加热	将坩内剩余液体和晶体脱离至热屏上下安全距离
15	冷却		将晶体停滞在炉内进行自然冷却，根据工艺冷却时间保持晶体在炉内缓慢降温自然冷却	维持晶体在炉内冷却达到工艺指定时间
16	开炉取棒		待工艺冷却时间完成后，关闭阀门及主真空泵，将炉内充入氩气至大气压状态，打开副室旋转一侧下降晶体取出	取晶体过程应缓慢操作，避免晶体摆动

（五）公司代表性业务指标情况

报告期各期具有代表性的业务指标主要为营业收入、毛利率、资产周转率等财务指标，各期变动情况及原因详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”和“十一、资产质量分析”。

（六）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

1、公司主营业务符合国家经济发展战略

2024 年 7 月，中共中央《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》在“三、健全推动经济高质量发展体制机制”中指出：要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展政策和治理体系；健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

2021 年，工信部、国家发改委等八部门印发《“十四五”智能制造发展规划》的通知，通知中提出大力发展智能制造装备，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规

划和 2035 年远景目标纲要》中提到，在高端装备制造等重点领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目，努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术，加快关键零部件国产化替代。

公司具备坚实的研发能力，在硅、碳化硅等半导体材料的制备环节，形成了大直径单晶硅棒拉制和碳化硅气相沉积等关键材料制备技术；在硅、石英、陶瓷和碳化硅等硬脆半导体材料的高精密加工环节，形成了微深孔精密制造、曲面精加工和微深孔刻蚀等精密加工技术；在熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理环节，阶段性突破了高致密陶瓷涂层制备等表面处理技术，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台。公司紧扣国家科技创新发展战略，持续加大技术研发投入，提升国产零部件技术水平和产品性能，助力供应链自主可控，符合国家经济发展战略。

2、公司主要产品和业务符合国家产业政策

公司主营业务产品符合工业和信息化部 2023 年 12 月颁布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》和《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》之先进基础材料和关键战略材料目录、国家发展和改革委员会 2023 年 12 月颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》和工业和信息化部、科技部、能源局和标准委 2023 年 8 月颁布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》目录。

公司主营业务产品已批量供应于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路芯片制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域，处于国内领先地位；并已在显示面板领域实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的自主可控。

3、公司战略契合现阶段中国产业突围路径

集成电路行业有“一代设备、一代工艺、一代产品”的规律，每开发一代新产品，每更新一代工艺制程，均需要新一代设备作支撑，而目前中国半导体产业面临

先进制程设备被禁售或限制的情形。

2020 年下半年，美国商务部将部分国内集成电路制造企业列入“实体清单”，依据《出口管理条例》（EAR）实施出口许可管制，并明确对 10nm 及以下先进制程技术的出口适用“推定拒绝”原则，限制其获取相关半导体制造设备与技术。2022 年 12 月，美国将数十家中国科技企业列入实体清单。2024 年以来，美国政府禁止国内先进集成电路制造企业从美国进口产品，包括芯片制造材料及零部件，并持续加大对国内存储芯片制造企业的制裁，以进一步限制中国先进半导体的发展。

美国的 AMAT、LAM 和日本的 TEL 等设备生产商深耕行业多年，而中国的半导体设备生产商起步较晚，集成电路制造厂商目前设备主要采购自国外设备生产商。目前，美国技术封锁正从设备逐渐扩展至售后服务和设备零部件，制裁范围不断扩大，美国设备生产商将相应执行美国政府对中国的各项限制性政策，有可能停止对集成电路制造厂商已有设备的售后服务和设备零部件的日常供应。为确保设备的正常运转，集成电路制造厂商必须对零部件进行国产化替代。在半导体供应链自主可控战略意义日益凸显的背景下，半导体设备零部件的本土化供应已成为主要的“卡脖子”突破口。同时，集成电路制造商为追赶世界先进，持续进行新产品迭代，只能在现有设备上通过核心零部件和新工艺的相互配合升级来实现。

公司通过与集成电路制造厂商的直接合作，加快了零部件研发进程，提高了服务反应效率，并不断通过自主开发新材料、新加工工艺和新涂层技术，突破产品在先进制程领域的应用极限。通过多材料、多品类、上下游一体化和整体设计能力，公司力争成为关键半导体设备腔体内非金属零部件整体方案提供方，助力客户向更先进制程、更多堆叠层数的集成电路芯片制造工艺升级，追赶世界领先水平。

二、行业基本情况

（一）所属行业

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）下的“电子专用材料制造”（代码：C3985）。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业领域属于

“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”。

（二）行业主管部门及监管体制、主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发展和改革委员会的主要职责是制定本行业发展规划和产业的宏观政策，指导行业技术法规和行业标准，推动行业技术发展升级，实施技术进步和产业现代化。工业和信息化部的主要职责是提出行业发展战略和政策，拟订并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化等。

公司所属行业的全国性自律组织主要包括中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业协会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会、集成电路材料产业技术创新联盟、集成电路零部件产业技术创新联盟和中国光学光电子行业协会。

2、行业主要法律法规和产业政策

习近平总书记在 2022 年 1 月 16 日出版的第 2 期《求是》杂志发表《不断做强做优做大我国数字经济》中指出：“要聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态”。

近年来，国家各部门相继出台了多项支持公司所处行业发展的政策，具体如下：

序号	政策	时间	发布主体	主要内容
1	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	2024.7	二十届中央委员会第三次全体会议	强调要健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用；要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智

序号	政策	时间	发布主体	主要内容
				能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展和治理体系，引导新兴产业健康有序发展
2	《重点新材料首次应用示范指导目录（2024年版）》	2023.12	工业和信息化部	（1）“先进基础材料”之“四、先进无机非金属材料”之“（一）特种玻璃及高纯石英制品”之“127、半导体用高纯石英玻璃制品”； （2）“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“220、半导体装备用精密陶瓷部件”之“刻蚀装备用碳化硅电极、碳化硅环、氮化硅陶瓷部件、碳化硅舟、碳化硅炉管”； （3）“先进基础材料”之“四、先进无机非金属材料”之“（三）先进陶瓷粉体及制品”之“137、高纯氧化铝及球形氧化铝粉”、“138、氮化铝粉体、陶瓷及基板”、“143、喷射成型耐高温耐腐蚀陶瓷涂层”、“145、高性能陶瓷基板”
3	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	2023.12	国家发展和改革委员会	鼓励类产业：（1）“.....等精密成型的陶瓷部件；.....电子陶瓷材料及部件”； （2）“信息。半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）、硅单晶（直径200mm以上）.....”；（3）“半导体用石英陶瓷器件（纯度大于等于99.9%）.....”；（4）“27、薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）.....等新型平板显示器件.....等关键部件及关键材料”
4	《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》	2023.8	工业和信息化部、科技部、能源局和标准委	“（四）前瞻布局未来产业标准研究”之“7.未来显示”之“研制 Micro-LED 显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准”
5	《重点新材料首次应用示范指导目录（2021年版）》	2021.12	工业和信息化部	“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“255、大尺寸硅电极产品”
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021.3	全国人民代表大会	“专栏2 科技前沿领域攻关”之“03 集成电路”
7	《战略性新兴产业分类（2018）》	2018.11	国家统计局	公司所属行业领域属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之

序号	政策	时间	发布主体	主要内容
				“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”
8	《产业关键共性技术发展指南（2017年）》	2017.10	工业和信息化部	（1）“三、电子信息与通信业”之“（一）集成电路”之“4、半导体制造装备用高精密陶瓷部件制造技术”：高度轻量化、高尺寸精度、中空闭孔等复杂结构碳化硅、氮化铝陶瓷部件制造共性技术，包括复杂结构陶瓷组件近净尺寸成型、烧结关键技术，高精密陶瓷部件中空制造技术，高精密复杂结构陶瓷部件超精加工技术，高精密陶瓷部件性能检测与评价技术等；（2）“一、原材料工业”之“（四）建材”之“2.先进陶瓷氧化铝原料高效合成与标准化制备技术，主要技术内容：高纯、超细、高烧结活性氧化铝新型粉体原料关键技术；先进陶瓷粉体材料的低成本、绿色制备工艺和生产装备关键技术”
9	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》（国科发高[2017]89号）	2017.4	科学技术部	“四、重点任务”之“（四）极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“2. 高端关键装备及零部件”之“面向集成电路14-10纳米先进工艺，重点开展刻蚀、薄膜、化学机械处理、掺杂和检测等关键装备及其配套核心零部件产品研发。”

3、行业主要法律法规政策对发行人经营发展、经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等方面的主要影响

近年来国家各部门相继制定了一系列产业政策来推动半导体和显示面板设备零部件行业的发展，设备零部件的国产化为科技前沿领域的重要攻关方向。上述主要法律法规政策属于行业鼓励性政策，对公司经营发展有重要支持作用，不会导致公司经营资质、准入门槛的监管发生重大不利变化，对公司的运营模式不构成重大不利影响，利好本土国产替代企业。

（三）行业发展情况

1、半导体行业

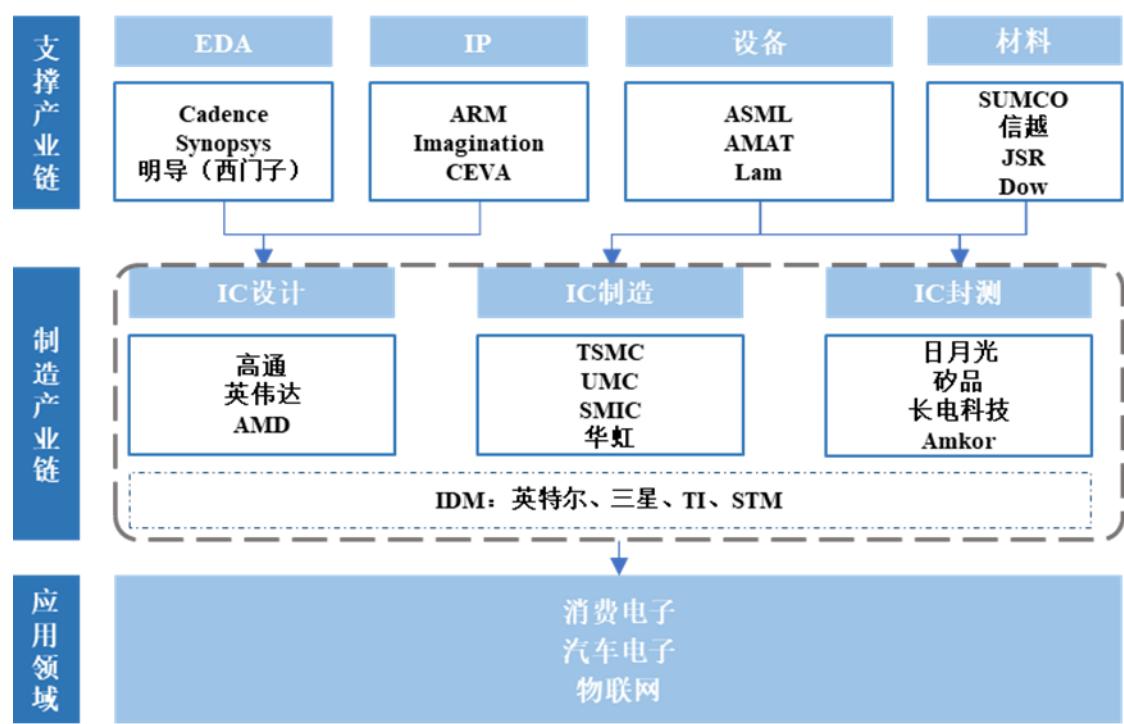
半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。半导体产业发展是

推动一国经济和科技发展的重要力量，其发展水平已成为衡量一个国家或地区现代化程度以及综合实力的重要标志。半导体产业领域业已成为当前国家间竞争的焦点之一。据半导体产业协会（SIA）公布数据显示，2024 年全球半导体销售额达 6,276 亿美元，同比增长 19.1%。根据 WSTS 统计，2025 年全球半导体市场规模将达到 7,009 亿美元，2026 年的全球半导体市场规模将进一步上升 8.5%至 7,607 亿美元。

（1）半导体产业链

从产业链结构来看，半导体产业链由上、中、下游三部分组成，其中上游包括半导体材料、半导体设备、EDA 软件、IP 核等支撑产业；中游包括设计、制造和封测等核心产业；下游则为消费电子、汽车电子、物联网等具体终端应用产业。

图 半导体产业链



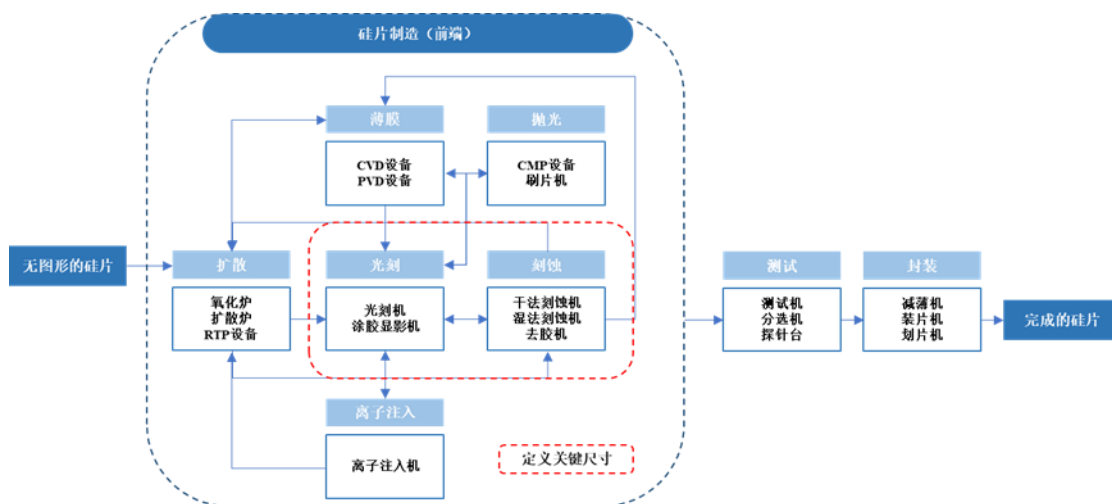
资料来源：公开资料整理

公司主要聚焦于芯片制造环节，主要为晶圆厂供应刻蚀、薄膜沉积设备零部件产品及表面处理服务，位于半导体产业链中游。

(2) 半导体设备行业

半导体设备主要应用于集成电路的制造和封测环节,可细分为晶圆制造设备(前道设备)和封装、测试设备(后道设备)。在前道晶圆制造过程中,主要有六大工艺步骤,分别为氧化/扩散、光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入和抛光,其中光刻、刻蚀和薄膜沉积是前道工艺的三大核心工艺,相应的设备直接影响芯片的制程精度和生产良率。

图 晶圆制造工艺流程及对应半导体设备



资料来源：《半导体制造技术》，Michael Quirk、Julian Serda，2015 年电子工业出版社出版

全球半导体设备行业随下游终端产品景气度每隔 3-4 年会呈周期性变动趋势。当下游终端产品技术迭代更新，激增的需求将带动资本向上游晶圆厂涌入，推动全球晶圆厂持续扩产。与此同时，随着技术节点的不断缩小，半导体设备投资呈大幅上升的趋势，成为半导体设备销售额增长的主要驱动力之一。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备出货金额达到 1,171 亿美元，相较 2023 年的 1,063 亿美元增长 10%。作为全球最大的半导体市场，中国大陆半导体设备销售额增速远高于全球市场。2024 年中国大陆半导体设备销售额为 495 亿美元，占全球半导体设备销售的 42.3%，同比增长 35%。2024 年全球市场前道工艺（晶圆制造）设备销售额预计为 1,042 亿美元，销售占比超过 80%，其中前道工艺设备中光刻设备、刻蚀设备和薄膜沉积设备占比最大。

1) 刻蚀设备行业概况

根据刻蚀方法不同，刻蚀主要分为湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀各向异性较差，侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差，通常用于工艺尺寸较大的应用，或用于干法刻蚀后清洗残留物等。干法刻蚀是目前主流的刻蚀技术，其中以等离子体干法刻蚀为主。按照被刻蚀的材料类型不同，干法刻蚀主要可分成三种：金属刻蚀、介质刻蚀和硅刻蚀。根据产生等离子体方法不同，干法刻蚀主要分为电容耦合等离子体刻蚀（CCP）和电感耦合等离子体刻蚀（ICP）。

图：刻蚀方法分类

刻蚀方法	原理	分类	优势	劣势
干法刻蚀	用等离子体进行薄膜刻蚀	CCP（主要用于介质刻蚀）	能实现各向异性，保证细小图形转移后的保真性	造价高
		ICP（主要用于硅、金属刻蚀）		
湿法刻蚀	将刻蚀材料浸泡在腐蚀液内进行腐蚀	-	表面均匀性好，对硅片损伤小，几乎适用于所有的金属、玻璃和塑料等	各向异性较差，侧壁容易产生横向刻蚀造成刻蚀偏差

其中干法刻蚀按照刻蚀材料进一步划分：

图：干法刻蚀分类

刻蚀方法		主要去除的材料
介质刻蚀（CCP）		介质材料刻蚀，包括氧化硅、氮化硅、光刻胶等
非介质刻蚀（ICP）	硅刻蚀	用于除硅，包括单晶硅、多晶硅、硅化物等
	金属刻蚀	刻蚀铝、钨、铜及合金层

据 Mordor Intelligence 数据统计，2024 年全球半导体刻蚀设备市场规模预计为 238 亿美元，预计到 2029 年增长至 343.2 亿美元，年复合增长率为 7.60%，刻蚀设备零部件产品的市场规模也随之受益。目前 LAM、TEL 和 AMAT 三家占全球干法刻蚀设备的份额占比较高，行业集中度高。

2) 薄膜沉积设备行业概况

根据工作原理不同，薄膜沉积工艺可分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉

积（CVD）和原子层沉积（ALD）等。根据 Maximize Market Research 数据，全球薄膜沉积设备整体规模稳定增长，2023 年市场规模为 260 亿美元，预计至 2029 年市场规模可达 559 亿美元。在全球 CVD 设备市场中，AMAT、LAM、TEL 和 ASMI 四大厂商占据了市场主要份额，行业集中度高。

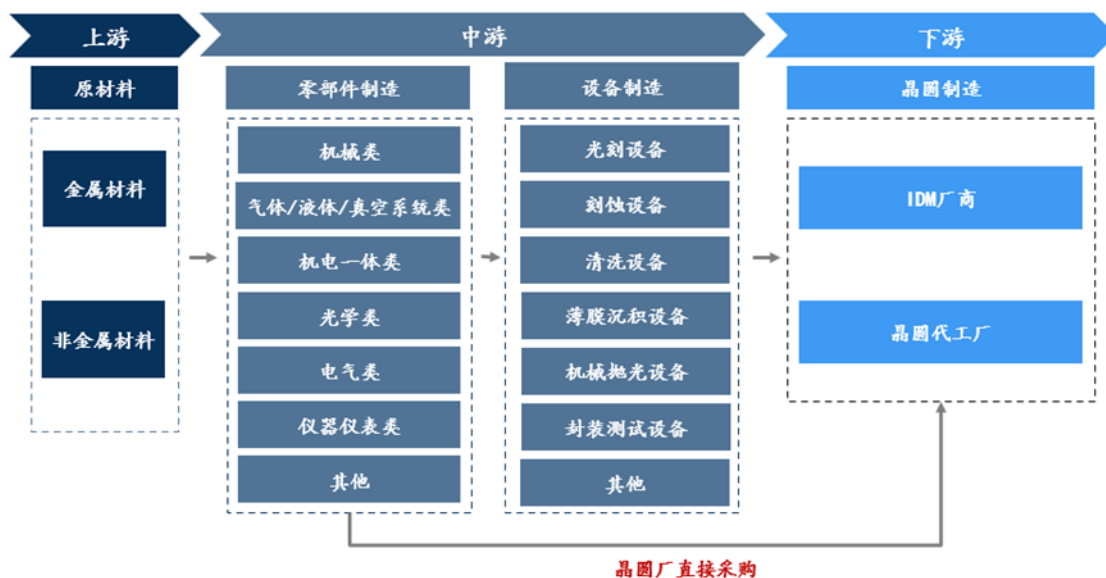
（3）半导体设备零部件行业

半导体设备零部件是指在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到了半导体设备及技术要求的零部件，是半导体设备的重要组成部分。零部件的质量、性能和精度优劣直接决定了半导体设备运行的可靠性和稳定性，是半导体设备的核心构成，对性能和成本起到决定性作用，因而是决定半导体设备产业发展水平的关键因素。

1) 半导体设备零部件产业链

半导体设备零部件产业链的上游包括硅、石英、陶瓷、金属等原材料供应商，产业链中游包括设备及零部件制造商，产业链的下游为晶圆厂。

图：半导体设备零部件行业产业链



资料来源：公开资料整理

从需求端角度，晶圆厂采购设备零部件主要有两种模式，具体如下：

图：晶圆厂采购零部件主要模式

供应商类别	供货路径
直接供应商	零部件厂商直接向晶圆厂供应零部件产品，属于一级供应商
间接供应商	零部件厂商与设备厂商合作，其生产的零部件产品通过设备厂商间接供应给晶圆厂，属于二级供应商

设备厂商并不直接生产零部件，通常指定其认证的零部件制造商生产配套零部件，即间接供应商通常根据设备厂商的需求定制生产设备零部件，属于 OEM 代工模式。晶圆厂通常在设备质保期内，会向设备厂商采购零部件作为备件。设备质保期过后，亦会向通过其认证的直接供应商采购零部件，用作现有设备零部件的替换备件。

2) 半导体设备零部件分类

按照应用领域划分，半导体零部件主要包含机械类、气体/液体/真空系统类、电气类、机电一体类、仪器仪表类以及光学类零部件。

图：半导体设备零部件分类

分类		代表产品	主要应用的半导体设备
机械类	金属工艺件	反应腔、传输腔、过渡腔、金属上下部电极、金属壁板等	所有设备
	金属结构件	托盘、底座、冷却板等	
	非金属机械件	石英零部件、硅零部件、陶瓷零部件等	
气体/液体/真空系统类	气体输送系统类	气柜、气体管路等	薄膜沉积设备、刻蚀设备、离子注入设备等
	真空系统类	真空阀门、分子泵等	
	气动液压系统类	阀门、过滤器、液体管路等	清洗设备、化学机械抛光（CMP）设备等
电气类		射频电源、射频匹配器、供电系统等	所有设备
机电一体类		设备前端模块、机械手、腔体模组、阀体模组、浸液系统、温控系统等	所有设备
仪器仪表类		气体流量计、真空压力计等	所有设备
光学类		激光源、物镜等	光刻设备、量测设备
其他		各类耗材等	所有设备

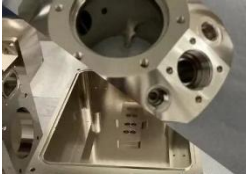
资料来源：公开资料整理

据 IC World2020 公开的 20 类半导体核心零部件产品的 44 家主要供应商数据，

美国供应商有 20 家，约占 45%；日本供应商 16 家，约占 36%；德国供应商 2 家，瑞士供应商 2 家，韩国供应商 2 家，英国供应商 1 家等，全部为境外供应商，且以美国和日本的厂商为主。近年来，随着国产化进程加快，中国本土核心零部件供应商的规模和实力迅速增强，但与国际同行业相比，差距仍然较大。

公司应用于半导体设备的零部件产品主要包括石英零部件、硅零部件、碳化硅零部件和工程塑料零部件等产品，且应用于半导体设备真空腔内，属于机械类零部件中的具有耗材特征的非金属零部件。

图：半导体设备机械类零部件分类

机械类零部件		示例图	代表产品	主要应用的半导体设备	晶圆厂在使用中是否需定期更换
金属零部件（分为工艺零部件和结构零部件）			反应腔、传输腔、过渡腔、托盘、底座、冷却板等	沉积设备、刻蚀设备、扩散设备等	金属工艺零部件参与真空腔内工艺反应，需定期更换但更换周期较长，一般可通过表面处理后再次使用；金属结构零部件负责设备结构支撑，伴随设备生命周期，过程中几乎不更换
非金属零部件	石英零部件		石英环、石英盘、石英喷嘴、石英电极等	刻蚀设备、炉管设备等	工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换
	陶瓷零部件		陶瓷环、静电卡盘、碳化硅环等	薄膜沉积设备、刻蚀设备、快速热处理设备等	工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换
	硅零部件		硅环、硅电极等	刻蚀设备、快速热处理设备等	工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换

机械类零部件		示例图	代表产品	主要应用的半导体设备	晶圆厂在使用中是否需定期更换
	其他		塑料垫圈、塑料固定座等	所有设备	工艺零部件，参与真空腔内工艺反应，需定期更换

资料来源：公开资料整理

3）半导体设备非金属零部件介绍

晶圆厂采购的零部件可归纳为非消耗型（Non-Consumable）和消耗型（Consumable）零部件。其中包括硅、石英、碳化硅在内的半导体设备非金属零部件属于消耗型零部件。非金属零部件在半导体设备中的应用情况如下：

①刻蚀设备

用于刻蚀设备中的非金属零部件主要是硅、石英、碳化硅等零部件。相较其他材料，硅、石英和碳化硅材料纯度较高，耐腐蚀性强，在刻蚀设备反应腔体中不易导致缺陷，可以聚焦反应腔体内的等离子体，满足工艺要求。因此，硅、石英和碳化硅等零部件在刻蚀设备中的用量较大，且更换周期相对较短，陶瓷零部件也应用于刻蚀设备中，但更换周期相对较长。

摩尔定律指出芯片上可接纳的元器件数目每隔 18-24 个月会增加一倍，性能也将提升一倍，该定律不断推动芯片线宽缩小。不断缩小的芯片线宽要求晶圆制造工序道数大幅增加，个别制造工序需百道以上，例如制造 7nm 芯片所需的刻蚀步骤达 140 道，较 14nm 芯片提升了 115%，同时对刻蚀设备在均匀性、高选择比、效率等各维度都提出了更高的要求，刻蚀设备在先进半导体产线中的投资占比也因此持续上升，也拉动消耗型非金属零部件的需求。

②薄膜沉积设备

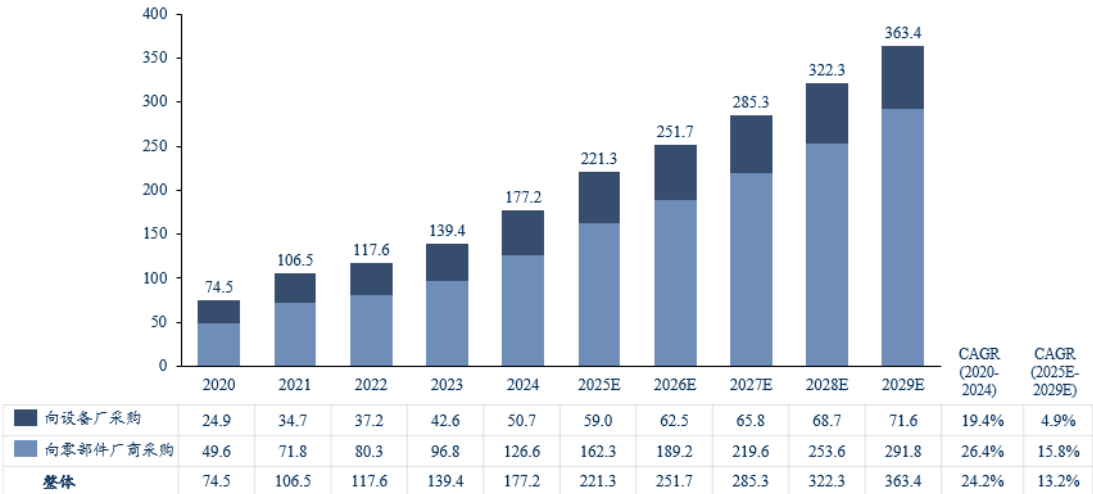
用于薄膜沉积设备中的非金属零部件主要是陶瓷零部件。由于陶瓷具有一定的耐腐蚀性、耐高温性等特点，由陶瓷材料制成的零部件在反应室可以承受腐蚀性气体和高温的影响，包括陶瓷筒、陶瓷板在内的陶瓷零部件大约 1-3 年需要更换一次。

4) 半导体设备零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的半导体设备零部件整体 177.2 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 71.4%，采购额达到 126.6 亿元。未来，随着国内晶圆厂加大对零部件厂商的采购力度，预计向零部件厂商直接采购的比例将逐步上升。预计到 2029 年，国内晶圆厂向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.3%，采购额将达到 291.8 亿元。

图：中国晶圆厂零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

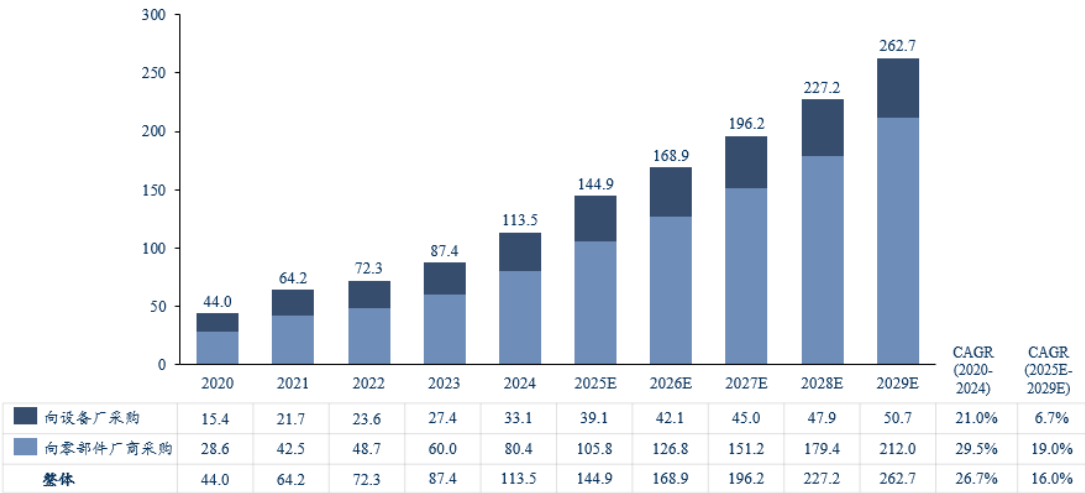
5) 半导体设备非金属零部件市场规模

因损耗较多，与金属零部件相比，半导体设备的非金属零部件采购以消耗型零部件为主，晶圆厂向零部件厂商直接采购非金属零部件的占比也更高。

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在国内晶圆厂的非金属零部件整体 113.5 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比达到了 70.8%，采购额达到 80.4 亿元。未来，随着晶圆厂加大对关键零部件供应链的自主把控力度，以及对本土供应商的积极扶持，预计向零部件厂商直接采购的比例将逐步提高。预计到 2029 年，在国内晶圆厂的非金属零部件整体 262.7 亿元的采购额中，向零部件厂商直接采购的占比将达到 80.7%，采购额达到 212.0 亿元。

图：中国晶圆厂非金属零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



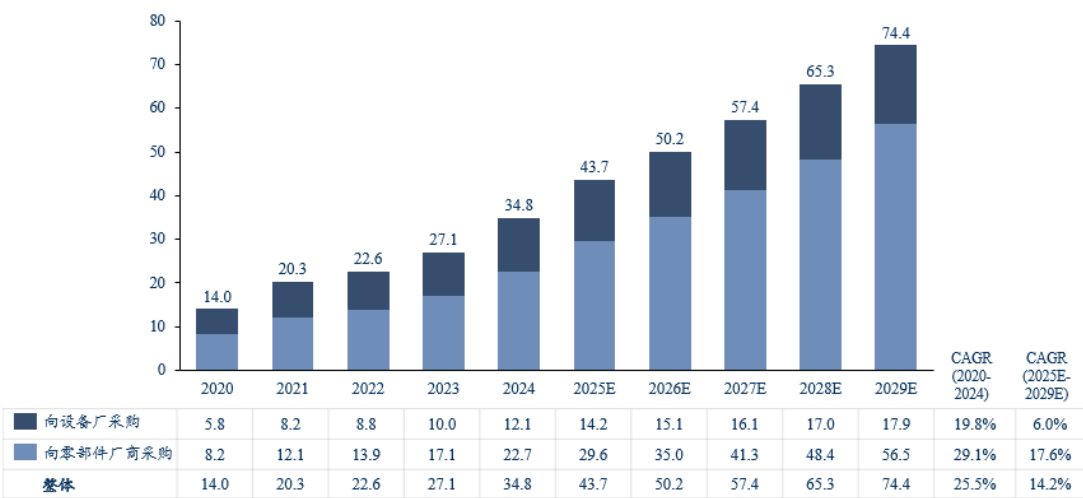
资料来源：弗若斯特沙利文

①石英零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 34.8 亿元的石英零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 22.7 亿元，占比 65.3%，预计在 2029 年可达 56.5 亿元，占比 75.9%。

图：中国晶圆厂石英零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



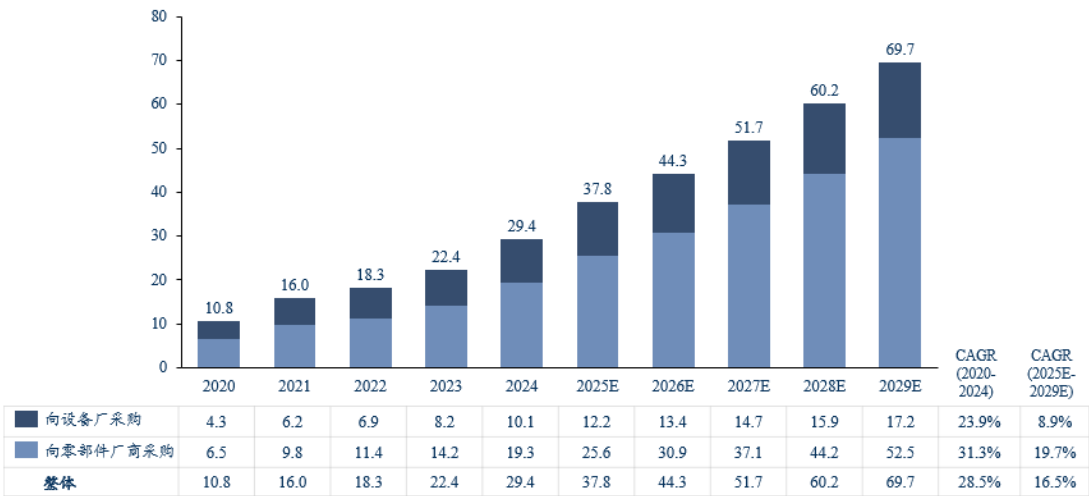
资料来源：弗若斯特沙利文

②陶瓷零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 29.4 亿元的陶瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 19.3 亿元，占比 65.6%，预计 2029 年可达 52.5 亿元，占比 75.3%。

图：中国晶圆厂陶瓷零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



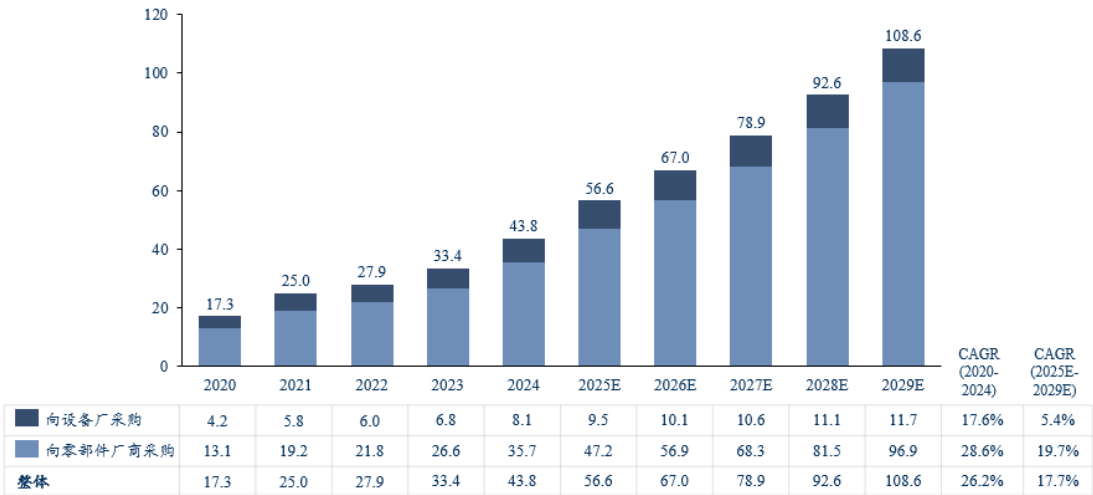
资料来源：弗若斯特沙利文

③硅零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2024 年，在晶圆厂 43.8 亿元的硅零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 35.7 亿元，占比 81.6%，预计 2029 年可达 96.9 亿元，占比 89.22%。

图：中国晶圆厂硅零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

2、显示面板行业

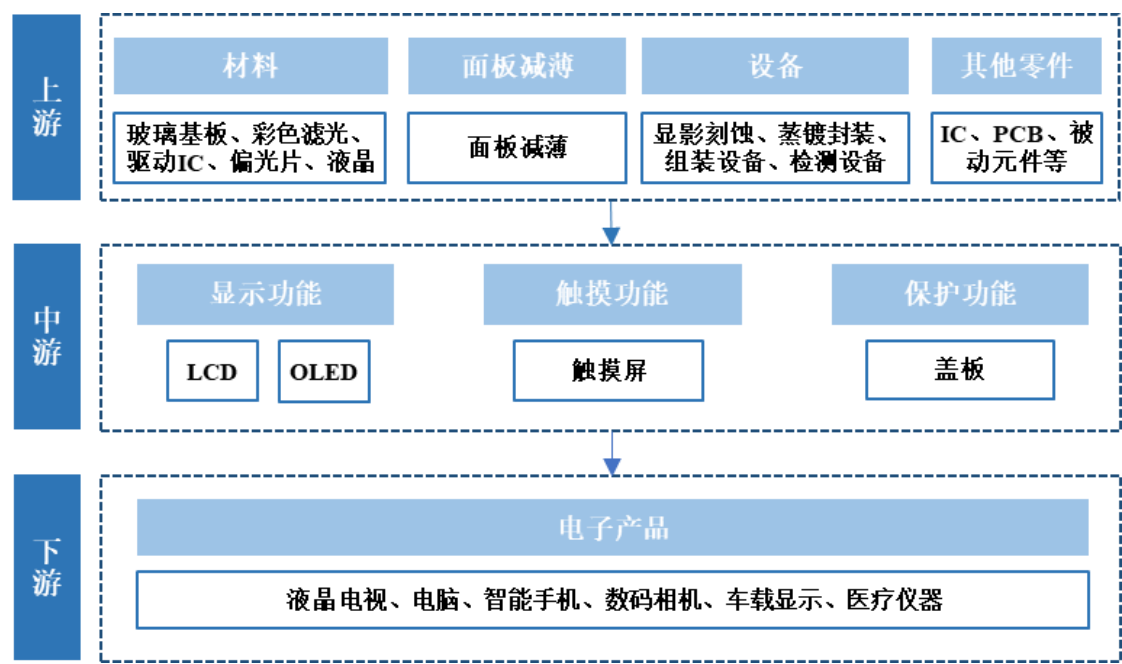
显示面板主要分为液晶（LCD）显示面板和有机发光二极管（OLED）显示面板两大类。其中，LCD 由于其技术的成熟性，以及在大屏幕显示如电视、笔记本电脑等的广泛应用，总需求和市场份额占比较大。OLED 因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕显示领域，同时也应用于一些新兴的电子产品如 VR、可穿戴设备等，需求增速更快。

根据 Omdia 数据，2024 年全球显示面板的出货面积约 2.63 亿平方米，同比增长 6%，市场规模约 1,338 亿美元，同比增长 13%，后续将呈现稳定增长趋势。预计 2030 年，面板市场规模将达到 1,487 亿美元，面板出货总量达到 40.8 亿片，出货总面积达到 3.3 亿平方米。

（1）显示面板产业链

液晶面板的产业链分为上游材料，如玻璃基板、彩色滤光、驱动 IC、偏光片和液晶等；中游组装则是电源管理、控制集成电路和液晶面板（阵列、成盒、模组）；下游则是电视、智能手机和笔记本等面向用户的终端产品。

图：显示面板产业链



资料来源：公开资料整理

公司主要聚焦于显示面板制造环节，为薄膜沉积、刻蚀和蒸镀设备提供零部件产品及表面处理服务，属于显示面板产业链中游。

(2) 显示面板设备行业

LCD 与 OLED 生产工艺均可分为前段 Array、中段 Cell 与后段 Module 三部分。

图：显示面板制程各阶段和主要步骤

制程	主要步骤
Array 制程	前段制程，将薄膜电晶体置于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检测等步骤
Cell 制程	中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基板结合，并在两片玻璃基板中注入液晶
Module 制程	后段模组制程，即完成显示屏与 Touch、IC 驱动芯片等的贴合、绑定等

资料来源：公开资料整理

在前段 Array 制程中，LCD 和 OLED 工艺和设备大致相同，与半导体类似，都需要刻蚀设备和薄膜沉积设备。在中段 Cell 制程中，LCD 与 OLED 的制程差异较大，OLED 需要蒸镀设备。在后段 Module 制程中，LCD 与 OLED 的工艺设备大致相同，主要设备有绑定、贴合、点胶和检测等设备。

Array 制程和 Cell 制程中，核心设备依然由外国企业所垄断，尤其是在 OLED 设备领域，蒸镀设备市场几乎被日本 Tokki、韩国 Sunic 等厂商垄断，检测设备中部分国产设备可供替代。在后段 Module 制程中，绑定、贴合和检测设备中国产比例较高。

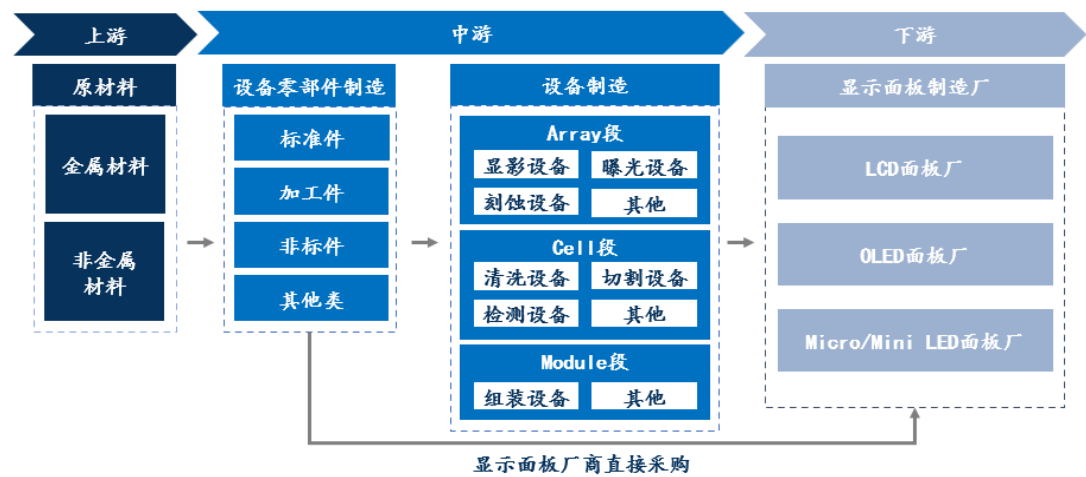
（3）显示面板设备零部件行业

显示面板设备零部件是显示面板设备制造过程中的核心组件，同时也是保障显示面板厂商产线效率、产品性能和良品率等关键因素之一。

1）显示面板设备零部件产业链

显示面板设备零部件产业链的上游包括石英、陶瓷、金属等原材料供应商，产业链中游包括设备及零部件制造商，产业链的下游为 LCD、OLED 等各类显示面板厂商。

图：显示面板设备零部件行业产业链



资料来源：公开资料整理

从需求端角度，显示面板厂商采购设备零部件主要有两种模式，具体如下：

图：显示面板厂商采购零部件主要模式

供应商类别	供货路径
直接供应商	零部件厂商直接向显示面板厂商供应零部件产品,属于一级供应商
间接供应商	零部件厂商与设备厂商合作,其生产的零部件产品通过设备厂商间接供应给显示面板厂商，属于二级供应商

资料来源：公开资料整理

设备厂商并不直接生产零部件，通常指定其认证的零部件制造商生产配套零部件，即间接供应商通常根据设备厂商的需求定制生产设备零部件，属于 OEM 代工模式。显示面板厂商通常在设备质保期内，向设备厂商采购零部件。设备质保期期满后，亦会向通过其认证的直接供应商采购零部件。

2）显示面板设备零部件分类

显示面板零部件可以分为标准类和加工类两大类。标准类零部件通常是指通用化、规格明确的部件，包括电控部件、视觉部件、机械部件和气动部件等，此类零部件产品除应用于显示面板设备外，还可用于其他行业的制造设备。加工类零部件则指专门为显示面板设备设计和生产的，需与显示面板设备高度适配的零部件。

图：显示面板设备零部件的分类

分类		代表产品
标准类零部件	电控部件	控制系统、传感器、仪器仪表等
	视觉部件	摄像头、镜头等
	机械部件	机械手、电机、导轨等
	气动部件	气缸、电磁阀、空压机等
加工类零部件	陶瓷零部件	静电卡盘、陶瓷筒、陶瓷杆、陶瓷板等
	石英零部件	石英视窗等
	金属零部件	气体分配盘、加热器、壁板等
	其他	橡胶部件等

资料来源：公开资料整理

3）显示面板设备零部件市场规模

公司显示面板设备零部件产品以定制化产品为主，需与显示面板设备适配，属于加工类零部件。从需求端角度，根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商 56.2 亿元的零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 47.8 亿元，占比 85.1%，预计 2028 年可达 81.3 亿元，占比 90.3%。

图：中国显示面板厂商零部件采购额（按供应商种类拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

4）显示面板设备非金属零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商 16.4 亿元的非金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 14.1 亿元，占比 86.0%，预计 2028 年可达 24.2 亿元，占比 90.6%。

图：中国显示面板厂商非金属零部件采购额（按供应商种类拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商整体 4.9 亿元的显示面板

设备陶瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 4.2 亿元，占比 84.8%，预计在 2028 年可达到 7.4 亿元，占比 89.2%。

图：中国显示面板厂商陶瓷零部件采购额（按供应商类型拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

5) 显示面板设备金属零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商整体 39.7 亿元的金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 33.7 亿元，占比 84.9%，预计 2028 年可达 57.1 亿元，占比 90.1%。

图：中国显示面板厂商金属零部件采购额（按供应商种类拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

3、半导体和显示面板设备零部件表面处理行业

表面处理既是硅、石英、陶瓷和金属等材质零部件制造的主要工序之一，也可用于旧零部件的更新，如精密清洗可以清除其表面的污染附着物，阳极氧化和熔射再生可以改善或克服母材弱点，提高零部件的耐腐蚀性，延长使用寿命。根据弗若斯特沙利文数据，针对新品制造的表面处理服务市场规模相对较小（仅考虑由设备厂商委托专业第三方表面处理服务厂商的部分，不包括设备厂商自行实施的部分），仅约占整体市场规模的 5%；对旧零部件的表面处理约占整体市场规模的 95%，是行业主要需求来源。

(1) 表面处理分类

半导体及显示面板设备反应腔内零部件由于长期处于真空、高温、高电压的特殊环境，需通过表面处理工艺，实现零部件在特殊环境下的耐腐蚀、耐击穿电压、耐高温、平整度、洁净度和粗糙度等性能，因此表面处理是设备零部件生产以及再生的核心工序，直接影响设备零部件的核心性能，对设备和工艺稳定性、质量和良率有重要影响。表面处理主要包括精密清洗、阳极氧化和熔射再生等工序。

1) 精密清洗

在集成电路和显示面板制造过程中，污染物会附着在设备零部件表面，尤其是腔体内零部件由于直接暴露在工艺反应环境中，其表面会吸附多种副产物。精密清洗主要采用物理清洗、化学清洗等方式去除设备零部件的表面污染物，防止污染物影响晶圆和玻璃基板的良率。

2) 阳极氧化

阳极氧化是将铝合金材质零部件置于特定环境下的电解液中，通过电化学反应，使其表面形成几十至几百微米厚的氧化膜，以此改善零部件表面的硬度、耐磨性和耐腐蚀性，从而有效提高腔体部件对工艺反应环境的耐电压性能和耐腐蚀性能。

3) 熔射再生

通过使用少量特殊材料制备特殊功能涂层，显著提高零部件表面耐腐蚀性能，形成特定表面形貌，延长使用寿命。公司的熔射再生服务主要包括等离子熔射和电弧铝熔射。

① 等离子熔射

等离子喷枪以等离子体的方式，将熔射粉高温熔化，形成中心温度 1 万度以上的高速等离子焰流，使其沉积到各类材质的基体表面，以提高其耐腐蚀性。

② 电弧铝熔射

电弧铝熔射是利用大电流产生的电弧将两股线状铝材熔化，使用高速气流将熔化的铝雾化并加速喷向基材，从而在零部件基材表面涂覆铝层，以形成零部件的特定表面形貌。

（2）表面处理产业链

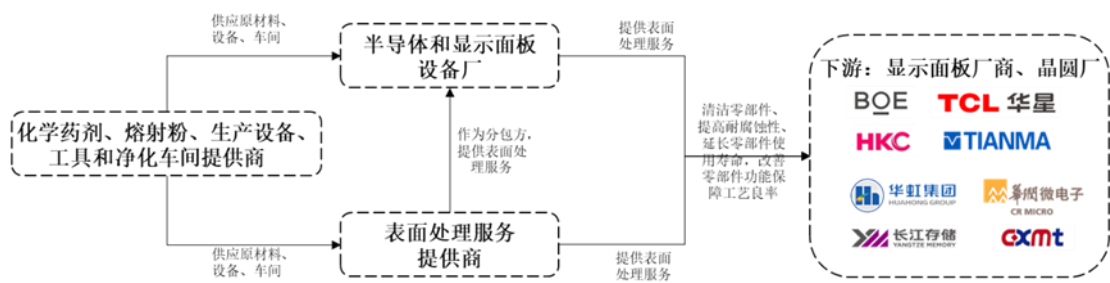
随着半导体和显示面板行业的发展，表面处理行业也经历了如下演化过程：

发展初期	二十世纪九十年代以来	
	设备质保期内	设备质保期外
作为设备销售的重要配套服务，	由设备厂提供，或由设备厂商分包	设备厂商和第三方厂商

发展初期	二十世纪九十年代以来	
仅由设备厂商提供表面服务	予第三方厂商提供表面处理服务	竞争提供表面处理服务

资料来源：公开资料整理

表面处理产业链情况如下：



资料来源：公开资料整理

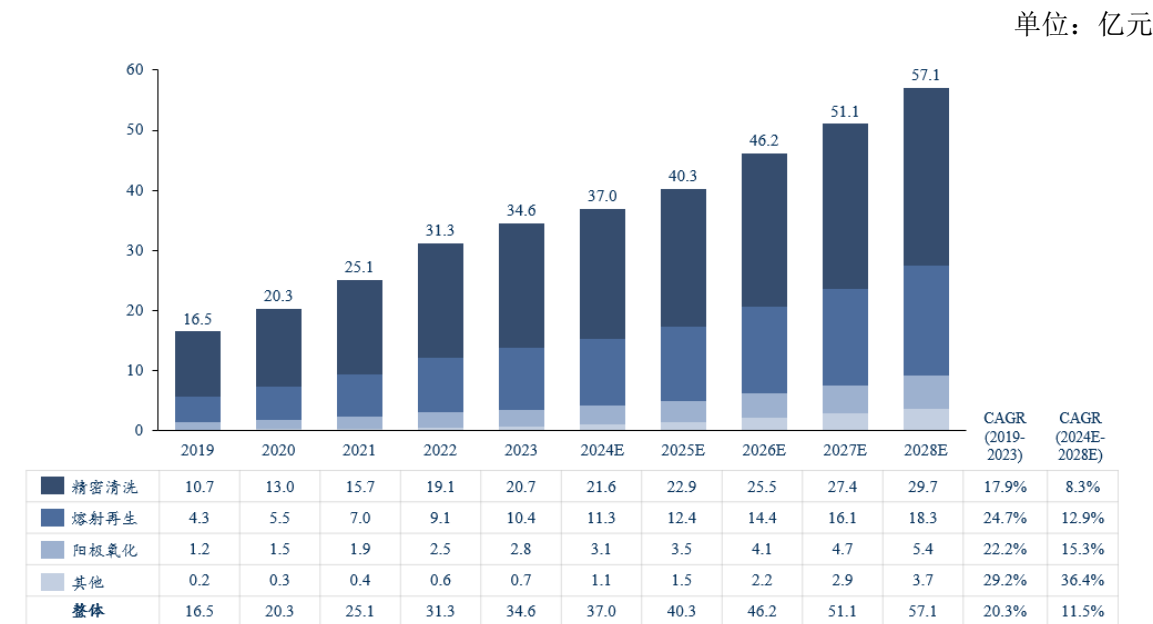
（3）表面处理市场规模

1）半导体设备表面处理服务市场规模

随着中国半导体行业的不断发展，中国晶圆厂产能迅速扩大，也相应带动了相关表面处理服务市场的发展。

根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提供商收入角度统计，中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模从2019年的16.5亿元上升至2023年的34.6亿元，期间的年复合增长率达到 20.3%，预计 2028 年市场规模将达到 57.1 亿元。根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务类型统计，精密清洗服务所占比例最高，其次是熔射再生和阳极氧化。2023 年，精密清洗、熔射再生及阳极氧化服务占比分别为 59.8%、30.1%和 8.1%，预计 2024-2028 年，精密清洗、熔射再生和阳极氧化服务的复合增长率分别为 8.3%、12.9%和 15.3%。

图：中国半导体设备零部件表面处理服务市场规模（按服务类型拆分）



资料来源：弗若斯特沙利文

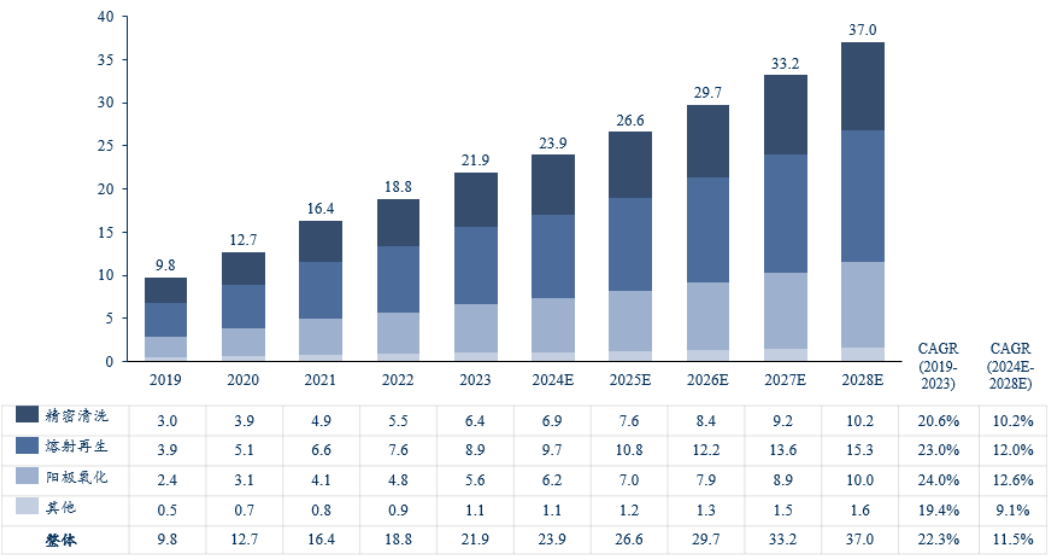
2）显示面板设备表面处理服务市场规模

随着我国显示面板产能规模不断增长，显示面板设备及零部件市场需求不断增加，零部件相关的表面处理服务市场也快速发展。

根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务提供商收入角度统计，显示面板相关的表面处理服务市场规模由 2019 年的 9.8 亿元增长至 2023 年的 21.9 亿元，期间年复合增长率为 22.3%，2028 年市场规模将达到 37.0 亿元。根据弗若斯特沙利文数据，按表面处理服务类型统计，熔射再生所占比例最高，其次是精密清洗和阳极氧化,2023 年,熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务占比分别为 40.6%、29.2%和 25.6%，预计 2024-2028 年,熔射再生、精密清洗及阳极氧化服务的复合增长率分别为 12.0%、10.2%和 12.6%。

图：中国显示面板设备零部件表面处理服务市场规模（按服务类型拆分）

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文

4、进入行业的主要壁垒

(1) 客户与认证壁垒

设备零部件供应商需要通过质量体系认证、工艺能力认证和性能指标认证后方能获得提供首件试制资格；在完成首件验证后，方可获得小中批量试产及稳定性测试资格，最后获得大批量生产资格。从商务接洽、基础资料审核、实地验厂、试样、性能全面测试乃至后续小中大批量生产，供应商认证难度较大、周期较长。由于半导体和显示面板产线投资动辄上百亿，一旦产品认证进程完成，客户不会再轻易开放产线上机测试以引入新供应商。

考虑到新供应商引入的周期长、成本高、风险大，一旦确立合作，客户不会轻易更换供应商，双方的合作黏性较强。同时，集成电路和显示面板制造行业研发投入大，新技术、新工艺更新迭代速度快，客户希望供应商有较强的同步开发能力，这需要供应商与客户保持长期稳定的互动交流、对客户现有工艺、装备和开发目标有深刻认知，新供应商无法在短期内达到与客户高度协同的水平。

（2）技术壁垒

设备零部件的材料生产、产品精密加工和表面处理具有较高技术壁垒。单晶硅、碳化硅材料的生产条件要求严苛，需要在严格控制的高温环境下进行，同时对晶体纯度、晶格完整性、掺杂均匀性以及缺陷控制等方面要求较高，因此在晶体生长控制、缺陷管理方面具有较高技术壁垒。硅、石英、碳化硅、陶瓷等零部件是真空反应腔内的核心零部件，具有高温晶格易改变、易折碎、易开裂、切削成型困难和加工精度难以控制等特点，需要生产商掌握复杂形状加工、微深孔加工、刻蚀和表面平坦化处理等技术。同时，设备零部件处于高温、强腐蚀、强电压环境中，需要经过表面处理以提升其耐腐蚀、耐高温和耐高压击穿能力，需要生产商掌握熔射再生、阳极氧化和精密清洗等技术。随着芯片制造精度和难度不断提高和显示面板尺寸不断增大，设备零部件的加工精度、洁净度、耐腐蚀和耐击穿电压等性能指标要求也不断提高，生产商必须具备全面且持续进步的技术研发能力。

随着客户先进及差异化工艺开发需求不断增加，供应商需要不断提高协同开发能力。该能力建立在对客户工艺和需求深刻理解的基础上，供应商需不断提升产品研发、设计及生产能力，与客户紧密协同，根据样品验证反馈及时调整技术参数，行业新进者难以在短期内具备该能力。

（3）人才壁垒

国内半导体和显示面板设备零部件产业是随着全球半导体和显示面板产能逐渐转移至大陆时建立的，之前国内大学并无专门的学科设置，也无专门的人才培养体系。设备零部件行业需要半导体物理学、固体物理、材料学、热力学、化学和精密数控加工等理工科知识以及丰富的研究、开发和制造经验，相关多学科综合型人才和具备丰富制造经验的一线人员较少。行业内高素质专业人才一般通过内部培养为主，这使得专业人才的培养和引进成为行业新进入者的重要壁垒。

（4）资金壁垒

半导体和显示面板设备零部件产业属于资金相对密集产业。为维持高水平的研发能力和生产能力，研发投入、设备购置和人才培养成本较高。半导体和显示面板

行业技术迭代快，为保持技术先进性、工艺领先性和产品市场竞争力，公司需持续投入资源以进行技术研发、产线升级更新和人才梯队培养。下游客户的多元化需求也需要企业具备快速响应能力，尤其是零部件产品类别众多，参数性能不尽相同，企业需要投入更多资源满足不同客户的多样化需求。持续性的高强度投入也是进入该行业的壁垒之一。

5、行业面临的机遇与挑战

（1）行业机遇

1）国家产业政策大力支持

在供应链自主可控战略意义日益凸显的背景下，半导体及显示面板设备零部件的国产替代成为“卡脖子”的重要突破口。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等政策大力支持本土设备零部件厂商牢牢把握国产化浪潮机会，助力供应链自主可控，推动国内制造业转型升级。

2）市场空间巨大

人工智能、汽车电子、物联网等新技术和新产品的应用，将带来庞大的半导体市场需求。半导体设备及零部件位于半导体产业链的上游，其市场规模随着下游半导体技术发展和市场需求而波动。根据 SEMI 的统计，2024 年全球设备支出预计达到 1,171 亿美元，未来三年将持续增长，中国已连续五年为全球半导体设备最大市场。预计中国芯片制造商在 2024 年增长 15%至 885 万片/月，2025 年将增长 14%至 1,010 万片/月，国内晶圆厂产能的快速扩张为设备零部件及表面处理服务提供了快速发展契机。

目前在人工智能、智能驾驶和人形机器人等推动下，无论是 CPU/GPU 还是功率半导体、电源芯片和连接芯片等，正迎来新一轮需求，晶圆厂的产能预计保持稳定增长。

3) 国产替代加速

在公司所处行业中，境外公司处于优势地位，国内厂商起步较晚，一直处于追赶态势。近年来随着美国对我国半导体行业实施一系列限制措施，国内半导体及显示面板产业的国产替代速度有所加快，但目前整体国产化水平仍然较低。据国内主流代工厂数据，目前全年日常运营过程中领用的零部件（包括维保更换和失效更换的零部件）达到 2,000 种以上，但国产占有率仅为 8% 左右，美国和日本占有率分别为 59.7% 和 26.7%。本土设备零部件厂商在原有的业务基础上，与下游厂商协同合作，加大自主研发投入，与客户合作定制开发更多新品和新技术，加快国产替代进程。

4) 下游产业技术迭代较快

目前国内逻辑芯片正从 28nm 向 14nm/7nm/5nm 等先进工艺制程演进、NAND 闪存芯片堆叠层数从 128 层向 2XX/3XX/4XX 层发展、DRAM 正从 20nm 进入 1x（16~19nm）/1y（14~16nm）/1z（12~14nm）制程领域；在后道封测领域，AI 驱动 HBM 需求大增，CoWoS 产能成为算力芯片关键卡口；显示面板领域，京东方、维信诺已经开建国内 G8.6 AMOLED 产线。

无论是摩尔定律下的制程演进，还是后摩尔时代的 2.5D/3D 封装，都大幅提升了对刻蚀和薄膜沉积设备的使用频次和性能要求，相应地提高了对上述设备真空腔内零部件的精度、洁净度、耐腐蚀和耐高压击穿等性能要求。显示面板领域，G8.6 AMOLED 产线的投产也意味着更多的设备及零部件需求。下游产业的持续技术迭代需求为本土设备零部件厂商技术升级和技术发展提供了历史性发展机遇。

（2）行业挑战

1) 人才供给不足、学术支撑力量薄弱

我国设备零部件行业起步较晚，发展水平与国际同行存在一定差距，整体技术水平有待提高，具有丰富研发经验和熟练生产经验的高端人才稀缺，在一定程度上制约了行业的发展。国内设备零部件领域的学科设置和人才培养体系较为薄弱，大学和研究所等机构对产业的学术支撑力量亟待提高。

2）西方国家技术封锁

集成电路产业属于西方发达国家的传统优势领域，中国大陆半导体产业的快速发展引起了以美国为首的西方发达国家的高度警惕，尤其是 2022 年以来，美国出台“芯片法案”及“出口管制条例”，对中国大陆购买先进设备、零部件及原材料等实施了较为严格的禁运和封锁措施，该等措施在很大程度上限制了国内集成电路行业发展。

（四）所属行业的技术现状及特点、行业经营特点、发展现状及未来发展趋势

1、行业技术现状及特点

（1）行业技术现状

1）半导体和显示面板技术快速迭代，客户客制化需求增加

随着集成路线宽的不断缩小，一次曝光无法实现更小尺寸要求，必须采用多重曝光多次刻蚀工艺以实现更小的线宽，因此设备的重要性进一步提高。此外，随着存储技术快速发展，堆叠层数的增加，需要采用高深宽比多次刻蚀技术，因此对刻蚀设备的技术要求和需求量也进一步加大，相应提高了对相关零部件的技术要求。制程工艺的提升和堆叠层数的增加对刻蚀和薄膜沉积设备零部件的精度、平面度、粗糙度、金属离子残留物浓度、表面颗粒物尺寸和数量等技术指标的要求更加严格，半导体行业技术快速迭代升级要求零部件厂商不断改进零部件加工技术指标。

随着 AMOLED 的世代线从 G6 到 G8.6 不断升级，显示面板制造设备对零部件的尺寸精度、平整度、洁净度要求持续提高，同时耐腐蚀和耐击穿电压等性能指标要求进一步提高，要求零部件厂商具备全面且持续进步的技术研发能力。

集成电路和显示面板设备零部件产品需与客户工艺相适配，随着集成电路制造厂商和显示面板厂商客制化需求的不断增加，零部件厂商也需不断提高客制化的新产品研发能力。

2）表面处理材料和工艺不断创新

人工智能带动对高算力芯片的需求，高算力芯片体现为更先进的半导体工艺制

程（4nm 以下制程的 GPU 和 CPU）和更先进的封装技术（256 层以上的 3D NAND、8 层以上的 HBM）。更先进工艺制程需要大幅提高刻蚀过程中对反应腔内污染颗粒物数量的管控要求，例如 5 纳米工艺制程下，反应腔内每立方米空间中直径大于等于 36 纳米的颗粒物数量不超过 5 颗。高堆叠工艺需要大幅提高通道孔（TSV）的深宽比，例如 128 层及以上的 3D NAND 的通道孔的深宽比接近 90:1-100:1，这需要加大等离子体（Plasma）的能量，腔内零部件因此需要承受更高能量的等离子体轰击。

设备零部件表面处理的材料和技术要求也相应提高，需要用低孔隙率、高硬度、低粗糙度的表面处理技术，用氧化钼等新材料来提高零部件的洁净度、耐腐蚀、耐高温和耐高压击穿能力，以满足客户持续的工艺迭代要求。

3）新型替代材料研发需求旺盛

当前，面对日益多元化的客户需求，一些此前被广泛使用的材料已经接近或达到物理和化学性能极限，单纯依靠既有材料体系的迭代升级已无法满足使用需求，替代材料的开发成为行业发展的新趋势。随着集成电路工艺制程的演进，半导体设备零部件所处环境更为复杂，先进工艺对设备零部件的表面缺陷和耐刻蚀性提出了更严格的要求，碳化硅、氮化铝等新型材料可以满足上述需求，有望在部分应用场景替代硅、石英、氧化铝等传统材料，因此零部件厂商需要掌握新型材料研发技术，不断适应行业技术发展需求。

（2）行业技术特点

1）技术密集，零部件精度及可靠性要求高

相比于其他行业的零部件生产，公司所处的集成电路及显示面板设备零部件生产制造及表面处理服务领域是典型的技术密集型产业，具有精度高、品种多、工艺复杂和品控严格等特点，部分零部件与晶圆、玻璃基板直接接触，产品质量的全生命周期稳定性直接影响设备稳定和晶圆、玻璃基板生产良率。

2）多学科交叉融合，复合型人才需求高

零部件在高精密、高洁净、高耐腐蚀和耐击穿电压等方面的综合性能要求较高，生产过程涵盖材料学、精密机械制造、表面处理科学等领域和学科。因此在其研发

设计、制造和应用过程中，需要大量材料、机械、物理、电子和化学等学科方面的人才投入，以满足跨学科的复合型人才需求。

2、行业经营特点

（1）周期性

1）半导体行业周期

半导体行业周期主要受下游需求、行业资本开支和技术升级等因素影响。

当终端产品需求增长时会促成半导体行业景气度提升，当消费需求阶段性饱和时也会导致行业景气度下降。以 ChatGPT 为代表的人工智能不仅新增 AI 服务器需求，还将促成笔记本电脑、PAD、手机和 AIOT 等端侧硬件的升级需求，直接拉动全社会“硅含量”的提升；但可能的全球经济放缓也会抑制整体的消费需求。

在“去全球化”趋势的影响下，国内增加晶圆厂的资本开支，从而增加对半导体设备及零部件的需求，但晶圆厂资本开支大，建设周期长（一般 2-3 年），较长的投产周期可能导致需求和产能供给的错配，从而使晶圆产线出现间歇性的稼动率上升或下降。

目前半导体的技术迭代仍在快速推进，芯片制程不断向 14nm 以下发展，3D 堆叠层数也向 2XX 层以上升级，新的技术节点的商业化量产往往意味着更高技术含量、更大投资规模的新建晶圆厂，对设备及零部件性能提出了更高要求，从而促进设备及零部件升级迭代，拉动市场需求。

2）显示面板行业周期

在过去十多年间，显示面板行业不断经历周期性循环，即“企业扩产-供大于求-生产过剩-价格下跌-收缩产能-价格回升-盈利回升-企业扩产更高世代线”。

经过数年的扩产及兼并收购，目前全球的显示面板产能已趋于稳定，行业集中度明显提升，行业的周期性有所减弱，但目前中国和韩国仍在推进 AMOLED G8.6 的产线建设，Mini/MicroLED 量产技术也在孕育中，显示面板行业仍具有一定周期性，相关设备及零部件行业也仍呈现周期性特征。

（2）区域性

历史上，半导体产业重心从美国转向日本，后转向至韩国和中国台湾地区，当下中国大陆的半导体产业正在迅速发展壮大；而显示面板产业，中国已成为全球产能最大的国家。

中国大陆集成电路制造厂商主要分布在华东、华中、西南和华南等区域，显示面板厂商主要分布在华东、华南、西南等区域。

（3）季节性

除春节放假等因素影响导致一季度收入较低外，行业的季节性并不特别明显。

3、行业发展现状及未来发展趋势

（1）行业发展现状

1）生产模式呈现“多品种、小批量、定制化”特点

由于相关设备零部件种类繁多、结构复杂且定制化程度高，无论是设备零部件制造，还是表面处理服务，都具有“多品种、小批量、定制化”特点。零部件供应商需具备多品种、多工艺加工能力和柔性生产管理能力，以满足集成电路和显示面板制造厂商的多元化需求，为客户提供多品类零部件整体解决方案。

2）低端领域竞争相对激烈，中高端仍有较大的国产替代空间

行业中部分企业通过价格竞争等手段快速进入技术已经较成熟的领域，如显示面板行业的精密清洗领域；但在其他表面处理领域和大部分设备零部件领域，国产替代空间仍然较大，本土企业在中高端领域、高附加值细分领域加大研发和投入，增强技术实力，扩展业务领域，实现差异化竞争。

（2）未来发展趋势

1）制程工艺的演进对设备零部件提出了更高的技术指标要求

随着制程工艺技术的不断进步，集成电路的技术节点已从上世纪 80 年代的 $1\mu\text{m}$ 逐渐发展至现如今的 7nm、5nm 乃至 3nm。随着特征尺寸的不断缩小，集成电路

制造工艺对设备零部件表面微粗糙度、金属杂质、表面颗粒尺寸和数量等直接影响晶圆良率和性能的技术指标要求更加严格，对设备零部件生产技术与制造工艺提出了更高的要求。

2) 国产替代为本土直接供应商带来发展机遇

国内集成电路和显示面板制造企业出于保障供应链的可获得性及稳定性、降低采购成本、提升采购效率的目的，在对本土直接供应商完成认证后直接采购零部件产品及表面处理服务。

受限于欧美日先进设备禁运，国内集成电路和显示面板制造企业在存量设备上进行新工艺开发的需求逐渐加大，越来越要求本土直接供应商参与其后续工艺的协同研发。为了提高上机测试效率、加强真空腔内零部件整体设计效果以及更好的质量追溯追责，国内集成电路和显示面板制造企业要求本土直接供应商提高多产品、多工艺的整体配套能力。

3) “原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台高效研发平台重要性上升

真空腔内零部件主要功能是控制工艺气体的均匀性、稳定性及部分结构支撑，在保证工艺反应顺利进行的同时做好工艺副产物管控，延长设备在线使用率，因此需要从原材料、精密加工和表面处理三方面持续提升零部件产品的尺寸精度、洁净度、耐腐蚀性和一致性，以满足日新月异的工艺迭代要求。

为具备与客户协同开发和一体化设计、多产品配套能力，零部件企业需同时具备材料自产、产品加工和表面处理技术能力，同时积极着手开发下一代新材料（如化学气相沉积碳化硅）、下一代精密加工技术（如深宽比 60:1 以上深孔加工）、下一代表面涂层技术（孔隙率趋近于 0 的涂层技术）和下一代涂层材料（氟化钽和氟氧化钽涂层材料）。

（五）行业内主要企业、竞争格局及公司市场地位

国内外涉及半导体和显示面板设备零部件产品和表面处理服务，且与公司产品和服务相似的企业主要有：

1、行业内主要企业

（1）半导体和显示面板设备零部件行业主要企业

序号	名称	业务介绍
1	Ferrotec	Ferrotec Holdings Corporation, 业务包括半导体及其他设备相关产品和电子器件等；半导体及其他设备相关产品有精密石英件、磁流体真空密封传输装置、先进陶瓷和表面处理等，并有硅片、碳化硅衬底等材料业务
2	贺利氏	贺利氏集团（Heraeus Group）,在半导体及电子领域，贺利氏提供手机、汽车中的电子封装材料、芯片制造设备所需的高纯石英玻璃等
3	京瓷集团	Kyocera Corporation, 京瓷株式会社，主营业务包括汽车等工业零部件、半导体零部件、电子元器件等；汽车等工业零部件业务包括先进陶瓷零部件、汽车零部件等；半导体零部件业务包括陶瓷封装、基板、有机封装、印刷电路板、有机化学材料等
4	Coorstek	CoorsTek, Inc., 是全球领先的先进陶瓷制造商，主要提供先进陶瓷零部件，在半导体设备的超高纯碳化硅陶瓷全球市场拥有较高份额
5	NGK	NGK Insulators, Ltd., 主营业务包括绝缘子等电力相关产品、汽车尾气净化催化剂陶瓷载体和陶瓷加热器等，在半导体设备的陶瓷加热器产品全球市场拥有较高份额
6	SK Enpulse	原 SKC Solmics Co., Ltd., 2023 年更名为 SK Enpulse Co., Ltd., 隶属于韩国 SK 集团，主营业务为终端晶圆厂商提供成熟制程的硅部件产品，具备材料及部件生产能力
7	三菱材料	三菱材料，主营业务涉及汽车零部件、电子元器件、半导体材料及零部件等诸多领域，向用户提供高性能基础材料和加工产品，主要聚焦先进制程中的高端硅部件产品（复杂硅环、硅喷淋头等），精密加工技术能力较强
8	Hana	HANA Materials Inc., 主要面向韩国市场提供刻蚀用硅部件产品，与三星电子、SK 海力士有良好的合作关系，并已得到主流的半导体刻蚀设备厂商的认可，具备材料及部件生产能力，产品涵盖先进制程及成熟制程，在硅喷淋头产品领域技术能力（微孔加工技术）相对突出，在全球影响力较大
9	Silfex	Silfex, 是全球最早开发等离子刻蚀工艺的硅部件厂商，与全球最大的等离子体刻蚀机设备厂商 LAM 在硅材料生产工艺、部件原型设计、产品应用等方面有着长期合作。公司在材料生产、机械加工、小孔加工和清洗等方面拥有全球领先的前沿技术
10	Worldex	Worldex Industry & Trading Co., Ltd., 成立于 2000 年，主要客户为三星电子、SK 海力士
11	盾源聚芯	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司，主要从事半导体级硅材料及部件，半导体级石英坩埚的研制、开发、生产。公司业务覆盖半导体用材料与部件产业的上下游，从大直径硅锭到精密硅制品，拓展至高纯石英坩埚等其他材料
12	神工股份	锦州神工半导体股份有限公司（上海证券交易所代码：688233），主要从事大尺寸、高纯度集成电路刻蚀用单晶硅材料生产。公司的主营业务为集成电路刻蚀用单晶硅材料的研发、生产和销售；产品类型包括单晶硅硅料、刻蚀用硅电极（本材料中硅电极即为硅气体分配盘）、芯片用硅片；量产单晶硅材料尺寸主要为 14 英寸以上产品
13	凯德石英	北京凯德石英股份有限公司（北京证券交易所代码：835179）主要从事石英玻璃制品的生产和销售，主要产品为石英仪器、石英管道、石英舟等石

序号	名称	业务介绍
		英玻璃制品，广泛应用于半导体集成电路领域、光伏太阳能行业领域及其他领域
14	菲利华	上海菲利华石创科技有限公司（母公司为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司，深圳证券交易所代码：300395），主要为半导体、光学、光通讯、光伏、LED 等多个下游行业客户提供各种规格的石英玻璃制品精密加工服务
15	浙江泓芯	浙江泓芯半导体有限公司，是半导体石英玻璃制品研发生产商，从事半导体、太阳能、LED 等行业设备备件的供应和技术支持
16	珂玛科技	苏州珂玛材料科技股份有限公司（301611.SZ）主营业务为先进陶瓷材料零部件、金属结构零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务
17	卡贝尼	上海卡贝尼精密陶瓷有限公司，主要经营先进陶瓷材料零部件和表面处理，其产品应用于半导体、显示面板和精密光学等领域
18	Nikkoshi	NIKKOSHI CO.,LTD.，在磁技术和精密加工、阳极氧化方面有着丰富的经验。其产品主要是情报机器，半导体制造装置，液晶制造装置用部件等
19	芜湖通潮	芜湖通潮精密机械股份有限公司，经营泛半导体设备零部件表面处理以及生产应用于显示面板和半导体生产设备的零部件，产品包括 CVD、干刻设备电极等
20	合肥微睿	合肥微睿光电科技股份有限公司，经营泛半导体设备零部件表面处理以及新品的设计、生产、销售，主要客户为京东方、TCL 华星光电等
21	亦盛精密	北京亦盛精密半导体有限公司，从事以硅、石英、碳化硅为主的工艺型零部件的研发、工程、制造一体化产品解决方案
22	杭州睿昇	杭州睿昇半导体科技有限公司，主要从事硅、石英、陶瓷及碳化硅等半导体设备核心零部件的研发、制造与销售
23	上海强华	上海强华实业股份有限公司，主要从事 8 寸及 12 寸全套石英器件、硅部件及热电偶等半导体零部件

（2）半导体和显示面板设备表面处理服务行业主要企业

序号	名称	业务介绍
1	KoMiCo	KoMiCo Ltd.，为韩国最大的表面处理服务企业，在半导体设备零部件熔射、阳极氧化方面处于技术领先地位，其主要客户包括三星电子、LG、海力士、现代、中芯国际、京东方等半导体和显示面板厂商
2	西诺斯	西诺斯（西安）洁净技术有限公司，母公司为韩国 CINOS，创建于 2002 年，为韩国三星集团配套企业，主要从事精密洗净、熔射再生业务
3	科秉电子	湖州科秉电子科技有限公司，母公司是台湾科智（TEAM WORLD INTERNATIONAL CO., LTD.），在中国台湾地区洗净领域排名第二，在湖州建成 1 万平米先进制程洗净工厂，具有较强的蚀刻技术水平
4	Nikkoshi	NIKKOSHI CO., LTD.，在磁技术和精密加工、阳极氧化方面有着丰富的经验，其产品包括，情报机器、半导体制造装置和液晶制造装置用部件等
5	世禾科技	世禾科技股份有限公司，是中国台湾地区最大的泛半导体设备零部件表面处理服务提供商，主要客户涵盖全球各大泛半导体设备厂商和制造厂商
6	富乐德	安徽富乐德科技发展股份有限公司，是一家泛半导体设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案

序号	名称	业务介绍
7	珂玛科技	苏州珂玛材料科技股份有限公司（301611.SZ），主营业务为先进陶瓷材料零部件、金属结构零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务
8	合肥微睿	合肥微睿光电科技股份有限公司，经营泛半导体设备零部件表面处理以及新品的设计、生产、销售，主要客户为京东方、TCL 华星光电等

（3）公司与同行业可比公司比较情况

考虑到境外同行业公司多主业经营，以及部分同行业公司未公开披露具体业务的财务信息详情，公司综合考虑境内外可比公司可比业务的生产经营和财务数据的获得性、境内外公司会计处理差异等因素，为更好的向投资者展现公司的财务状况、盈利能力，选取所处行业及产品较为相似的 A 股上市公司先锋精科、珂玛科技、富乐德、富创精密和凯德石英作为同行业可比公司。

截至 2025 年 12 月末，公司与同行业可比公司在产品、客户、经营情况等方面的比较情况如下：

单位：万元					
公司名称	产品情况	客户情况	2025 年 营业收入	2025 年 归母净利润	2025 年 12 月 末总资产
先锋精科	半导体设备关键工艺部件、工艺部件和结构部件	中微公司、北方华创、中芯国际、华海清科、拓荆科技、屹唐股份等半导体产业链厂商	123,785.50	19,028.04	220,151.99
珂玛科技	先进陶瓷材料零部件、表面处理和金属结构零部件	A 公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、京东方、TCL 华星光电、友达光电、天马微电子、三安光电、耐驰、布勒、山东埃尔派、广东鸿凯、BloomEnergy、华晨宝马、舍弗勒和佛吉亚等	未披露	未披露	未披露
富乐德	精密洗净服务、精密洗净衍生增值服务	中芯国际、台积电、英特尔、华虹集团、先进半导体、长江存储、长鑫科技、京东方、TCL 华星光电、惠	未披露	未披露	未披露

公司名称	产品情况	客户情况	2025 年 营业收入	2025 年 归母净利润	2025 年 12 月 末总资产
		科股份等			
富创精密	工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路	客户 A、北方华创、中微公司、拓荆科技	355,056.39	-934.09	892,857.60
凯德石英	石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品	北京北方华创微电子装备有限公司、吉林华微电子股份有限公司、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司等	28,314.01	2,327.66	106,269.63
公司	硅、石英、碳化硅、工程塑料、陶瓷等零部件以及设备零部件的表面处理	客户 3、客户 4 等国内主流存储芯片制造厂商，客户 1、客户 2、芯联集成、华润微电子、粤芯半导体、中芯宁波等国内主流集成电路制造厂商 京东方、TCL 华星光电、天马微电子、惠科股份、彩虹光电等主流国产显示面板厂商，同时已进入英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等国际厂商供应链	86,758.17	22,593.08	161,747.81

注：数据及资料来源为各公司招股说明书、业绩快报、业绩预告或官网

2、竞争格局

国产替代进程启动前，集成电路和显示面板设备制造领域主要由国外企业主导，其核心零部件供应链也高度依赖海外供应商。相较于本土零部件供应商，国外同行业企业在经营规模、技术实力及品牌声誉等方面更具优势。近年来，随着本土集成电路和显示面板制造企业日益重视培育本土供应链体系，加之本土设备厂商的快速崛起，国内零部件供应商迎来了重要发展机遇。但囿于资金实力和技术实力，本土供应商普遍呈现以下特征：经营品类较为单一，多聚焦于特定材料或单一产品类别；

技术路线以成熟制程配套为主，在先进制程领域配套能力相对薄弱；大多只具备在局部产品领域进行国产替代，不具备较强的自主设计开发能力和协助客户提升工艺水平的能力。因此，目前市场格局呈现企业较多、规模较小的特点，具备多品类、一体化业务平台和协助客户进行工艺升级的企业较少。

（1）半导体设备零部件市场

公司的半导体设备零部件产品主要为石英零部件、硅零部件、碳化硅零部件和工程塑料零部件，属于半导体设备机械类非金属零部件，行业内的主要企业可以分为以盾源聚芯（Ferrotec）、Hana、Coorstek、SK Enpulse、三菱材料和 Worldex 为代表的外资背景企业，以及以臻宝科技、凯德石英、珂玛科技、浙江泓芯、菲利华和卡贝尼等为代表的本土企业。

（2）显示面板设备零部件市场

公司的显示面板设备零部件产品主要为陶瓷零部件，属于显示面板设备加工类零部件，行业内的主要企业可以分为以 SK Enpulse 等为代表的海外企业，以及以臻宝科技、珂玛科技和卡贝尼为代表的本土企业。上述同行业公司中，SK Enpulse 作为直接供应商，主要供应显示面板厂商 LG 显示。

（3）半导体设备及显示面板设备零部件表面处理服务市场

中国半导体及显示面板设备零部件表面处理服务提供商主要可分为两类，即以 KoMiCo、世禾科技、富乐德（Ferrotec）为代表的国外和中国台湾地区企业，以及以臻宝科技、芜湖通潮、合肥微睿和珂玛科技为代表的中国大陆本土企业。

3、公司市场地位

公司系国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、重庆市先进智能工厂、重庆博士后工作站、重庆市技术创新示范企业和重庆市企业技术中心等。报告期内，公司积极承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，并协同行业龙头客户开发超厚曲面硅上部电极、氧化钼陶瓷零部件、碳化硅零部件等客制化设备零部件，助力等离子体刻蚀和薄膜沉积等生产设备的关键零部件自主可控，保障供应链安全，推动国内制造业转型升级。

零部件产品方面，公司已批量供应客户 3、客户 4 等存储芯片制造厂商、客户 1、客户 2、晶合集成等国内前十大晶圆代工厂以及格罗方德、联华电子等全球前十晶圆代工厂商。根据弗若斯特沙利文数据，2024 年直接供应晶圆厂的半导体设备零部件本土企业中，公司在硅零部件市场排名第一，收入市场份额 4.5%，在石英零部件市场排名第一，收入市场份额为 8.8%。

表面处理方面，公司在熔射再生的稳定性、耐电压性、孔隙率以及阳极氧化扩孔率等方面处于国内领先水平，且综合服务能力较强。根据弗若斯特沙利文数据，2023 年半导体及显示面板设备零部件表面处理服务本土服务提供商中，公司市场排名第四，收入市场份额为 2.8%，其中熔射再生服务市场排名第一，市场份额为 6.3%。

（六）公司的技术水平及特点、竞争优势和劣势

1、公司的技术水平及特点

公司所处集成电路及显示面板设备零部件行业涉及多个学科的专业技术，包括材料、机械、物理、电子和化学等多个技术领域，公司始终坚持研发驱动的经营战略，从多个方面着手开展研发工作，取得了一系列具有行业竞争力的核心技术。

公司主要产品	核心指标	指标释义	公司与中国大陆地区竞争对手比较	公司与全球竞争对手对比较	对应全球范围内主要厂商
硅零部件	平面度	平面度是评定零部件表面质量的关键指标之一，指标越小，精度和性能越高	一致	一致	三菱材料、SK Enpulse、Hana、Silfex、盾源聚芯等
	粗糙度	粗糙度是指加工表面微小的峰谷之间的距离，指标越小，表面越光滑	一致	一致	
	单孔偏差	实际微孔直径与标准直径间的差距，单孔偏差越小，硅部件的打孔技术越好	优于	略低于	
	微孔直径	硅气体分配盘表面分布有上百个微孔，用于反应气体通过微孔均匀进入反应腔体内，微孔直径越小，机械点啄打孔技术越好	可比口径披露数据较少	一致	
	微孔深径比	机械点啄打孔技术下，微孔深度与直径的比例越大，加工难度越高，孔径内部处理难度越大	优于	优于	
石英零部件	平面度	平面度是评定零部件表面质量的关键指标之一，指标越小，精度和性能越高	可比口径披露数据较少	一致	Ferrotec、贺利氏等
	粗糙度	粗糙度是指加工表面微小的峰谷之间的距离，指标越小，表面越光滑	可比口径披露数据较少	一致	
	火加工形变量	火加工形变量是指氢氧焰高温熔化石英材料退火后的尺寸变化量，尺寸变化数值越小，火加工技术要求越高	国内火加工石英零部件企业较少	一致	
	火加工光洁度	火加工光洁度是指用氢氧焰高温熔化石英材料后的表面粗糙度，光洁度指标越小，火加工技术要求越高		优于	
陶瓷零部件	密度	致密性指标，指标越大，性能越优	优于	一致	京瓷集团、CoorsTek、NGK等
	机械强度	将挤压断裂时的最大应力除以试样横截面积得到机械强度，指标越大，性能越优	一致	一致	
	酸碱腐蚀速率	单位时间的腐蚀程度平均值，指标越小，耐酸碱腐蚀性能越强	一致	一致	
精密清洗	颗粒物数量（particle）	颗粒物数量（particle）是影响半导体器件制造质量的重要因素，能反映零部件的固体颗粒污染物情况的指标，颗粒数越少，受污染程度越低	一致	一致	KoMiCo、西诺斯、世禾科技、科秉电子、富乐德等
	部件损耗量	零部件清洗过程中的损耗情况，指标越小，部件损耗量越小	一致	一致	

公司主要产品	核心指标	指标释义	公司与中国大陆地区竞争对手比较	公司与全球竞争对手对比较	对应全球范围内主要厂商
阳极氧化	扩孔率	产品进行阳极氧化处理后，该制备工艺对产品微孔的损耗度，微孔扩孔率指标越小，阳极氧化处理性能越好	可比口径公开信息较少	一致	
熔射再生	耐电压性	能够承受的最高电压值，指标越大，耐压性能越好	优于	一致	
	孔隙率	多孔物体的孔隙体积和总体积之比，孔隙率越小，致密性越好	一致	略低于	
熔射再生、阳极氧化和精密清洗业务综合解决方案能力		表面处理服务能力越多，提供综合解决方案能力越强	少数企业具备	少数企业具备	珂玛科技、富乐德等

资料来源：企业官网、公告文件、弗若斯特沙利文

注：本招股说明书中中国大陆地区/本土竞争对手不包含母公司注册在境外的企业

2、公司的竞争优势

公司经营紧扣国家产业政策和科技创新战略，坚持面向经济主战场、面向产业链自主可控，深耕半导体和显示面板产业链“卡脖子”领域，依托于“原材料+零部件+表面处理”的一体化业务平台，为客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

（1）技术优势

公司是国内少数同时掌握大直径单晶硅棒、多晶硅棒、化学气相沉积碳化硅等半导体材料制备技术和硅、石英、陶瓷等硬脆材料零部件高精密加工和表面处理技术的企业之一。

半导体设备零部件及表面处理方面，公司突破了微深孔加工、曲面加工等多项技术难题，实现了碱性刻蚀曲面硅上部电极、高致密陶瓷零部件等零部件产品的自主可控，在碳化硅零部件、半导体静电卡盘等关键精密零部件和高致密涂层制备等表面处理技术领域持续加大研发投入。公司的半导体设备零部件产品已批量应用于逻辑类 14nm 及以下技术节点先进工艺集成电路制造、存储类 200 层及以上堆叠先进工艺 3D NAND 闪存芯片制造、20nm 及以下技术节点 DRAM 先进工艺存储芯片制造等领域。

显示面板设备零部件及表面处理方面，公司突破了熔射再生等核心工艺，实现 AMOLED PVD 双极静电卡盘的自主可控，并通过自主设计电极棒、优化涂层结构和自主开发粉末配方、改进喷涂方式，实现氧化铝涂层孔隙率低于 3%，耐等离子刻蚀涂层质量损失小于 $8 \times 10^{-8} \text{mg/s}$ ，氧化钼涂层孔隙率小于 1% 的致密涂层制备，实现了显示面板静电卡盘在 4.5KV 高电压领域的突破。公司的显示面板零部件及表面处理服务已应用于 10.5G-11G 超大世代线 LCD、6G AMOLED 产线中的刻蚀、薄膜沉积、蒸镀等设备。

公司目前继续在高致密涂层技术、静电卡盘和氮化铝陶瓷加热器等领域进行研发和产能布局，具体详见本节“六、公司的技术与研发情况”之“（三）研发项目情况”之“1、正在从事的研发项目情况”。

（2）多品类、多业务供应优势

公司持续深耕集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积等关键半导体设备零部件，形成了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，具备向客户提供真空腔体内的多品类零部件的能力。

在原材料制造方面，公司自产大直径单晶硅棒、多晶硅棒和化学气相沉积碳化硅、氧化铝陶瓷造粒粉、氧化钼陶瓷造粒粉等关键材料，用于设备零部件产品的生产，保障了自身供应链的稳定性和安全性，满足客户对于原材料的多元化需求。

在零部件制造方面，公司致力于为客户提供真空反应腔体内的综合解决方案，通过自产硅、石英、碳化硅、陶瓷等多品类零部件，可以免去下游客户对单一零部件供应商的多次认证，减少不同供应商产品间的磨合成本，提高客户对零部件产品整体质量管控效率，简化事后质量追溯流程，从而降低客户综合采购成本和风险，提高管理效率和产品效能。

在表面处理服务方面，公司具备精密清洗、阳极氧化和熔射再生等多种表面处理能力，可根据不同客户、不同工艺和不同场景灵活定制表面处理服务方案。此外，公司阶段性突破了高致密涂层制备技术，可以增强设备零部件在先进制程工艺的极端反应环境下的稳定性，成功拓展了国内集成电路制造行业头部客户的表面处理业务。

因此，公司原材料制造、零部件制造和表面处理服务的一体化供应优势有利于提升产品质量、保障供应链稳定和提升客户采购效率。

（3）大客户优势

在半导体领域，公司产品及服务已批量供应于客户 3、客户 4 等国内主流存储芯片制造厂商，客户 1、客户 2、晶合集成、华润微电子、芯联集成、武汉新芯、积塔半导体和粤芯半导体等国内主流集成电路制造厂商，且主要供应于逻辑类 14nm 及以下、3D NAND 200 层及以上和 DRAM 20nm 及以下技术节点等先进工艺产线。同时，公司产品已实现多家国际厂商的认证和批量供货，如英特尔（大连）、格罗方德、联华电子和德州仪器等国际集成电路制造厂商。

在显示面板领域，公司产品及服务已批量供应于京东方、TCL 华星光电、天马微电子、惠科股份和彩虹光电等国内主流显示面板厂商，且主要供应于 G8.5-G11 高世代线和 AMOLED 等高端工艺产线，并成功实现了 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备中的静电卡盘以及 PVD 设备中的双极静电卡盘等关键零部件的自主可控。

报告期内，公司与主要客户的业务合作关系稳定，业务品类不断拓展，业务规模持续增长。

（4）协同开发优势

基于多品类零部件产品体系和整体解决方案能力，公司与国内主流集成电路和显示面板制造企业建立了长期稳定的业务合作关系，并配备了专门团队和人员长期服务客户，深入了解客户现有产线的工艺路线、设备选型、技术要求和产品特点。

报告期内，公司协助并承担客户 3、客户 4、客户 2 等客户的重点攻关项目中的部分研发工作，开发超厚曲面硅上部电极、氧化钇陶瓷零部件、碳化硅零部件等客制化设备零部件，助力等离子体刻蚀和薄膜沉积等生产设备的关键零部件自主可控，保障供应链安全。此外，公司已量产大直径单晶硅棒、化学气相沉积碳化硅等关键材料，可以满足客户对原材料的尺寸、电阻率等性能要求，进一步提高了公司客制化零部件的研发生产能力，强化公司协同开发优势。

（5）研发团队优势

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有 145 名研发人员，61 项已授权发明专利，50 项在申请发明专利。报告期内，公司研发费用分别为 2,701.63 万元、5,119.27 万元和 6,116.94 万元，研发费用率分别为 5.34%、8.07%和 7.05%。

公司通过自主培养、人才引进等方式组建了以杨佐东、蒋晓钧、陈立航、王文彬和曾德强为骨干的技术研发团队，研发团队核心成员均为行业内资深专家，具有专业的理论基础和丰富的产业经验，主导了公司集成电路及显示面板设备零部件的制造工艺研发、先进精密陶瓷材料制备技术及涂层工艺研发和设备零部件表面处理工艺研发等，公司具有较强的研发技术创新能力。

3、公司的竞争劣势

（1）融资渠道有限

随着下游行业对半导体设备零部件的需求日益增加，公司生产经营规模不断扩大，品牌知名度不断提高。当前公司发展迅速，流动资金需求量大，募投项目等都需要大量资金。为进一步提升公司市场地位，公司需要在产能建设、技术升级、产品创新等方面持续加大投入，资金实力对公司发展的重要性日益凸显。目前公司融资渠道单一，一定程度上限制了公司的进一步快速发展。

（2）业务规模尚待提升

公司目前主要以半导体及显示面板设备零部件生产及表面处理服务为主，尽管在中国大陆具有较强的市场竞争力，但与美国、日本、韩国和中国台湾地区同行业企业相比，公司的业务规模仍然偏小，产能规模有限，尚需自身的长期持续投入与不断成长。

三、公司销售情况和主要客户

（一）报告期内销售情况

1、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入构成及变动的原因详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（一）主营业务收入分析”之“2、主营业务收入的变动分析”。

2、主要产品的产能、产量及销量

公司表面处理既作为一项业务，独立对外服务客户；也作为一项工序，应用于自身零部件产品的后道处理。表面处理服务具有“非标”特性，加工工件在尺寸规格、工艺复杂程度和处理要求等方面差异较大，具有小品种、多规格、多批次和非标化特征，目前行业内不存在统一的产能、产量标准，亦不存在单位换算标准。因此，产能、产量、产能利用率和产销率等指标统计不适用于该业务。

报告期内，公司根据客户订单及预计订单安排作业计划，不同批次订单的处理

数量、处理时长、所需设备、处理成本和费用差异较大。

表面处理服务一般对于运输成本较敏感，且交期要求较高，因此部分业务受到服务半径的影响。公司在重庆、湖北建有表面处理生产线，目前服务能力充足，能够满足下游客户的需求，报告期内未出现持续性产能不足的情形。

（1）主要产品的产能情况

公司的硅、石英和陶瓷等零部件需要各类精密机械加工设备加工，例如各种加工中心，因此可以根据加工中心的产能来测算整体的产能情况。

报告期内，公司产能利用率情况如下：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
理论产能（万小时）	127.80	75.30	57.12
实际生产工时（万小时）	135.18	78.15	55.68
产能利用率（%）	105.78	103.79	97.49

报告期内，受客户订单持续增长影响，公司产能利用率持续增加。公司“以销定产”的生产模式确保自有产能能够充分利用，各车间产能协同配合，使得报告期内发行人产能利用率持续增长。

（2）主要产品的产量、销量情况

报告期内，公司主要产品的产量、销量和产销率情况如下：

单位：件

产品类别	指标	2025 年	2024 年	2023 年
硅零部件	产量	44,034	25,479	22,640
	销量	39,218	26,194	19,251
	产销率	89.06%	102.81%	85.03%
石英零部件	产量	63,782	39,017	40,675
	销量	60,946	37,295	34,338
	产销率	95.55%	95.59%	84.42%
陶瓷零部件	产量	74,733	42,169	18,071
	销量	59,863	38,187	16,597

产品类别	指标	2025 年	2024 年	2023 年
	产销率	80.10%	90.56%	91.84%

注：销量含免费样品

报告期内，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户需求和交期，结合产线现有排产计划及库存情况制定生产计划。

2023 年公司石英零部件和硅零部件的产销率有所下降，主要系 2023 年集成电路制造厂商受到行业周期性特征影响，产能利用率下降，零部件采购需求相应下降，使得公司当年度的零部件销量不及预期，产销率较 2022 年大幅下降。2024 年度的零部件产销率整体保持较高水平。2025 年度产销率有所下降，主要系公司硅零部件和石英零部件的新建产线投入量产，产能增长较快所致。

3、主要产品服务销售价格的变动情况

报告期内，公司主要产品服务销售价格的变动情况及原因详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（一）主营业务收入分析”之“2、主营业务收入的变动分析”之“（1）主营业务收入按产品分析”。

4、主营业务收入按销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接客户	80,836.01	95.60%	62,121.69	98.19%	49,714.01	98.52%
经销商	3,720.88	4.40%	1,147.03	1.81%	747.13	1.48%
总计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，公司销售模式以直销为主，存在少量经销商客户，收入占比较低。

（二）前五大客户的销售情况

报告期各期，公司前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

期间	客户名称	销售收入	占营业收入比例
2025 年度	客户 3	23,363.43	26.93%
	客户 2	13,488.33	15.55%
	京东方	10,233.59	11.80%
	客户 1	7,183.54	8.28%
	客户 4	5,828.50	6.72%
	合计	60,097.39	69.27%
2024 年度	客户 3	16,235.89	25.59%
	客户 2	10,461.58	16.49%
	京东方	9,930.51	15.65%
	客户 1	4,847.45	7.64%
	客户 4	4,717.24	7.43%
	合计	46,192.68	72.80%
2023 年度	客户 3	10,202.45	20.15%
	京东方	9,316.85	18.40%
	客户 4	6,990.18	13.80%
	客户 2	5,864.55	11.58%
	客户 1	5,396.54	10.66%
	合计	37,770.57	74.59%

注：已合并同一控制下企业

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入 50%或严重依赖少数客户的情形。公司与上述客户不存在关联关系，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有权益。

四、公司采购情况和主要供应商

（一）公司主要采购情况

报告期内，公司采购内容主要包括石英材料、硅材料、熔射粉、陶瓷材料等原材料，工装治具、化学品、气体等辅材辅料和 OEM 定制与成品采购等产品，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	15,585.18	53.18%	11,533.93	53.49%	7,997.35	42.90%
辅料辅材	8,926.48	30.46%	5,807.91	26.94%	5,110.59	27.42%
OEM 定制与成品采购	4,390.38	14.98%	4,053.48	18.80%	5,262.91	28.23%
外协加工采购	407.09	1.39%	166.06	0.77%	269.64	1.45%
总计	29,309.14	100.00%	21,561.39	100.00%	18,640.50	100.00%

报告期内，公司原材料采购金额逐年增长，主要系硅、石英等零部件业务增长，相应原材料采购金额增加所致。辅材辅料主要为工装治具、化学品、气体等产品，各期采购金额较为稳定。OEM 定制和成品采购内容主要为陶瓷零部件、塑料零部件、石英零部件和碳化硅零部件等产品，各期采购金额保持稳定。外协加工主要为机加工工序、表面处理，采购金额及采购占比较低。

（二）主要原材料采购均价情况

报告期内，各主要原材料采购单价具体情况如下：

单位：元/千克

主要原材料	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	平均单价	变动率	平均单价	变动率	平均单价	变动率
硅材料	430.16	-29.53%	610.39	-1.36%	618.82	-1.23%
石英材料	378.46	-4.89%	397.90	2.26%	389.10	3.42%
熔射粉	141.33	18.64%	119.13	-32.62%	176.82	-8.34%

报告期各期，发行人主要原材料的采购价格整体保持稳定。

石英材料价格整体保持稳定；硅材料价格呈现稳定下降趋势，主要系硅原材料价格持续走低，同时公司通过积极引入新供应商、年度议价等策略，降低了硅原材料采购价格，**2025 年硅材料采购单价下降，主要系上游硅材料价格持续下降，叠加公司采购低单价多晶硅原材料用于拉制单晶硅棒等材料所致；**熔射粉价格呈下降趋势，2024 年采购单价大幅下降，主要原因是 2024 年公司减少了直接采购高价氧化钪造粒粉的比例，转而采购价格更低的氧化钪原粉并自行加工，从而降低了整体采

购成本，2025 年熔射粉采购单价上升，主要系高单价的氧化钨造粒粉采购占比上升所致。

（三）辅材辅料采购情况

报告期内，公司采购的辅材辅料主要为钻头、刀具等工装治具、化学品、气体等辅材辅料，用于零部件制造和表面处理业务。公司辅材辅料的采购金额及占比情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工装治具	2,511.48	28.14%	1,400.29	24.11%	1,285.50	25.15%
化学品	1,721.76	19.29%	1,137.80	19.59%	886.16	17.34%
气体	342.37	3.84%	281.83	4.85%	735.09	14.38%
其他	4,350.86	48.74%	2,987.99	51.45%	2,203.84	43.12%
合计	8,926.48	100.00%	5,807.91	100.00%	5,110.59	100.00%

工装治具主要用于硅、石英等零部件的加工，采购金额保持稳定上升。化学品主要用于表面处理服务，采购金额逐年增长，主要系业务规模增长所致；公司采购的气体主要用于表面处理服务，各期采购金额有所波动，2024 年采购金额下降，主要系公司改进加工工艺，减少了高单价气体等采购金额，增加了低单价气体采购金额，2025 年采购金额上升主要系业务规模增长所致。

（四）能源采购情况

报告期内，公司生产经营主要耗用的能源包括水、电和天然气，采购数量和采购金额持续增长，具体采购金额及单价情况如下：

项目	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
水	数量（万吨）	26.39	15.42	12.44
	采购总额（万元）	110.91	67.78	55.63
	单价（元/吨）	4.20	4.40	4.47
电力	数量（万度）	5,799.59	4,043.99	2,892.02
	采购总额（万元）	3,899.75	2,787.27	2,153.94

项目	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	单价（元/度）	0.67	0.69	0.74
天然气	数量（万立方米）	13.55	10.22	8.85
	采购总额（万元）	41.86	30.62	26.39
	单价（元/立方米）	3.09	3.00	2.98

报告期内，公司采购水和电的价格保持相对稳定，能源供应均来自于当地给水和电网，配套供应充足、稳定。天然气单价快速增长，主要系重庆当地的天然气价格波动所致。

（五）前五大供应商的采购情况

报告期各年度，公司向前五名供应商的采购情况如下：

单位：万元

期间	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额比例
2025 年度	菲利华	石英材料	4,599.13	15.69%
	盾源聚芯	硅材料	2,648.10	9.04%
	连云港黑石	硅材料	1,595.13	5.44%
	CSN	碳化硅材料	1,273.47	4.34%
	鑫华半导体	硅材料	1,165.54	3.98%
	合计	-	11,281.37	38.49%
2024 年度	盾源聚芯	硅材料	2,632.57	12.21%
	菲利华	石英材料	2,306.30	10.70%
	CSN	碳化硅材料	1,437.17	6.67%
	CREST	工程塑料零部件	1,228.23	5.70%
	SINWON	陶瓷零部件	1,152.00	5.34%
	合计	-	8,756.28	40.61%
2023 年度	CREST	工程塑料零部件	2,110.85	11.32%
	菲利华	石英材料	2,080.50	11.16%
	SINWON	陶瓷零部件	914.26	4.90%
	易芯半导体	硅材料	876.95	4.70%
	盾源聚芯	硅材料	696.94	3.74%
	合计	-	6,679.50	35.83%

注：已合并同一控制下企业

公司不存在向单个供应商的采购占采购总额的比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。截至报告期末，公司的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员、公司主要关联方、持有公司 5%以上股份的主要股东在上述供应商中不占有任何权益。

五、主要资产情况

（一）固定资产

公司固定资产主要包括机器设备等，截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产基本情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
生产设备	46,972.57	11,180.24	—	35,792.33	76.20%
工具器具及家具	4,570.55	1,767.90	—	2,802.65	61.32%
运输工具	557.24	366.06	—	191.18	34.31%
办公设备	294.70	154.74	—	139.95	47.49%
合计	52,395.05	13,468.94	—	38,926.11	74.29%

注：房屋及建筑物本期全部转入投资性房地产，本期末无金额

（二）租赁房产

截至本招股说明书签署日，公司租赁房产主要承租自重庆铝产业开发投资集团有限公司，用于公司生产和研发等日常经营活动等。具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	位置	租赁协议期限	用途
1	臻宝科技	重庆铝产业开发投资集团有限公司	47,716.27	九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号	2023-08-15 至 2028-08-14	生产或经营
2	臻宝科技	重庆铝产业开发投资集团有限公司	62.40	D40 地块 3 号楼第一层配电用房	2021-06-01 至 2026-05-31	生产或经营
3	重庆芯洁	臻宝科技	62.40	D40 地块 3 号楼第一层配电用房	2026-01-01 至 2026-12-31	生产或经营
4	臻宝科技	重庆铝产业开发投资集团有限公司	7,504.32	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号（D40 地块 6 号）标准厂房第一层至三层	2022-01-01 至 2026-12-31	生产或经营

序号	承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	位置	租赁协议期限	用途
5	重庆芯洁	臻宝科技	5,619.88	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号（D40 地块 6 号）标准厂房第一层至三层	2026-01-01 至 2026-12-31	生产或经营
6	重庆芯洁	重庆铝产业开发投资集团有限公司	3,056.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 5 幢（D40 地块）标准厂房第一层	2023-05-28 至 2028-05-27	生产或经营
7	重庆芯洁	重庆铝产业开发投资集团有限公司	400.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 D40 地块 5 幢厂房第二层	2023-01-01 至 2027-12-31	生产或经营
			300.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 D40 地块 5 幢厂房第二层	2022-12-01 至 2027-11-30	
			650.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 D40 地块 5 幢厂房第二层	2023-06-01 至 2028-05-31	
8	重庆芯洁	重庆铝产业开发投资集团有限公司	3,052.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 8 号 5 幢（D40 地块 5 号楼）第三层标准厂房	2026-01-01 至 2028-12-31	生产或经营
9	湖北芯洁	黄冈融创资产经营有限公司	9,791.60	湖北省黄冈市黄州区华海大道特 1 号融创星城内 5 号厂房及附属厂房	2023-12-25 至 2026-12-24	生产或经营
10	臻宝半导体	臻宝科技	179.15	九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号厂房第 2 层	2025-09-01 至 2026-04-30	生产或经营
11			990.41	九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号厂房第 2 层	2025-04-01 至 2026-03-31	生产或经营
12			66.75	九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号厂房第 2 层	2025-11-01 至 2026-04-30	生产或经营
13			368.00	九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号附属厂房 1	2025-05-01 至 2026-04-30	生产或经营
14	臻宝半导体	九龙现代（重庆）园区运营管理有限公司	30,049.87	九龙坡区九港大道 42 号	2025-01-24 至 2030-01-23	生产或经营
15	臻宝技术	上海由鹏资产管理有限公司	3,116.60	上海市浦东新区金桥出口加工区金吉路 568 号第 1 幢通用厂房（1F&2F）	2024-11-01 至 2027-10-31	生产或经营
16	臻宝科技	北京峰客共创科技有限公司	租赁合同未载明	北京市经济技术开发区地盛北街 1 号院 32 号楼 501-02 室	2025-06-20 至 2026-06-26	生产或经营
17	臻宝科技	安徽绿岸信息技术有限公司	10 个工位	合肥市包河区芜湖路万达广场 6#2203 室 2218 工作室	2024-01-04 至 2027-01-03	生产或经营
18	臻宝科技	邓泽曦	67.72	创智南一路 88 号 1 栋 4 楼 22 号	2025-12-13 至 2026-12-13	生产或经营
19	臻宝科技	深圳金銓集团有限公司	47.69	深圳市龙华区龙华办事处和平东路金銓时代广场（弓村	2025-07-01 至 2026-06-30	生产或经营

序号	承租方	出租方	租赁面积 (m ²)	位置	租赁协议期限	用途
				商业大厦) 7 楼 710		
20	臻宝科技	武汉缘企商业运营管理有限公司	150.00	武汉东湖新技术开发区高新大道 780 号光谷新汇 1 地 6 层 07 室	2025-05-19 至 2027-05-18	生产或经营
21	上海升芯	臻宝科技	121.38	殷行路 1286 号 705A	2023-07-01 至 2028-06-30	生产或经营
22	上海臻宝	臻宝科技	121.38	殷行路 1286 号 705B	2023-07-01 至 2028-06-30	生产或经营
23	新加坡臻宝	GEORETTA ASSOCIATE SPTE.LTD.	租赁合同未载明	8,UbiRoad2,Zervex#05-08 (Room2)	2024-06-01 至 2026-05-31	生产或经营
24	上海升芯	高末（上海）有限公司	20.00	上海浦东自由贸易试验区奥纳路 160 号(D4 区 003 地块) 3 幢 2 层 214	2024-07-01 至 2026-06-30	生产或经营

（三）无形资产

1、商标

截至报告期末，公司拥有商标的情况如下：

序号	商标	权利人	注册证号	核定种类	有效期
1		臻宝科技	第 57373689 号	第 42 类	2022-01-14 至 2032-01-13
2		臻宝科技	第 57360518 号	第 40 类	2022-01-21 至 2032-01-20
3		臻宝科技	第 57324442 号	第 9 类	2022-01-21 至 2032-01-20
4		臻宝科技	第 57345729 号	第 42 类	2022-03-14 至 2032-03-13
5		臻宝科技	第 57331214 号	第 40 类	2022-11-14 至 2032-11-13
6		臻宝科技	第 65754604 号	第 40 类	2023-09-14 至 2033-09-13

序号	商标	权利人	注册证号	核定种类	有效期
7		臻宝科技	第 52420839 号	第 9 类	2021-08-21 至 2031-08-20
8		臻宝科技	第 52414887 号	第 7 类	2021-10-21 至 2031-10-20
9	臻宝	臻宝科技	第 57328685 号	第 40 类	2022-08-07 至 2032-08-06
10	臻宝	臻宝科技	第 57334973 号	第 9 类	2022-03-28 至 2032-03-27
11	臻宝	臻宝科技	第 50973969 号	第 7 类	2021-09-14 至 2031-09-13
12	Genori	臻宝科技	第 65757672 号	第 40 类	2023-09-14 至 2033-09-13
13	Genori	臻宝科技	第 57322902 号	第 40 类	2022-11-14 至 2032-11-13
14	Genori	臻宝科技	第 57338091 号	第 9 类	2022-01-21 至 2032-01-20
15	Genori	臻宝科技	第 57322934 号	第 42 类	2022-03-14 至 2032-03-13
16	Genori	臻宝科技	第 51003661 号	第 9 类	2021-08-21 至 2031-08-20
17		臻宝科技	第 57336251 号	第 40 类	2022-01-21 至 2032-01-20
18	芯洁	臻宝科技	第 57331221 号	第 40 类	2022-01-21 至 2032-01-20
19	芯洁	臻宝科技	第 50996777 号	第 7 类	2021-11-14 至 2031-11-13

序号	商标	权利人	注册证号	核定种类	有效期
20	芯洁	臻宝科技	第 51003657 号	第 9 类	2021-10-07 至 2031-10-06
21		臻宝科技	第 52420821 号	第 7 类	2021-10-28 至 2031-10-27
22		臻宝科技	第 52414902 号	第 7 类	2021-10-28 至 2031-10-27
23	ZHENBAO INDUSTRIAL	臻宝科技	第 50986118 号	第 9 类	2021-10-07 至 2031-10-06
24		臻宝科技	第 71172565 号	第 40 类	2023-10-28 至 2033-10-27
25		臻宝科技	第 70687478 号	第 7 类	2023-10-14 至 2033-10-13
26		臻宝科技	第 70666232 号	第 9 类	2024-01-07 至 2034-01-06
27	臻宝科技	臻宝科技	第 71164412 号	第 7 类	2023-10-28 至 2033-10-27
28	臻宝科技	臻宝科技	第 71150904 号	第 40 类	2023-10-28 至 2033-10-27
29	臻宝科技	臻宝科技	第 71178890 号	第 9 类	2024-01-28 至 2034-01-27
30		臻宝科技	第 81078540 号	第 7 类	2025-04-14 至 2035-04-13
31		臻宝科技	第 81083318 号	第 9 类	2025-04-14 至 2035-04-13
32		臻宝科技	第 81081827 号	第 40 类	2025-04-14 至 2035-04-13

2、专利权

截至报告期末，公司及其子公司在中国境内拥有的已授权专利共计 116 项，其

中发明专利 61 项，具体情况如下：

序号	类别	名称	权利人	专利号	申请日
1	发明专利	高寿命电极棒	臻宝科技	2018116048013	2018-12-26
2	发明专利	耐等离子体腐蚀的氧化铝涂层封孔方法	臻宝科技	2019107737331	2019-08-21
3	发明专利	用于下部电极的电极棒及其制造方法	臻宝科技	2019113918245	2019-12-30
4	发明专利	上部电极气孔修复工艺	臻宝科技	2020110044834	2020-09-22
5	发明专利	用于使下部电极表面的密封液固化的装置及固化工艺	臻宝科技	2020110026944	2020-09-22
6	发明专利	下部电极塑封夹具及塑封工艺	臻宝科技	2020110027133	2020-09-22
7	发明专利	一般电阻硅产品的蚀刻液及其蚀刻方法	臻宝科技	2020113404422	2020-11-25
8	发明专利	一种低电阻硅产品的蚀刻液及其蚀刻方法	臻宝科技	2020113361380	2020-11-25
9	发明专利	一种蚀刻清洗装置	臻宝科技	2021103133927	2021-03-24
10	发明专利	一种 14nm 干刻设备用超大型上部电极的制作方法	臻宝科技	202110321477X	2021-03-25
11	发明专利	一种用于石英取芯设备的上料装置	臻宝科技	202110946450X	2021-08-18
12	发明专利	一种陶瓷棒自动打磨装置	臻宝科技	2021109463988	2021-08-18
13	发明专利	一种陶瓷粉末灌粉设备	臻宝科技	2021110677278	2021-09-13
14	发明专利	一种半导体材料表面脱脂处理的清洗剂	臻宝科技	2021113266624	2021-11-10
15	发明专利	一种用于半导体材料的金属离子清洗剂	臻宝科技	2021113258327	2021-11-10
16	发明专利	用于半导体材料的清洗方法	臻宝科技	202111326661X	2021-11-10
17	发明专利	一种硅片边缘抛光装置	臻宝科技	202111483007X	2021-12-07
18	发明专利	用于微小孔钻孔装置	臻宝科技	2021115157015	2021-12-13
19	发明专利	一种可有效防止 Arcing 的下部电极结构及其安装方法	臻宝科技	2022100115832	2022-01-06
20	发明专利	一种下部电极 1Pitch Emboss 的形成方法	臻宝科技	2022100115921	2022-01-06
21	发明专利	一种石英环片卧式分离装置	臻宝科技	2022100574015	2022-01-19
22	发明专利	一种单晶硅材料的深、微孔加工方法	臻宝科技	2022100589805	2022-01-19
23	发明专利	硅环台阶检测装置	臻宝科技	2022101218910	2022-02-09
24	发明专利	一种金刚线切割机冷却液回收过滤系统	臻宝科技	202210133255X	2022-02-09

序号	类别	名称	权利人	专利号	申请日
25	发明专利	一种具有交叉回路下部电极的制备工艺	臻宝科技	2022101249232	2022-02-10
26	发明专利	一种上部电极氦气孔的涂层形成方法	臻宝科技	2022102416232	2022-03-11
27	发明专利	一种带孔产品的高压清洗装置及其清洗方法	臻宝科技	2022102416764	2022-03-11
28	发明专利	一种半导体石英研磨装置	臻宝科技	2022102627341	2022-03-17
29	发明专利	一种半导体刻蚀腔耐等离子体涂层制备方法	臻宝科技	2022102679717	2022-03-18
30	发明专利	一种对称圆曲面电极曲面研磨的加工方法	臻宝科技	2022102676085	2022-03-18
31	发明专利	一种注浆成型的真空模具	臻宝科技	2022102816269	2022-03-22
32	发明专利	一种具有双极回路下部电极的涂布式制备工艺	臻宝科技	2022104080743	2022-04-19
33	发明专利	一种稀土氟氧化物薄膜的形成方法	臻宝科技	2022105047456	2022-05-10
34	发明专利	一种用于金属表面化学处理的封孔方法	臻宝科技	2022106836187	2022-06-17
35	发明专利	一种 CVD 腔室工件的微弧氧化再生制备方法	臻宝科技	202210883026X	2022-07-26
36	发明专利	一种微孔清洗装置	臻宝科技	2022109305743	2022-08-04
37	发明专利	一种用于硅材料微孔蚀刻的蚀刻液及蚀刻方法	臻宝科技	2022111869049	2022-09-28
38	发明专利	一种耐等离子蚀刻硅橡胶及其制备方法	臻宝科技	2023104106184	2023-04-18
39	发明专利	一种 J-R 型静电卡盘及其制备方法与应用	臻宝科技	2024102426746	2024-03-04
40	发明专利	碱性蚀刻制绒溶液的添加剂及包含其的制绒液	臻宝科技	2024103007576	2024-03-15
41	发明专利	一种陶瓷振动注浆成型装置及方法	臻宝半导体	202210715585X	2022-06-23
42	发明专利	一种降低氧化铝陶瓷板材孔隙率的成型装置	臻宝半导体	2023103423172	2023-04-03
43	发明专利	一种稀土金属盐类陶瓷复合涂层及其制备方法与应用	湖北芯洁	202110881661X	2021-08-02
44	发明专利	半导体衬底的高压水洗设备及其使用方法	重庆芯洁	2020103049354	2020-04-17
45	发明专利	一种板材液压矫正机	重庆芯洁	2021112959866	2021-11-03
46	发明专利	一种 CVD 用陶瓷基板超声清洗装置	重庆芯洁	2021114430679	2021-11-30
47	发明专利	一种适用于异形零部件的喷砂机	重庆芯洁	2021116660622	2021-12-31

序号	类别	名称	权利人	专利号	申请日
48	发明专利	一种气相沉积设备零部件用高压水洗装置	重庆芯洁	2022100040323	2022-01-04
49	发明专利	一种硅片酸洗装置	重庆芯洁	2022105527453	2022-05-19
50	发明专利	一种真空喷砂室	重庆芯洁	2022108449691	2022-07-19
51	发明专利	一种铝膜板高压清洗装置	重庆芯洁	2022112447129	2022-10-12
52	发明专利	一种铝合金局部膜层修复装置及方法	臻宝科技	2022108591216	2022-07-21
53	发明专利	一种适用于半导体部件的直径检具	臻宝科技	202211067200X	2022-09-01
54	发明专利	一种用于解决带孔产品药液留痕的治具	臻宝科技	2022113228665	2022-10-27
55	发明专利	一种水浴升温加快 SiC 电化学机械抛光速率的装置及方法	臻宝科技	202310668261X	2023-06-07
56	发明专利	一种高纯稀土及合金靶材的制备方法	臻宝半导体	2021115151254	2021-12-13
57	发明专利	一种金属固态沉积用喷嘴及其应用	臻宝半导体	2022103293121	2022-03-30
58	发明专利	一种硅环斜面加工工装	臻宝科技	2023109952714	2023-08-09
59	发明专利	一种氧化铝陶瓷及其制备方法与应用	臻宝科技	2024102145259	2024-02-27
60	发明专利	具有高结合强度的氧化钇-氧化铝复合陶瓷及其制备方法与应用	臻宝半导体	2024115654933	2024-11-05
61	发明专利	一种防着母板上熔射涂层的制备方法	重庆芯洁	2023109648714	2023-08-02
62	实用新型	用于下部电极的电极棒	臻宝科技	2018222045323	2018-12-26
63	实用新型	支撑杆及带有该支撑杆的蚀刻装置	臻宝科技	201920904479X	2019-06-17
64	实用新型	蚀刻用上部电极	臻宝科技	2019209657163	2019-06-25
65	实用新型	用于熔射的旋转工作台	臻宝科技	2019211652026	2019-07-23
66	实用新型	下部电极模拟检测系统	臻宝科技	2019212735717	2019-08-07
67	实用新型	蚀刻基板边沿压紧框架	臻宝科技	2019214240780	2019-08-29
68	实用新型	高绝缘性电极棒	臻宝科技	2019224421903	2019-12-30
69	实用新型	化学沉积气体扩散板	臻宝科技	2020206065299	2020-04-21
70	实用新型	化学沉积气体导向板	臻宝科技	2020206063607	2020-04-21
71	实用新型	用于化学沉积的上部电极	臻宝科技	2020206063734	2020-04-21
72	实用新型	用于化学沉积的气体布散结构及化学沉积装置	臻宝科技	2020206083780	2020-04-21

序号	类别	名称	权利人	专利号	申请日
73	实用新型	一种用于圆饼状或圆环状的石英产品的搬运工装	臻宝科技	2021205867297	2021-03-23
74	实用新型	一种用于圆饼状或圆环状的石英产品的蚀刻工装	臻宝科技	202120586716X	2021-03-23
75	实用新型	一种双电主轴钻孔装置	臻宝科技	2021206029579	2021-03-24
76	实用新型	一种石英倒角治具	臻宝科技	202120604582X	2021-03-25
77	实用新型	一种推拉力测量仪固定工装	臻宝科技	2021228264472	2021-11-18
78	实用新型	一种电极片研磨夹具	臻宝科技	202122875627X	2021-11-22
79	实用新型	可变角度旋转工作台	臻宝科技	2021229580246	2021-11-29
80	实用新型	一种陶瓷熔射及喷砂夹具	臻宝科技	202122956541X	2021-11-29
81	实用新型	一种球头研磨刀具	臻宝科技	2022204006238	2022-02-25
82	实用新型	砂轮圆弧自动修复器	臻宝科技	2022204006628	2022-02-25
83	实用新型	一种可伸缩的台车	臻宝科技	2022212112385	2022-05-19
84	实用新型	上部电极气体分流孔堵塞检测工装	臻宝科技	2022223148592	2022-08-30
85	实用新型	一种用于下部电极的通用夹具	臻宝科技	2022230029973	2022-11-10
86	实用新型	一种鼓泡清洗槽	湖北芯洁	2021230722106	2021-12-09
87	实用新型	一种片状产品熔射治具	湖北芯洁	2021230827930	2021-12-09
88	实用新型	一种超声波清洗槽	湖北芯洁	2021230726889	2021-12-09
89	实用新型	一种快速吹干放置夹具	湖北芯洁	2022215296287	2022-06-16
90	实用新型	一种多用途防撞周转台车	湖北芯洁	2022215293734	2022-06-16
91	实用新型	一种物理方法除铜膜装置	湖北芯洁	2022216166327	2022-06-24
92	实用新型	一种多功能水洗平台结构	湖北芯洁	2022216166346	2022-06-24
93	实用新型	一种熔射旋转装置	湖北芯洁	2022219343836	2022-07-25
94	实用新型	一种 E-Chuck 清洗治具	湖北芯洁	2022230210935	2022-11-14
95	实用新型	一种陶瓷帽喷涂装置	湖北芯洁	2022231843403	2022-11-24
96	实用新型	一种半导体陶瓷基板固定治具	湖北芯洁	2023202887387	2023-02-22
97	实用新型	一种可移动式陶瓷基板夹具	湖北芯洁	2023203094927	2023-02-22
98	实用新型	一种金属防着帽熔射治具	湖北芯洁	202320288940X	2023-02-22
99	实用新型	一种 tray mask 遮蔽治具	湖北芯洁	202320330905X	2023-02-23
100	实用新型	一种顶部压板高压水清洗治具	湖北芯洁	2023205052204	2023-03-13

序号	类别	名称	权利人	专利号	申请日
101	实用新型	一种 CF CARRIER 遮蔽治具	湖北芯洁	2023208478321	2023-04-17
102	实用新型	一种快速校正直角治具	湖北芯洁	2023216872508	2023-06-30
103	实用新型	一种硅电极清洗治具	湖北芯洁	2023218940923	2023-07-19
104	实用新型	一种用于半导体衬底清洗工艺的周转车	重庆芯洁	2019224886686	2019-12-31
105	实用新型	半导体显示衬底的拆分装置	重庆芯洁	2020201349970	2020-01-20
106	实用新型	高适应性的喷砂治具	重庆芯洁	2020201349839	2020-01-20
107	实用新型	喷砂区域可调节的喷砂治具	重庆芯洁	2020201356512	2020-01-20
108	实用新型	半导体显示衬底的化学清洗治具	重庆芯洁	2020201333953	2020-01-20
109	实用新型	砂水可循环利用的喷砂机	重庆芯洁	2020202095524	2020-02-21
110	实用新型	高效的喷砂机	重庆芯洁	2020202095558	2020-02-21
111	实用新型	半导体显示衬底的化学清洗设备	重庆芯洁	2020203480177	2020-03-18
112	实用新型	用于半导体显示衬底的超声波清洗设备	重庆芯洁	2020203471591	2020-03-18
113	实用新型	便于放置工件的喷砂房	重庆芯洁	2020203478567	2020-03-18
114	实用新型	高适应性的熔射机	重庆芯洁	2020203478266	2020-03-18
115	实用新型	便于运输工件的喷砂房	重庆芯洁	2020203471801	2020-03-18
116	实用新型	一种 Lam 系列下部电极孔内清洗治具	湖北芯洁	2024223391992	2024-09-25

3、美术著作权

截至报告期末，公司拥有的美术著作权具体情况如下：

序号	登记号	名称	著作权人	创作完成日
1	渝作登字-2021-F-00023217	芯洁标志辅助图形	臻宝科技	2018.9.1
2	渝作登字-2021-F-00023216	臻宝标志辅助图形	臻宝科技	2020.8.1

4、域名

截至报告期末，公司拥有域名具体情况如下：

序号	域名	域名持有者	到期日
1	zhenbaotech.com	臻宝科技	2026.4.3
2	genori.com.cn	臻宝科技	2031.1.1

5、软件著作权

截至报告期末，公司拥有软件著作权具体情况如下：

序号	登记号	名称	版本号	著作权人	登记日期
1	2024SR1404376	臻宝科技研发管理系统	V1.0	臻宝科技	2024-06-25

（四）各要素与所提供产品或服务的内在联系

发行人拥有的自有房产及租赁房产主要用于公司生产经营，拥有的机器设备、运输工具、电子设备等用于公司生产经营，专利及商标等无形资产对公司的生产经营具有支持作用，是公司技术成果、品牌实力等软实力的体现。上述固定资产、无形资产等主要资源要素不存在重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，对公司持续经营不存在重大不利影响。

（五）与他人共享资源要素、特许经营权情况

公司不存在与他人共享资源要素的情况，无特许经营权。

（六）发行人资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司的资质情况如下：

序号	持有人	证书/文件名称	证书/文件编号	有效期/起止日期
1	臻宝科技	高新技术企业	GR202551102044	2025-11 至 2028-11
2	湖北芯洁	高新技术企业	GR202342000097	2023-10 至 2026-10
3	臻宝科技	报关单位注册登记证书	50079608BC	2016-06 至长期有效
4	湖北芯洁	报关单位备案证明	/	/
5	上海升芯	报关单位注册登记证书	3122461274	2012-12 至长期
6	上海升芯	报关单位备案证明	/	/
7	上海臻宝	报关单位备案证明	/	/
8	臻宝技术	报关单位备案证明	/	/
9	重庆芯洁	报关单位备案证明	/	/
10	臻宝科技	《GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书》	00124S32619R1M/5000	2025-07 至 2027-08
11	重庆芯洁	《GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018 职业健康安全	00122S31284ROM/5000	2025-05 至 2028-05

序号	持有人	证书/文件名称	证书/文件编号	有效期/起止日期
		管理体系认证证书》		
12	湖北芯洁	《GB/T 45001-2020/ ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书》	00124S33249R1M/4200	2024-10 至 2028-01
13	臻宝科技	《GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书》	00124E33321R1M/5000	2025-08 至 2027-08
14	重庆芯洁	《GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书》	00122E31611ROMI/5000	2025-05 至 2028-05
15	湖北芯洁	《GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书》	00124E34116R1M/4200	2024-10 至 2028-01
16	臻宝科技	《GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书》	00124Q36903R1M/5000	2025-07 至 2027-08
17	重庆芯洁	《GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书》	00122033573ROMI/5000	2025-05 至 2028-05
18	湖北芯洁	《GB/T 19001-2016/ ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书》	00124Q38713R1M/4200	2024-10 至 2027-10
19	臻宝科技	《ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证证书》	00125IS20243R0M/5000	2025-06 至 2028-06
20	臻宝科技	《GB/T 29490-2023 知识产权管理体系认证证书》	CQC24IPMS0046R0M/5000	2025-08 至 2027-09
21	重庆芯洁	道路运输经营许可证	渝交运管许可渝字 500107613658 号	2023-10 至 2027-10
22	湖北芯洁	道路运输经营许可证	鄂交运管许可黄冈字 421102101392 号	2023-05 至 2027-05
23	臻宝科技	固定污染源排污登记回执	91500107MA5U4QJ58P002W	2021-07 至 2026-07
24	臻宝科技	排污许可证	91500107MA5U4QJ58P001Q	2023-01 至 2028-01
25	重庆芯洁	固定污染源排污登记回执	91500107MA5YY0T4XQ001Z	2020-07 至 2025-07
26	重庆芯洁	排污许可证	91500107MA5YY0T4XQ001Z	2025-04 至 2030-04
27	湖北芯洁	排污许可证	91421100MA49CT1G4N0010	2021-08 至 2026-08
28	臻宝半导体	排污许可证	91500107MABYB3954K001V	2025-05 至 2030-05

六、公司的技术与研发情况

（一）核心技术情况

1、主要产品和服务的核心技术及技术来源

公司自成立以来一直坚持自主研发、持续创新的理念，积极跟进行业技术发展，结合自身多学科多专业的优势，在半导体及显示面板设备零部件精密制造及表面处理领域的多个环节积累了多项核心技术。

根据生产环节的不同，核心技术类型可以分为零部件制造技术、零部件表面处理和原材料制造技术，具体如下：

序号	技术类型	应用的产品	核心技术名称	核心技术的具体体现	核心技术内容	专利情况
1	零部件制造技术	硅零部件	硅锥面制造技术	应用该技术的曲面硅气体分配盘产品已向国内最先进的3D堆叠存储器客户批量供货，成功实现自主可控	公司自行设计加工工艺、平磨设备、成型刀具和研磨工装，曲面硅气体分配盘产品的多角度曲面均匀，曲面尺寸偏差在0.1mm以内，表面粗糙度在0.4μm以内，满足集成电路龙头客户的工艺升级需求	10项发明专利
2		硅零部件	微深孔加工技术	应用该技术的硅气体分配盘产品已向国内最先进的逻辑芯片制造和3D堆叠存储器客户批量供货，成功实现自主可控	公司通过研发特制工具和装置，通过改变转速、单次啄钻深度、进给速度等参数，提高了细微深孔加工能力；常规硅气体分配盘产品制作过程中需要打近千个微小深孔，深径比范围为20:1-60:1，加工难度高；而公司目前已实现深径比为60:1的小孔加工，且加工后大小孔偏差在0.02mm以内，单孔偏差在0.05mm以内，破碎层在0.025mm以内	
3		石英零部件	石英喷嘴制造技术	国内极少数具备石英双驱喷嘴机械制造与火加工技术并实现量产的企业	公司通过优化火加工工艺和工装设计，实现多个不同异形结构石英的高温融合，使用高精密加工设备对通气孔进行雕刻，机加工与火加工的再次处理，并结合使用自主研发的清洗剂，使产品的粗糙度、表面金属离子浓度与洁净度符合客户工艺要求	
4		工程塑料零部件	塑料零部件制造技术	国内极少数具备工程塑料零部件量产能力的企业之一	公司根据不同产品的材料特性，自主设计制作工艺、成型刀模和工装治具，实现复杂多特征产品的快速成型制作，产品的性能及洁净度满足刻蚀设备腔内使用要求	
5		陶瓷零部件	陶瓷加工技术	应用该技术的陶瓷产品的变形量、密度均匀性、平面度、平行度等指标已通过主要客户验证，产品已实现稳定供货	公司掌握铣刀、镗刀等多种刀具设计能力，可根据不同产品和不同生产工艺特点进行优化；通过设置烧结治具、模具、温度等参数，保证所有产品的变形量和密度均匀性可控；掌握1800mm*600mm的大尺寸陶瓷板加工技术，其平面度和平行度可以达到0.05mm以内	
6	零部件表面处理技术	硅零部件、石英零部件	刻蚀技术	公司同时具备酸性和碱性刻蚀能力，可以根据客户需求提供完整的表面处理方案	公司自主研发酸性和碱性刻蚀溶液配方，去除零部件制造过程中产生的破碎层并且使零部件表面形成特有的形貌，具备提供酸性、碱性刻蚀方案，在客户生产工艺中防止颗粒物掉落、加大对副产物吸附能力，以满足客户的工艺升级要求	20项发明专利
7		硅零部件、石英零部件、陶瓷零部件	精密清洗技术	应用于石英、硅、陶瓷产品，去除零部件表面附着的各种污染物，特别是微量金属离子，达到客户工艺要求	公司自主研发溶液配方，洗净后的产品表面金属离子浓度及洁净度符合客户工艺要求	

序号	技术类型	应用的产品	核心技术名称	核心技术的具体体现	核心技术内容	专利情况
8		硅零部件、石英零部件、陶瓷零部件	表面平坦化处理技术	通过研磨、抛光等工艺，使零部件的平面度、平行度、粗糙度达到客户的工艺要求	自主研发表面研磨工艺，具备平面、台阶、斜面、内外径等不同表面研磨能力，改善了硅、石英产品表面缺口、裂纹、划伤、色差等外观缺陷，配合刻蚀技术，可以实现粗糙度 $0.2\sim 4.5\mu\text{m}$ 全覆盖，平面度 $<0.03\text{mm}$ ，平行度 $<0.03\text{mm}$ ；自主研发表面抛光工艺，具备平面、台阶、斜面、凹面、凹槽、环槽、凹孔等不同表面抛光能力，使硅、石英、陶瓷表面达到镜面效果且无划伤、色差、橘皮等缺陷，表面粗糙度 $<0.02\mu\text{m}$ ，平面度 $<0.03\text{mm}$ 、平面度 $<0.03\text{mm}$ 。	
9		陶瓷零部件、熔射再生服务	大气等离子喷涂技术	通过等离子喷涂方式，形成金属层导电层和绝缘层，达到客户工艺要求	公司通过自主开发粉末配方，改进喷涂方式，实现氧化铝涂层孔隙率低于3%，耐等离子刻蚀涂层质量损失小于 $8\times 10^{-8}\text{mg/s}$ ，氧化钽涂层孔隙率小于1%的致密涂层制备，实现在静电卡盘在4.5KV 高电压领域耐压性突破，是首家实现该部件产品量产的本土企业； 公司通过自主设计导电层回路，优化金属回路边缘形状，形成了线宽1.2mm 正负极交叉金属导电层，其金属回路线宽均一、侧壁光滑无毛刺，达到在2KV 电压下不击穿，1.5KV 电压下吸附力超过 40gf/cm^2 的要求，满足了客户使用需求，突破了双极静电卡盘核心技术，是首家实现双极静电卡盘量产的本土企业，通过龙头客户验证	
10		阳极氧化服务	阳极氧化技术	在铝合金零部件表面形成薄氧化层，达到绝缘、耐蚀的效果	通过精确控制电流、电压及高温电解溶液参数波动范围保持在 $\pm 2.5\%$ 以内，实现膜层在 μm 级别范围内的均匀沉积。所形成的氧化膜具有优异的耐腐蚀性、绝缘性及高温稳定性，在 500°C 以上环境下无裂纹产生。经 GB/T 5478-2008 标准测试，膜层磨损量为 $1.74\text{mg}/1000\text{r}$ ，远优于 $3.5\text{mg}/1000\text{r}$ 的标准限值。依据 GB/T 10125-2021 标准进行336 小时中性盐雾试验（NSS），氧化膜表面未见明显腐蚀，显示出优异的耐蚀性能	
11	原材料制造技术	陶瓷零部件	喷雾造粒技术	通过喷雾造粒技术，实现自制陶瓷造粒粉	公司自研 Al_2O_3 陶瓷造粒工艺，提供具有领先粉体性能的 Al_2O_3 陶瓷造粒粉，实现原材料自主可控	1 项发明专利
12		陶瓷零部件	CIP 成型工艺技术	自研半导体级陶瓷成型加工技术，实现大尺寸陶瓷产品的制备	公司通过自研陶瓷成型技术，实现大尺寸（板材： $\text{L}2.5*\text{W}0.6*\text{T}0.05\text{m}$ 或环材 $\phi 0.6*\text{T}0.05\text{m}$ ）半导体级陶瓷坯体生产能力	
13		陶瓷零部件	陶瓷烧结技术	自研半导体级陶瓷烧结技术，实现精密陶瓷产品的制备	公司通过自研陶瓷烧结技术，可提供性能优异的陶瓷成品（瓷体密度 $3.93\text{-}3.94\text{g/cm}^3$ 、气孔率 $<10\%$ 、抗折强度 $>400\text{Mpa}$ ）	
14		碳化硅零部件	碳化硅	突破高纯度的化学气相	公司通过优化气体配比、压力及温度等工艺参数和气体喷嘴、支撑结构	

序号	技术类型	应用的产品	核心技术名称	核心技术的具体体现	核心技术内容	专利情况
		件	制造技术	沉积碳化硅材料制造技术	及热场等设备参数，实现高纯度、大尺寸且电阻率可控的高性能碳化硅材料的高效生产能力（碳化硅性能参数：密度>3.2g/cm ³ 、纯度>99.999%、热导率 180~250W/（m·K）、热膨胀系数 3.5~4.5×10 ⁻⁶ /°C）	
15		单晶硅棒	大直径单晶硅棒拉制技术	保障原材料供应链可获得性	公司通过自研控制技术，调节晶体生长直径，基于 V/G 理论，通过径向热区设计，开发出无缺陷晶体，已完成纯度≥99.9999%超大直径单晶硅棒的量产	

注 1：发明专利情况更新至 2025 年 12 月 31 日，未列示实用新型专利情况

注 2：喷雾造粒、陶瓷烧结、碳化硅制造和大直径单晶硅棒等原材料开发技术的发明专利正在申请中，因此发明专利数量较少

公司经过持续的技术积累与创新，已在关键材料制造、高精密加工工艺、表面处理技术等核心环节形成了一系列具有竞争优势的核心技术，公司的核心技术系公司研发团队自主研发形成，并已实现量产应用。

2、核心技术产品收入占比

报告期内，公司主要依靠核心技术开展生产经营。报告期各期公司应用核心技术的产品和服务收入占公司主营业务收入的比例超过 80%。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品和服务收入	77,740.79	55,458.26	40,551.38
主营业务收入	84,556.89	63,268.72	50,461.13
核心技术产品和服务收入占主营业务收入的比重	91.94%	87.66%	80.36%

（二）核心技术的科研实力和成果

1、专利情况

公司及其子公司获得的专利情况详见本节“五、主要资产情况”之“（三）无形资产”之“2、专利权”。

2、主要荣誉情况

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司获得的主要荣誉奖项情况如下：

序号	持证主体	类型	证书名称	发证单位	发证日期
1	发行人	科技类	国家知识产权优势企业	国家知识产权局	2022 年
3			第四批国家级专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部	2022 年
4			重庆市先进智能工厂	重庆市经信委	2024 年
5			2024 年重庆市瞪羚企业	重庆市经信委	2024 年
6			重庆市先进智能工厂	重庆市经信委	2024 年
7			重庆市海智工作站	重庆市科学技术协会	2024 年
8			高新技术企业	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2025 年
9			重庆市企业技术中心	重庆市经信委、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局、重庆海关	2022 年
10			重庆市博士后工作站	重庆市人社局	2022 年

序号	持证主体	类型	证书名称	发证单位	发证日期
11			重庆市技术创新示范企业	重庆市经信委、重庆市财政局	2021 年
12			重庆市知识产权优势企业	重庆市知识产权局	2021 年
13			重庆市“专精特新”企业	重庆市经信委	2020 年
14		协会证书	2023 创新奖/2023 半导体设备新锐企业 TOP10	亿欧	2024 年
15			2022 年度重庆市机械工业协会先进集体	重庆市机械工业协会	2023 年
16			中国光学光电子行业协会液晶分会会员单位	中国光学光电子行业协会液晶分会	2022 年
17			2020 年中国表面工程	中国表面工程协会	2020 年
18			集成电路零部件会员	中国集成电路零部件创新联盟	2019 年
19			2019 年中国表面工程协会团体会员证书	中国表面工程协会	2019 年
20			集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员（2017）	集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟	2017 年
21			中国半导体行业协会会员	中国半导体行业协会	2016 年
22	重庆芯洁科技有限公司	科技类	重庆市“专精特新”企业	重庆市经信委	2022 年
23	湖北芯洁科技有限公司	科技类	高新技术企业认定	湖北省高新技术企业认定办公室	2023 年
24	重庆臻宝半导体材料有限公司	科技类	高新技术企业	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局	2025 年

3、承担重大科研项目情况

报告期内，公司牵头承担国家发改委重大技术装备攻关专项项目，并承担客户 2、客户 3、客户 4 等集成电路制造客户承担的国家攻关项目中的部分工作。

（三）研发项目情况

1、正在从事的研发项目情况

为了紧跟集成电路和显示面板制造等下游领域的发展趋势，保持在设备零部件和表面处理服务领域的本土领先优势，努力追赶国际先进水平，公司自成立以来一直坚持自主研发、持续创新的理念，跟进行业技术发展趋势，积极响应国家政策指

引，大力推进自主可控和智能制造。公司结合客户客制化需求，进行产品和技术布局。

公司主要技术创新和研发方向如下：

序号	研发方向	部分创新目标	效益分析
1	现有零部件产品升级 增加新材料产品品类	硅零部件：开发风扇型多晶硅环、高精度硅环、新品硅电极开发 碳化硅零部件：碳化硅环再生及新品开发 石墨零部件：自主开发半导体用高纯石墨部件 石英零部件：开发新型火加工石英零部件、石英喷嘴 工程塑料零部件：开发新型工程塑料零部件 陶瓷零部件：新型陶瓷材料零部件开发 金属零部件：金属气体分配盘、遮蔽框等新品开发	公司顺应下游集成电路和显示面板制造行业发展，进一步巩固设备零部件领域的技术创新优势和领先地位，为集成电路和显示面板制造厂商提供客制化设备零部件，确保公司业务的稳定增长
2	现有表面处理工艺升级	耐等离子涂层：开发多种新型涂层工艺及封孔材料配方 喷涂用粉末：开发氟化钼、氟氧化钼等热喷涂粉末 熔射再生：集成电路先进制程领域的薄膜沉积设备零部件的高致密铝熔射等熔射再生工艺升级	
3	优化原材料生产工艺	研发18寸及以上的大直径单晶硅棒拉制新工艺 化学气相沉积碳化硅气体分配盘原材料的沉积工艺开发	
4	战略新品的研发	自主研发半导体12寸刻蚀设备静电卡盘产品、氮化铝加热器、碳化硅气体分配盘	继续推动半导体设备核心零部件国产代，进一步拓展公司业务发展空间
5	下一代表面处理技术研发	高致密涂层（孔隙率趋近于0）：推动高致密涂层制备技术在零部件产品上的自主可控	拓展集成电路先进制程工艺领域的表面处理业务

截至 2025 年 12 月 31 日，公司正在实施的重点研发项目如下：

序号	项目名称	研发内容和目标	应用于产品和服务	拟达到技术目标	项目阶段
1	大型陶瓷板材 CIP 工艺配方研制项目	研发高致密氧化铝陶瓷板、陶瓷环等零部件	陶瓷零部件	国内领先	在研
2	OLED CVD 四大件再生工艺开发	显示面板产业的主流 OLED 产品再生工艺开发，满足客户的需求，进而提高市场占有率，提高公司竞争力	OLED 产线 CVD 设备用气体扩散器和面板载台	国内领先	在研
3	OLED PICP ESC 新品开发	研究 OLED 工艺使用 PICP ESC 新品制作工艺，满足客户使用需求，实现国产替代	OLED 产线设备用静电卡盘	国内领先	在研
4	半导体 12 寸 Etch 设备静电吸盘开发	自主研发半导体设备用静电卡盘	半导体设备静电卡盘	国内领先	在研
5	CVD SiC SHOWER HEAD 部件工艺开发	实现超厚 CVD-SiC 圆盘的材料制备；在 CVD-SiC 碳化硅圆盘上进行微深孔加工；后处理工艺，达到客户对污染物要求。应用在最先进制程逻辑和存储芯片制造产线	碳化硅零部件	国内领先	在研
6	AlN Heater 陶瓷部件开发项目	研发氮化铝陶瓷与金属共烧技术，陶瓷之间的焊接技术，实现 12 英寸薄膜沉积设备用氮化铝加热器的自主可控	陶瓷零部件	国内领先	在研
7	离子辅助沉积氧化钇涂层技术开发 (GD3)	通过离子辅助沉积技术，将电子束蒸镀与等离子体沉积相结合，开发耐等离子体刻蚀的氧化钇涂层工艺，提高半导体核心零部件的抗刻蚀能力，推动耐等离子体刻蚀保护涂层技术的国产化，应用于 28nm 及以下先进制程	半导体零部件的先进致密涂层制备	国内领先	在研
8	气溶胶沉积氧化钇涂层技术开发 (GD1)	采用气溶胶沉积技术，开发氧化钇涂层制备工艺，提高半导体核心零部件使用寿命和刻蚀工艺稳定性，推动气溶胶沉积技术国产化替代，应用于 28nm 及以下先进制程	半导体零部件的先进致密涂层制备	国内领先	在研
9	GD 商业机搭建和验证	推进高致密耐等离子刻蚀氧化钇涂层的 GD 商用设备搭建和工艺验证，以制备极低孔隙率、高致密、低粒径耐等离子刻蚀涂层，应用于 28nm 及以下先进制程	半导体零部件的先进致密涂层制备	国内领先	在研

序号	项目名称	研发内容和目标	应用于产品和服务	拟达到技术目标	项目阶段
10	静电吸盘 L1-L3 级再生技术开发	通过失效机理与损伤建模、精密修复工艺开发和性能恢复升级技术，掌握静电吸盘陶瓷精密加工、再生技术、电性能检测等核心技术，推动静电吸盘再生技术自主可控	半导体静电卡盘	国内领先	在研

2、受托研发情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在正在履行的受托研发项目。

3、合作研发情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在合作研发。

4、委托研发情况

截至本招股说明书签署日，公司正在履行的委托研发项目主要为公司委托武汉理工大学研究开发的化学气相沉积超厚碳化硅项目。报告期内，公司委托研发的具体情况请见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（四）期间费用分析”之“3、研发费用”之“（3）委外研发项目情况”。

5、研发投入情况

公司高度重视研发工作，持续加大研发投入，通过研发促进技术水平提升和产品性能提升。报告期各期，公司研发费用及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	6,116.94	5,119.27	2,701.63
营业收入	86,758.17	63,450.10	50,635.63
占营业收入的比例	7.05%	8.07%	5.34%

具体情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（四）期间费用分析”之“3、研发费用”。

（四）核心技术人员、研发人员情况

1、研发人员情况

（1）研发人员认定口径

公司研发人员认定口径为当期参与公司研发项目、直接从事研发活动，且当期研发工时占比超过 50%的人员。

（2）报告期各期研发人员数量、占比、学历分布情况

报告期各期末，公司研发人员数量合计为 92 人、113 人和 **145 人**，占员工总数的比例为 11.81%、13.23%和 **14.16%**。

报告期内，公司研发人员学历分布如下：

学历程度	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
硕士及以上	65	44.83%	36	31.86%	17	18.48%
本科	62	42.76%	41	36.28%	46	50.00%
大专	12	8.28%	18	15.93%	18	19.57%
大专以下	6	4.14%	18	15.93%	11	11.96%
合计	145	100.00%	113	100.00%	92	100.00%

报告期各期末，公司研发人员学历在大专及以上的占比均超过 80%，学历分布合理，可满足研发活动的需求。

2、核心技术人员情况

公司综合考虑以下因素认定核心技术人员：

- （1）拥有与公司核心业务相匹配的专业背景，在行业内拥有较为深厚的资历和丰富的工作经验；
- （2）在公司的研发或生产管理岗位上担任重要职务，例如公司的研发部门负责人、总监；
- （3）在公司研发方面承担重要角色，对公司核心产品或服务的研发起到重要作用，对公司主要知识产权具有重要贡献。

报告期内，公司核心技术人员共 5 人，公司核心技术人员的学历背景、专业资质、科研成果和获奖情况，以及对公司研发的具体贡献情况如下：

姓名	学历背景	专业资质、科研成果和获奖情况	对公司研究的贡献
杨佐东	复旦大学硕士	作为发明人的有效授权专利 64 项，其中发明专利 38 项；	主导的技术研究方向为集成电路和显示面板零部件的制造工艺：（1）集成电路方面，2019 年主导 65nm-55nm 干法刻蚀工艺腔体

姓名	学历背景	专业资质、科研成果和获奖情况	对公司研发的贡献
		作为起草人参加的国家标准共 2 项，其中 1 项正在批准中	内硅、石英、陶瓷零部件自主可控开发，并于次年顺利量产；2020 年下半年主导国内最先进逻辑工艺干法刻蚀工艺腔体内硅、石英零部件自主可控，2021 年顺利量产；2021 年第四季度主导国内 3D Nand Flash 工艺干法刻蚀工艺腔体内硅、石英零部件自主可控，并顺利量产；2022 年主导国内 DRAM 工艺干法刻蚀工艺腔体内硅、石英零部件自主可控，并顺利量产。2023 年主导 CVD 碳化硅材料的制备开发，并实现窄带宽的电阻率精准控制，2024 年下半年在客户端小批量测试、试生产。（2）平板显示方面，主导各个世代（4.5G、6G、8.5G/8.6G、10.5G）、各个工艺（A-Si，LTPS，AMOLED）的 ESC 在国内显示头部企业的自主可控
蒋晓钧	中国科学院化学所硕士	作为发明人的申请中发明专利 19 项，作为发明人的有效授权专利 1 项	技术研发方向为集成电路和显示面板先进精密陶瓷材料制备技术及涂层工艺：2023 年主导了半导体级氧化钇、氧化铝粉末造粒开发制造，YOF 涂层工艺的开发；2024 年起至今主导大尺寸陶瓷板材、环材制备技术开发并顺利量产，正在进行高致密涂层新技术研发，高精密陶瓷盖板零部件开发，静电卡盘制备技术研发和氮化铝加热器制备技术研发
陈立航	日本名古屋大学博士	作为发明人的有效授权专利 15 项，均为发明专利	主导的技术研发方向为集成电路和显示面板设备精密结构陶瓷材料制备技术和表面改质（化学反应、阳极氧化、等离子喷涂工艺及喷涂材料）技术：2021 年主导硅材料表面钝化刻蚀及制绒刻蚀开发并实现自产；2022 年主导半导体刻蚀部件氧化钇等离子喷涂及氧化钇粉体开发并实现自产，主导先进粉体（YOF，YF3，YAG 等）工艺开发，以及导入阳极氧化产线和硅气体分配盘配件产线；2023 年主导等离子喷涂高介电材料致密性开发、多相等离子喷涂粉体开发；2024 年主导喷涂用氧化钇粉末及冷等静压氧化铝造粒粉开发及量产；2025 年起至今主导大尺寸陶瓷板材、环材制备技术开发，并顺利量产；主导高精密陶瓷盖板零部件开发
王文彬	兰州大学学士	作为发明人的有效授权专利 20 项，其中发明专利 8 项	主导技术研发方向为集成电路零部件精密加工、表面处理技术以及显示面板 PVD、CVD 等真空零部件的精密清洗再生。2018 年至 2023 年，完成显示面板核心零部件精密清洗工艺的搭建并实现稳定量产。2024 年至今主导开发集成电路核心零部件的精密

姓名	学历背景	专业资质、科研成果和获奖情况	对公司研发的贡献
			加工、表面处理工艺提升以及碳化硅表面处理工艺开发
曾德强	复旦大学硕士	-	主导的技术方向为半导体先进氮化铝陶瓷加热器，刻蚀机耐腐蚀高致密涂层制备工艺技术与设备开发，以及半导体静电吸盘陶瓷后道加工与静电吸盘再生技术研究； 2024 年主导了半导体先进氮化铝加热器制备工艺模块分析，关键制备技术的工艺路线、流程与核心技术指标的制定，并组建了核心团队进行相关核心技术的开发。2025 年作为耐腐蚀高致密涂层技术开发负责人，制定了高致密涂层工艺路线，主导了气溶胶真空冷喷涂与物理气相沉积两种工艺的开发工作。另外，也主导了半导体静电吸盘后道加工工艺路线选择与工艺开发，组建核心技术团队并主导了静电吸盘再生测试与制造工艺的开发

注 1：核心技术人员专利情况更新至 2025 年 12 月 31 日
注 2：曾德强 2024 年 9 月加入公司，在公司任职时间较短，截至 2025 年 12 月 31 日，未在公司拥有专利

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

公司与核心技术人员签署技术保密协议等法律文件，明确约定知识产权的归属，并出台了一系列研发流程管理文件，将核心技术的研发过程进行分段隔离，有效防范技术泄密及人才流失风险。同时，公司对核心技术人员实施积极有效的激励措施，通过给予核心技术人员股权、奖金等方式，将个人利益与公司可持续发展的长期利益绑定，从而确保了核心技术团队的稳定性和凝聚力。

（五）公司保持技术不断创新的机制、技术创新的安排

公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程；公司积极引入材料、化学、微电子和机械等领域的人才，挖掘和提炼半导体材料、产品工艺设计以及化学表面处理技术，形成了相应的技术创新研发模式。

公司直接与客户进行业务合作，能准确了解客户对集成电路和显示面板制造工艺的提升需求，亦逐步构建与客户协同研发、共同提高的研发机制，为客户不断迭

代制造工艺提供了有力支撑。公司各部门协调配合，共同进行设备零部件生产制造及表面处理技术难题的研发立项、设计、实施和验证。公司通过提供关键零部件技术配套支持，保障客户新技术、新工艺的落实。

公司基于对未来市场的预判进行主动研发，不断开发新产品和服务，开拓新的应用市场，保证紧跟新技术发展趋势并且保持技术领先性。

七、环境保护和安全生产情况

公司业务所属行业不属于重污染行业。公司严格依照《环境保护法》等国家相关法律法规生产经营，对生产经营过程中产生的固体废弃物、废水、废气、噪声等进行有效地预防和治理。

（一）环境保护

公司生产经营过程中会产生废气、废水、噪声、固废，不存在高危险、重污染的情况，具体情况如下：

项目	治理对象	处理措施	验收标准
废水	生产废水	生产废水进入厂区综合废水处理站处理达标后与生活污水接入市政污水管网	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	生活污水	生活污水生化池处经市政污水管网排入西彭园区污水处理厂处理	
废气	氟化物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等	通风柜内密闭抽风收集率95%，酸碱雾净化塔处理	重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	阳极酸雾塔：硫酸雾、氮氧化物	通风柜内密闭抽风收集率95%，酸碱雾净化塔处理	《电镀污染物排放标准 GB 21900-2008》
	喷砂、熔射排放的颗粒物	于密闭喷砂间收集并由除尘器净化	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	塑封、擦拭非甲烷总烃	集气罩、封闭装置等收集后经光催化氧化+活性炭吸附装置处理	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	清洗废气	经“UV 光催化+活性炭吸附”或经酸雾喷淋塔处理后经 40m 排气筒排放	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	阳极蒸汽发生器：氮氧化物、林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物	蒸汽发生器处理后排放	《锅炉大气污染物排放标准 DB 50/658-2016》
噪声	中心机加设备、风机房	基础减振、合理布局、厂	《工业企业厂界环境噪声排放

项目	治理对象	处理措施	验收标准
	风机、空压机房空压机、废水处理站水泵等噪音	房隔声	标准》（GB12348-2008）3类区标准
固废	粘蜡、喷砂、研磨、包装、净水等	暂存于一般工业固废临时储存间，定期送一般工业固废处理场处	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	切削液、废研磨剂、设备机油、危险化学品桶、废塑封液、废槽液、擦净布、污泥、废UV灯管、废活性炭等	暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质危废处置单位处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
土壤	/	/	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值
地下水	/	/	《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III类标准限值
其他	食堂油烟	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）	

报告期内，公司及附属公司建设项目存在部分工程未单独编制环评报告，项目实施地点变化未及时办理环评变更手续，未取得环评批复、未完成环评验收即投产的情况，存在程序瑕疵。截止本招股说明书签署日，公司及附属公司已就上述项目环评瑕疵进行整改，已取得重庆市九龙坡区生态环境局、黄冈市生态环境保护综合执法支队出具的合规证明，确认上述环境影响评价手续瑕疵不属于重大违法、违规行为，不会因此受到行政处罚。

综上所述，报告期内，公司严格遵守环境保护各项法律法规，环保手续齐全，环保设施运行正常，各项污染因子均达标排放，在生产经营过程中未发生过严重违反环境保护相关法律法规的行为，也未受到过环保方面的行政处罚，并取得了重庆市九龙坡区生态环境局、黄冈市生态环境保护综合执法支队出具的合规证明。

（二）安全生产

公司始终将安全生产置于首要位置，已建立了系统化、规范化的安全生产管理体系，形成了较为完善的制度体系、组织体系和应急预案措施。公司制定了《安全生产事故报告与处理制度》、《安全生产责任制度》等安全生产制度并严格履行。报告期内，公司不存在构成重大违法行为或构成发行上市障碍的安全事故，其他安

全生产事故和处罚情况如下：

2024 年 11 月，公司员工高大韩在工作期间因其操作失误导致受伤，公司已第一时间联系其就医并申报工伤认定。截至本招股说明书签署日，该员工已基本康复。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的重大事故认定标准及九龙坡区应急管理局出具的专项说明，该起事故不属于重大事故。

综上所述，报告期内公司不存在构成重大违法行为或构成发行上市障碍的生产安全事故或处罚，并取得了重庆市九龙坡区应急管理局出具的合规证明。

八、发行人境外经营情况

公司涉及中国大陆以外的地区和国家客户销售。为更好服务海外客户，公司已设立子公司新加坡臻宝，主要负责销售，不从事生产业务。相应子公司经营和财务情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人子公司、参股公司及分公司情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经天健会计师事务所审计的财务报告。投资者欲对公司进行更详细的了解，应当认真阅读财务报告及审计报告（天健审〔2026〕8-152号）全文。本章讨论与分析所指的数据，除非特别说明，均指合并口径数据。

一、财务报表

天健会计师对公司2023年12月31日、2024年12月31日和**2025年12月31日**的合并及母公司资产负债表，2023年度、2024年度和**2025年度**的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕8-152号）。

（一）合并报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	145,892,536.58	234,812,862.38	329,912,122.45
交易性金融资产	229,176,823.08	152,746,375.46	-
应收票据	1,736.00	1,944,068.54	-
应收账款	290,351,367.88	211,873,895.12	173,017,234.47
预付款项	5,977,045.38	5,096,844.79	4,771,207.09
其他应收款	1,817,484.77	2,045,640.18	1,760,188.13
存货	159,369,925.05	119,323,333.18	102,897,050.25
其他流动资产	42,454,829.89	16,581,169.60	6,606,221.49
流动资产合计	875,041,748.63	744,424,189.25	618,964,023.88
非流动资产：			
投资性房地产	5,813,866.53	-	-
固定资产	389,261,077.70	242,992,205.72	166,885,223.35

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
在建工程	46,925,588.65	35,743,565.58	26,928,517.85
使用权资产	94,209,288.46	93,572,131.56	82,947,171.09
无形资产	7,375,689.49	2,917,475.83	1,704,644.48
长期待摊费用	159,575,028.65	115,442,599.43	99,667,455.09
递延所得税资产	17,346,835.57	9,897,894.25	898,492.72
其他非流动资产	23,127,098.11	26,671,542.53	25,868,938.58
非流动资产合计	743,634,473.16	527,237,414.90	404,900,443.16
资产总计	1,618,676,221.79	1,271,661,604.15	1,023,864,467.04
流动负债：			
短期借款	10,007,486.11	10,018,555.56	3,003,758.33
应付账款	155,861,398.95	80,178,236.67	60,584,212.87
合同负债	1,598,672.96	9,522,338.09	381,724.34
应付职工薪酬	35,399,577.82	25,387,053.78	20,852,424.20
应交税费	18,725,627.54	10,847,203.86	9,597,949.67
其他应付款	543,572.83	1,184,248.99	497,003.24
一年内到期的非流动负债	11,351,650.29	10,935,861.41	9,555,510.11
其他流动负债	1,776,342.53	654,879.94	910,497.45
流动负债合计	235,264,329.03	148,728,378.30	105,383,080.21
非流动负债：			
租赁负债	108,505,247.48	103,607,795.80	90,236,520.77
预计负债	4,897,218.85	3,223,941.02	1,193,190.42
递延收益	59,738,748.08	45,422,103.57	15,886,166.31
递延所得税负债	1,320.49	977.28	-
非流动负债合计	173,142,534.90	152,254,817.67	107,315,877.50
负债合计	408,406,863.93	300,983,195.97	212,698,957.71
所有者权益：			
实收资本/股本	116,467,696.00	116,467,696.00	116,467,696.00
资本公积	551,839,340.07	538,171,527.30	530,512,821.33
其他综合收益	47,543.97	55,229.72	57,898.57
盈余公积	44,661,701.09	28,929,775.38	14,862,658.52

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未分配利润	497,253,076.73	287,054,179.78	149,264,434.91
归属于母公司所有者 权益合计	1,210,269,357.86	970,678,408.18	811,165,509.33
少数股东权益		-	-
所有者权益合计	1,210,269,357.86	970,678,408.18	811,165,509.33
负债和所有者权益 总计	1,618,676,221.79	1,271,661,604.15	1,023,864,467.04

2、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	867,581,663.10	634,500,957.70	506,356,287.39
减：营业成本	435,110,926.54	331,167,964.54	291,417,490.47
税金及附加	5,955,369.15	3,676,887.57	3,926,494.21
销售费用	29,281,697.36	21,718,611.51	20,630,259.34
管理费用	57,172,471.16	52,915,409.78	29,292,603.70
研发费用	61,169,376.76	51,192,733.43	27,016,316.57
财务费用	6,312,260.18	5,220,038.93	5,184,026.43
其中：利息费用	5,743,732.21	4,976,159.92	5,029,885.21
利息收入	1,387,148.69	493,629.00	1,212,604.74
加：其他收益	13,505,668.27	10,472,710.77	7,976,420.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,194,397.90	3,951,043.93	419,641.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,055,513.71	3,018,898.53	241,850.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,397,717.47	-2,008,516.67	-2,880,545.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,021,415.34	-12,447,717.38	-6,910,377.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-9,438.47	-190,961.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,916,009.02	171,586,292.65	127,545,124.98
加：营业外收入	625,793.91	209,093.58	294,105.73
减：营业外支出	846,588.82	1,414,691.39	632,397.73
三、利润总额（亏损总额	264,695,214.11	170,380,694.84	127,206,832.98

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
以“-”号填列)			
减：所得税费用	38,764,391.45	18,523,833.11	17,812,720.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	225,930,822.66	151,856,861.73	109,394,112.60
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	225,930,822.66	151,856,861.73	109,394,112.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列)	225,930,822.66	151,856,861.73	109,394,112.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-7,685.75	-2,668.85	8,840.89
六、综合收益总额	225,923,136.91	151,854,192.88	109,402,953.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,923,136.91	151,854,192.88	109,402,953.49
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股)	1.94	1.30	1.07
（二）稀释每股收益（元/股)	1.94	1.30	1.07

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	881,586,998.35	679,048,731.57	518,359,453.95
收到的税费返还	793,941.42	345,199.07	1,675,458.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,239,333.37	39,290,409.85	8,076,059.38
经营活动现金流入小计	909,620,273.14	718,684,340.49	528,110,972.07
购买商品、接受劳务支付的现金	364,595,856.99	289,100,593.73	261,318,501.69

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	162,639,946.04	130,398,140.97	104,237,394.46
支付的各项税费	81,564,776.71	60,586,081.09	64,628,192.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,852,614.70	32,280,343.59	20,228,874.08
经营活动现金流出小计	650,653,194.44	512,365,159.38	450,412,962.85
经营活动产生的现金流量净额	258,967,078.70	206,319,181.11	77,698,009.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,457,351,207.49	1,676,273,567.00	427,623,411.33
取得投资收益收到的现金	1,400,410.90	-	191,302.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,260.04	66,533.00	103,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	192,869,920.00	-	61,093,333.32
投资活动现金流入小计	1,651,736,798.43	1,676,340,100.00	489,011,547.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,449,627.68	153,031,824.46	119,077,119.48
投资支付的现金	1,528,500,000.00	1,822,050,000.00	426,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	225,390,120.00	-	70,291,055.55
投资活动现金流出小计	2,033,339,747.68	1,975,081,824.46	616,168,175.03
投资活动产生的现金流量净额	-381,602,949.25	-298,741,724.46	-127,156,627.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	396,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,010,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	28,200,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,010,000.00	427,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,010,000.00	7,500,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,036.80	190,484.03	7,750,595.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	10,327,753.99	4,906,407.87	34,504,698.87
筹资活动现金流出小计	20,609,790.79	12,596,891.90	69,755,294.78
筹资活动产生的现金流量净额	-10,609,790.79	-2,586,891.90	357,444,705.22

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,592.08	-89,825.69	-748,315.15
五、现金及现金等价物净增加额	-133,844,253.42	-95,099,260.94	307,237,771.62
加：期初现金及现金等价物余额	234,812,361.20	329,911,622.14	22,673,850.52
六、期末现金及现金等价物余额	100,968,107.78	234,812,361.20	329,911,622.14

（二） 审计意见

1、注册会计师审计意见

天健会计师审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、**2025 年 12 月 31 日**的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、**2025 年度**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

天健会计师认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、**2025 年 12 月 31 日**的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度、2024 年度、**2025 年度**的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、关键审计事项

关键审计事项是天健会计师根据职业判断，认为对 2023 年度、2024 年度、**2025 年度**的财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，天健会计师不对这些事项单独发表意见。

（1）收入确认

1) 事项描述

公司的营业收入主要来自于集成电路和显示面板设备核心零部件的研发、生产和销售以及提供表面处理服务。2023 年度、2024 年度、**2025 年度**实现的营业收入金额分别为人民币 50,635.63 万元、63,450.10 万元、**86,758.17 万元**。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收

入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，天健会计师将收入确认确定为关键审计事项。

2) 审计应对

针对收入确认，天健会计师实施的审计程序主要包括：

①了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

③按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

④对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、运输单、客户签收单、客户耗用单据、客户验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售订单、销售发票、发货单、出口报关单、提单等；

⑤结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

⑥对重要客户进行实地走访，核实客户真实性；

⑦实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

⑧检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（2）应收账款减值

1) 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 **2025 年 12 月 31 日**，公司应收账款账面余额分别为人民币 18,257.43 万元、22,326.01 万元和 **30,565.22 万元**；坏账准备分别为人民币 955.71 万元、1,138.62 万元和 **1,530.09 万元**，账面价值分别为人民币 17,301.72 万元、21,187.39 万元和 **29,035.14 万元**。

公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照

相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，因此，天健会计师将应收账款减值确定为关键审计事项。

2) 审计应对

针对应收账款减值，天健会计师实施的审计程序主要包括：

①了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

②针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

③复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

④对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

⑤结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

⑥检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营能力评价

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（二）合并财务报表范围及变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司纳入合并范围的子公司的情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例		取得方式
			直接	间接	
1	湖北芯洁	湖北省黄冈市	100%	-	设立
2	重庆芯洁	重庆市九龙坡区	100%	-	同一控制下企业合并
3	上海臻宝	上海市宝山区	100%	-	同一控制下企业合并
4	上海升芯	中国（上海）自由贸易试验区	100%	-	同一控制下企业合并
5	臻宝半导体	重庆市九龙坡区	100%	-	设立
6	新加坡臻宝	新加坡	100%	-	设立
7	臻宝技术	上海	100%	-	设立

报告期内，公司新增子公司的情况如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
臻宝技术	设立	2024 年 1 月 8 日	100%

三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%的在建工程项目
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额 5%的承诺事项
重要的或有事项	单项或有事项金额超过资产总额 5%或性质特殊的或有事

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
	项
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 5%的或性质特殊的资产负债表日后事项

四、重要会计政策及会计估计

公司报告期内采用的具体各项会计政策和会计估计详见天健会计师出具的审计报告后附的财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”，本招股说明书仅列示公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司新加坡臻宝从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

（五）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初

始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

注：应收账款及其他应收款的账龄自款项初始确认日起算

3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

（七）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，公司结合存货的种类和特征，按照成本减去可变现净值计算的金额与按照库龄计算的金额综合判断确认。对于库龄 1 年以内的存货，采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于 1 年以上存货，按照库龄、保管状态、预计未来销售情况等因素，结合可变现净值综合考虑计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（八）投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20.00	5.00	4.75
生产设备	直线法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
工具器具及家具	直线法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
运输工具	直线法	4.00-6.00	5.00	15.83-23.75
办公设备	直线法	3.00	5.00	31.67

（十）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产或长期待摊费用。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产/长期待摊费用的标准和时点
装修工程	工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
生产设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期

损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产包括软件使用权和专利权，按成本进行初始计量。

2、无形资产使用寿命及摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法
专利权	按预期受益期限确定使用寿命为 10 年	直线法

3、研发支出的归集范围

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件使用权和专利权的摊销费用。

（5）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

（6）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术服务费、知识产权的申请费、注册费、代理费、会议费、差旅费、通讯费等。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十五）预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十六）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日

的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十七）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时

点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约

义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司主要销售设备核心零部件以及提供表面处理服务，属于在某一时点履行的履约义务，其收入确认的具体方法如下：

（1）设备核心零部件销售

1)内销，分为寄售模式及非寄售模式，①非寄售模式下：对半导体及其他客户，在货物交付客户并经其签收后视同控制权转移，确认收入；对面板客户，在货物交付客户并经其验收后视同控制权转移，确认收入；②寄售模式下，在客户从寄售库领用公司货物时视同控制权转移，确认收入，公司每月与客户确认领用数量，公司以经确认后的寄售耗用明细作为收入确认的依据。

2)外销，按照国际通行的贸易条件确认控制权转移时点从而确认收入：在 FOB 和 CIF 模式下，公司按照合同约定，将产品报关，取得报关单、提单后确认收入；在 DAP 模式下，公司将产品发运至进口国客户指定交货地点并经客户签收确认，取得签收凭证后确认收入。

（2）表面处理服务

公司提供表面处理服务，于将已完成服务的产品按照合同规定运至交货地点并经客户验收时确认收入。

（十八）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

五、重要的会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

报告期内，公司不存在重大会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

报告期内，公司不存在重大会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

报告期内，公司存在会计差错更正事项，天健会计师已出具《关于重庆臻宝科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》（天健审〔2026〕8-155号）。

1、差错更正事项及更正情况

（1）根据研发项目结项时点，将部分研发费用进行调整，相关追溯调整对报告期内财务报表的影响情况如下：

单位：万元

项目	影响金额	
	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
营业成本	7.64	19.47
研发费用	-7.64	-19.47

（2）对报告期内部分研发材料核算及研发活动产生的样品成本重新核算并予以追溯调整，相关追溯调整对报告期内财务报表的影响情况如下：

单位：万元

项目	影响金额	
	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
存货	267.40	238.60
营业成本	123.94	18.10
研发费用	-152.73	-256.70
年初未分配利润	238.60	-

（3）对报告期内部分研发设备折旧、研发人员薪酬、样品费归类至营业成本或销售费用，相关追溯调整对报告期内财务报表的影响情况如下：

单位：万元

项目	影响金额	
	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
营业成本	20.73	16.69
销售费用	1.49	-
研发费用	-22.22	-16.69

根据上述事项调整所得税及盈余公积，相应调整递延所得税资产、所得税费用、应交税费、盈余公积、未分配利润等列报项目。

2、前期差错更正对公司财务状况、经营成果的主要影响

（1）2024 年 12 月 31 日/2024 年度

单位：万元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	11,664.94	267.40	11,932.33
资产总计	126,898.76	267.40	127,166.16
应交税费	964.08	120.64	1,084.72
负债合计	29,977.68	120.64	30,098.32
盈余公积	2,877.35	15.63	2,892.98
未分配利润	28,574.29	131.13	28,705.42
所有者权益合计	96,921.08	146.76	97,067.84
营业成本	32,964.49	152.31	33,116.80
销售费用	2,170.38	1.49	2,171.86
研发费用	5,301.86	-182.59	5,119.27
利润总额	17,009.28	28.79	17,038.07
所得税费用	1,818.18	34.20	1,852.38
净利润	15,191.09	-5.41	15,185.69

（2）2023 年 12 月 31 日/2023 年度

单位：万元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	10,051.10	238.60	10,289.71
资产总计	102,147.84	238.60	102,386.45
应交税费	873.36	86.44	959.79
负债合计	21,183.46	86.44	21,269.90
盈余公积	1,470.95	15.32	1,486.27
未分配利润	14,789.60	136.85	14,926.44
所有者权益合计	80,964.38	152.17	81,116.55
营业成本	29,087.49	54.26	29,141.75
研发费用	2,994.49	-292.86	2,701.63
利润总额	12,482.08	238.60	12,720.68
所得税费用	1,701.56	79.72	1,781.27
净利润	10,780.52	158.89	10,939.41

3、原始报表与申报报表的差异调整对净利润和净资产的影响情况

报告期各期，原始报表与申报报表的差异调整对净利润和净资产的影响情况如下表：

单位：万元

项目	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	申报财务报表净利润①	22,593.08	15,185.69	10,939.41
	原始财务报表净利润②	22,593.08	15,191.09	10,820.94
	申报财务报表与原始财务报表净利润差异③=①-②	-	-5.41	118.47
净资产	申报财务报表净资产①	121,026.94	97,067.84	81,116.55
	原始财务报表净资产②	121,026.94	96,921.08	81,696.77
	申报财务报表与原始财务报表净资产差异③=①-②	-	146.76	-580.22

4、本次前次差错更正不构成公司在会计基础工作规范及相关内控方面不符合发行条件的情形

本次公司会计差错更正对公司日常经营不构成直接影响，对公司报告期内财务状况、经营成果影响较小，更正后的相关会计处理更加准确，符合企业会计准则要

求，调整后的报表更真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果。公司不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，不存在滥用会计政策或者会计估计，不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录等情形，差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，不存在会计基础薄弱和内控缺失的情形，公司在会计基础工作规范及相关内控方面符合发行条件。

六、非经常性损益

（一）非经常性损益的具体内容及金额

天健会计师对公司最近三年的非经常性损益进行了鉴证，并出具了《关于重庆臻宝科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕8-154号）。报告期内，公司非经常性损益情况具体如下：

单位：万元			
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5.29	-12.15	-24.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,019.15	765.70	620.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	524.99	696.99	66.15
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-812.98	-557.96	-138.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.79	-109.35	-28.38
小计	709.08	783.23	495.53
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	216.95	111.81	66.74
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	492.13	671.42	428.79

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 428.79 万元、671.42 万元和 492.13 万元，主要为计入当期损益的政府补助、银行理财产品带来

的投资收益、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用。

（二）非经常性损益对当期经营成果的影响

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额	492.13	671.42	428.79
归属于母公司股东的净利润	22,593.08	15,185.69	10,939.41
占比	2.18%	4.42%	3.92%
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	22,100.95	14,514.26	10,510.63

七、发行人适用的税种、税率及主要税收优惠政策

（一）主要税种、税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、20%、25%

公司子公司存在不同企业所得税税率的情况，具体如下：

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
臻宝科技	15%	15%	15%
重庆芯洁	15%	15%	15%
新加坡臻宝	17%	17%	17%
上海臻宝	20%	20%	20%
臻宝半导体	15%	15%	15%
上海升芯	20%	20%	20%
湖北芯洁	25%	20%	20%

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
臻宝技术	20%	20%	-

注：新加坡臻宝为境外子公司，适用所在地税率

（二）主要税收优惠政策

1、根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局 2022 年核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202251100848，有效期三年）及 2025 年核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551102044，有效期三年），公司被认定为高新技术企业，报告期内企业所得税按 15%缴纳。

根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局 2025 年核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551103562，有效期三年），臻宝半导体被认定为高新技术企业，2025 年度企业所得税按 15%缴纳。

2、根据财政部、税务总局、国家发改委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。重庆芯洁、臻宝半导体符合西部地区鼓励类产业目录界定的产业范围，享受西部大开发企业所得税优惠政策，2023 年度至 2025 年度企业所得税按 15%缴纳。

3、根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。该公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号）、《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海臻宝 2023 年度至 2025 年度属于小型微利企业，

企业所得税按 20%缴纳；湖北芯洁 2023 年度至 2024 年度属于小型微利企业，企业所得税按 20%缴纳。上海升芯 2023 年度至 2025 年度属于小型微利企业，企业所得税按 20%缴纳。

4、根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。2023 年度至 2025 年度，公司享受该税收优惠政策。

八、主要财务指标

（一）基本财务指标

主要财务指标	2025. 12. 31/2025 年度	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度
流动比率（倍）	3. 72	5.01	5.87
速动比率（倍）	3. 04	4.20	4.90
资产负债率（母公司）	22. 80%	17.57%	17.37%
资产负债率（合并）	25. 23%	23.67%	20.77%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	10. 39	8.33	6.96
利息保障倍数（倍）	47. 08	35.24	26.29
存货周转率（次）	2. 80	2.67	2.86
应收账款周转率（次）	3. 28	3.13	3.23
息税折旧摊销前利润（万元）	34, 632. 40	22,866.08	17,227.51
归属于发行人股东的净利润（万元）	22, 593. 08	15,185.69	10,939.41
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	22, 100. 95	14,514.26	10,510.63
研发投入占营业收入的比例	7. 05%	8.07%	5.34%
每股经营活动产生的现金流量（元）	2. 22	1.77	0.67
每股净现金流量（元）	-1. 15	-0.82	2.64

注：上述财务指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的期末净资产/期末普通股份总数；

5、利息保障倍数=息税前利润/利息费用；

- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
7、存货周转率=营业成本/存货平均余额；
8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
9、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入；
10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加/（减少）额/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

项目	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	20.73	1.94	1.94
	2024 年度	17.06	1.30	1.30
	2023 年度	24.78	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2025 年度	20.28	1.90	1.90
	2024 年度	16.31	1.25	1.25
	2023 年度	23.81	1.03	1.03

注：上述财务指标的具体计算公式如下：

（1）加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数

（2）每股收益计算公式

1）基本每股收益= $P_0 \div SS = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

2）稀释每股收益= $P_1 \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整

九、影响发行人报告期及未来经营能力或财务状况的因素

（一）影响公司经营能力及财务状况的主要因素

1、公司产品特点

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案，主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。公司零部件产品和表面处理服务主要应用于集成电路行业等离子体刻蚀、薄膜沉积等工艺的半导体设备和显示面板行业等离子体刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等工艺的面板制造设备。

公司产品应用于集成电路及显示面板行业，业务具有“多品种、小批量”的特点，主要系相关设备零部件种类繁多、工艺复杂所致，因此单价和毛利率差异较大。公司产品销售价格和产品结构的变化直接影响公司主营业务收入和毛利率，从而影响公司未来盈利能力和财务状况。公司产品的收入构成分析详见本节之“十、盈利能力分析”之“（一）主营业务收入分析”。公司产品的毛利率分析详见本节之“十、盈利能力分析”之“（三）主营业务毛利及毛利率分析”。

2、公司业务模式

公司结合主要产品和服务特点、自身发展历史、竞争优劣势以及国家产业政策、宏观背景和同行业竞争对手等因素，形成了目前的业务模式，符合自身发展及行业特点，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（三）公司主要经营模式”。

公司持续开拓全球集成电路及显示面板龙头企业客户，通过品质良好的零部件产品和表面处理服务，取得其对公司技术和服务的认可，以树立公司的市场声誉；凭借在行业取得的业绩和声誉，公司持续开拓集成电路及显示面板行业新兴区域市场。经过多年的努力，公司已与国内外集成电路及显示面板行业龙头企业形成了较为稳定的合作关系，市场影响力和占有率逐步提升。同时，公司会不断根据客户的新品研发来调整或升级工艺，具有较强的客户协同产品或工艺开发能力优势。

公司与国内集成电路和显示面板制造的头部厂商建立了长期稳定的合作关系，产品已批量供应国内业界龙头企业。同时，公司保持对下游集成电路领域零部件新产品的研发，并持续开发新客户，公司未来的经营业绩将保持稳定的增长。

3、公司所处行业发展趋势

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案，主要产品和服务为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件产品，以及熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务，经营业绩与集成电路和面板行业及表面处理行业的发展趋势密切相关。

半导体设备及零部件位于半导体产业链的上游，其市场规模随着下游半导体技术发展和市场需求而波动。根据 SEMI 的统计，2024 年全球设备支出预计达到 1,171 亿美元，未来三年将持续增长，中国已连续五年为全球半导体设备最大市场。预计中国芯片制造商在 2024 年增长 15%至 885 万片/月，2025 年将增长 14%至 1010 万片/月，国内晶圆厂产能的快速扩张为设备零部件及表面处理服务提供了快速发展契机。

因此，在市场快速发展、国产替代进程不断推进的背景下，公司所处行业的市场空间将不断扩大，营业收入和经营业绩也将随之增长。

（二）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

根据公司所处行业的状况和公司业务特点，主营业务收入、主营业务毛利率等指标对分析公司财务状况和盈利能力具有重要的意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。关于主营业务收入和主营业务毛利率的分析详见本节之“十、盈利能力分析”之“（一）主营业务收入分析”、“（三）主营业务毛利及毛利率分析”。

同时，公司管理层认为，公司优质的客户群、核心技术水平专利数量以及重要研发项目进展等对公司具有重要意义，是对业绩变动具有较强预示作用的非财务指标。

十、盈利能力分析

报告期各期，公司的经营情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	86,758.17	63,450.10	50,635.63
营业成本	43,511.09	33,116.80	29,141.75
营业利润	26,491.60	17,158.63	12,754.51
利润总额	26,469.52	17,038.07	12,720.68
净利润	22,593.08	15,185.69	10,939.41
归属于母公司股东的净利润	22,593.08	15,185.69	10,939.41
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	22,100.95	14,514.26	10,510.63

公司 2023 年度至 2025 年度营业收入复合增长率为 30.90%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的复合增长率为 45.01%。报告期内，公司持续进行研发积累及技术创新，持续开发新客户，业务规模持续扩大，公司营业收入及净利润整体呈增长趋势。

（一）主营业务收入分析

1、营业收入的构成分析

报告期内，公司营业收入构成如下所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	84,556.89	97.46%	63,268.72	99.71%	50,461.13	99.66%
其他业务收入	2,201.28	2.54%	181.38	0.29%	174.49	0.34%
合计	86,758.17	100.00%	63,450.10	100.00%	50,635.63	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 50,461.13 万元、63,268.72 万元和 84,556.89 万元，2023 年至 2025 年主营业务收入年均复合增长率为 29.45%，主营业务收入持续增长。公司其他业务收入为给客户提供的驻场服务费，销售废料、废

砂等收入，整体占比较小。报告期内，公司营业收入主要由主营业务收入构成，公司主营业务突出。

2、主营业务收入的变动分析

（1）主营业务收入按产品分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、半导体行业	65,564.98	77.54%	45,687.11	72.21%	31,864.14	63.15%
零部件产品	61,313.59	72.51%	43,064.36	68.07%	30,541.94	60.53%
表面处理服务	2,970.91	3.51%	1,998.97	3.16%	930.56	1.84%
其他	1,280.48	1.51%	623.78	0.99%	391.63	0.78%
二、显示面板行业	18,916.73	22.37%	17,203.95	27.19%	18,083.52	35.84%
表面处理服务	13,622.17	16.11%	12,766.38	20.18%	13,943.35	27.63%
零部件产品	5,288.21	6.25%	4,430.15	7.00%	4,093.37	8.11%
其他	6.35	0.01%	7.41	0.01%	46.81	0.09%
三、其他行业	75.19	0.09%	377.66	0.60%	513.48	1.02%
合计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为 50,461.13 万元、63,268.72 万元和 84,556.89 万元。主营业务收入主要来源于半导体行业及显示面板行业的产品及服务收入，主要产品包括石英零部件、硅零部件、工程塑料零部件、碳化硅零部件和陶瓷零部件等，以及前述设备核心零部件表面处理服务。

1) 半导体行业产品收入变动分析

报告期内，半导体行业持续发展，随着终端应用市场的发展推动国内半导体行业发展以及晶圆厂扩建，晶圆厂及半导体设备厂商对设备零部件的需求稳步增长。目前公司半导体设备零部件产品已批量供应国内最先进的逻辑芯片制造厂商、3D NAND FLASH 存储芯片制造厂商和先进 DRAM 存储芯片制造厂商。此外，公司通过不断加大研发投入，开发新技术和新产品，并逐步拓展行业内其他客户，公司在

半导体行业的产品及服务收入金额及占比持续增长。报告期内，公司半导体行业主要产品的变动情况具体分析如下：

①零部件产品

报告期内，半导体行业零部件产品的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况如下：

年度	销售收入（万元）	占比（%）	销量（万件）	平均单价（元/件）
2025	61,313.59	72.51	23.75	2,581.73
2024	43,064.36	68.07	21.35	2,017.14
2023	30,541.94	60.53	16.95	1,801.57

报告期内，半导体行业零部件产品的收入分别为 30,541.94 万元、43,064.36 万元和 **61,313.59 万元**，呈逐年增长的趋势，主要系公司客户在报告期内的采购金额增加所致。报告期各期，半导体行业零部件产品的单价受客户采购的产品结构变动而有所波动。2023 年当期部分客户采购了较多单价相对较低的石英窗产品，导致当年度平均单价有所下降；2024 年当期单价较高的硅零部件收入占比提升，导致当年度平均单价显著上升；**2025 年，单价较高的石英和硅零部件的销量占比提升，导致当年度平均单价有所上升。**

②半导体行业表面处理服务

报告期内，半导体行业的表面处理服务的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况如下：

年度	销售收入（万元）	占比（%）	销量（万件）	平均单价（元/件）
2025	2,970.91	3.51	5.68	523.14
2024	1,998.97	3.16	7.31	273.52
2023	930.56	1.84	2.19	425.69

报告期内，半导体行业表面处理收入与占比逐年提升，主要系公司持续拓展客户并新增产品服务，熔射再生及精密清洗服务的收入金额及占比均逐年上升。因不同客户及服务的产品结构差异较大，平均单价存在较大波动。

2）显示面板行业产品收入变动分析

报告期内，公司在显示面板领域的整体收入较为稳定。公司在显示面板零部件及表面处理服务领域的市场地位稳固，产品应用于超大世代 LCD、AMOLED/Micro LED 等高端或新型技术产线，在多项产品上实现了自主可控，产品应用覆盖龙头面板厂商。同时，公司积极进行内部产品结构调整，重点开发高端高难度产品。公司在显示面板领域成功实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV-5KV 超高压工艺和 OLED 工艺制造设备关键零部件（静电卡盘）以及 PVD 设备中关键零部件（双极静电卡盘）的自主可控。

①显示面板行业表面处理服务

报告期内，显示面板行业表面处理服务的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况如下：

年度	销售收入（万元）	占比（%）	销量（万件）	平均单价（元/件）
2025	13,622.17	16.11	1.69	8,044.98
2024	12,766.38	20.18	1.59	8,013.05
2023	13,943.35	27.63	1.45	9,612.46

公司显示面板行业表面处理服务应用于产业龙头客户的高世代产线，2023-2025 年度，销量不断提升，公司在主要客户的竞争力持续增强。受部分客户成本控制影响，报告期内，该业务的销售单价有所波动，但该业务整体收入水平保持平稳。

②零部件产品

报告期内，显示面板行业零部件产品的收入金额及占主营业务收入比重、销量及平均单价情况如下：

年度	销售收入（万元）	占比（%）	销量（万件）	平均单价（元/件）
2025	5,288.21	6.25	8.26	640.50
2024	4,430.15	7.00	7.11	623.35
2023	4,093.37	8.11	4.66	877.76

报告期内，显示面板行业零部件产品销量逐年上升。2023 年度，部分客户采购

了较多单价较高的产品，因此当年度平均单价及销售收入相比上年显著提升。2024年度，部分客户采购了较多单价较低的产品，因此当年度平均单价相比 2023 年度有所下降。2025 年，受当期销售的陶瓷零部件产品结构影响，当期平均单价及收入较上年有所提升。

(2) 主营业务收入按地区分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	83,899.68	99.22%	62,967.53	99.52%	50,398.45	99.88%
境外	657.20	0.78%	301.19	0.48%	62.68	0.12%
合计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于境内，境内收入占主营业务收入的比例分别为 99.88%、99.52%和 99.22%。

报告期内，公司产品及服务销售覆盖区域较广，其中华东、华中、西南区域销售规模较大，销售金额与主要客户所在地区基本一致。

(3) 主营业务收入按季节分析

报告期内，公司主营业务收入按季节分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一季度	16,516.91	19.53%	12,841.57	20.30%	12,070.04	23.92%
二季度	18,846.60	22.29%	15,299.55	24.18%	11,257.22	22.31%
三季度	22,703.88	26.85%	16,763.78	26.50%	11,207.78	22.21%
四季度	26,489.49	31.33%	18,363.81	29.03%	15,926.10	31.56%
合计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，受春节放假等因素导致一季度收入占比较低外，公司其他各季度收

入占比较稳定，行业的季节性不太明显。

（4）主营业务按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	80,836.01	95.60%	62,121.69	98.19%	49,714.01	98.52%
经销	3,720.88	4.40%	1,147.03	1.81%	747.13	1.48%
总计	84,556.89	100.00%	63,268.72	100.00%	50,461.13	100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于直接客户，经销商贡献的收入占比较低。

（5）第三方回款

报告期内，公司销售存在第三方回款的情形，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
第三方回款金额	4,534.75	794.70	22.62
营业收入	86,758.17	63,450.10	50,635.63
占比	5.23%	1.25%	0.04%

报告期内，公司因客户——TCL 华星光电、英特尔（大连）的供应链管理存在第三方回款的情形，具体如下：

TCL 华星光电技术有限公司、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司等 TCL 华星光电下属公司受其所属集团统一安排，遵循 TCL “金单” 模式支付公司货款。TCL 金单是指 TCL 集团的成员根据 TCL 集团设立并运营的“简单汇平台”的规则和指引，开具的显示基础合同项下 TCL 集团成员与基础合同交易对方之间债权债务关系的凭证。在金单模式下，TCL 对集团内成员单位统一进行商业信用管理，发挥供应链金融平台的作用。

英特尔（大连）聘请大连精典优普电子有限公司（以下简称“大连精典”）担任其 VMI 服务商，大连精典为英特尔（大连）提供订单管理、物流追踪及库存管理等服务。在该等模式下，发行人虽然与英特尔（大连）签署了购销协议，但日常订单下达、资金支付均由大连精典根据英特尔（大连）的指示进行。

报告期内，上述第三方回款具有真实的业务背景，符合公司所在行业的特点以及公司的商业模式，具有商业合理性；第三方回款所涉金额较小，占营业收入的比例较低，不存在虚构交易或调节账龄情形。

（二）主营业务成本分析

1、营业成本的构成分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	43,399.81	99.74%	33,078.94	99.89%	29,044.85	99.67%
其他业务成本	111.29	0.26%	37.86	0.11%	96.90	0.33%
合计	43,511.09	100.00%	33,116.80	100.00%	29,141.75	100.00%

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，公司营业成本与营业收入呈现出相同的变化趋势。

2、主营业务成本按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类别构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、半导体行业	29,065.90	66.97%	19,840.75	59.98%	14,635.08	50.39%
零部件产品	26,784.96	61.72%	18,488.67	55.89%	13,853.03	47.70%
表面处理服务	1,328.12	3.06%	961.13	2.91%	536.14	1.85%
其他	952.83	2.20%	390.95	1.18%	245.91	0.85%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
二、显示面板行业	14,235.80	32.80%	12,895.81	38.98%	13,938.09	47.99%
表面处理服务	10,471.92	24.13%	9,306.06	28.13%	10,717.91	36.90%
零部件产品	3,759.09	8.66%	3,586.35	10.84%	3,181.83	10.95%
其他	4.78	0.01%	3.40	0.01%	38.35	0.13%
三、其他行业	98.11	0.23%	342.38	1.04%	471.67	1.62%
合计	43,399.81	100.00%	33,078.94	100.00%	29,044.85	100.00%

3、主营业务成本按成本类别分析

报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	19,546.36	45.04%	16,081.59	48.62%	13,241.50	45.59%
直接人工	6,090.54	14.03%	5,425.55	16.40%	5,103.43	17.57%
制造费用	17,762.90	40.93%	11,571.79	34.98%	10,699.91	36.84%
合计	43,399.81	100.00%	33,078.94	100.00%	29,044.85	100.00%

公司主营业务成本由直接材料、直接人工及制造费用构成。其中，直接材料包括石英、陶瓷、硅和熔射粉等，直接人工系从事生产的员工薪酬，制造费用系为生产产品及提供服务而发生的各项间接费用，包括低值易耗品费用、固定资产折旧费、水电气费等。直接材料和制造费用是公司主营业务成本的主要组成部分，报告期各期二者合计占主营业务成本的 82.43%、83.60%和 **85.97%**，较为稳定。**2025 年**公司制造费用占比较上年有所提升，系因扩产导致固定资产折旧费用增加所致。

（三）主营业务毛利及毛利率分析

1、毛利及综合毛利率

报告期内，公司产品综合毛利和综合毛利率的基本情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	86,758.17	63,450.10	50,635.63
营业成本	43,511.09	33,116.80	29,141.75
综合毛利	43,247.07	30,333.30	21,493.88
综合毛利率	49.85%	47.81%	42.45%

2、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、半导体行业	36,499.07	88.68%	25,846.36	85.61%	17,229.05	80.45%
零部件产品	34,528.64	83.89%	24,575.70	81.40%	16,688.91	77.93%
表面处理服务	1,642.79	3.99%	1,037.84	3.44%	394.41	1.84%
其他	327.64	0.80%	232.83	0.77%	145.73	0.68%
二、显示面板行业	4,680.93	11.37%	4,308.14	14.27%	4,145.43	19.36%
表面处理服务	3,150.25	7.65%	3,460.32	11.46%	3,225.44	15.06%
零部件产品	1,529.11	3.72%	843.81	2.80%	911.54	4.26%
其他	1.57	0.00%	4.01	0.01%	8.46	0.04%
三、其他行业	-22.92	-0.06%	35.28	0.12%	41.80	0.20%
合计	41,157.08	100.00%	30,189.78	100.00%	21,416.29	100.00%

报告期各期，公司主营业务毛利分别为 21,416.29 万元、30,189.78 万元和 41,157.08 万元，随着业务规模的增加，公司毛利水平逐年提高。

报告期内，公司毛利主要来源于半导体行业产品和服务。公司主要产品各期的毛利持续增长，主要系公司在报告期内保持对下游半导体领域零部件新产品的研发，并持续开发新客户所致。

3、主营各业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率及占主营业务收入比重按产品分类情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
一、半导体行业	55.67%	77.54%	56.57%	72.21%	54.07%	63.15%
零部件产品	56.31%	72.51%	57.07%	68.07%	54.64%	60.53%
表面处理服务	55.30%	3.51%	51.92%	3.16%	42.38%	1.84%
其他	25.59%	1.51%	37.33%	0.99%	37.21%	0.78%
二、显示面板行业	24.74%	22.37%	25.04%	27.19%	22.92%	35.84%
表面处理服务	23.13%	16.11%	27.10%	20.18%	23.13%	27.63%
零部件产品	28.92%	6.25%	19.05%	7.00%	22.27%	8.11%
其他	24.67%	0.01%	54.07%	0.01%	18.07%	0.09%
三、其他行业	-30.48%	0.09%	9.34%	0.60%	8.14%	1.02%
主营业务毛利率	48.67%	100.00%	47.72%	100.00%	42.44%	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 42.44%、47.72%和 **48.67%**，毛利率整体稳中有升。2024 年度，公司主营业务毛利率相比上年提升了 5.28 个百分点，主要系半导体行业产品毛利率提升带动整体毛利率提升所致。**2025 年度，公司主营业务毛利率相比上年不存在较大波动。**报告期内，公司分产品的毛利率波动情况如下：

（1）半导体行业

1) 零部件产品

报告期内，半导体行业零部件产品的平均单价、平均单位成本和毛利率情况如下：

年度	平均单价（元/件）	单位成本（元/件）	毛利率
2025	2,581.73	1,127.84	56.31%
2024	2,017.14	866.01	57.07%
2023	1,801.57	817.14	54.64%

报告期内，公司半导体零部件产品毛利率分别为 54.64%、57.07%和 **56.31%**。2022-2024 年，公司毛利率逐年上涨，主要原因为：①公司不断增加研发投入，高端产品陆续通过客户验证并逐步上量；②公司对成本管控进一步精细化，并在报告期内持续提升设备自动化水平，降低产品生产成本。**2025 年，公司毛利率有所回落，**

整体较稳定。

2) 表面处理服务

报告期内，半导体行业表面处理服务的平均单价、平均单位成本和毛利率情况如下：

年度	平均单价（元/件）	单位成本（元/件）	毛利率
2025	523.14	233.86	55.30%
2024	273.52	131.51	51.92%
2023	425.69	245.26	42.38%

公司半导体行业表面处理服务主要包括熔射再生和精密清洗等。2022 年，半导体行业表面处理业务处于起步阶段，当年度实现的收入与销量较小，尚未形成规模效应，导致该业务分摊的固定成本较高，毛利率因此为负。2023 年以来，表面处理服务销量和收入显著提升，随着规模效应逐步体现，毛利率由负转正并逐年提升。2023 年至 2025 年，表面处理服务单价、单位成本出现波动，主要系客户采购的产品结构存在变动所致。2023 年，公司客户主要采购高附加值的业务；2024 年，由于部分客户采购的精密清洗业务产品小、数量多，平均单价和单位成本低，因此公司表面处理服务的平均单价和单位成本有所下降；2025 年，客户采购高附加值的精密清洗业务有所增加，平均单价有所回升。

(2) 显示面板行业

1) 表面处理服务

报告期内，表面处理服务的平均单价、平均单位成本和毛利率情况如下：

年度	平均单价（元/件）	单位成本（元/件）	毛利率
2025	8,044.98	6,184.51	23.13%
2024	8,013.05	5,841.11	27.10%
2023	9,612.46	7,388.86	23.13%

公司显示面板行业表面处理服务主要包括熔射再生和精密清洗等。2023 年，受客户成本控制影响，整体毛利率有所下滑。2024 年，公司进行工艺改进，获得了成本效益，因此当年度毛利率相比上年同期有所增加。2025 年，受客户年度议价及行

业竞争影响，毛利率略有下滑。

2) 零部件产品

报告期内，显示面板行业零部件的平均单价、平均单位成本和毛利率情况如下：

年度	平均单价（元/件）	单位成本（元/件）	毛利率
2025	640.50	455.29	28.92%
2024	623.35	504.62	19.05%
2023	877.76	682.30	22.27%

报告期内，公司显示面板零部件产品毛利率分别为 22.27%、19.05%和 **28.92%**。**2023-2024 年**，该产品毛利率整体较为稳定。**2025 年**，显示面板零部件毛利率相比上年上升 **9.87** 个百分点，主要是毛利率较高的陶瓷零部件收入提升所致。销售单价各期存在一定波动主要系各年销售的产品结构不同所致。

4、同行业上市公司毛利率比较

报告期内，公司与同行业可比公司综合毛利率对比如下：

毛利率	2025 年度	2024 年度	2023 年度
先锋精科	尚未披露	33.83%	29.93%
珂玛科技	尚未披露	58.49%	39.78%
富乐德	尚未披露	39.76%	38.27%
富创精密	尚未披露	25.80%	25.20%
凯德石英	尚未披露	41.67%	38.90%
平均	尚未披露	39.91%	34.42%
公司	49.85%	47.81%	42.45%

数据来源：可比公司招股说明书、年度报告、wind

先锋精科、富创精密及凯德石英的业务或产品包含应用于半导体设备的零部件；富乐德主要从事表面处理服务；珂玛科技业务涵盖泛半导体领域的零部件和表面处理服务；前述上市公司与公司具有一定的可比性。报告期内，公司毛利率与珂玛科技水平较为接近，总体高于先锋精科、富创精密、富乐德及凯德石英。

公司毛利率与可比公司存在差异主要原因系客户及产品构成有所差别。先锋精

科、富创精密的主要客户为半导体设备厂商，而公司主要向制造厂商销售，业务模式存在差异。凯德石英的主要产品为石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品，而公司石英零部件产品主要包括石英环、石英盘、石英窗等，部分产品与晶圆直接接触，属于集成电路制造中关键的零部件，与凯德石英的细分产品存在差异。富乐德主要从事泛半导体设备的清洗服务，其综合毛利率与公司同类业务毛利率相似。2024 年，珂玛科技毛利率较上年有较大提升，主要是因为珂玛科技当年度毛利较高的半导体产品收入占比上升所致。

综上所述，发行人毛利率高于同行业可比公司具有合理性。其中，公司下游为半导体行业的产品收入占比持续增长，毛利率整体呈现上升趋势，与公司的业务发展趋势一致。同时，公司在报告期内保持对下游半导体领域零部件新产品的研发，并持续开发新客户，毛利率水平具有可持续性。

报告期内，公司主营业务成本逐年上升，与主营业务收入构成和变动基本一致。随着公司各类产品和服务的业务规模不断扩大，主营业务收入不断增长，主营业务成本相应增加。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的金额和费用率情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	2,928.17	3.38%	2,171.86	3.42%	2,063.03	4.07%
管理费用	5,717.25	6.59%	5,291.54	8.34%	2,929.26	5.78%
研发费用	6,116.94	7.05%	5,119.27	8.07%	2,701.63	5.34%
财务费用	631.23	0.73%	522.00	0.82%	518.40	1.02%
合计	15,393.58	17.74%	13,104.67	20.65%	8,212.32	16.22%

报告期内，随着公司业务规模的增长，公司期间费用金额不断上升。公司期间费用分别为 8,212.32 万元、13,104.67 万元和 15,393.58 万元，占各期营业收入的比例分别为 16.22%、20.65%和 17.74%。

1、销售费用

（1）销售费用构成和变动分析

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,294.19	44.20%	996.73	45.89%	924.27	44.80%
样品费	738.71	25.23%	457.49	21.06%	499.03	24.19%
业务招待费	409.45	13.98%	373.78	17.21%	366.61	17.77%
差旅费	182.11	6.22%	114.23	5.26%	99.79	4.84%
折旧与摊销	61.78	2.11%	57.64	2.65%	49.22	2.39%
股份支付	57.99	1.98%	47.55	2.19%	58.60	2.84%
其他	183.94	6.28%	124.44	5.73%	65.50	3.17%
合计	2,928.17	100.00%	2,171.86	100.00%	2,063.03	100.00%

报告期内，公司销售费用分别为2,063.03万元、2,171.86万元和**2,928.17万元**，占营业收入的比例分别为4.07%、3.42%和**3.38%**，销售费用率呈现下降趋势。公司2024年度销售费用率低于2023年度，主要系公司客户结构趋于稳定，销售费用增长金额较少，营业收入增长金额较高所致。**公司2025年度销售费用率较为稳定。**

报告期内，公司销售费用主要包括职工薪酬、样品费和业务招待费，上述费用合计占比分别为86.76%、84.17%和**83.41%**，具体变动分析如下：

1) 职工薪酬

报告期内，公司销售费用中职工薪酬分别为924.27万元、996.73万元和**1,294.19万元**，占当期销售费用的比例分别为44.80%、45.89%和**44.20%**。报告期内，随着报告期内公司业务规模的扩大，公司销售人员数量有所增加，职工薪酬支出略有增长。

2) 样品费

报告期内，公司销售费用中样品费分别为499.03万元、457.49万元和**738.71**

万元，均系公司开发新产品和新客户提供的样品实物。2024 年度，样品费较为稳定，主要为公司持续进行新品推广和新客户开拓。2025 年度，样品费金额增长，主要系公司持续开发新产品和新客户，推进产品验证所致。

3) 业务招待费

报告期内，公司销售费用中业务招待费分别为366.61万元、373.78万元和409.45万元，主要为公司为市场开拓和原有客户的维护而发生的业务招待费用。报告期内公司业务招待费用金额较为稳定，受收入规模增长影响，占营业收入的比例逐年下降。

(2) 销售费用率与可比公司对比情况

报告期内，公司销售费用率与可比公司的对比情况如下：

指标	公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售费用率（%）	先锋精科	尚未披露	0.58	0.90
	珂玛科技	尚未披露	2.65	3.81
	富乐德	尚未披露	6.17	6.29
	富创精密	尚未披露	1.99	1.77
	凯德石英	尚未披露	1.87	1.96
	可比公司平均值	尚未披露	2.65	2.95
	公司	3.38	3.42	4.07

注：销售费用率=销售费用/营业收入，可比上市公司数据来源于 Wind

公司的销售费用率高于先锋精科、珂玛科技、富创精密和凯德石英，低于富乐德，主要系主营业务及对应的销售模式差异所致。

先锋精科、富创精密的主要客户为半导体设备厂商，而公司主要客户为晶圆和显示面板制造厂商，业务模式存在差异。报告期内，公司加大新产品的开发力度，向客户送样较多，与可比公司相比，公司的样品费较高。

先锋精科销售费用主要包括服务费、销售人员薪酬和业务招待费等，其客户集中度较高，且销售人员人数较少，销售人员薪酬费用较低，因此销售费用率较低；富创精密销售费用以职工薪酬、业务招待费和差旅费为主，客户集中度较高，且收

入规模较大，呈现出明显的规模效应，因此销售费用率较低；珂玛科技的销售费用率略低于公司，主要为公司为开拓新的客户产生的样品费较高；凯德石英销售费用以职工薪酬为主，其销售人员数量较少，销售费用率较低；富乐德销售费用率相对较高，主要系其主要业务为表面处理，需要派出较多服务人员所致。

2、管理费用

（1）管理费用构成和变动分析

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,615.73	45.75%	2,216.82	41.89%	1,620.36	55.32%
中介费用	588.14	10.29%	1,070.74	20.23%	375.80	12.83%
股份支付	1,007.84	17.63%	609.79	11.52%	273.15	9.33%
存货报废损失	239.48	4.19%	352.05	6.65%	4.34	0.15%
折旧与摊销	342.83	6.00%	328.98	6.22%	186.35	6.36%
业务招待费	111.51	1.95%	132.69	2.51%	66.44	2.27%
交通差旅费	76.88	1.34%	96.87	1.83%	90.33	3.08%
办公费	57.15	1.00%	76.09	1.44%	57.18	1.95%
搬迁费	130.74	2.29%	45.72	0.86%	-	0.00%
水电气费	78.55	1.37%	38.10	0.72%	55.02	1.88%
其他	468.40	8.19%	323.70	6.12%	200.28	6.84%
合计	5,717.25	100.00%	5,291.54	100.00%	2,929.26	100.00%

报告期内，公司管理费用分别为2,929.26万元、5,291.54万元和**5,717.25万元**，占营业收入的比例分别为5.78%、8.34%和**6.59%**。2024年度，公司管理费用增加，主要系职工薪酬、股份支付、中介费用、折旧摊销和存货报废损失增加所致。

公司的管理费用主要包括职工薪酬、股份支付费用、中介机构费用、折旧与摊销等，上述费用合计占比分别为83.83%、79.87%和**79.66%**，具体变动分析如下：

1) 职工薪酬

报告期内，公司管理费用中职工薪酬分别为 1,620.36 万元、2,216.82 万元和 **2,615.73 万元**，金额持续上涨，主要系随着公司业务规模的扩大，公司引入优质管理人才、提升薪资竞争力所致。

2) 股份支付

报告期内，公司管理费用中股份支付费用分别为 273.15 万元、609.79 万元和 **1,007.84 万元**，2024 年度及 **2025 年度** 股份支付金额增长，主要系公司进行了股份授予，公允价值和授予价格存在差价，**同时因取消、修改股权激励计划一次性确认股份支付费用**所致。

3) 中介费用

报告期内，公司管理费用中中介费用分别为 375.80 万元、1,070.74 万元和 **588.14 万元**，中介费用主要为公司因科研项目申报支付的相关中介机构费用，及申报 IPO、审计、法律顾问等工作支付的 IPO 等相关中介机构费用。

4) 折旧与摊销

报告期内，公司管理费用中折旧与摊销分别为 186.35 万元、328.98 万元和 **342.83 万元**，主要为固定资产折旧、使用权资产折旧、长期待摊费用摊销和无形资产摊销等。2024 年度，公司的新厂房交付后进入前期装修阶段，尚未投入生产，折旧与摊销增加。**2025 年度，折旧与摊销金额相比 2024 年度较为稳定。**

5) 存货报废损失

报告期内，公司管理费用中存货报废损失分别为 4.34 万元、352.05 万元和 **239.48 万元**，主要系因客户产品迭代，对公司零部件原材料的技术规格要求产生相应改变，客户需求变更导致的存货报废产生的损失所致。

(2) 管理费用率及与可比公司对比情况

报告期内，公司管理费用率与可比公司的对比情况如下：

指标	公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
管理费用率（%）	先锋精科	尚未披露	4.29	6.51
	珂玛科技	尚未披露	6.82	8.39
	富乐德	尚未披露	10.87	9.62
	富创精密	尚未披露	11.24	10.69
	凯德石英	尚未披露	18.37	13.24
	可比公司平均值	尚未披露	10.32	9.69
	公司	6.59	8.34	5.78

注：管理费用率=管理费用/营业收入，可比上市公司数据来源于 Wind

报告期内，可比公司间管理费用率差异较大，主要系不同公司之间业务规模、管理人员数量、资产折旧和摊销规模的差异所致。凯德石英管理费用率高于可比公司平均值，主要系其整体规模较小，且管理人员人数占比较高所致。

3、研发费用

（1）研发费用构成和变动分析

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,812.39	45.98%	2,404.47	46.97%	1,264.19	46.79%
物料消耗	1,419.32	23.20%	1,092.22	21.34%	809.44	29.96%
折旧与摊销	748.66	12.24%	747.49	14.60%	411.62	15.241%
能源费用	279.25	4.57%	459.97	8.99%	41.53	1.54%
委托开发费	84.00	1.37%	117.69	2.30%	12.50	0.46%
股份支付	164.82	2.69%	59.92	1.17%	19.13	0.71%
其他	608.50	9.95%	237.52	4.64%	143.22	5.30%
合计	6,116.94	100.00%	5,119.27	100.00%	2,701.63	100.00%

报告期内，公司研发费用分别为2,701.63万元、5,119.27万元和6,116.94万元，占营业收入的比例分别为5.34%、8.07%和7.05%，2023年至2025年，公司累计研发投入金额为13,937.84万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.94%，研发投

入复合增长率为 **50.47%**，整体呈现上升趋势，主要系报告期内随着公司经营规模的扩大及研发创新需求的增长，公司不断扩大研发人员队伍、加强研发投入力度所致。报告期内，公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧与摊销等。**2025 年度**，研发费用率有所降低，主要系公司收入规模增长，而研发投入与上年相比保持了稳定的投入水平。

报告期内，为增强核心竞争力、保持技术先进性，公司加大新产品和新技术开发力度，增加研发人员，提高研发人员工资水平，研发投入不断增加。

1) 职工薪酬

报告期内，公司研发费用中职工薪酬分别为 1,264.19 万元、2,404.47 万元和 **2,812.39 万元**。报告期内公司研发费用中职工薪酬金额逐年提高，主要为随着公司业务规模的扩大，公司在新产品、新技术方面加大了研发投入力度，以保持公司的技术先进性，公司的研发人员数量也随之增加。

2) 物料消耗

报告期内，公司研发费用中物料消耗分别为 809.44 万元、1,092.22 万元和 **1,419.32 万元**。2024 年度，物料消耗相比 2023 年度保持稳定。**2025 年度**，物料消耗金额增长，主要系公司新材料类研发项目投入增加所致。

3) 折旧与摊销

报告期内，公司研发费用中折旧与摊销分别为 411.62 万元、747.49 万元和 **748.66 万元**，主要包括固定资产折旧、长期待摊费用摊销和使用权资产折旧。**2024 及 2025 年度**，公司研发设备增加，导致折旧与摊销增加。此外，随着公司三期厂房投入使用，相关租赁厂房所属研发区域的使用权折旧和装修的摊销费用也大幅增加。

(2) 研发项目投入的研发费用情况

报告期内，公司按研发项目独立核算，报告期内累计研发费用投入前十大的研发项目汇总情况如下：

单位：万元

项目名称	2025 年	2024 年	2023 年	报告期合计	截至 2025 年末进度
碳化硅环再生及新品开发	727.24	744.90	114.74	1,586.88	结题
半导体 12 寸 Etch 设备静电吸盘开发	859.59	430.07	18.64	1,308.30	在研
大直径单晶硅棒	3.66	509.88	555.02	1,068.56	结题
单晶硅长晶提效新工艺开发	177.49	747.08	-	924.56	结题
GD Coating 技术开发	246.66	279.99	1.16	527.81	结题
新品石英开发	312.20	151.81	-	464.01	在研
OD 450mm 单晶硅工艺开发	414.58	-	-	414.58	结题
多晶硅工艺开发	201.88	173.56	-	375.44	结题
大型陶瓷板材 CIP 工艺配方研制项目	187.63	154.71	-	342.34	在研
高难度深孔和曲面电极	-	32.05	247.92	279.97	结题
前十大合计	3,130.93	3,224.04	937.48	7,292.45	-
前十大合计占当年研发费用比例	51.18%	62.98%	34.70%	52.32%	-

（3）委外研发项目情况

报告期内，公司委外研发支出金额较小，委外研发具有真实性、必要性，定价具有公允性。报告期内，公司委外研发情况如下：

受托方	服务主要内容	签订日期	有效期限	合同金额	合作状态	委外研发费用		
						2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海大学	委托受托方为委托方在生产工作中所需的陶瓷喷涂粉体和涂层提供研究和技术服务	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 10 日	100.00 万元	已完成	-	37.50 万元	12.50 万元
某研究院所	委托受托方就涂层制备工艺项目进行专项技术开发	2024 年 2 月 18 日	2024 年 2 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日	85.00 万元（含税）	已完成	-	80.19 万元	-
重庆理工大学	委托受托方研究开发 96 氧化铝瓷流延制备技术开发项目	2025 年 2 月 1 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	84.00 万元	进行中	84.00 万元	-	-

受托方	服务主要内容	签订日期	有效期限	合同金额	合作状态	委外研发费用		
						2025年度	2024年度	2023年度
武汉理工大学	委托受托方在化学气相沉积超厚碳化硅项目提供研究及技术服务	2025年5月28日	2025年6月1日至2026年9月30日	50.00万元	进行中	-	-	-

报告期内，公司委托研发的合作方为高校或科研院所，合同均经过公司及高校或科研院所各自的内部审批流程。研发的定价根据研发项目的工作量、研发难度、研发周期等因素确定，定价具有公允性。

（4）研发费用率及与可比公司对比情况

报告期内，公司研发费用率与可比公司的对比情况如下：

指标	公司	2025年度	2024年度	2023年度
研发费用率（%）	先锋精科	尚未披露	5.64	6.51
	珂玛科技	尚未披露	7.73	9.69
	富乐德	尚未披露	7.82	7.61
	富创精密	尚未披露	7.28	9.97
	凯德石英	尚未披露	6.47	7.60
	可比公司平均值	尚未披露	6.99	8.28
	公司	7.05	8.07	5.34

注：研发费用率=研发费用/营业收入，可比上市公司数据来源于 Wind

2023 年度，公司研发费用率略低于可比公司均值，主要为富创精密、珂玛科技等可比公司规模相对较大、资金实力相对较强，研发人员数量多于发行人；与其他可比公司相比，公司研发费用率不存在较大差异。随着公司经营规模的扩大及研发创新需求的增长，公司不断扩大研发人员队伍、加强研发投入力度，公司研发费用率整体呈上升趋势。

4、财务费用

（1）财务费用构成和变动分析

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	574.37	90.99%	497.62	95.33%	502.99	97.03%
减：利息收入	138.71	21.98%	49.36	9.46%	121.26	23.39%
汇兑损益	176.06	27.89%	57.08	10.93%	120.62	23.27%
手续费	19.51	3.09%	16.67	3.19%	16.06	3.10%
合计	631.23	100.00%	522.00	100.00%	518.40	100.00%

报告期内，公司财务费用分别为 518.40 万元、522.00 万元和 **631.23 万元**，主要由利息支出、利息收入和汇兑损益组成；公司财务费用分别占当期营业收入的比重为 1.02%、0.82%和 **0.73%**，整体占比较小。公司财务费用主要受利息支出及汇率波动导致的汇兑损益影响。汇兑损益方面，公司存在外币交易，因人民币汇率波动导致公司汇兑损益金额存在波动。

（2）财务费用率及与可比公司对比情况

报告期内，公司财务费用率与可比公司的对比情况如下：

指标	公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
财务费用率（%）	先锋精科	尚未披露	-0.09	-0.75
	珂玛科技	尚未披露	0.27	0.07
	富乐德	尚未披露	-0.13	-1.22
	富创精密	尚未披露	0.49	0.33
	凯德石英	尚未披露	0.36	-0.73
	可比公司平均值	尚未披露	0.18	-0.46
	公司	0.73	0.82	1.02

注：财务费用率=财务费用/营业收入，可比上市公司数据来源于 Wind

报告期内，公司与同行业可比上市公司财务费用占营业收入比例均较低。公司利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费等其他财务费用与各公司的实际经营情况有关，公司与同行业公司之间无法直接可比。

（五）利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	717.68	432.41	368.10
与收益相关的政府补助	301.47	333.29	252.89
代扣个人所得税手续费返还	8.58	20.10	5.91
增值税加计抵减	322.84	257.90	170.74
其他	-	3.58	-
合计	1,350.57	1,047.27	797.64

报告期内，公司其他收益主要为政府补助。报告期内，公司计入其他收益的各项政府补助具体明细如下：

单位：万元

项目	金额	列报项目	与资产相关/与收益相关
2025 年度			
2025 年第一批市工业和信息化专项资金	19.88	其他收益	资产相关
电子产业专项扶持资金	248.45	其他收益	资产相关
ESC 下部电极生产线智能化提升项目	14.08	其他收益	资产相关
工业和信息化专项资金	2.32	其他收益	资产相关
中小微企业发展专项资金	4.00	其他收益	资产相关
第二批工业和信息化专项资金	5.94	其他收益	资产相关
装修补贴	5.38	其他收益	资产相关
半导体和液晶显示配套洗净和再生项目	3.74	其他收益	资产相关
半导体干法刻设备核心零部件智能化生产项目	11.54	其他收益	资产相关
半导体设备核心部件生产数字化车间	48.42	其他收益	资产相关
制造业高质量发展专项资金（技术改造项目）	22.65	其他收益	资产相关
2024 年工信领域第二批专项资金	37.89	其他收益	资产相关
2024 年重大技术装备攻关项目	303.11	其他收益	资产相关

项目	金额	列报项目	与资产相关/与收益相关
“小巨人”企业奖补资金	13.06	其他收益	资产相关
社保补贴款	39.63	其他收益	收益相关
新重庆引才计划项目资金	110.00	其他收益	收益相关
2023 年度全区现代服务业高质量发展扶持资金	8.20	其他收益	收益相关
2024 年第二批（2023 年度）稳产贡献补贴	40.00	其他收益	收益相关
2025 年高新技术企业补助款	20.00	其他收益	收益相关
工业提振行动专项资金	10.13	其他收益	收益相关
重大企业技术创新补贴	30.00	其他收益	收益相关
其他	20.70	其他收益	资产/收益相关
小计	1,019.15	其他收益	-
2024 年度			
“工业入规”补贴	8.00	其他收益	收益相关
2022 年-2023 年 5 月贫困员工就业补助	4.85	其他收益	收益相关
2023 年九龙坡区技术创新与产业应用项目经费	10.00	其他收益	收益相关
2024 年第二批工业和信息化专项资金	80.00	其他收益	收益相关
2024 年度高价值专利培育项目经费	20.00	其他收益	收益相关
2024 年知识产权保护示范创建项目经费	6.00	其他收益	收益相关
重庆臻宝房租减免	42.15	其他收益	收益相关
高新技术企业认定奖补贴	10.00	其他收益	收益相关
黄冈高新技术产业开发区管理委员会：“开门红”补贴	5.09	其他收益	收益相关
技术创新与应用发展重点专项等补贴	52.50	其他收益	收益相关
社保补贴款	53.92	其他收益	收益相关
湖北省黄冈市稳岗补贴	1.67	其他收益	收益相关
新建海智工作站经费等	5.00	其他收益	收益相关
一次性吸纳就业补贴	3.60	其他收益	收益相关
政府高企返还补贴	10.00	其他收益	收益相关
重庆市九龙坡区市场监督管理局 2022 年知识产权资助及奖励项目资金	10.00	其他收益	收益相关
专利转化专项资金	6.10	其他收益	收益相关
重庆臻宝电子产业专项扶持资金	242.99	其他收益	资产相关

项目	金额	列报项目	与资产相关/与收益相关
重庆芯洁电子产业专项扶持资金	5.46	其他收益	资产相关
ESC 下部电极生产线智能化提升项目	14.08	其他收益	资产相关
工业和信息化专项资金	13.92	其他收益	资产相关
中小微企业发展专项资金	4.00	其他收益	资产相关
第二批工业和信息化专项资金	5.94	其他收益	资产相关
装修补贴	5.38	其他收益	资产相关
芯片及液晶生产核心设备材料西彭基地生产线	1.06	其他收益	资产相关
半导体和液晶显示配套洗净和再生项目	3.74	其他收益	资产相关
半导体干法刻设备核心零部件智能化生产项目	11.54	其他收益	资产相关
半导体设备核心部件生产数字化车间	50.54	其他收益	资产相关
制造业高质量发展专项资金（技术改造项目）	22.65	其他收益	资产相关
2024 年工信领域第二批专项资金	6.32	其他收益	资产相关
2024 年重大技术装备攻关项目	44.78	其他收益	资产相关
其他	4.41	其他收益	收益相关
小计	765.70	其他收益	-
2023 年度			
2022 年第二批重点专项补助资金	50.00	其他收益	收益相关
2022 年研发准备金补助资金	10.00	其他收益	收益相关
2022 年重点扶持科技型企业补助经费	10.00	其他收益	收益相关
2023 年市工业和信息化领域重点专项资金（第二批）	29.00	其他收益	收益相关
电力公司 2023 年迎峰度夏工业企业采用发电机组自发电保生产补贴	6.00	其他收益	收益相关
关于重庆市知识产权优势企业、知识产权贯标补贴	4.30	其他收益	收益相关
湖北省黄冈市稳岗补贴	2.43	其他收益	收益相关
湖北芯洁房租补贴	10.11	其他收益	收益相关
九龙坡区“科创杯”创新创业大赛奖金	2.00	其他收益	收益相关
九龙坡区财政局 2023 年第四批一次性吸纳就业补贴费用	6.00	其他收益	收益相关
贫困人员和退伍军人退税补贴	80.73	其他收益	收益相关
上海石洞口经济开发区扶持资金	8.00	其他收益	收益相关
外经贸进口贴息专项资金补贴	7.27	其他收益	收益相关

项目	金额	列报项目	与资产相关/与收益相关
重庆市稳岗补贴	14.32	其他收益	收益相关
重庆芯洁房租补贴	8.19	其他收益	收益相关
重庆臻宝电子产业专项扶持资金	242.99	其他收益	资产相关
重庆芯洁电子产业专项扶持资金	5.46	其他收益	资产相关
ESC 下部电极生产线智能化提升项目	14.08	其他收益	资产相关
工业和信息化专项资金	13.92	其他收益	资产相关
中小微企业发展专项资金	4.00	其他收益	资产相关
第二批工业和信息化专项资金	5.94	其他收益	资产相关
装修补贴	5.38	其他收益	资产相关
芯片及液晶生产核心设备材料西彭基地生产线	1.06	其他收益	资产相关
半导体和液晶显示配套洗净和再生项目	3.74	其他收益	资产相关
半导体干法刻设备核心零部件智能化生产项目	11.54	其他收益	资产相关
半导体设备核心部件生产数字化车间	50.54	其他收益	资产相关
制造业高质量发展专项资金（技术改造项目）	9.44	其他收益	资产相关
其他	4.54	其他收益	收益相关
小计	620.99	其他收益	-

2、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置交易性金融资产取得的投资收益	319.44	395.10	41.96
合计	319.44	395.10	41.96

报告期内，公司投资收益占同期营业收入比例分别为 0.08%、0.62%和 0.37%，占比较小，主要为理财产品投资收益款项。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产产生的公允价值变动收益	205.55	301.89	24.19
合计	205.55	301.89	24.19

报告期内，公司公允价值变动收益金额较小，主要为理财产品的公允价值变动损益。

4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
坏账损失	-439.77	-200.85	-288.05
合计	-439.77	-200.85	-288.05

报告期内，公司严格按照会计准则要求计提各项减值准备，减值计提情况与实际情况匹配，各项减值准备计提充分。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-2,202.14	-1,244.77	-691.04
合计	-2,202.14	-1,244.77	-691.04

报告期内，公司资产减值损失主要由存货跌价损失构成。公司存货跌价准备的计提情况详见本节之“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产分析”之“7、存货”之“（2）存货跌价准备计提情况”。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
固定资产处置收益	-	-0.94	-17.69
使用权资产处置收益	-	-	-1.40
合计	-	-0.94	-19.10

报告期内，公司资产处置收益主要为固定资产处理收益和使用权资产处置收益，金额较小。

7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
无法支付的款项	20.99	0.41	0.21
违约、赔偿收入	37.95	19.38	8.72
其他	3.64	1.12	20.47
合计	62.58	20.91	29.41

报告期内，公司的营业外收入分别为 29.41 万元、20.91 万元和 **62.58 万元**。2023 年度，其他主要为公司取得的保险赔款。

8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
对外捐赠	14.50	7.23	6.65
非流动资产毁损报废损失	5.29	11.21	5.45
税收滞纳金	3.89	74.64	0.07
存货报废损失	21.07	17.93	37.92
未决诉讼	-	-	4.32
其他	39.91	30.46	8.81
合计	84.66	141.47	63.24

报告期内，公司的营业外支出分别为 63.24 万元、141.47 万元和 **84.66 万元**。

报告期内，公司营业外支出主要由税收滞纳金、存货报废损失等构成。2023 年度，公司存货报废损失主要为外部物流公司运输过程中造成的存货损耗。2024 年度，公司缴纳了所得税滞纳金。**2025 年度，营业外支出主要包括存货报废损失及对外捐赠。**

（六）税项

1、纳税情况

报告期内，公司主要税种纳税情况如下：

单位：万元

项目	期间	期初未交数	本期已交数	期末未交数
增值税	2023 年度	904.04	4,013.87	-528.88
	2024 年度	-528.88	2,972.37	-1,372.00
	2025 年度	-1,372.00	3,613.24	-2,000.89
企业所得税	2023 年度	708.00	1,820.59	860.69
	2024 年度	860.69	2,655.74	957.17
	2025 年度	957.17	3,883.46	1,695.01

公司优惠情况详见本节“七、发行人适用的税种、税率及主要税收优惠政策”之“（二）主要税收优惠政策”的相关说明。报告期内，公司严格遵守国家及地方的税收法律、法规，依法缴纳各种税金，执行的税种、税率均符合相关税收法律、法规的规定，不存在重大税收政策变化。公司及子公司所在地税务局已就报告期内的纳税情况出具了无违法违规行为的证明文件。

2、所得税费用

报告期内，公司所得税费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	4,621.30	2,752.23	1,973.27
递延所得税费用	-744.86	-899.84	-192.00
合计	3,876.44	1,852.38	1,781.27

十一、资产质量分析

（一）资产整体分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	87,504.17	54.06%	74,442.42	58.54%	61,896.40	60.45%
非流动资产	74,363.45	45.94%	52,723.74	41.46%	40,490.04	39.55%
资产总计	161,867.62	100.00%	127,166.16	100.00%	102,386.45	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 102,386.45 万元、127,166.16 万元和 161,867.62 万元。随着公司经营规模、净利润的持续增长以及股权融资，公司资产规模持续快速增长。

（二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	14,589.25	16.67%	23,481.29	31.54%	32,991.21	53.30%
交易性金融资产	22,917.68	26.19%	15,274.64	20.52%	-	0.00%
应收票据	0.17	0.00%	194.41	0.26%	-	0.00%
应收账款	29,035.14	33.18%	21,187.39	28.56%	17,301.72	27.95%
预付款项	597.70	0.68%	509.68	0.68%	477.12	0.77%
其他应收款	181.75	0.21%	204.56	0.27%	176.02	0.28%
存货	15,936.99	18.21%	11,932.33	16.03%	10,289.71	16.62%
其他流动资产	4,245.48	4.85%	1,658.12	2.23%	660.62	1.07%
流动资产合计	87,504.17	100.00%	74,442.42	100.00%	61,896.40	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成，具体情况如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	-	0.00%	0.31	0.00%	-	0.00%
银行存款	14,332.82	98.24%	23,480.92	100.00%	32,991.16	100.00%
其他货币资金	256.43	1.76%	0.05	0.00%	0.05	0.00%
合计	14,589.25	100.00%	23,481.29	100.00%	32,991.21	100.00%

报告期内，公司货币资金主要为银行存款。2024 年末，公司货币资金相比 2023 年末减少 9,509.93 万元，主要系年末存在未赎回的理财所致。**2025 年末，公司货币资金相比 2024 年末减少 8,892.03 万元，主要系利用暂时闲置资金购买银行理财产品所致。**

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 0.00 万元、15,274.64 万元和 **22,917.68 万元**，均为公司利用暂时闲置资金购买的银行理财产品。

3、应收票据

报告期各期末，公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	0.17	194.41	-
合计	0.17	194.41	-

报告期各期末，公司的应收票据账面价值分别为 0.00 万元、194.41 万元和 **0.17 万元**，均为银行承兑汇票，银行承兑汇票承兑人主要为信誉良好、资金较为充足的商业银行，到期无法兑付的可能性较低。

4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	30,565.22	22,326.01	18,257.43
应收账款坏账准备	1,530.09	1,138.62	955.71
应收账款账面价值	29,035.14	21,187.39	17,301.72
营业收入	86,758.17	63,450.10	50,635.63
应收账款账面余额占营业收入的比例	35.23%	35.19%	36.06%

（1）应收账款变动情况

报告期内，公司应收账款余额呈现持续上升趋势，占营业收入的比例较为稳定，主要系公司经营业绩持续向好，应收账款金额随着营业收入规模增加而提高所致。

（2）按应收账款坏账计提方法分类分析

公司按应收账款坏账计提方法分类情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	30,565.22	100.00	1,530.09	5.01	29,035.14
合计	30,565.22	100.00	1,530.09	5.01	29,035.14
项目	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	22,326.01	100.00	1,138.62	5.10	21,187.39
合计	22,326.01	100.00	1,138.62	5.10	21,187.39
项目	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比（%）	金额	计提比例（%）	

按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	18,257.43	100.00	955.71	5.23	17,301.72
合计	18,257.43	100.00	955.71	5.23	17,301.72

报告期各期末，公司无单项计提坏账准备的应收账款，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款均为账龄组合。

（3）应收账款账龄分析

报告期各年末，公司应收账款按组合计提的坏账准备情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	30,528.72	1,526.44	5.00
1-2 年	36.50	3.65	10.00
合计	30,565.22	1,530.09	5.01
账龄	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	22,204.99	1,110.25	5.00
1 至 2 年	102.94	10.29	10.00
3 年以上	18.08	18.08	100.00
合计	22,326.01	1,138.62	5.10
账龄	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	17,985.49	899.27	5.00
1 至 2 年	198.84	19.88	10.00
2 至 3 年	73.10	36.55	50.00
合计	18,257.43	955.71	5.23

（4）应收账款主要客户分析

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

时间	公司名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备余额
2025 年 12 月 31 日	客户 2	5,083.92	16.63	254.20
	客户 3	4,982.82	16.30	249.14
	客户 4	3,233.49	10.58	161.67
	京东方	3,147.70	10.30	157.39
	英特尔（大连）	2,090.14	6.84	104.51
	小计	18,538.08	60.65	926.90
2024 年 12 月 31 日	客户 2	3,995.99	17.90	199.80
	京东方	3,527.58	15.80	176.38
	客户 3	3,484.18	15.61	174.21
	英特尔（大连）	2,417.02	10.83	120.85
	TCL 华星光电	1,826.56	8.18	91.33
	小计	15,251.33	68.32	762.57
2023 年 12 月 31 日	客户 3	4,701.55	25.75	235.08
	京东方	3,736.89	20.47	186.84
	客户 2	2,643.09	14.48	164.11
	TCL 华星光电	1,488.90	8.16	77.19
	惠科股份	1,406.64	7.70	70.33
	小计	13,977.07	76.56	733.56

注：英特尔（大连）存在第三方回款的情形，其聘请大连精典优普电子工程有限公司（以下简称“大连精典”）担任其 VMI 服务商，大连精典为英特尔（大连）提供订单管理、物流追踪及库存管理等服务。在该等模式下，发行人虽然与英特尔（大连）签署了购销协议，但日常订单下达、资金支付均由大连精典根据英特尔（大连）的指示进行

报告期各期末，公司应收账款前五名余额占应收账款总余额的比例分别为 76.56%、68.32%和 60.65%。公司的主要客户多为国内知名的半导体、面板行业企业，资质及信用情况良好，且账龄集中在 1 年以内，应收账款质量较高，发生坏账的风险较小。

（5）应收账款期后回款进度

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况均较为良好，不存在大额应收账款期后无法收回的情形。

报告期各期末应收账款及回款情况如下：

单位：万元

项目	2025. 12. 31/2025 年度	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度
应收账款账面余额	30,565.22	22,326.01	18,257.43
坏账准备	1,530.09	1,138.62	955.71
期后回款	12,506.00	22,321.25	18,239.35
回款比例	40.92%	99.98%	99.90%

注：期后回款金额截至 2026 年 2 月 28 日

（6）应收账款坏账准备计提政策与同行业上市公司比较

账龄	公司	先锋精科	珂玛科技	富乐德	富创精密	凯德石英
1 年以内	5.00%	5.00%	6 个月以内： 1.01%； 7-12 个月：4.65%	5.00%	0.13%	5.00%
1-2 年	10.00%	20.00%	20.27%	10.00%	31.78%	15.00%
2-3 年	50.00%	30.00%	59.10%	50.00%	67.56%	40.00%
3-4 年	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	94.58%	100.00%
4-5 年	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	未披露	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注 1：富创精密系基于其客户分类，按参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。上表列示了其 2024 年度审计报告中除客户 A 外其他半导体及泛半导体设备客户组合期末应收账款对应按账龄的预期信用损失率，2025 半年度报告中未披露相关信息

注 2：珂玛科技按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。上表列示了其 2025 半年度报告中按账龄分类的客户组合的预期信用损失率

公司设定的应收账款坏账计提比例处于合理范围内。报告期内，公司应收账款账龄主要为 1 年以内，公司 1 年以内应收账款坏账计提比例为 5%，与同行业可比上市公司不存在显著差异。公司应收账款坏账计提比例谨慎、合理。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款主要为预付供应商的采购款、预付海关关税等，公司预付款项按账龄列示情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	586.85	98.18%	509.68	100.00%	474.73	99.50%
1 至 2 年	10.85	1.82%	-	0.00%	2.15	0.45%
2 至 3 年	-	0.00%	-	0.00%	0.24	0.05%
合计	597.70	100.00%	509.68	100.00%	477.12	100.00%

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 477.12 万元、509.68 万元和 **597.70 万元**，账龄主要在 1 年以内。报告期内，公司预付款项增加，主要系随着公司经营规模扩大，预付的材料采购款增加所致。

报告期各期末，公司预付款项余额前五大情况如下：

单位：万元

时间	公司名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
2025 年 12 月 31 日	无锡万嘉芯成电子科技有限公司	106.59	17.83
	福建联合新材料科技有限公司	97.85	16.37
	CSN Co., Ltd.	93.75	15.69
	武汉理工大学	30.00	5.02
	上海权特半导体材料有限公司	23.63	3.95
	小计	351.82	58.86
2024 年 12 月 31 日	东海耀碳素（大连）有限公司	98.64	19.35
	重庆理工大学	92.58	18.16
	INFICON LIMITED	58.53	11.48
	上海在途国际旅行社有限公司	33.46	6.57
	CSN Co., Ltd.	30.23	5.93
	小计	313.45	61.49
2023 年 12 月 31 日	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司	146.00	30.60
	东海耀碳素（大连）有限公司	64.60	13.54
	无锡万嘉芯成电子科技有限公司	52.88	11.08
	美尔森银河新材料（烟台）有限公司	25.00	5.24
	日朋碳素（上海）有限公司	22.80	4.78

时间	公司名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
	小计	311.27	65.24

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金保证金	140.54	113.81	107.56
备用金	13.97	11.35	6.57
应收暂付款	86.82	59.78	60.92
往来款	20.91	69.81	33.24
账面余额合计	262.23	254.75	208.28
减：坏账准备	80.48	50.18	32.27
账面价值合计	181.75	204.56	176.02

报告期各期末，公司其他应收款主要为租赁房屋的押金、员工备用金和应收暂付款等，系公司日常生产经营产生，均不属于财务性投资。其中，应收暂付款中的个人承担社保/公积金为代扣代缴的员工社保公积金费用。

(1) 2025 年末前五大其他应收款明细

单位：万元

名称	款项性质	其他应收款账面余额	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
个人承担社保/公积金	应收暂付款	77.12	29.41	3.86
重庆铝产业开发投资集团有限公司	押金保证金	43.00	16.40	35.35
上海由鹏资产管理有限公司	押金保证金	31.62	12.06	3.16
黄冈融创资产经营有限公司	押金保证金	21.20	8.08	20.07
沃肯表面技术（上海）有限公司	押金保证金	20.00	7.63	1.00
小计		192.94	73.58	63.44

(2) 2024 年末前五大其他应收款明细

单位：万元

名称	款项性质	其他应收款账面余额	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
个人承担社保/公积金	应收暂付款	58.88	23.11	2.94
重庆铝产业开发投资集团有限公司	押金保证金	39.60	15.54	17.59
上海由鹏资产管理有限公司	押金保证金	31.62	12.41	1.58
连云港正耀石英科技有限公司	应收暂付款	29.18	11.46	1.46
黄冈融创资产经营有限公司	押金保证金	20.15	7.91	20.01
小计		179.43	70.43	43.58

(3) 2023 年末前五大其他应收款明细

单位：万元

名称	款项性质	其他应收款账面余额	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
个人承担社保/公积金	应收暂付款	51.25	24.61	2.56
重庆铝产业开发投资集团有限公司	押金保证金	36.20	17.38	3.83
惠科股份有限公司	押金保证金	34.10	16.37	1.71
金圣喆	往来款	23.28	11.18	1.16
黄冈融创资产经营有限公司	押金保证金	20.00	9.6	20.00
小计		164.84	79.14	29.26

7、存货

报告期各期末，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4, 116. 81	329. 03	3, 787. 78
在产品	1, 321. 47	47. 65	1, 273. 82
库存商品	6, 617. 41	721. 11	5, 896. 30
低值易耗品	16. 43	-	16. 43
发出商品	5, 528. 42	565. 76	4, 962. 67

合计	17,600.55	1,663.55	15,936.99
项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,248.38	369.82	2,878.56
在产品	1,546.80	14.91	1,531.89
库存商品	4,445.89	619.04	3,826.86
低值易耗品	6.73	-	6.73
发出商品	4,252.45	564.14	3,688.30
合计	13,500.24	1,567.91	11,932.33
项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,179.53	210.23	2,969.30
在产品	739.31	2.78	736.53
库存商品	4,344.53	319.60	4,024.94
低值易耗品	8.28	-	8.28
发出商品	2,995.96	445.30	2,550.66
合计	11,267.61	977.91	10,289.71

（1）存货结构及变动分析

报告期内，随着公司生产销售规模的不断扩张，公司存货规模呈现逐年增长的趋势。

公司存货由原材料、在产品、库存商品、低值易耗品及发出商品组成，其中以原材料、库存商品、发出商品为主，上述三类存货各期占比均在 85%以上。原材料主要为公司产品的研发、生产所需的硅材料、石英材料和陶瓷材料等；库存商品主要为公司已生产尚未发货的产品；发出商品主要为已发货尚未满足收入确认条件的产品、寄售业务中尚未实际领用的产品。

1）原材料

报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 3,179.53 万元、3,248.38 万元和 4,116.81 万元，占存货账面余额的比例分别为 28.22%、24.06%和 23.39%。2024 年

度，公司原材料需求较为稳定。**2025 年末**，原材料余额上涨，主要系公司三期厂房投入运营，石英零部件、硅零部件生产线继续扩张，原材料备货增长所致。

2) 库存商品

报告期各期末，公司库存商品账面余额分别为 4,344.53 万元、4,445.89 万元和 **6,617.41 万元**，占存货账面余额的比例分别为 38.56%、32.93%和 **37.60%**。随着公司销售规模增长，公司产品需求量上涨，同时根据客户的备货需求以及公司的生产管理方针，为客户所备的库存量也同步增长。

3) 发出商品

报告期各期末，公司发出商品账面余额分别为 2,995.96 万元、4,252.45 万元和 **5,528.42 万元**，占存货账面余额的比例分别为 26.59%、31.50%和 **31.41%**。公司发出商品主要为寄售模式下存放于客户指定仓库的产成品，寄售模式的主要客户包括客户 1、客户 2 和客户 3 等。公司寄售产品的规模根据客户需求有所变动，2024 年末，发出商品余额增加，系新品通过验证后，客户对产品备货和寄售产品的需求增加所致。**2025 年末**，发出商品余额增加，系客户对产品备货和寄售产品的需求稳定增长。

(2) 存货跌价准备计提情况

报告期内，对于存货跌价准备计提，公司结合存货的种类和特征，按照成本减去可变现净值计算的金额与按照库龄计算的金额综合判断确认。具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	计提比例
原材料	4,116.81	329.03	7.99%
在产品	1,321.47	47.65	3.61%
库存商品	6,617.41	721.11	10.90%
低值易耗品	16.43	-	0.00%
发出商品	5,528.42	565.76	10.23%
合计	17,600.55	1,663.55	9.45%

项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	计提比例
原材料	3,248.38	369.82	11.38%
在产品	1,546.80	14.91	0.96%
库存商品	4,445.89	619.04	13.92%
低值易耗品	6.73	-	0.00%
发出商品	4,252.45	564.14	13.27%
合计	13,500.24	1,567.91	11.61%
项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	计提比例
原材料	3,179.53	210.23	6.61%
在产品	739.31	2.78	0.38%
库存商品	4,344.53	319.60	7.36%
低值易耗品	8.28	-	0.00%
发出商品	2,995.96	445.30	14.86%
合计	11,267.61	977.91	8.68%

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 977.91 万元、1,567.91 万元和 **1,663.55 万元**，占存货账面余额的比例分别为 8.68%、11.61%和 **9.45%**。**2023 至 2025 年末**，公司存货跌价准备计提比例**先升后降**，主要系公司存货库龄结构变化所致。

公司存货管理制度执行有效，于每年年末对各类存货进行逐项检查。资产负债表日，公司结合存货的种类和特征，按照成本减去可变现净值计算的金额与按照库龄计算的金额综合判断确认。对于库龄 1 年以内的存货，采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于 1 年以上存货，按照库龄、保管状态、预计未来销售情况等因素，结合可变现净值综合考虑计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货计提跌价准备充分。

公司对于不同库龄、不同类型存货可变现净值及存货跌价准备计提的具体方式如下：

存货类别	库龄 1 年以内	库龄 1-2 年	库龄 2 年以上
原材料-辅材/表面处理服务主材	入库时间较短流动性良好，不计提减值	按账面余额 50%计提	预计无法产生经济利益流入，全额计提减值
原材料-半导体零部件主材	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额与账面余额 50%的金额孰低值作为可变现净值	
在产品			
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额与账面余额 50%的金额孰低值作为可变现净值	
发出商品			
低值易耗品	公司正常领用消耗，不计提	按账面余额 50%计提	

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣进项税	2,067.99	48.71%	1,440.04	86.85%	552.65	83.66%
待认证进项税	739.43	17.42%	47.33	2.85%	48.95	7.41%
预缴税金	25.80	0.61%	-	0.00%	1.88	0.28%
应收退货成本	315.37	7.43%	165.91	10.01%	54.54	8.26%
上市中介费用	905.66	21.33%	-	0.00%	-	0.00%
其他	191.24	4.50%	4.84	0.29%	2.61	0.39%
合计	4,245.48	100.00%	1,658.12	100.00%	660.62	100.00%

报告期各期末，发行人其他流动资产分别为 660.62 万元、1,658.12 万元和 4,245.48 万元，主要为待抵扣进项税。2025 年末，其他流动资产余额增加，主要系待抵扣进项税、待认证进项税及上市中介费用增加。

（三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
投资性房地产	581.39	0.78%	-	0.00%	-	0.00%
固定资产	38,926.11	52.35%	24,299.22	46.09%	16,688.52	41.22%
在建工程	4,692.56	6.31%	3,574.36	6.78%	2,692.85	6.65%
使用权资产	9,420.93	12.67%	9,357.21	17.75%	8,294.72	20.49%
无形资产	737.57	0.99%	291.75	0.55%	170.46	0.42%
长期待摊费用	15,957.50	21.46%	11,544.26	21.90%	9,966.75	24.62%
递延所得税资产	1,734.68	2.33%	989.79	1.88%	89.85	0.22%
其他非流动资产	2,312.71	3.11%	2,667.15	5.06%	2,586.89	6.39%
非流动资产合计	74,363.45	100.00%	52,723.74	100.00%	40,490.04	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产和长期待摊费用构成，三项资产合计占报告期各期末非流动资产的比例分别为 86.32%、85.73%和 86.47%。

1、投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025. 12. 31	2024.12.31	2023.12.31
一、账面原值	654.85	-	-
1、房屋建筑物	654.85	-	-
二、累计折旧和累计摊销	73.47	-	-
1、房屋建筑物	73.47	-	-
三、减值准备	-	-	-
1、房屋建筑物	-	-	-
四、账面价值	581.39	-	-
1、房屋建筑物	581.39	-	-

公司 2025 年末新增投资性房地产 581.39 万元，系公司将位于殷行路 1286 号 705 室的房产对外租赁。

2、固定资产

（1）基本情况

报告期各期末，公司的固定资产构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日					
	房屋及建筑物	生产设备	工具器具及家具	运输工具	办公设备	合计
账面原值	-	46,972.57	4,570.55	557.24	294.70	52,395.05
累计折旧	-	11,180.24	1,767.90	366.06	154.74	13,468.94
减值准备	-	-	-	-	-	-
账面价值	-	35,792.33	2,802.65	191.18	139.95	38,926.11
项目	2024 年 12 月 31 日					
	房屋及建筑物	生产设备	工具器具及家具	运输工具	办公设备	合计
账面原值	654.85	29,498.43	3,043.99	405.36	189.03	33,791.67
累计折旧	43.99	7,768.37	1,283.11	296.97	100.01	9,492.45
减值准备	-	-	-	-	-	-
账面价值	610.87	21,730.06	1,760.88	108.39	89.03	24,299.22
项目	2023 年 12 月 31 日					
	房屋及建筑物	生产设备	工具器具及家具	运输工具	办公设备	合计
账面原值	654.85	20,095.26	2,094.07	408.77	124.08	23,377.03
累计折旧	14.51	5,475.92	897.88	236.23	63.97	6,688.51
减值准备	-	-	-	-	-	-
账面价值	640.35	14,619.34	1,196.18	172.54	60.11	16,688.52

报告期各期末，公司固定资产主要由生产设备、工具器具及家具、房屋及建筑物、运输工具和办公设备等构成。随着公司生产经营规模的扩大，公司固定资产逐年增加。

报告期各期末，公司结合《企业会计准则第 8 号——资产减值》要求对固定资产是否存在减值迹象进行了分析和识别，各类固定资产均在正常使用中，不存在闲置情况，公司固定资产无明显减值迹象。

(2) 固定资产折旧计提政策

公司固定资产折旧计提政策如下：

项目	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5.00	4.75
生产设备	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00
工具器具及家具	直线法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	直线法	4-6	5.00	15.83-23.75
办公设备	直线法	3	5.00	31.67

公司的固定资产折旧年限与同行业可比公司的对比情况如下所示：

类别	先锋精科	珂玛科技	富乐德	富创精密	凯德石英	公司
房屋及建筑物	20	20	20	5-20	20	20
生产设备	10	3-10	5-10	10	5-10	5-10
工具器具及家具	5-10	3-5	3-5	5	3-5	3-5
运输工具	4	3-5	4-5	4	4-5	4-6
办公设备	3	3-5	3-5	3	3-5	3

综上，公司固定资产折旧计提政策制定合理，固定资产折旧政策与同行业相比不存在重大差异。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
二期生产基地设备购置与技改	2,159.49	46.02%	-	-	-	-
二期生产基地项目	6.99	0.15%	350.88	9.82%	1,095.01	40.66%
三期生产基地项目	1,286.51	27.42%	3,174.48	88.81%	1,512.80	56.18%
上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	1,132.18	24.13%	-	-	-	-
其他零星工程	107.39	2.29%	49.00	1.37%	85.05	3.16%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	4,692.56	100.00%	3,574.36	100.00%	2,692.85	100.00%

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 2,692.85 万元、3,574.36 万元和 **4,692.56 万元**，占非流动资产总额的比例分别为 6.65%、6.78%和 **6.31%**。2024 年末公司在建工程账面价值较 2023 年末增加 881.50 万元，主要系公司三期生产基地的基建安装所致。**2025 年末**公司在建工程账面价值较 2024 年末增加 **1,118.20 万元**，主要系公司上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目的基建及设备安装、**二期生产基地设备购置与技改**所致。

（1）主要在建工程变动情况

2025 年度，公司主要在建工程变动情况如下：

单位：万元

工程名称	期初金额	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用或其他	期末金额
二期生产基地设备购置与技改	-	7,639.03	4,353.83	1,125.70	2,159.49
三期生产基地项目	3,174.48	14,908.84	12,052.55	4,744.26	1,286.51
上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	-	3,350.09	1,522.78	695.12	1,132.18
小计	3,174.48	25,897.95	17,929.16	6,565.09	4,578.19

2024 年度，公司主要在建工程变动情况如下：

单位：万元

工程名称	期初金额	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用或其他	期末金额
二期生产基地项目	1,095.01	5,250.55	4,056.85	1,937.82	350.88
三期生产基地项目	1,512.80	7,511.73	5,646.71	203.34	3,174.48
小计	2,607.80	12,762.28	9,703.56	2,141.16	3,525.36

2023 年度，公司主要在建工程变动情况如下：

单位：万元

工程名称	期初金额	本期增加	转入固定资产	转入长期待摊费用或其他	期末金额
二期生产基地项目	287.15	2,494.26	1,672.09	14.31	1,095.01
三期生产基地项目	-	5,225.95	130.63	3,582.52	1,512.80
小计	287.15	7,720.21	1,802.73	3,596.83	2,607.80

（2）大额在建工程转入固定资产的内容、依据及影响说明

报告期内，公司在建工程转入固定资产的内容主要为二期生产基地项目、三期生产基地项目和**二期生产基地设备购置与技改**，转入固定资产的类别以生产设备为主，在安装调试后达到设计要求或合同规定的标准时转为固定资产。公司生产基地项目的投入使用有利于提高公司的生产经营能力。

（3）尚未完工交付项目转入固定资产的条件和预计时间

截至报告期末，公司尚未完工的在建工程项目主要为三期生产基地项目、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目和**二期生产基地设备购置与技改**，公司将在其达到预定可使用状态时转入固定资产。

（4）在建工程减值情况的说明

报告期各期末，发行人在建工程不存在重大减值因素，未计提减值准备。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 8,294.72 万元、9,357.21 万元和 **9,420.93 万元**，为生产经营用租赁房产。**2023 至 2025 年末**，公司使用权资产增长主要系报告期内公司业务持续扩大，厂房租赁面积增加所致。

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项目		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面原值	软件使用权	840.40	361.42	211.39
	专利权	23.58	-	-

项目		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	合计	863.99	361.42	211.39
累计摊销	软件使用权	124.84	69.68	40.93
	专利权	1.59	-	-
	合计	126.42	69.68	40.93
减值准备	软件使用权	-	-	-
	专利权	-	-	-
	合计	-	-	-
账面价值	软件使用权	715.57	291.75	170.46
	专利权	22.00	-	-
	合计	737.57	291.75	170.46

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 170.46 万元、291.75 万元和 737.57 万元，占非流动资产的比重分别为 0.42%、0.55%和 **0.99%**。公司无形资产状况良好，各期末不存在账面价值高于其可收回金额的情况，不存在减值迹象，未计提减值准备。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 9,966.75 万元、11,544.26 万元和 **15,957.50 万元**，占非流动资产的比例分别为 24.62%、21.90%和 **21.46%**，主要为厂房装修费用。

7、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 89.85 万元、989.79 万元和 **1,734.68 万元**。递延所得税资产形成的原因主要为公司存在租赁负债、待结转递延收益及资产减值准备等事项，导致存在可抵扣暂时性差异，报告期内公司按规定确认了递延所得税资产。

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 2,586.89 万元、2,667.15 万元和 **2,312.71 万元**，占非流动资产的比例分别为 6.39%、5.06%和 **3.11%**，为预

付购建长期资产款项和大额定期存单。

9、所有权或使用权受到限制的资产

报告期各期末，公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

单位：万元

项目	账面价值			受限类型	受限原因
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日		
其他货币资金	0.05	0.05	0.05	ETC 保证金	非随时可支取
其他货币资金	222.34	-	-	冻结	诉讼
合计	222.39	0.05	0.05	-	-

（四）负债整体分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	23,526.43	57.61%	14,872.84	49.41%	10,538.31	49.55%
非流动负债	17,314.25	42.39%	15,225.48	50.59%	10,731.59	50.45%
负债合计	40,840.69	100.00%	30,098.32	100.00%	21,269.90	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 21,269.90 万元、30,098.32 万元和 40,840.69 万元，流动负债占比分别为 49.55%、49.41%和 57.61%，非流动负债占比分别为 50.45%、50.59%和 42.39%。

（五）流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	1,000.75	4.25%	1,001.86	6.74%	300.38	2.85%
应付账款	15,586.14	66.25%	8,017.82	53.91%	6,058.42	57.49%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同负债	159.87	0.68%	952.23	6.40%	38.17	0.36%
应付职工薪酬	3,539.96	15.05%	2,538.71	17.07%	2,085.24	19.79%
应交税费	1,872.56	7.96%	1,084.72	7.29%	959.79	9.11%
其他应付款	54.36	0.23%	118.42	0.80%	49.70	0.47%
一年内到期的非流动负债	1,135.17	4.83%	1,093.59	7.35%	955.55	9.07%
其他流动负债	177.63	0.76%	65.49	0.44%	91.05	0.86%
流动负债合计	23,526.43	100.00%	14,872.84	100.00%	10,538.31	100.00%

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和应交税费等构成，具体情况如下：

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	-	1,000.00	300.00
保证借款	-	1.00	-
质押借款	1,000.00	-	-
应计利息	0.75	0.86	0.38
合计	1,000.75	1,001.86	300.38

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 300.38 万元、1,001.86 万元和 1,000.75 万元，占流动负债的比例分别为 2.85%、6.74%和 4.25%。2024 年末和 2025 年末，公司短期借款余额较高，主要系公司业务快速扩张，为补充日常经营所需营运资金，公司向银行借入款项，形成短期借款所致。报告期内，公司银行信用记录良好，偿债能力优良，相关短期借款的实际还款情况良好，未出现逾期情况，不存在债务风险。

2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货款	6,906.92	44.31%	3,771.51	47.04%	2,984.23	49.26%
工程及设备款	6,019.76	38.62%	2,873.40	35.84%	2,362.69	39.00%
服务采购款	2,485.69	15.95%	1,288.28	16.07%	672.77	11.10%
其他	173.77	1.11%	84.63	1.06%	38.73	0.64%
合计	15,586.14	100.00%	8,017.82	100.00%	6,058.42	100.00%

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 6,058.42 万元、8,017.82 万元和 15,586.14 万元，主要为应付供应商材料采购款、工程款和设备款。报告期内，公司生产经营和业务规模扩大以及新厂房建设投资增加，公司材料采购、设备购置和工程施工等增加，使得期末应付款项规模整体有所增加。

3、合同负债

报告期各期末，公司合同负债明细如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预收商品销售款	159.87	179.40	38.17
预收服务费	-	772.83	-
合计	159.87	952.23	38.17

报告期各期末，公司合同负债分别为 38.17 万元、952.23 万元和 159.87 万元，占流动负债的比例分别为 0.36%、6.40%和 0.68%，主要为公司预收商品销售款和预收服务费。2024 年末，公司合同负债大幅增加，主要为公司当年度预收的技术研发服务费。

4、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	3,523.41	2,529.26	2,082.80

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
离职后福利-设定提存计划	3.41	1.74	2.23
辞退福利	13.14	7.71	0.21
合计	3,539.96	2,538.71	2,085.24

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2,085.24 万元、2,538.71 万元和 **3,539.96 万元**，占当期流动负债的比例分别为 19.79%、17.07%和 **15.05%**。公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，由工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费构成。

报告期内，公司应付职工薪酬稳定增长，主要系随着公司生产经营规模快速扩张，公司相应增加了生产、行政管理、研发等岗位人员所致。报告期各期末，公司员工人数分别为 779 人、854 人和 **1,024 人**，应付职工薪酬相应呈上升趋势。

5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	67.10	68.04	23.77
企业所得税	1,720.80	957.17	862.57
代扣代缴个人所得税	56.70	43.74	29.26
城市维护建设税	4.12	3.33	13.04
房产税	0.54	0.83	0.83
土地使用税	0.00	0.00	0.00
教育费附加	1.77	1.45	5.61
地方教育附加	1.18	0.97	3.74
环境保护税	0.56	0.72	0.90
印花税	19.79	8.47	20.07
合计	1,872.56	1,084.72	959.79

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 959.79 万元、1,084.72 万元和 **1,872.56 万元**，占流动负债的比例分别 9.11%、7.29%和 **7.96%**。公司应交税费主要为企业所

得税、增值税等。**2025 年末，公司应交税费金额增加，主要系企业所得税金额增加。**

6、其他应付款

报告期内，公司的其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金保证金	4.76	5.00	0.66
赔偿款	-	41.70	-
应付暂收款	1.57	-	0.14
员工报销款	28.59	32.09	37.88
其他	19.45	39.64	11.02
合计	54.36	118.42	49.70

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 49.70 万元、118.42 万元和 **54.36 万元**，占流动负债的比重分别为 0.47%、0.80%和 **0.23%**，主要为员工报销款等。2024 年末，赔偿款主要为产品质量赔偿。

7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	-	-	450.61
一年内到期的租赁负债	1,135.17	1,093.59	504.95
合计	1,135.17	1,093.59	955.55

报告期各期，公司一年内到期的非流动负债分别为 955.55 万元、1,093.59 万元和 **1,135.17 万元**，主要由一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债构成。

8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税额	7.69	-	0.02
产品质量保证	169.95	65.49	91.03
合计	177.63	65.49	91.05

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 91.05 万元、65.49 万元和 177.63 万元，金额较小，主要为产品质量保证金。

（六）非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	10,850.52	62.67%	10,360.78	68.05%	9,023.65	84.08%
预计负债	489.72	2.83%	322.39	2.12%	119.32	1.11%
递延收益	5,973.87	34.50%	4,542.21	29.83%	1,588.62	14.80%
递延所得税负债	0.13	0.00%	0.10	0.00%	-	0.00%
非流动负债合计	17,314.25	100.00%	15,225.48	100.00%	10,731.59	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债主要由递延收益和租赁负债构成，具体情况如下：

1、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁付款额	12,897.56	12,617.83	11,192.97
减：未确认融资费用	2,047.03	2,257.06	2,169.32
合计	10,850.52	10,360.78	9,023.65

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》，公司作为承租人，将租赁的房屋及建筑物所产生的相关应付租金确认为租赁负债。2023 至 2025

年末，公司租赁负债为按照新租赁准则确认的一年期以上租赁房屋相关负债，账面价值分别为 9,023.65 万元、10,360.78 万元和 **10,850.52 万元**。2023 至 2025 年末，公司租赁负债余额逐年增加，主要系随着公司业务扩大、新租赁厂房面积增加所致。

2、预计负债

报告期各期末，公司预计负债情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预计销售退货	489.72	322.39	115.00
未决诉讼	-	-	4.32
合计	489.72	322.39	119.32

报告期各期末，公司预计负债分别为 119.32 万元、322.39 万元和 **489.72 万元**，金额较小，主要为预计销售退货。

3、递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为政府补助，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
政府补助	5,973.87	4,542.21	1,588.62
合计	5,973.87	4,542.21	1,588.62

报告期各期末，公司递延收益分别为 1,588.62 万元、4,542.21 万元和 **5,973.87 万元**，占非流动负债的比例分别为 14.80%、29.83%和 **34.50%**，均为与资产相关的政府补助。

4、递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 0.00 万元、0.10 万元和 **0.13 万元**，主要由固定资产一次性扣除产生的应纳税暂时性差异和使用权资产暂时性差异形成。

（七）资产周转能力分析

1、资产周转能力情况

报告期内，公司主要资产周转指标如下：

单位：次/年

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	3.28	3.13	3.23
存货周转率	2.80	2.67	2.86

报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.23、3.13 和 **3.28**，应收账款周转率**整体相对稳定，保持在较高水平**。报告期内，公司存货周转率分别为 2.86、2.67 和 **2.80**，存货周转率**整体相对稳定**。

2、公司资产周转能力与同行业上市公司比较情况

报告期内，公司同行业可比上市公司资产周转能力指标情况如下：

（1）应收账款周转率

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
先锋精科	尚未披露	3.51	2.86
珂玛科技	尚未披露	2.77	2.31
富乐德	尚未披露	3.96	3.57
富创精密	尚未披露	2.98	3.00
凯德石英	尚未披露	4.52	4.70
可比公司平均	尚未披露	3.55	3.29
发行人	3.28	3.13	3.23

报告期内，公司信用政策保持稳定，一般根据客户资质、资金状况等给予相应信用期，应收账款质量较好，不存在通过放宽信用政策增加销售的情形。

（2）存货周转率

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
先锋精科	尚未披露	3.08	2.01

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
珂玛科技	尚未披露	1.68	1.78
富乐德	尚未披露	4.91	4.14
富创精密	尚未披露	2.32	2.04
凯德石英	尚未披露	1.40	1.52
可比公司平均	尚未披露	2.68	2.30
发行人	2.80	2.67	2.86

报告期内，公司存货周转率整体相对稳定，整体高于同行业可比公司平均水平。

十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析

（一）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

报告期内，公司各项偿债能力指标如下：

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.72	5.01	5.87
速动比率（倍）	3.04	4.20	4.90
资产负债率（母公司）	22.80%	17.57%	17.37%
资产负债率（合并）	25.23%	23.67%	20.77%
息税折旧摊销前利润(万元)	34,632.40	22,866.08	17,227.51

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 20.77%、23.67%和 25.23%，流动比率分别为 5.87、5.01 和 3.72，速动比率分别为 4.90、4.20 和 3.04。2024 年度，公司流动比率、速动比率较为稳定。2025 年度，流动比率、速动比率下降，主要系随着公司生产经营和业务规模扩大，应付账款余额增加。

总体来看，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，未发生过无法偿还到期债务的情形。

2、同行业可比上市公司情况

报告期内，公司与同行业可比上市公司偿债能力指标对比情况如下：

资产负债表日	代码	证券简称	资产负债率	流动比率	速动比率
2025. 12. 31	688605.SH	先锋精科	尚未披露	尚未披露	尚未披露
	301611.SZ	珂玛科技	尚未披露	尚未披露	尚未披露
	301297.SZ	富乐德	尚未披露	尚未披露	尚未披露
	688409.SH	富创精密	尚未披露	尚未披露	尚未披露
	835179.BJ	凯德石英	尚未披露	尚未披露	尚未披露
	可比公司均值		尚未披露	尚未披露	尚未披露
	发行人		25. 23%	3. 72	3. 04
2024.12.31	688605.SH	先锋精科	25.04%	3.27	2.70
	301611.SZ	珂玛科技	22.77%	3.04	2.41
	301297.SZ	富乐德	16.48%	4.69	4.22
	688409.SH	富创精密	43.77%	2.17	1.65
	835179.BJ	凯德石英	21.17%	2.73	2.02
	可比公司均值		25.84%	3.18	2.60
	发行人		23.67%	5.01	4.20
2023.12.31	688605.SH	先锋精科	30.54%	2.48	1.88
	301611.SZ	珂玛科技	45.44%	1.74	1.28
	301297.SZ	富乐德	12.10%	5.70	5.15
	688409.SH	富创精密	37.29%	3.43	2.67
	835179.BJ	凯德石英	21.68%	2.16	1.47
	可比公司均值		29.41%	3.10	2.49
	发行人		20.77%	5.87	4.90

总体来看，与同行业可比公司相比，公司偿债能力指标高于同行业可比公司平均值。

（二）现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	88,158.70	67,904.87	51,835.95
收到的税费返还	79.39	34.52	167.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,723.93	3,929.04	807.61
经营活动现金流入小计	90,962.03	71,868.43	52,811.10
购买商品、接受劳务支付的现金	36,459.59	28,910.06	26,131.85
支付给职工以及为职工支付的现金	16,263.99	13,039.81	10,423.74
支付的各项税费	8,156.48	6,058.61	6,462.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,185.26	3,228.03	2,022.89
经营活动现金流出小计	65,065.32	51,236.52	45,041.30
经营活动产生的现金流量净额	25,896.71	20,631.92	7,769.80
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入	101.61%	107.02%	102.37%
经营活动产生的现金流量净额/净利润	114.62%	135.86%	71.03%

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 7,769.80 万元、20,631.92 万元及 **25,896.71 万元**。公司经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金。报告期内，随着公司销售收入的逐年增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金也逐年递增。报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入分别为 102.37%、107.02%和 **101.61%**，整体保持稳定。

报告期各期，公司净现比分别为 71.03%、135.86%和 **114.62%**，**2023 年度净现比较低**，主要受到存货、经营性应收项目与经营性应付项目的影响。

报告期内，公司经营活动现金净流量与净利润情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	22,593.08	15,185.69	10,939.41
加：资产减值准备	2,202.14	1,244.77	691.04
信用减值准备	439.77	200.85	288.05
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,614.10	3,995.57	3,222.35
无形资产摊销	56.74	28.75	19.40

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长期待摊费用摊销	1,917.66	1,306.07	762.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	－	0.94	19.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5.29	11.21	5.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－205.55	-301.89	-24.19
财务费用（收益以“－”号填列）	556.09	475.08	466.42
投资损失（收益以“－”号填列）	－319.44	-395.10	-41.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	－744.89	-899.94	32.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.03	0.10	-224.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	－6,206.77	-2,887.40	-2,636.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	－8,140.48	-4,147.61	-5,240.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,330.49	3,095.36	-765.90
其他	2,798.45	3,719.46	258.47
经营活动产生的现金流量净额	25,896.71	20,631.92	7,769.80

2、投资活动产生的现金流量

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	145,735.12	167,627.36	42,762.34
取得投资收益收到的现金	140.04	-	19.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.53	6.65	10.35
收到其他与投资活动有关的现金	19,286.99	-	6,109.33
投资活动现金流入小计	165,173.68	167,634.01	48,901.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,944.96	15,303.18	11,907.71
投资支付的现金	152,850.00	182,205.00	42,680.00
支付其他与投资活动有关的现金	22,539.01	-	7,029.11
投资活动现金流出小计	203,333.97	197,508.18	61,616.82
投资活动产生的现金流量净额	－38,160.29	-29,874.17	-12,715.66

报告期内，公司投资活动现金流量净额分别为-12,715.66 万元、-29,874.17 万元和**-38,160.29 万元**，主要系公司购买固定资产设备、投入在建工程项目、**购买银行理财产品**所致。

3、筹资活动产生的现金流量

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	-	39,600.00
取得借款收到的现金	1,000.00	1,001.00	300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	2,820.00
筹资活动现金流入小计	1,000.00	1,001.00	42,720.00
偿还债务支付的现金	1,001.00	750.00	2,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.20	19.05	775.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,032.78	490.64	3,450.47
筹资活动现金流出小计	2,060.98	1,259.69	6,975.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,060.98	-258.69	35,744.47

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别 35,744.47 万元、-258.69 万元和 **-1,060.98 万元**。2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较高，主要为吸收投资收到的现金增加。2024 年度，筹资活动产生的现金流量净额为-258.69 万元，由正转负，主要系公司根据经营资金需求银行借款较少、同时偿还到期的银行借款所致。**2025 年度，筹资活动产生的现金流量净额为-1,060.98 万元，主要系支付上市中介费用。**

4、报告期内股利分配的具体实施情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

（三）未来可预见的重大资本性支出计划

截至报告期期末，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出，重大资本性支出决议及具体情况详见本招股说明书“第七节 募集

资金运用与未来发展规划”。

（四）发行人的流动性风险及应对流动性风险的具体措施

报告期内，公司不存在重大或有负债，偿债能力较强。公司现金流量情况良好，资金周转正常。同时，公司银行资信情况良好，不存在不良信用记录，具备良好的信用基础。综合上述因素，公司整体流动性风险较低。

（五）发行人在持续经营能力方面的风险因素及管理层自我评判依据

报告期内，公司经营规模不断扩大，公司资产质量、财务状况和盈利能力良好，公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化；公司的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化；公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖；公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。本次公开发行募集资金到位后，随着募投项目建设的推进，公司的综合竞争力将进一步提升，整体经营能力进一步提高。

十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项

（一）重大投资事项

报告期内，公司不存在重大对外股权投资事项。

（二）资本性支出情况

报告期内，公司的资本性支出主要为购置生产公司产品所用的生产设备、装修费及其他长期资产的支出，及部分募集资金投资项目前期支出。

（三）重大资产业务重组情况

报告期内，公司不存在重大资产业务重组情况。

（四）股权收购事项

报告期内，公司不存在股权收购事项。

十四、财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项、重要承诺事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至公司财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至报告期期末，公司不存在应披露的或有事项。

（三）其他重要事项

截至报告期期末，公司不存在应披露的其他重要事项。

（四）重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至招股说明书签署日，公司、子公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼、其他或有负债和重大期后事项。

十五、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

十六、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况

（一）审计基准日后主要经营情况

公司财务报告审计截止日为**2025年12月31日**，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，产业政策、税收政策、行业发展周期等未发生重大变化；公司主营业务、经营模式及竞争趋势等未发生重大变化；公司主要原材料的采购、主要产品的销售情形未出现重大不利变化；公司主要客户、供应商、高级管理人员和核心技术人员均保持稳定；公司未出现对经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2026 年 1-3 月财务数据预计情况

基于目前的经营状况和市场环境，发行人预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月（预计）	2025 年 1-3 月	变动比例
营业收入	18,000.00-22,000.00	16,523.37	8.94%-33.14%
归属于母公司股东的净利润	3,300.00-3,900.00	3,096.04	6.59%-25.97%
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	3,000.00-3,500.00	2,721.58	10.23%-28.60%

2026 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入较上年同期增长 8.94%至 33.14%，主要系受益于集成电路行业的快速发展所致。2026 年一季度，全球集成电路行业在 2025 年高增长基数上延续高景气发展，市场对全年的增长预期普遍乐观。SIA 预测 2026 年全球半导体销售额将突破 1 万亿美元，步入万亿级市场规模。同时，中国半导体市场在人工智能应用落地与国产替代进程加速的驱动下增长势头强劲，产业链各环节景气度同步攀升。下游市场的持续扩张以及国产替代需求的迫切性，拉动了公司所处上游半导体核心零部件与表面处理服务的需求，为公司一季度及全年业务增长提供支撑。

公司 2026 年 1-3 月业绩预计情况是管理层结合目前的市场环境和自身经营状况，在最佳估计假设的基础上编制，所依据的各种假设具有不确定性，并且相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金使用管理制度

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度（草案）》。按照该制度规定，募集资金将存放于募集资金专户集中管理，其存储、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度进行，做到专款专用。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理投入募集资金。

二、募集资金运用基本情况

（一）本次募集资金投资项目计划

公司本次拟申请首次公开发行人民币普通股 A 股不超过 3,882.26 万股，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	使用募集资金投入 金额（万元）	项目代码
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06	2401-500107-04-02-432138/ 2212-500107-04-01-194336
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56	2401-500107-04-05-894367
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68	2411-310115-04-01-716502
合计		128,336.42	119,752.30	-

本次募集资金投资项目的建设是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充，不会导致公司生产经营模式发生变化。公司将以现有的管理水平和技术积累为依托，通过募集资金投资项目进一步提升管理和研发能力，提升公司在半导体和显示面板设备核心零部件领域的市场占有率。同时，公司将对上游产业链进行延伸布局，通过对单晶硅棒、碳化硅材料和陶瓷粉造粒等原材料量产，进一步降低公司产品成本，增强公司综合竞争力。

（二）实际募集资金量与项目投资需求出现差异时的安排

本次募集资金投资项目总投资金额为 128,336.42 万元。如公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分可由董事会根

据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者由公司通过自筹资金方式解决。若实际募集资金净额满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，公司通过自筹资金进行前期投入；待募集资金到位后，公司将用募集资金置换前期投入该等项目的自筹资金。

（三）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（四）募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系

本次发行募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展。公司已经建立较完整的研发体系和生产能力，掌握了零部件制造技术、零部件表面处理技术和原材料制造技术。本次募集资金投资项目通过扩大现有产品产能、探索新产品领域和加强研发投入，将进一步提高产品科技含量，提升生产能力，满足下游市场需求，提高公司盈利能力。

（五）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

本次募集资金拟投资项目均围绕公司主营业务进行，按照公司业务发展规划对现有业务提升和拓展，新建全新生产线及购置新设备，扩大公司现有产品产能，并布局上游原材料，提高产品科技含量，提升公司核心竞争力。

三、募集资金投资项目可行性分析

（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

1、广阔的市场前景为本项目的顺利开展提供有利条件

当前，我国是全球最大的半导体设备消费市场。根据国际半导体产业协会数据显示，2022 年中国半导体设备的销售额占全球半导体设备销售额占比超过 20%。但从 2021 年中国晶圆厂设备采购额看，国内半导体设备的自给率却仅有 11.00%，相

关先进制程设备及核心零部件仍高度依赖进口。随着本土晶圆厂积极扩产，叠加欧美日对我国相关设备、产品和技术的限制，国产半导体设备零部件需求将大幅增加，市场前景广阔。

本项目建设中，公司拟扩产的产品主要应用于半导体设备和显示面板设备中，广阔的市场需求将为本项目的产品销售提供市场基础。综上，受益于半导体设备国产化替代及泛半导体领域市场需求增长等因素，本项目产品具备良好的市场前景及可行性。

2、健全的质量管控体系为本项目实施提供质量保证

作为国内较为成熟的精密零部件制造企业之一，公司经过多年行业深耕和生产经营经验积累，在研发、生产、质量控制等环节制定了全流程、较成熟的控制标准和体系，以确保在新增产品类型及扩充产能的情况下保证产品质量，避免因产品质量问题出现客户流失。

具体而言，公司已建立了完整的质量管理体系，明确了产品质量检验标准，能及时跟踪并处理产品质量问题，并提出改进策划，确保产品满足质量标准和客户要求。目前，公司已取得包括 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 GB/T29490-2023 知识产权管理等体系的资质认证。

综上，公司完善的质量控制体系将为本项目产品质量提供保证，确保项目有序实施。

3、丰富的客户资源为本项目顺利实施提供保障

自成立以来，公司专注于半导体设备核心零部件（硅电极、硅环、石英电极、石英环、陶瓷产品）和显示面板制造设备核心零部件（上部电极、下部电极）的设计、生产和销售。

为保障产品技术的先进性，公司密切跟踪下游领域的技术革新，深度挖掘客户需求，持续扩充产品品类。经过多年的经营发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源，与业内知名客户建立了长期稳定的合作关系。

综上，公司丰富的客户资源将为本项目顺利实施提供保障。

（二）臻宝科技研发中心建设项目

1、国家政策支持为项目实施提供良好的政策基础

半导体产业是实现我国战略科技自立自强的核心力量，半导体设备作为产业发展的支撑，是决定我国半导体芯片制造高质量发展的关键领域。因此，大力发展半导体设备及其零部件，提升国内精密零部件制造研发水平，是我国实现半导体领域关键产品和核心技术自主安全可控的必经之路。

近年来，受新能源汽车、数据中心等产业强劲需求的推动，半导体设备市场需求不断增大，国家对于半导体行业愈发重视，先后出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等一系列产业相关的发展规划、资金支持和技术扶持政策，助推半导体行业持续发展，半导体设备零部件及相关材料进入高速发展阶段。国家一系列政策法规对半导体产业的鼓励和支持，为项目实施营造了良好的政策环境和基础。

2、经验丰富的管理团队及完善的研发体系为本项目的建设提供保障

公司深耕泛半导体设备零部件领域，目前已形成一套完善的管理运作体系。公司核心团队成员均拥有多年的半导体和显示面板产业从业经历，能够把握公司产品应用领域的发展趋势、挖掘潜在市场需求，引领公司在行业内迅速扩张。此外，公司高度重视研发工作，在研发管理制度方面，制定了高效合理、分工明确的研发管理制度，并能根据外部市场环境的判断以及内部技术储备，适时地调整、优化资源配置，梳理研发方向，确保项目务实、高效的推进。在专业技术人才方面，公司通过外部招聘和内部培养的形式，组建了一批研发经验丰富、自主创新能力强的专业研发团队。

综上，公司经验丰富的管理团队和完善的研发体系有助于公司建立高水平研发人才团队，提高技术创新能力，促进研发成果的转化，为本项目的顺利实施提供了人才保障。

3、丰厚的技术储备和生产经验为本项目的实施提供技术支持

自成立以来，公司始终坚持核心技术自主研发，将技术创新作为增强公司核心竞争力的关键因素之一。经过公司研发团队不断探索，公司当前已经积累了微深孔加工、曲面加工等核心技术。此外，公司在集成电路和显示面板制造设备核心零部件领域也积累了丰富的生产经验，对相关产品的工艺流程、生产特点等均具有深刻的理解。公司凭借优秀的技术研发和生产实力，先后被评定为重庆市高新技术企业、重庆市“专精特新”中小企业和国家级专精特新“小巨人”企业等。

综上，公司的技术储备和生产经验能为本项目建设提供较好的技术支撑。

（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

1、持续的研发投入和完善的研发体系为本项目实施提供良好基础

受下游应用领域需求变化的驱动，公司产品技术迭代需紧密贴合半导体行业的技术演进与工艺升级趋势，这就要求公司具有持续研发投入能力。为了保持行业竞争力，公司不断加大在研发上的投入强度。目前，公司在高纯硅、石英、陶瓷等设备核心零部件以及显示面板上、下电极的制造、等离子涂层保护工艺等方面处于国内领先地位，并获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级知识产权优势企业等荣誉资质。

除了持续的研发投入，为了保障研发项目的顺利实施，公司还设置了一套完善的研发流程体系，制定了高效合理、分工明确的研发管理制度，并能根据外部市场环境的判断以及内部技术储备，适时地调整、优化资源配置，梳理研发方向，确保项目高效推进。

综上，持续稳定的研发投入为项目实施提供了坚实的经济保障，高效的研发体系则为项目建设提供了稳固的战略支撑，项目具有实施的可行性。

2、专业的研发团队为本项目的建设提供人才保障

泛半导体设备零部件领域属于人才密集和技术密集型产业，在该领域，企业的核心竞争力不仅体现在精密制造能力上，更依赖于人才对前沿技术的敏锐洞察力与

持续创新能力。

公司高度重视人才团队的培养和建设，目前已形成一支多背景、高素质的专业研发团队。公司核心团队成员均拥有多年的半导体和显示面板产业从业经历，已掌握了本行业先进生产工艺，能够前瞻性地把握行业中技术的发展趋势，了解客户技术需求，快速开发出贴合市场需求及行业发展趋势的新产品。同时，为持续优化人才梯队结构，公司不断引进优秀高端人才，丰富人才储备。未来，公司将继续深化人才驱动战略，扩大研发团队规模，为公司持续的研发创新提供动力。综上，公司经验丰富的研发团队，有助于提高公司技术创新能力，促进研发成果的转化，为本项目的顺利实施提供人才保障。

3、深厚的开发经验积累和技术协同优势为本项目的实施提供技术支持

自成立以来，公司始终专注于半导体及泛半导体精密零部件的研发和生产，积累了微深孔加工、曲面加工等核心技术。本项目中在对 TCP Windows 特殊涂层材料研发的过程中，凭借自身在阳极氧化、等离子熔射等既有涂层工艺方面的积累，进一步探索氧化铝、氧化钼和氟化钼等新型陶瓷材料，并将其与特殊喷涂工艺相结合，将该技术应用于高端产业设备的精密陶瓷零部件制造中，实现了从材料研发到产品应用的完整闭环。公司拥有的产品开发经验，以及在原有技术基础上持续创新的开发能力，能够为本项目的建设提供坚实的技术基础。

此外，公司还具备较强的技术协同能力，能够基于自身在显示面板等金属材料领域的加工、陶瓷烧结、焊接等经验，进行金属气体分配盘、加热盘等新产品的开发。通过跨领域的技术融合与创新，公司不仅在本项目中实现了技术应用，也为公司未来在新材料、新工艺、新产品领域的持续探索与创新提供了必要的技术支撑。

四、募集资金投资项目具体情况

（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

1、项目基本情况

泛半导体产业下游应用市场的不断丰富，以及制造工艺、技术的不断演进，不

仅为设备零部件提供广阔市场需求，亦对零部件的精度、质量提出更高的要求。同时，由于泛半导体设备零部件的下游应用场景具有多样化特征，能够提供更多元解决方案的厂商才能全面满足客户的需求。

目前，公司产品包括硅零部件、石英零部件和陶瓷零部件等，主要应用在集成电路和显示面板制造领域，如刻蚀、薄膜沉积和蒸镀等环节的制造设备中。本项目拟通过新增场地的方式，引进高端生产加工设备，构建先进生产线，对公司现有产品进行扩产，以满足日益增长的下游应用市场需求，扩大产品销售规模，巩固公司的市场地位。此外，为了保障公司综合竞争力，本项目将继续布局上游单晶硅棒、碳化硅材料和陶瓷造粒粉等原材料产业。通过上下游产业链整合，公司能进一步降低生产成本，提高行业竞争力。项目建设完成后，公司在行业的竞争力和盈利能力将得到显著提升。

本项目预计建设期为 4 年，项目总投资 81,061.32 万元，其中工程建设费用 75,834.53 万元，基本预备费 1,516.69 万元，铺底流动资金 3,710.10 万元。

2、项目必要性分析

（1）本项目是进一步扩充产品产能，促进公司业务增长的必要举措

泛半导体包括了半导体、显示面板等领域，具有技术水平高、产业链带动能力强的特点，是国家的战略性基础性产业，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合实力的重要标志之一。

公司成立以来，专注于集成电路和显示面板设备核心零部件的研发和生产，形成了以硅、石英、碳化硅和陶瓷零部件为核心的几大系列产品。近年来，公司业务订单和收入规模持续增长。随着公司新产品的不断开发和新客户的不断开拓，以及半导体和显示面板市场需求的带动，公司产品需求仍将保持大幅增长趋势，现有的生产能力将难以满足客户的未来需求。因此，本项目将通过购置新场地、建设新产线的方式增加公司石英、硅、陶瓷和碳化硅材料及零部件的产能，促进公司业务规模增长，为公司持续快速发展奠定基础。

综上，本项目的建设具有必要性。

（2）本项目是延伸公司业务链，增强公司核心竞争力的必要举措

公司始终专注于泛半导体工艺设备核心零部件的研发和生产，已积累了丰富的产业经验。公司位于设备零部件产业的中游，上游是硅、石英等原材料供应厂商，公司在采购各类零部件所需的原料后，再通过公司的特定工艺进行精密加工和表面处理，最终以零部件的产品形态进行交付。

但是，由于材料行业具有周期性，原料供应和价格的波动易对公司产品生产和成本产生影响，未来公司研发新产品也对原材料性能提出更高要求。在此背景下，公司结合自身战略规划，在本项目中将布局延伸至产业链上游，进行碳化硅、单晶硅棒、陶瓷粉造粒等研发和生产，用于公司硅、陶瓷等零部件产品的加工和生产。项目建设完成后，公司可以提升原料的自给能力，保障产能稳定，有效改善业务结构，增强公司的成本优势和核心竞争力。

综上，本项目的建设具有必要性。

（3）本项目是抓住国产化机遇，满足市场需求的必要举措

由于技术水平的相对落后，我国泛半导体领域部分关键设备和零部件仍需依赖进口。目前，越来越多的本土厂商选择国内设备厂商和零部件厂商，为本土供应商带来广阔的市场空间。

多年来，公司积累了丰富的硅、石英及陶瓷零部件的生产经验，可广泛用于集成电路和显示面板制造设备中。本项目中，公司通过建设先进的生产基地，对已有的产品进行扩产，进一步提高生产规模 and 产品质量，抓住国产化机遇，满足日益增长的市场需求。本项目的建设有助于进一步强化公司在泛半导体领域的技术优势，为公司未来高速稳健发展打下坚实基础。

综上，本项目的建设具有必要性。

3、项目投资概算

本项目预计建设期为4年，项目总投资81,061.32万元，各项具体投资金额及比例如下：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	工程建设费用	75,834.53	93.55%
2	基本预备费（2%）	1,516.69	1.87%
3	铺底流动资金	3,710.10	4.58%
合计		81,061.32	100.00%

4、项目备案情况

本项目分为两个子项目，其中：高纯度高强度固态碳化硅陶瓷材料研发生产子项目已于 2022 年 12 月取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案号为 2212-500107-04-01-194336；半导体及泛半导体精密零部件研发生产子项目已于 2024 年 1 月取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案号为 2401-500107-04-02-432138。

5、项目经济效益分析

经测算，项目内部收益率为 15.89%，税后投资回收期（含建设期）为 7.7 年。

（二）臻宝科技研发中心建设项目

1、项目基本情况

半导体设备零部件是设备核心技术的基础保障，直接影响到设备性能、生产效率及技术的升级迭代，但其国产化率总体较低。因此，半导体设备国产化，需突破精密零部件制造及其材料生产的工艺节点。

公司自成立以来，深耕泛半导体设备核心零部件领域，目前已经具备以氧化铝、氧化钪为原料的先进陶瓷制造能力和石英、硅材料的零部件制造工艺及研发能力，产品覆盖了集成电路及显示面板制造设备领域。

本项目中，公司将基于对终端应用市场发展的深刻理解，结合公司现有优势和资源，进行静电卡盘 ESC 的研发。同时，本项目将在公司已有硅、石英和陶瓷材料体系外，新增石墨材料、炉管 SIC 材料和特殊涂层材料的自主开发，进一步丰富公司材料类产品，增强公司竞争优势。

本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 30,274.42 万元，其中工程建设费用 18,508.50 万元，研发费用 11,172.31 万元，基本预备费 593.61 万元。

2、项目必要性分析

（1）本项目是增强公司研发水平，巩固公司技术优势的必要举措

与其他行业设备相比，泛半导体设备具有品种多、尺寸特殊、工艺和结构复杂的特点，同时还要兼顾强度、应变、抗腐蚀、电子特性、材料纯度等功能要求，需要各种零部件相互配合，共同支持设备的运转。精密零部件作为泛半导体设备行业的支撑，生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科，在材料、结构、工艺、精度及可靠性等性能方面均需要达到相应的技术要求，是泛半导体设备核心技术的直接保障。

作为技术密集型行业，公司在多年的研发、生产过程中积累了深厚的技术基础。但是随着行业技术的不断演进、下游客户对产品需求的不断变化和提升，泛半导体设备精密零部件必须紧跟趋势，不断研发升级，这对公司的研发和创新能力提出更高要求。本项目中，公司将通过新增研发人员、增加研发设备的方式，对静电卡盘 ESC、石墨材料及零部件应用、炉管 SIC 材料和特殊涂层材料等方面进行前瞻性研究，以便及时满足客户工艺制程的演进，保持公司产品技术的先进性。通过本次项目建设，公司可以有效地整合内部资源，提升技术水平，增强公司整体研发效率，有效提升公司技术竞争力。

（2）本项目是丰富公司产品种类，满足公司战略发展的必要举措

刻蚀工艺是通过化学或物理方法有选择地从硅片表面去除不需要材料的过程，目前以干法刻蚀为主，由刻蚀机完成。作为一种高精密工艺设备，刻蚀机主要由真空室、刻蚀腔体、供气系统组成，刻蚀腔体为气体反应的主要场所，是刻蚀机的核心部分。从零部件组成来看，刻蚀腔体包括上下电极、窗视镜、静电卡盘、硅/石英环等。其中，静电卡盘作为精密零部件中技术难度最高的一类，国产化水平很低，我国仍以进口为主。

由于静电卡盘功能的特殊性，要求其制造材料不同于导体材料与绝缘体材料，目前主要以氧化铝陶瓷或氮化铝陶瓷作为主体材料。本项目中，公司将基于多年的陶瓷材料研发和生产经验，运用流延法，温等静压等技术，研发具有更好导热性、

耐磨性、高硬度和电绝缘性的陶瓷材料和零部件，以应用于半导体刻蚀设备的静电卡盘中。项目建设完成后，公司产品的种类会更加丰富。同时，本项目的建设亦能与公司已有产品产生联动效应，形成更加全面的、以干法刻蚀工艺为核心的产品系列，进而为客户提供更加全面的产品和服务。综上，本项目的建设是丰富公司产品种类，促进公司发展的必要举措。

（3）本项目是抓住行业机会，拓展产业深度的必要举措

成立以来，公司以陶瓷、石英和硅材料为核心，进行相关产品的研发和生产，广泛运用于集成电路和显示面板领域。集成电路和显示面板产业的不断渗透，为相关厂商带来良好的市场机遇。在此背景下，公司将及时抓住行业机遇，通过新设研发中心的形式，对石墨材料进行研发。

一方面，由于石墨材料具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、导电性好和性能稳定等优点，广泛用于多晶硅提纯、硅棒拉制和制造。本项目将主要运用直拉单晶工艺进行石墨材料的研发，本项目研发的材料可用于石墨电极、加热器和石墨坩埚的制造，是直拉单晶炉热系统的主要构成部件。同时，虽然目前行业生产中的石墨材料能够耐高温，但是使用寿命较短，本项目研发的石墨材料不仅具有更强的耐高温、抗氧化等特点，还能够增强机械强度，延长使用寿命，提升直拉单晶的生产效率。另一方面，通过本项目的研发建设，公司的业务范围将进一步延伸至上游原材料领域，丰富公司产品品类。综上，本项目的建设具有必要性。

3、项目投资概算

本项目预计建设期为3年，项目新增总投资30,274.42万元，各项具体投资金额及比例如下：

序号	投资项目	金额（万元）	投资比重
1	工程建设费用	18,508.50	61.14%
2	研发费用	11,172.31	36.90%
3	基本预备费（2%）	593.61	1.96%
合计		30,274.42	100.00%

4、项目备案情况

该项目已于 2024 年 1 月取得《重庆市企业投资项目备案证》，备案号为 2401-500107-04-05-894367。

5、项目经济效益分析

本项目为研发投入项目，不产生直接经济收益。

（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

1、项目基本情况

半导体设备精密零部件是设备核心技术的基础保障，直接影响到设备性能、生产效率及技术的升级迭代，但由于其制造难度大、技术含量高，国产化率总体较低。

公司自成立以来，深耕半导体设备核心零部件领域，产品覆盖了集成电路及显示面板制造设备领域。在本项目中，公司将基于对终端应用市场发展的深刻理解，根据多年来积累的加工技术优势，以及丰富的技术研发经验，开展 ESC 静电卡盘、TCP Windows 特殊涂层、金属气体分配盘和加热盘等产品的研发。

项目建设完成后，将有利于公司提升泛半导体设备核心部件的技术水平，提高产品性能。同时，公司将依托上海在人才储备、技术资源、产业链完整度等方面的综合优势，深化产业布局，加速整合重庆项目研发成果，推动新产品快速实现量产转化，进一步增强公司竞争优势，为拓展市场份额提供持续动能。

本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 17,000.68 万元，其中工程建设费用 9,143.66 万元，研发费用 7,523.68 万元，基本预备费 333.34 万元。

2、项目必要性分析

（1）本项目是提升公司技术创新能力，加速公司研发成果转化的必要举措

随着半导体及泛半导体行业技术的快速发展以及下游客户对产品性能、功能需求的持续升级，要求泛半导体设备精密零部件必须不断推陈出新，以满足持续迭代的工艺要求，并同时具备适配未来制程演进的技术水平。

本项目中，公司将基于自身积累的技术经验，通过自主研发、合作开发等方式，进行 ESC 静电卡盘、TCP Windows 特殊涂层和金属气体分配盘（Shower Head）与加热盘（Ceramic Heater）等关键部件的技术研究。尤其在 TCP Windows 特殊涂层方面，本项目将根据自身在阳极氧化、等离子熔射等既有涂层工艺方面积累的技术优势，将氧化铝、氧化钇和氟化钇等新型陶瓷材料与特殊喷涂工艺相结合，并自研喷涂设备。本项目研发成功后，公司相关产品的性能可达到国际领先标准。同时，本项目还将同步规划中试产线，通过构建“研发-中试-量产”的快速迭代闭环，缩短技术成果转化周期，并为后续规模化量产提供全流程技术验证与工艺参数优化支持。

本项目的技术研发涵盖了从新型材料挖掘到工艺创新等多方面的研究和探索，项目的建设能够提升公司技术创新能力，加速公司研发成果转化，具有建设的必要性。

（2）本项目是拓展公司产品矩阵，助力公司业务规模扩张的必要举措

目前，公司主要产品及服务包括石英零部件、硅零部件、陶瓷零部件以及表面处理服务，广泛用于泛半导体设备中。泛半导体设备作为其产业的核心支撑，涵盖晶圆制造、光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、清洗、封装测试等十余个工艺环节，每一环节均对零部件的精度、可靠性及协同运作能力提出了极高的技术要求。面对日益激烈的市场竞争与不断升级的技术挑战，持续的技术创新与产品多元化战略，成为了行业内公司保持竞争优势的重要战略。

本项目中，公司将根据自身在显示面板金属材料领域的技术积累，进行金属气体分配盘和加热盘等新产品的研发。在金属气体分配盘方面，公司将运用金属加工以及微孔加工技术，实现金属气体分配盘气体分布的均匀性与结构可靠性。在加热盘方面，公司将运用陶瓷烧结、ESC 温控以及焊接技术，提升加热盘的温度控制稳定性与响应速度，增强公司产品竞争优势。

综上，本项目的建设不仅能够满足泛半导体设备对关键零部件的严苛要求，还能进一步拓展公司产品矩阵，扩大公司产品覆盖范围，持续为公司未来业务规模增

长提供动力，本项目建设具有必要性。

（3）本项目是深化产业布局，增强公司竞争优势的必要举措

臻宝科技是于 2016 年成立的高科技制造企业，总部位于重庆市，是公司主要的生产基地。本次募集资金将投入在上海，从而与重庆生产基地形成“研发-制造”协同体系。其中，重庆研发中心着重于前期的前瞻性理论研究，而本项目则聚焦于精密加工环节，基于本项目建设的中试线进行后段工艺开发以及项目成果的转化。

上海拥有全球领先的高校集群及科研院所，更便于进行技术合作开发，且上海在半导体、材料科学领域的高端人才密度居全国首位，有利于专业技术团队的招募，弥补重庆本地高端人才不足的缺点。同时，上海拥有半导体及泛半导体的完整产业链生态，公司部分客户位于上海，便于公司快速获取客户需求反馈，针对性开发适配先进制程的技术和产品。

本项目不仅有助于公司提升在静电卡盘、气体分配盘和加热盘等核心部件的技术水平，满足半导体和显示面板等行业的高端需求，还可以通过利用上海的人才、技术和地域优势，深化产业布局，加快新产品研发速度，为公司带来更大的市场份额和竞争优势，具有建设的必要性。

3、项目投资概算

本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 17,000.68 万元，其中工程建设费用 9,143.66 万元，研发费用 7,523.68 万元，基本预备费 333.34 万元。

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	投资金额占比
1	工程建设费用	9,143.66	53.78%
2	研发费用	7,523.68	44.26%
3	基本预备费 2%	333.34	1.96%
合计		17,000.68	100.00%

4、项目备案情况

该项目已于 2025 年 4 月取得《上海市企业投资项目备案证》，备案号为

2411-310115-04-01-716502。

5、项目经济效益分析

本项目为研发投入项目，不产生直接经济收益。

五、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务产品展开，在现有产品基础上进一步提升产品性能指标，拓宽产品应用领域，从而提升公司整体的技术研发实力，是现有业务的升级、延伸与补充。项目的开展将有助于公司实现现有产品的升级和新产品的研发及产业化。同时，募集资金投资项目的顺利实施将进一步提升公司研发能力，有效增加公司营运资金，保证公司核心竞争力。

六、募集资金运用对公司财务状况、经营成果及独立性的影响

（一）对公司财务状况的影响

募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有较大幅度增加，公司的资产负债率水平将降低，从而改善短期偿债指标，公司的资本结构将进一步优化，有利于提高公司的间接融资能力，降低财务风险。

（二）对公司经营成果的影响

本次发行后，公司净资产将大幅增长，而在募集资金到位初期，由于投资项目规模效应尚不能完全显现，公司的净资产收益率短期内将有一定幅度的下降。本次募集资金项目成功实施后，公司得以继续完善产品线，将继续巩固在已有市场的地位，进一步加大对核心市场的渗透力度，有利于公司加强品牌宣传能力、市场开拓能力、售后服务能力，进一步增强公司的核心竞争力。因此，预计募集资金的投入将增加公司的营业收入和盈利能力。

（三）对公司独立性的影响

本次募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

七、未来发展规划

（一）公司战略规划

1、总体发展战略

公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理整体解决方案，未来将继续推动集成电路和显示面板干法刻蚀和薄膜沉积等设备的关键零部件自主可控，保障供应链的安全性和稳定性。公司紧扣国家产业政策和科技创新发展战略，持续加大技术研发投入，提升国产零部件技术水平和产品性能，不断拓展产品品类，推动碳化硅零部件、石墨零部件、静电卡盘、氮化铝加热器等高附加值产品量产和高致密涂层等表面处理技术的研发，同时向单晶硅棒、化学气相沉积碳化硅和陶瓷造粒粉体等上游材料领域持续投入研发资源，致力于夯实“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，协同上下游产业链创新发展，建立安全可控的供应链，力争成为具有自主新质生产力，国内领先、世界一流的中国半导体零部件整体解决方案智造者。

2、未来三年发展规划与目标

人工智能和算力芯片的快速发展，带动集成电路制造先进工艺对制造设备的性能及用量需求快速增长，与此同时，刻蚀及薄膜沉积设备对零部件的性能及用量需求相应大幅增加。

面对日新月异的技术发展和持续攀升的设备零部件市场需求，公司拟通过对主营业务产品进行扩产，满足市场需求的同时提高公司在集成电路、显示面板的市场占有率；其次，公司推动碳化硅零部件、石墨零部件、静电卡盘等新产品量产；再次，将业务延伸至单晶硅棒、化学气相沉积碳化硅和陶瓷粉体等原材料，充分发挥上下游产业资源整合优势，提高生产效率、降低产品成本，提升公司市场竞争力和品牌影响力，加速国内半导体零部件的国产化突围，填补国内半导体材料及零部件领域技术空白，着力解决先进制程集成电路制造领域零部件的相关“卡脖子”问题，助力国产供应链体系的完善和自主可控，保障集成电路制造行业的稳定可持续发展。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

公司报告期内已开展碳化硅零部件、石墨零部件、静电卡盘等零部件新产品研发和单晶硅棒、气相沉积碳化硅材料、陶瓷粉体等原材料研发，并实现了单晶硅棒和碳化硅零部件的研发与量产，建立了“原材料+零部件+表面处理”一体化业务平台，为客户提供制造设备真空腔体内多品类零部件整体解决方案。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司于 2023 年 1 月完成股份制改造。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定，规范公司运作，建立和完善了现代公司治理结构，搭建了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司依法设立了股东大会、董事会及监事会（已取消），并制定了股东大会、董事会、监事会（已取消）、独立董事及高级管理人员的权责范围和工作程序。董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和《公司章程》的规定，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

《公司章程（草案）》在本次发行完毕，公司在登记机关办理完毕工商备案手续后，即构成规范公司、公司股东、董事及高级管理人员权利义务的具有法律约束力的合法文件。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价

为保护公司及股东的合法权益，提高公司管理水平和经营效率，公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，包括日常经营及财务核算、物资采购、产品销售、人力资源管理、存货管理、内部审计与资产管理控制、研究

开发、投资管理、对外担保、关联交易等各方面建立了相应的制度。

公司董事会对内部控制完整性、合理性及有效性进行了自我评价，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求于**2025年12月31日**在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。

（二）注册会计师对发行人内部控制的审核意见

天健会计师出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8-153号），其结论为：臻宝科技于**2025年12月31日**按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、发行人报告期内违法违规行及受到处罚的情况

报告期内，发行人及其附属公司受到的行政处罚情况如下：

2023年7月1日至2023年9月30日期间，合肥分公司未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，主要涉及增值税、印花税、教育费附加（增值税教育费附加）、地方教育附加（增值税地方教育附加）等税种，且未在责令限期改正的期限内补充申报。2023年12月9日，国家税务总局合肥市包河区税务局根据《中华人民共和国税收征收管理法》等法规向合肥分公司出具了包河税简罚〔2023〕7998号《税务行政处罚决定书（简易）》，并处以50元人民币的罚款。合肥分公司已就上述问题进行了整改并按期缴纳了上述罚款。

2025年3月1日至2025年4月30日期间，杭州分公司未按期申报个人所得税（工资薪金所得）。2025年5月23日及2025年7月7日，国家税务总局杭州市钱塘区税务局根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条向杭州分公司分别出具了杭钱塘税简罚〔2025〕4247号《税务行政处罚决定书（简易）》、杭钱塘税简罚〔2025〕5600号《税务行政处罚决定书（简易）》，并处以合计100元人民币的罚款。杭州分公司已就上述问题进行了整改并按期缴纳了上述罚款。

结合《证券期货法律适用意见第17号》相关规定，发行人上述违法行为轻微、罚款数额较小，对发行人主营业务收入或者净利润不具有重要影响，不属于重大违法行为。

除上述情况外，报告期内发行人不存在违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、发行人报告期内资金占用及担保情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人独立经营情况

公司自整体变更设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司系由臻宝有限整体变更设立，设立时，公司整体承继了臻宝有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司历史上历次增资，股东的出资均已足额到位。公司拥有独立完整的业务体系，具备与业务运营有关的办公场所、机器设备、办公及电子设备等主要运营资产，拥有相关资产的合法所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司业务和经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的

总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立后，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。公司独立对外签订合同，不存在与公司实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，并制定了相适应的股东大会、董事会和监事会的议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等。根据业务经营需要，公司设置了相应的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与公司股东及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与公司股东及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

（五）业务独立

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作、独立经营，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力。公司在本招股说明书中关于自身独立经营情况的表述内容真实、准确、完整。

（六）其他

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业

务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。具体人员变动情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（三）近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职变动情况及原因”。股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年发行人实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

1、基本情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人王兵控制或曾经控制的其他企业具体情况如下：

序号	关联企业名称	成立日期	目前状态	持股比例	主营业务	是否经营或曾经营类似业务
1	香港 SKYTECH	2011 年 3 月 4 日	已注销	王 兵 曾 持 股 100.00%，已于 2024 年 6 月注销	从事半导体及面板行业的零部件贸易	是
2	马绍尔 ZHENBAO	2012 年 4 月 5 日	已注销	王 兵 曾 持 股 100.00%，已于 2023 年 8 月注销	从事半导体及面板行业的零部件贸易	是
3	马绍尔 SKYHITEK	2015 年 4 月 1 日	已注销	王 兵 曾 持 股 100.00%，已于 2023 年 8 月注销	从事半导体及面板行业的零部件贸易	是
4	重庆臻芯合伙	2019 年 11 月 15 日	存续	王兵持有 28.64% 份额，夏冰持有 17.53% 份额	臻宝科技员工持股平台	否
5	重庆臻宝合伙	2020 年 9 月 24 日	存续	王兵持有 28.95% 份额	臻宝科技员工持股平台	否
6	义乌市臻微电子商务商行	2020 年 12 月 2 日	已注销	王兵个体工商户，已于 2023 年 6 月注销	无实际经营业务	否
7	WANG BING FAMILY LIMITED	2023 年 5 月 9 日	由信托公司实际控制	王 兵 曾 持 股 100%，按照信托协议要求，已于 2023 年 6 月悉数赠予信托公司	无实际经营业务，未曾持有发行人股份；系为海外家族信托而设立的 SPV	否

2、报告期内公司实际控制人曾经控制经营类似业务企业的基本情况

（1）香港 SKYTECH

公司名称	SKYTECH（HONGKONG）LIMITED
成立日期	2011 年 3 月 4 日
股本（万港元）	1.00
住所	Room 1003, 10/F Tower 1, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
董事	王兵
股权变动情况	香港 SKYTECH 已于 2024 年 6 月完成注销
主营业务	从事半导体及面板行业的零部件贸易
与发行人业务关系	香港 SKYTECH 从事半导体及面板行业的零部件贸易，但报告期内无实际经营

香港 SKYTECH 曾从事半导体及面板行业的零部件贸易，但其已于 2018 年停止经营，并于 2024 年完成注销。报告期内香港 SKYTECH 与发行人不存在经营类似业务的情况。

（2）马绍尔 ZHENBAO

公司名称	ZHENBAO TECHNOLOGY CO., LTD.
成立日期	2012 年 4 月 5 日
股本（万美元）	5.00
住所	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands MH96960
董事	王兵
股权变动情况	马绍尔 ZHENBAO 已于 2023 年 8 月完成注销
主营业务	从事半导体及面板行业的零部件贸易
与发行人业务关系	马绍尔 ZHENBAO 从事半导体及面板行业的零部件贸易，但报告期内已停止经营并注销

马绍尔 ZHENBAO 曾从事半导体及面板行业的零部件贸易，但其已于 2022 年 3 月停止经营，2023 年 8 月完成注销。报告期内马绍尔 ZHENBAO 与发行人不存在经营类似业务的情况。

（3）马绍尔 SKYHITEK

公司名称	SKYHITEK（HONGKONG）LIMITED
成立日期	2015 年 4 月 1 日
股本（万美元）	5.00
住所	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands MH96960
董事	王兵
股权变动情况	马绍尔 SKYHITEK 已于 2023 年 8 月完成注销
主营业务	从事半导体及面板行业的零部件贸易
与发行人业务关系	马绍尔 SKYHITEK 从事半导体及面板行业的零部件贸易,但报告期内已停止经营并注销

马绍尔 SKYHITEK 曾从事半导体及面板行业的零部件贸易,但其已于 2022 年 11 月停止经营,2023 年 8 月完成注销。报告期内马绍尔 SKYHITEK 与发行人不存在经营类似业务的情况。

3、同业竞争解决措施

为解决潜在的同业竞争,香港 SKYTECH 已于 2018 年停止经营,并于 2024 年 6 月完成注销;马绍尔 ZHENBAO、马绍尔 SKYHITEK 分别于 2022 年 3 月、2022 年 11 月起停止经营,并于 2023 年 8 月完成注销。

综上所述,公司相关潜在同业竞争方已在报告期内注销,未来不会存在主营业务重合的情况。公司与相关同业竞争方之间不存在利益输送、利益倾斜,不存在影响上市条件的同业竞争情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司的控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺,具体内容详见本招股说明书“附件一：与投资者保护相关的承诺”之“十、关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《科创板股票上市规则》等法律法规相关规定，截至报告期末，公司主要的关联方及关联关系如下：

1、直接或者间接控制发行人的自然人、法人或其他组织

公司实际控制人王兵及其一致行动人配偶夏冰、姐姐王凤英、哥哥王喜才、重庆臻芯合伙及重庆臻宝合伙，不存在直接或者间接控制发行人的法人或者其他组织。

2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人

杨璐。

3、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员

公司现任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员为王兵、杨佐东、张静、薛锋、杨璐、刘子钊、LIANSHENG CAO（曹炼生）、张金若、龙莉、龚汉远、陈莉、郭丽丽和蒋晓钧。

发行人原董事周淋于 2021 年 12 月辞去公司董事一职，发行人原监事窦江梅、洪萍及刘利莹分别于 2021 年 12 月、2022 年 11 月及 2023 年 3 月辞去公司监事一职，根据《科创板股票上市规则》，该等关联自然人及其关系密切的亲属自其离职之日起十二个月内亦为发行人之关联方。

4、上述关联自然人关系密切的家庭成员

前述 1-3 项所述人士的关系密切的家庭成员为公司关联方，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

5、直接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人

直接持有臻宝科技 5%以上股份的股东共计 2 名，分别为重庆臻芯合伙、重庆科芯及其一致行动人杨海斌。

6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员或其他主要负责人

不存在直接或者间接控制臻宝科技的法人或者其他组织。

7、由前述 1-6 项所述关联法人和关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

（1）除臻宝科技及其附属公司以外，不存在由前述关联法人直接或者间接控制的法人或者其他组织。

（2）除臻宝科技及其附属公司以外，由前述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	重庆臻芯合伙	实际控制人王兵担任执行事务合伙人
2	重庆臻宝合伙	实际控制人王兵担任执行事务合伙人
3	上海乐牙口腔门诊部有限责任公司	实际控制人的一致行动人王喜才担任业务院长
4	重庆赣江实业有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶持股 71%并担任董事
5	重庆赣江文化产业发展有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶担任执行董事兼经理
6	重庆赣江文化传媒有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶担任董事
7	重庆耐德智能技术有限公司	公司董事杨璐配偶控制
8	重庆贸富物资有限公司	公司董事杨璐配偶控制
9	重庆禾美物业管理有限公司	公司董事杨璐配偶控制
10	重庆赣略商业管理有限公司	公司董事杨璐配偶控制
11	重庆通耀科技有限公司	公司董事杨璐配偶控制
12	重庆朗顺机械有限公司	公司董事杨璐配偶控制
13	重庆昶之鑫机械设备有限公司	公司董事杨璐配偶控制
14	重庆坤勤贸易有限公司	公司董事杨璐配偶控制
15	重庆亮福商贸有限公司	公司董事杨璐配偶控制
16	重庆诺瑞商贸有限公司	公司董事杨璐配偶控制
17	高新技术企业开发区洪派五金机电经营部	公司董事杨璐配偶控制

序号	关联方名称	关联关系
18	重庆道威货物运输有限公司	公司董事杨璐配偶控制
19	重庆品禄建筑装饰工程有限公司	公司董事杨璐配偶控制
20	重庆赣江健康管理有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶担任执行董事兼总经理
21	重庆赣江体育发展有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶担任执行董事兼总经理
22	重庆赣江科技有限公司	公司董事杨璐配偶及其父亲控制，且杨璐配偶担任执行董事兼总经理
23	重庆硕冠商业管理有限公司	公司董事杨璐配偶之父亲控制，并担任执行董事兼总经理
24	重庆申宸歆谷科技股份有限公司	公司董事杨璐配偶之父亲控制
25	重庆乾有物流有限公司	公司董事杨璐配偶之父亲控制，并担任执行董事兼经理
26	重庆龙共尊生态农业有限公司	公司董事杨璐配偶之亲属控制
27	重庆金通种鸽养殖有限公司	公司董事杨璐配偶之亲属控制
28	重庆市石桥铺机电市场有限责任公司	公司董事杨璐配偶之亲属控制
29	重庆灵达商业管理有限公司	公司董事杨璐配偶之亲属控制
30	重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司	公司董事薛锋担任职工代表董事、公司股东杨海斌担任副总经理
31	西安航天民芯科技有限公司	公司董事刘子钊担任董事
32	上海九同方技术有限公司	公司董事刘子钊担任董事
33	中国电子工程设计院股份有限公司	公司董事刘子钊担任董事
34	汉王科技股份有限公司	公司董事刘子钊配偶父亲历任总经理、常务副总经理
35	北京汉王卓文科技有限公司	公司董事刘子钊配偶父亲担任董事
36	重庆创升鑫电子科技有限公司	公司取消监事会前在任监事陈莉及其配偶控制
37	香港浩義成贸易有限公司	公司取消监事会前在任监事陈莉及其配偶控制
38	重庆万物维企业管理咨询有限公司	公司独董龙莉母亲控制的企业（持股 80%并担任执行董事）
39	镇江大白鲸海洋世界有限公司	公司股东杨海斌担任董事

注：经互联网检索公开信息，有 2 家企业存在电话与重庆赣江实业有限公司相同的情形；经访谈重庆赣江实业有限公司实际控制人（公司董事杨璐配偶），确认前述 2 家企业不属于《科创板股票上市规则》规定的关联方认定范围

除上表外，臻宝科技前述关联自然人关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业亦属于公司的关联方。

8、间接持有/控制发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司为直接持有发行人 5%以上股份的股东重庆科芯的执行事务合伙人，基本情况如下：

名称	重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司
注册地址	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-471
法定代表人	谷永红
统一社会信用代码	91500106MA5U3J9T6J
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：私募股权投资基金管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2015 年 11 月 11 日
营业期限	2015 年 11 月 11 日至长期

9、中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织

10、报告期内曾经的关联方

（1）报告期内曾担任过公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

姓名	曾任职务
周淋	董事，由股东重庆科芯提名
窦江梅	监事，由股东王兵提名
洪萍	监事，由股东王兵提名
刘利莹	监事，由股东王兵提名

注：发行人原董事周淋、原监事窦江梅分别于 2021 年 12 月辞去公司董事、监事一职，根据《科创板股票上市规则》，该等关联自然人及其关系密切的亲属自其离职之日起十二个月内亦为发行人之关联方

前述人员关系密切的家庭成员亦为公司报告期内曾经的关联方，包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（2）上述“1、关联自然人”所列人员曾经控制、担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或其他组织以及上述“3、报告期内曾经的关联方”中曾经的关

联自然人控制、担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或其他组织等（臻宝科技及其附属公司除外）

序号	关联方名称	关联关系
1	上海菁庚信息技术咨询中心	王兵曾持有 100%份额，该企业已于 2021 年 12 月注销
2	义乌市臻徽电子商务商行	王兵曾持有 100%份额，该企业已于 2023 年 6 月注销
3	香港 SKYTECH	王兵曾持有 100%份额，该企业已于 2024 年 6 月注销
4	马绍尔 ZHENBAO	王兵曾持股 100%并担任董事，该企业已于 2023 年 8 月注销
5	马绍尔 SKYHITEK	王兵曾持股 100%并担任董事，该企业已于 2023 年 8 月注销
6	上海贯铁	王兵曾持股 90%（系由王兵姐姐王凤英代为持有），已于 2021 年 3 月转让全部股份并退出，2022 年 3 月后不再作为公司关联方
7	WANG BING FAMILY LIMITED	王兵曾持股 100%并担任执行董事，已于 2023 年 6 月转让全部股份，并卸任执行董事
8	顺源政信（重庆）企业管理有限责任公司	公司原董事周淋担任执行董事并持股 40%
9	重庆予凡文化艺术有限公司	公司原董事周淋曾担任执行董事兼经理，周淋及关系密切的家庭成员合计持有 100%股权，该企业已于 2023 年 10 月注销
10	重庆天籁教育科技有限公司	公司原董事周淋担任董事
11	三羊马（重庆）物流股份有限公司（001317.SZ）	公司原董事周淋历任董事的企业（2025 年 7 月卸任）
12	重庆万泉私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司原董事周淋担任执行事务合伙人委派代表
13	重庆全瀚安电子科技有限公司	公司原监事洪萍配偶担任总经理（非工商登记经理，系内部组织架构上的总经理）
14	重庆市龙商融资担保有限责任公司	杨璐配偶历任董事的企业

注：上海菁庚信息技术咨询中心已于报告期起始之日前予以注销。

除上表外，臻宝科技关联自然人关系密切的家庭成员曾经控制、共同控制或施加重大影响的其他企业，曾经的关联自然人及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业亦属于公司的关联方。

（3）报告期内，曾直接、间接持有/控制臻宝科技 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人：天津显智链投资中心（有限合伙）。

（二）关联交易

1、重大关联交易判断标准

根据企业会计准则的规定，公司与包括在公司合并财务报表合并范围内的各企业之间的交易不予披露。

重大关联交易指对财务状况和经营成果产生重大影响的关联交易，具体标准如下：

（1）公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%以上，且超过人民币 300 万元的关联交易事项；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易事项。

此外，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，为一般关联交易。

2、关联交易汇总表

公司报告期内所发生的关联交易如下表所示：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
重大经常性关联交易	报告期内，发行人不存在重大经常性关联交易事项			
重大偶发性关联交易	关联担保	报告期内，王兵及重庆臻芯合伙向公司提供银行借款的担保。截至 2025 年 12 月 31 日 ，关联担保均已履行完毕		
	关联方资金拆借	报告期内，公司由于业务发展及资金流转需要，向实际控制人王兵拆借资金，拆借资金已全部归还		
一般经常性关联交易	关联采购	160.51	160.51	160.51
	关键管理人员薪酬	871.31	730.95	515.91
一般偶发性关联交易	关联采购	-	-	105.00
关联方往来款项余额	应付账款	12.57	13.38	21.63
	其他应付款	7.21	0.23	2.67

3、重大经常性关联交易

报告期内，发行人不存在重大经常性关联交易事项。

4、重大偶发性关联交易

（1）关联担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至报告期末是否已经履行完毕
1	王兵、重庆臻芯合伙	发行人	1,000.00	2022/6/29	2023/6/29	是
2	王兵	发行人	1,000.00	2022/11/28	2023/11/28	是
3	王兵	发行人	1,000.00	2022/12/13	2024/12/12	是
4	王兵	发行人	1.00	2024/12/10	2028/1/10	是

报告期内，公司的关联担保均系实际控制人王兵及重庆臻芯合伙向公司银行借款提供的担保事项。

（2）关联方资金拆借

单位：万元

关联方名称	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
王兵	期初余额	-	-	-
	本期借出	-	-	2,820.00
	本期归还	-	-	2,820.00
	期末余额	-	-	-

报告期内，公司由于业务发展及资金流转需要，向实际控制人王兵拆借资金，用于购买设备及流动资金周转，拆借资金已于 2023 年 4 月清偿，并参照同期银行利率支付了利息。

5、一般经常性关联交易

（1）关联采购

单位：万元

关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
重庆禾美物业管理有限公司	160.51	160.51	160.51

报告期内，公司与关联方重庆禾美物业管理有限公司签订了物业管理协议，约定由重庆禾美物业管理有限公司为公司提供保安、保洁等物业管理服务。物业管理费为每月固定金额，报告期内每年的物业管理费均为 160.51 万元。

（2）关键管理人员薪酬

单位：万元

关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	871.31	730.95	515.91

报告期内，公司向担任董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员等关键管理人员支付薪酬。报告期内，公司关键管理人员薪酬合计分别为 515.91 万元、730.95 万元及 871.31 万元。

报告期内，除上述关联交易外，公司无其他经常性关联交易。由于上述关联交易具备合理的商业背景、公允的交易定价，公司不存在对关联方的重大依赖。

6、一般偶发性关联交易

（1）关联采购

单位：万元

关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
重庆耐德智能技术有限公司	-	-	105.00
合计	-	-	105.00

报告期内，公司与关联方重庆耐德智能技术有限公司签订了咨询服务合同，重庆耐德智能技术有限公司为施耐德电气（中国）有限公司在西南地区的合作方，双方约定由重庆耐德智能技术有限公司为公司提供智能制造咨询及改造服务，该合同已于 2023 年度执行完毕。

7、关联方往来款项余额

（1）应付账款

单位：万元

关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
重庆禾美物业管理有限公司	12.57	13.38	13.38
重庆耐德智能技术有限公司	-	-	8.25
合计	12.57	13.38	21.63

报告期内，公司与重庆禾美物业管理有限公司之间的应付账款均为报告期各期末当月的物业管理费，公司通常次月支付当月物业管理费；公司与重庆耐德智能技术有限公司之间的应付账款为当年尚未支付完毕的项目款项。

（2）其他应付款

单位：万元

关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
王兵	7.17	-	2.01
杨佐东	-	0.01	-
张静	-	-	0.17
龚汉远	-	0.13	-
蒋晓钧	0.03	0.07	0.01
夏冰	-	-	0.49
陈莉	-	0.03	-
合计	7.21	0.23	2.67

报告期内公司与上述关联方之间的其他应付款均为员工费用报销。

（三）报告期内关联交易履行《公司章程》规定程序的情况及独立董事意见

公司第一届董事会第十四次会议及 2024 年度股东大会通过了《关于确认最近三年关联交易执行情况及预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，第二届董事会第三次会议通过了《关于确认 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，2025 年度股东会待审议《关于确认 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，确认 2023 年度、2024 年度

及 **2025 年度**与关联方所发生的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司独立董事对公司最近三年关联交易发表了独立意见，认为公司 2023 年度、2024 年度及 **2025 年度**与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，不存在损害发行人利益及股东利益之情形。董事会在审议该项议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

发行人现行有效的《公司章程》及《关联交易管理制度》规定明确了关联交易公允决策的程序。

（四）规范和减少关联交易的措施

股份公司成立后，公司已按照《公司法》等有关法律法规，并参照《上市公司章程指引》，制定了《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》等一系列关于关联交易的决策程序文件。公司严格按照上述文件规定履行关联交易的决策程序，确保关联交易价格的公允，以保障其他股东的合法权益。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排

根据 2025 年 4 月 3 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

二、股利分配政策

（一）发行人本次发行后的股利分配政策

1、利润分配原则

公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2、利润分配形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式。

3、利润分配的期间间隔

在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4、公司现金分红的具体条件和比例

在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件，并满足公司正常的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

5、现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、公司发放股票股利的条件

公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

7、对公众投资者的保护

存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配方案的实施

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后，股利分配政策不存在重大差异情况。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或其他类似特殊安排。公司不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

报告期内，公司已履行及正在履行的合同中，对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同确定依据为：（1）公司及其子公司与报告期内前五大客户签署的框架合同；（2）公司及其子公司与报告期内前五大供应商签署的框架合同，或未签署框架合同情况下金额大于 300.00 万元的订单；（3）报告期内，公司及其子公司正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的重要银行借款或授信合同；（4）报告期内，公司及子公司已经履行完毕及正在履行的 1,000.00 万以上的建筑施工合同；（5）对公司在研技术有重要协同效力的技术开发方面的研发合同；（6）其他对公司生产经营活动具有重要影响的合同。

（一）销售合同

公司及其子公司与报告期内前五大客户签署的框架合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同金额	合同期限	履行状态
1	客户 3	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2023 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日	履行中
2	客户 3	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2022 年 8 月 19 日至 2027 年 8 月 18 日	履行中
3	客户 3	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2022 年 1 月 6 日至 2027 年 1 月 5 日	履行中
4	客户 3	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2021 年 5 月 11 日至协议项下的主要事项完成后终止	履行中
5	客户 2	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	长期有效	履行中
6	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日，届满前 15 天未通知不续约的，自动延续一年	履行中
7	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2024 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日，届满前 60 天未通知不续约的，自动延续一年	履行中
8	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日	履行完毕
9	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日	履行完毕
10	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2024 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日，届满前 30 天未通知不续约的，自动延续一年	履行中
11	京东方	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2024 年 9 月 10 日至 2027 年 9 月 9 日，届满前 30 天未通知不续约的，自动延续一年	履行中

序号	客户名称	合同内容	合同金额	合同期限	履行状态
12	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年9月14日至2025年9月13日, 届满前30天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
13	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年10月14日至2025年10月13日, 届满前30天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
14	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年10月16日至2025年10月15日, 届满前30天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
15	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	合同经双方签署后生效,除非双方同意提前终止,合同将持续有效	履行中
16	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	合同经双方签署后生效,除非双方同意提前终止,合同将持续有效	履行中
17	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年3月3日至2024年3月2日, 届满前60天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
18	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年3月6日至2024年3月5日, 届满前60天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
19	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年4月29日至2029年4月28日, 届满前30天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
20	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年8月1日至2029年7月31日, 届满前60天未通知不续约的,自动延续一年	履行中
21	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年3月27日至2024年3月26日	履行完毕
22	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年3月27日至2024年3月26日	履行完毕
23	客户4	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2024年1月1日至2027年12月31日, 期满日自动到期,除非双方于期满日前至少30日书面延长期限	履行中
24	客户1	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	长期有效	履行中
25	华星光电	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2021年3月31日至2024年3月30日	履行完毕
26	华星光电	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年1月1日至2027年12月31日	履行中
27	华星光电	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2021年5月5日至2024年5月4日	履行完毕
28	华星光电	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2023年1月1日至2027年12月31日	履行中
29	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2025年7月16日至2026年7月15日	履行中
30	京东方	框架协议,约定通用条款	以订单金额为准	2025年10月27日至2026年10月26日	履行中

（二）采购合同

公司及其子公司与报告期内前五大供应商签署的框架合同，或未签署框架合同情况下金额大于300.00万元的订单如下：

单位：万元

序号	供应商	合同内容	合同金额	签署日期	履行状态
1	菲利华	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2024 年 1 月 5 日	履行完毕
2	霏泽材料	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2023 年 11 月 27 日	履行完毕
3	CREST	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2022 年 11 月 15 日	履行中
4	SINWON	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2022 年 11 月 15 日	履行中
5	Visiontech	框架协议，约定通用条款	以订单金额为准	2022 年 11 月 15 日	履行中
6	盾源聚芯	硅材料	776.20	2024 年 10 月 24 日	履行完毕
7	盾源聚芯	硅材料	597.76	2024 年 5 月 23 日	履行完毕
8	盾源聚芯	硅材料	467.88	2024 年 8 月 28 日	履行完毕
9	盾源聚芯	硅材料	388.08	2024 年 3 月 19 日	履行完毕
10	盾源聚芯	硅材料	864.85	2025 年 3 月 10 日	履行完毕
11	盾源聚芯	硅材料	930.80	2025 年 5 月 6 日	履行中
12	易芯半导体	硅材料	440.85	2024 年 3 月 19 日	履行完毕
13	易芯半导体	硅材料	422.50	2023 年 2 月 9 日	履行完毕
14	CSN	硅材料	387.31	2024 年 9 月 23 日	履行完毕
15	CSN	硅材料	382.00	2024 年 8 月 1 日	履行完毕
16	CSN	硅材料	382.00	2024 年 8 月 16 日	履行完毕
17	CSN	表面修复服务	344.04	2023 年 8 月 20 日	履行完毕
18	CSN	硅材料	579.95	2025 年 6 月 20 日	履行完毕
19	CSN	硅材料	528.99	2025 年 11 月 4 日	履行中
20	连云港黑石	硅材料	518.00	2025 年 8 月 29 日	履行完毕
21	盾源聚芯	硅材料	485.06	2025 年 12 月 9 日	履行完毕
22	鑫华半导体	硅材料	以订单金额为准	2025 年 2 月 20 日	履行中

（三）银行借款或授信合同

截至报告期末，发行人正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的重要银行借款或授信合同如下：

单位：万元

序号	受信人/借款人	授信人/贷款人	最高授信额度/借款金额	授信期限/借款期限	担保方式
1	臻宝科技	中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,000.00	2025 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 21 日	臻宝科技以三项专利为质物，与中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行签署了《最高额质押合同》

（四）建筑施工合同

报告期内公司及子公司已经履行完毕、正在履行的 1,000.00 万以上的建筑施工合同如下：

单位：万元

序号	施工方	工程内容	合同金额	签署日期	履行状态
1	天津安美环境科技工程有限公司	湖北芯洁厂房装修及设备安装	1,230.00	2020 年 11 月	履行完毕
2	中机中联工程有限公司	臻宝科技二期厂房装修及设备安装	1,600.00	2021 年 12 月	履行完毕
3	重庆中尔机电安装工程 有限公司	臻宝科技三期 1#厂房装修及设备安装	1,094.54	2023 年 8 月	履行完毕
4	天津安美环境科技工程 有限公司	臻宝科技三期 2#厂房装修及设备安装	1,958.60	2024 年 11 月	履行中

（五）研发合同

重大研发合同共计 4 项，分别为（1）与上海大学合作的“耐刻蚀陶瓷喷涂粉末/涂层的制备和性能优化”研发项目；（2）与江苏神州半导体科技有限公司合作的氮化铝产品研发项目；（3）与某研究所合作的涂层制备工艺研发项目；（4）与客户 4 合作的“碳化硅环”研发项目。

（六）其他合同

其他对公司生产经营活动具有重要影响的合同：

序号	合同名称	合同对手方	合同主要内容
1	重庆臻宝实业有限公司 半导体新材料研发制造 项目投资协议	重庆西彭工业园区管理 委员会、重庆铝产业开 发投资集团有限公司	由合同对手方提供土地、厂房、办公楼及配套设施等并交付公司使用。公司在厂区完成验收并交付使用（建成投产）9 年后达产，达产后实现年值 8 亿元，实现年经济贡献（企业增值税和所得税）5600 万元
2	重庆臻宝实业有限公司 下部电极基板及半导体 零部件二期扩能项目投 资合作协议书	重庆西彭工业园区管理 委员会、重庆铝产业开 发投资集团有限公司	项目签约后 10 个月内，甲方按照公司要求将定制厂房交付给公司；公司承诺，待租赁厂房交付之日起 3 个月内完成设备安装调试，6 个月内实现项目投产；投产 5 年后达产，达产后实现年产值为 2 亿元的目标

二、发行人对外担保有关情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，不存在公司控股股东、实际控制人、子公司及公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项的情形。

第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司全体董事签字：



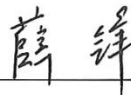
王 兵



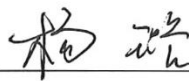
杨佐东



张静



薛 锋



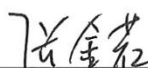
杨 璐



刘子钊



曹炼生

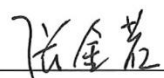


张金若



龙 莉

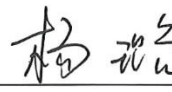
本公司全体审计委员会成员签字：



张金若



龙 莉



杨 璐

其他高级管理人员签字：



蒋晓钧



一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司全体董事签字：

_____ 王 兵	_____ 杨佐东	_____ 张静
_____ 薛 锋	_____ 杨 璐	_____ 刘子钊
_____ 曹炼生	_____ 张金若	_____ 龙 莉

本公司全体审计委员会成员签字：

_____ 张金若	_____ 龙 莉	_____ 杨 璐

其他高级管理人员签字：

蒋晓钧



一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司全体董事签字：

王 兵

杨佐东

张静

薛 锋

杨 璐

刘子钊



曹炼生

张金若

龙 莉

本公司全体审计委员会成员签字：

张金若

龙 莉

杨 璐

其他高级管理人员签字：

蒋晓钧



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：



王 兵

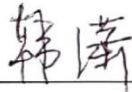


三、保荐人（主承销商）声明

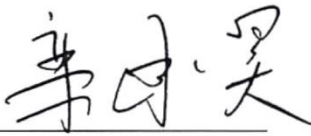
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人签名：


杨 腾


韩 谦

项目协办人签名：


栾承昊

法定代表人签名：


张佑君



保荐人董事长声明

本人已认真阅读重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：

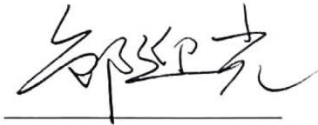

张佑君



保荐人总经理声明

本人已认真阅读重庆臻宝科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：



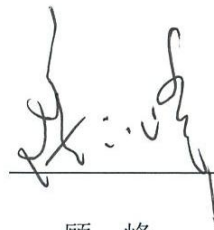
邹迎光

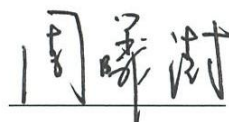


四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

负责人： 
张学兵

经办律师： 
顾 峰

经办律师： 
周曦澍

北京市中伦律师事务所（盖章）

2026 年 3 月 31 日

五、审计机构声明

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8-152号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8-153号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆臻宝科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、审阅报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

弋守川
弋守川

祝芹敏
祝芹敏

周理霞
周理霞

天健会计师事务所负责人：

李青龙
李青龙

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年三月十一日



六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



吴宁华

吴宁华



资产评估机构法定代表人：

龙明

龙明

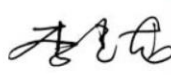


七、验资机构声明

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验〔2022〕8-43号、天健验〔2022〕8-46号、天健验〔2023〕8-36号、天健验〔2023〕8-42号、天健验〔2023〕8-54号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆臻宝科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


李青龙

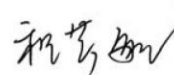
李青龙


文永丽

文永丽


弋守川

弋守川


祝芹敏

祝芹敏

天健会计师事务所负责人：


钟建国

钟建国

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年三月十一日



第十二节 附件

一、本招股说明书的备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （九）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告；
- （十）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （十一）内部控制审计报告；
- （十二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十三）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十五）募集资金具体运用情况；
- （十六）子公司、参股公司简要情况；
- （十七）其他与本次发行有关的重要文件。

附件一：与投资者保护相关的承诺

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

（一）公司实际控制人及其一致行动人承诺

1、公司实际控制人王兵及其一致行动人关于锁定期承诺如下：

（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由公司回购该等股份。

（2）公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人/本企业持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。期间公司如有现金红利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。

（3）公司上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月；公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月；公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限十二个月。前述“届时所持股份”分别指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年公司年报披露时仍持有的股份。

（4）根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。

（5）若本人/本企业违背前述股份限售承诺，本人/本企业因减持股份而获得的

任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本人/本企业应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人/本企业违反上述承诺，造成公司、投资者损失的，本人/本企业将依法赔偿公司、投资者由此产生的直接损失。

2、公司实际控制人王兵及其一致行动人关于持股及减持意向承诺如下：

（1）对于本人/本企业在首次公开发行前持有的公司股份，本人/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定、已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的相关承诺，在限售期内，不出售首次公开发行前持有的公司股份。

（2）本人/本企业持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。本人/本企业如在锁定期满后减持首次公开发行股票前股份的，会明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

（3）如本人/本企业根据实际需要拟在锁定期满后两年内减持的，将审慎制定减持计划，并严格按照上海证券交易所科创板减持、股份变动相关法律、法规、规范性文件的规定进行减持，遵守减持数量、减持方式、减持价格、信息披露等相关的规定和要求。减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应相应作除权除息处理。

（4）以上股份不包括本人/本企业通过二级市场买入的公司股份。

（二）其他持股 5%以上的股东及其一致行动人承诺

1、其他持股 5%以上的股东及其一致行动人关于锁定期承诺如下：

（1）自公司股票上市之日起一年内，本人/本企业不转让或者委托除基金管理人以外的他人管理本人/本企业直接及/或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由公司回购本人/本企业直接及/或间接持有的公司首发前股份。

（2）本人/本企业将遵守《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定；如相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构对本人/本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人/本企业将按该等相关要求执行。

（3）本人/本企业将遵守上述股份锁定及减持承诺，如本人/本企业违反上述承诺，则本人/本企业将按照法律规定承担相应责任。

2、其他持股5%以上的股东及其一致行动人关于持股及减持意向承诺如下：

（1）对于本人/本企业在首次公开发行前持有的公司股份，本人/本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定、已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的相关承诺，在限售期内，不出售首次公开发行前持有的公司股份。

（2）本人/本企业如在锁定期满后减持首次公开发行股票前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定保证公司持续稳定经营。

（3）若本人/本企业违反上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的责任。

以上股份不包括本人/本企业通过二级市场买入的公司股份。

（三）公司其他股东的承诺

1、公司股东集成电路二期基金关于锁定期承诺如下：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

（2）本企业将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所所有股份锁

定和减持的相关规定。若法律、法规、中国证监会或上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

（3）本企业将按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

2、公司其他股东关于锁定期承诺如下：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）本单位/本人将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所有关股份锁定和减持的相关规定。若法律、法规、中国证监会或上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

（3）如果本单位/本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本单位/本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

（四）持有公司股份的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

1、持有公司股份的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员关于锁定期承诺如下：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接通过公司员工持股平台重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙）和/或重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应相应作除权除息处理。

（3）上述锁定期届满后，在本人担任公司董事/取消监事会前在任监事/高级管理人员的期间，以及本人在任期届满前离职的，在满足股份锁定承诺的前提下，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，自离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。

（4）本人将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所有关股份锁定和减持的相关规定。若法律、法规、中国证监会或上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

（5）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺（仅限于承诺人为董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的情形）。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

2、持有公司股份的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员关于持股及减持意向承诺如下：

对于本人在首次公开发行前持有的公司股份，本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定、已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的相关承诺，在限售期内，不出售首次公开发行前持有的公司股份。

本人持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。本人如在锁定期满后减持首次公开发行股票前股份的，会明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

如本人根据实际需要拟在锁定期满后两年内减持的，将审慎制定减持计划，并严格按照上海证券交易所科创板减持、股份变动相关法律、法规、规范性文件的规定进行减持，遵守减持数量、减持方式、减持价格、信息披露等相关的规定和要求。减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。若公司股份在上述期间内发生

派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价应相应作除权除息处理。

若本人违反上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

以上股份不包括本人通过二级市场买入的公司股份。

（五）核心技术人员承诺

核心技术人员关于股份锁定期承诺如下：

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人间接通过公司员工持股平台重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙）和/或重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

2、上述锁定期届满之日起四年内，在本人担任公司核心技术人员的期间，以及本人离职的，在满足股份锁定承诺的前提下，在本人就任时和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司首次公开发行股票前已发行的股份总数的 25%，自离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股份。减持比例可以累积使用。

3、本人将严格遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所有关股份锁定和减持的相关规定。若法律、法规、中国证监会或上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行承诺。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。

二、关于稳定股价的措施和承诺

（一）公司稳定股价的预案

根据公司 2025 年 4 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》，公司稳定股价的预案如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情形时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；

（2）停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，公司将停止实施股价稳定措施；

（3）公司董事会公告稳定公司股价的预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止稳定公司股价事宜。

为免疑义，（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一个会计年度末公司股份总数，如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产值相应进行调整，下同）。

2、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（1）由公司回购股票

①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》《证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；

②公司董事会应在首次触发股票回购义务之日起 20 个交易日内作出实施回购股份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大会审议。公司董事会、股东大会对回购股份做出决议，均须经特别决议方式审议通过（即出席会议的主体所持表决权的三分之二以上通过）。公司董事会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。经公司股东大会决议实施回购的，回购的股份将被依法注销并及时办理公司减资程序。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件：

公司在单一会计年度内单次回购股份的数量不得超过回购前公司股份总数的 1%，同时单次用于回购的资金不得超过人民币 500 万元。公司在单一会计年度累计回购股份的数量不得超过回购前公司股份总数的 2%，同时在单一会计年度累计用于回购的资金不得超过人民币 1,000 万元或公司上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%（两者取孰低）。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

（2）控股股东、实际控制人增持

①下列任一条件发生时，控股股东、实际控制人应按照相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的增持股份：公司回购股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司未按照本预案规定如期公告股票回购计划；或因各种原因导致公司的股票回购计划未能通过公司股东大会。

②公司控股股东、实际控制人应在触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告，应在符合《公司法》《证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提

下，对公司股票进行增持。

③在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；公司控股股东、实际控制人在单一会计年度内累计购买所增持股票的总金额，不高于控股股东、实际控制人自本次发行上市后累计从公司所获得现金分红金额的 10%，且累计增持的股份数量应不超过本次发行上市后股份总数的 2%。公司控股股东、实际控制人增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动条件的，控股股东、实际控制人可以终止增持股份。

（3）董事、高级管理人员增持

①下列任一条件发生时，公司董事及高级管理人员应根据相关法律、法规的规定实施稳定股价之目的增持股份：控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产；或控股股东、实际控制人未如期公告增持计划。

②在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员在触发稳定股价义务之日起 20 个交易日内，应就其增持公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并由公司进行公告，应在符合《公司法》《证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。

③在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票；公司董事、高级管理人员在单一会计年度内累计购买所增持股票的总金额应不超过其上一年度从公司领取的税后现金薪酬总额的 15%，且累计增持的股份数量应不超过本次发行上市后股份总数的 1%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。

④自本次发行上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员，且上述

新聘人员符合本预案相关规定的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（4）法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章规范性文件所允许的其它措施。

公司及公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以视公司实际情况、股票市场等情况，同时或分步骤实施回购和/或增持股票措施。

公司制定股价稳定的具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律法规的规定的情况下，各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。若公司在实施稳定股价方案前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

公司及其他相关责任主体如未能履行上述关于履行稳定股价预案，将严格执行相关约束措施。

（二）公司承诺

公司关于稳定股价的措施和承诺如下：

1、公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（三）公司实际控制人承诺

公司实际控制人王兵关于稳定股价的措施和承诺如下：

本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

（四）公司董事、高级管理人员承诺

公司的董事（领薪非独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺如下：

本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》，按照预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。

三、关于股份回购和股份买回的承诺函

（一）公司承诺

公司关于股份回购和股份买回承诺如下：

1、启动股份回购及买回措施的条件

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

2、股份回购及买回措施的启动程序

（1）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起5个工作日内，将本次公开发行A股的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。

（2）若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证监会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后10个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，按照发行价格加新股上市日至回购日期期间的同期银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，依法回购公司本次公开发行的全部新股。

（3）当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。

3、约束措施

（1）公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、买回措施的相应承诺。

（2）公司自愿接受中国证监会及证券交易所等证券监管机构对股份回购、买回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、买回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、买回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：

① 在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

② 因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

（二）公司实际控制人承诺

公司实际控制人王兵关于股份回购和股份买回承诺如下：

本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对

判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，则本人将极力督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票；且本人将依法购回本次公开发发行时已公开发售的原限售股份（如有），督促发行人及自身严格根据彼时现行有效的法律法规或内部规定履行相应的回购程序。

四、对欺诈发行上市的股份回购承诺

（一）公司承诺

公司关于欺诈发行上市的股份回购承诺如下：

1、本公司首次公开发行的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在本公司不符合发行上市条件而以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。

3、因本公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（二）公司实际控制人承诺

公司实际控制人王兵关于欺诈发行上市的股份回购承诺如下：

1、公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在公司不符合发行上市条件而以欺诈手段骗取发行注册的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

五、利润分配政策的承诺

公司关于利润分配政策事项承诺如下：

首次公开发行后，公司将遵守并执行届时有效的《重庆臻宝科技股份有限公司章程（草案）》及股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》所规定的股利分配政策及股东分红回报规划向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。

如本公司违反承诺给投资者造成损失的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺并将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东会审议，并对投资者依法承担责任。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）公司承诺

公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

1、加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续巩固和发挥自身研发、生产、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，持续拓展市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。

2、加强内部管理、提升运营效率、降低运营成本

公司将积极推进产品/服务优化、研发及生产流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升运营效率，不断降低损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率。

3、加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。同时，公司将建立健全募集资金管理制度，根据相关法规

和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

4、建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

5、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照《公司章程》的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

6、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对投资者的补偿责任。

（二）公司实际控制人承诺

公司实际控制人王兵关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行并督促公司履行

填补摊薄即期回报的相关措施；

2、在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；

3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（三）公司董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺如下：

1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人（作为董事和/或高级管理人员）的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求；

7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意按照中国证

监会和证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

七、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

（一）公司承诺

公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

1、本公司承诺招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、如中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

3、如中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

4、公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定，或根据中国证监会或其他有权部门认可的其他价格。若公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，上述发行价为除权、除息后的价格。上述回购实施时，法律、法规另有规定的从其规定。

5、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，公司将自愿无条件遵从该等规定。

（二）公司实际控制人承诺

公司实际控制人王兵关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

1、本人承诺招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。若上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务。

3、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本人将自愿无条件遵从该等规定。

（三）公司全体董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

公司全体董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

1、公司本次发行的《招股说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。若上述虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，按照司法程序履行相关义务，并且，上述承诺不因本人在公司的职务调整或离职而发生变化。

3、若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定的，本人将自愿无条件遵从该等规定。

（四）中介机构承诺

1、中信证券股份有限公司承诺如下：

本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者

损失。

2、北京市中伦律师事务所承诺如下：

本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：

本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、重庆坤元资产评估有限公司承诺如下：

本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

八、关于未能履行承诺约束措施的承诺

（一）公司承诺

公司关于未能履行承诺约束措施承诺如下：

1、本公司将严格履行在首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向全体股东及社会公众投资者道歉，按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任，并提出补充承诺或替代承诺。

（2）如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。

（3）自公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不得以任何形式向董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员增加薪资或津贴。

3、若公司因不可抗力原因导致未能履行承诺事项中各项义务或责任，公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的原因，且将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案（如向投资者提出补充承诺或替代承诺），尽可能地保护投资者利益。

（二）公司实际控制人及其一致行动人承诺

公司实际控制人王兵及其一致行动人公司关于未能履行承诺约束措施承诺如下：

1、如本人/本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，在有关监管机关要求的期限内予以纠正，如该违反的承诺属于可以继续履行的，将继续履行该承诺；

2、若本人/本企业未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本企业承诺如本人/本企业非因不可抗力原因违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人/本企业将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉；同时，本人/本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人/本企业还应说明原有承诺是否继续实施，如不继续实施的，本人/本企业应根据实际情况提出补充承诺或替代承诺；

（2）如本人/本企业未能履行相关承诺事项，公司有权将应付给本人/本企业的

现金分红或派发的红股、薪酬和/或津贴暂时扣留，直至本人/本企业实际履行上述各项承诺义务，完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响为止；

（3）本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；

（4）本人/本企业未履行首次公开发行上市招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；

（5）本人/本企业直接或间接方式持有的公司股份（如有）的锁定期除被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人/本企业完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。

3、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人/本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者致歉。同时，本人/本企业将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者的利益。

（三）公司其他持股5%以上股东及其一致行动人承诺

公司其他持股5%以上股东及其一致行动人承诺关于未能履行承诺约束措施承诺如下：

1、如本人/本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，在有关监管机关要求的期限内予以纠正，如该违反的承诺属于可以继续履行的，将继续履行该承诺；

2、如本人/本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：如本人/本企业未履行首次公开发行上市招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

3、如本人/本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人/本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况。同时，本人/本企业将尽快研究处理方案，尽可能地保护公司和投资者的利益。

4、如本人基于公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员职务或任何其他身份签署了其他关于未能履行承诺时约束措施的承诺函，如前述二者存在矛盾，则均以要求更为严格者为准。（适用自然人股东）

（四）公司全体董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

公司全体董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员关于未能履行承诺约束措施承诺如下：

1、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）如违反相关承诺给投资者造成损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。

2、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：

（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

九、关于信息披露的相关承诺

发行人关于信息披露的承诺如下：

1、除国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司未接受股东访谈外，本公司及本公司其他股东已及时向本次发行的中介机构提供了直接层面股东真实、准确、完整的资料，并积极和全面配合了本次发行的中介机构开展包括但不限于股东穿透核查在内的尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

2、公司附属公司在被收购前存在的股权代持情形已彻底解除，截至本承诺函出具日，公司不存在股份代持、信托持股或其他影响或潜在影响公司股权结构的事项或特殊利益安排等情形，公司股东持有的发行人股份权属清晰，不存在任何股权（份）权属纠纷或潜在纠纷以及影响发行人控股权清晰的情形。

3、截至本确认函出具日，本公司现有直接或间接股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公务员法》《关于印发参照公务员法管理的党中央、国务院直属事业单位名单的通知》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国人民解放军内务条令（试行）》《中共中央、国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《关于加强国有企业领导人员廉洁自律工作的意见》《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》或其他法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份。

4、本公司及实际控制人与申请首次公开发行的中介机构中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其负责人、签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。除保荐机构中信证券股份有限公司附属公司中信证券投资有限公司直接及间接持有公司股份外，不存在其它中介机构及其负责人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、项目经办人员直接或间接持有公司股份的情形。

5、本公司及其实际控制人、股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在以本公司股权作为对价进行不当利益输送的情形。

6、公司的自然人股东入股公司均具有合理性，入股价格公允，该等股东已足额支付相关价款，资金来源为自有/自筹资金，入股交易价格不存在明显异常的情形。

7、公司机构股东中，股权架构为两层以上合伙企业或公司的，均系依法在基金业协会备案的私募投资基金，该等私募投资基金均已按照《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规的要求履行了私募投资基金备案手续，其私募投资基金管理人均已按照《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规的要求履行了私募投资基金人登记手续，该等私募投资基金均已纳入监管，不存在无实际经营业务的股东。该等股东入股公司均具有合理性，入股价格公允，该等股东已足额支付相关价款，资金来源为自有/自筹资金，不存在明显异常情况。

8、公司直接股东不存在资产管理计划、信托计划等“三类股东”的情形。

9、重庆臻芯企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆臻宝企业管理合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台（以下合称“持股平台”），前述两平台均以自有资金投资，其设立目的仅为持有公司股份，公司与持股平台及其合伙人不存在任何股权（份）权属纠纷或潜在纠纷。持股平台不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按照前述规定履行备案/登记程序。

10、公司设立至今不存在境外证券交易所上市情形，不存在基于通过集合竞价、连续竞价交易方式增加股东申请豁免的需要，亦不存在因继承、执行法院判决或仲裁裁决、执行国家法规政策要求或由省级及以上人民政府主导取得公司股份的股东。

11、公司的直接或间接股东不属于《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》规定的离开证监会系统未满十年的工作人员，不涉及离职人员入股重大媒体质疑的情况。

12、公司的直接或间接股东不存在以下不当入股的情况：利用原职务影响谋取投资机会；入股过程存在利益输送；在入股禁止期内入股；入股资金来源违法违规；

入股价格显失公允等。

十、关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人王兵及其一致行动人关于避免同业竞争承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的企业（除公司及其下属企业以外的其他企业，下同）均未直接或间接从事任何与公司及其下属企业从事的业务有实质性竞争的业务，亦未通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与公司及其下属企业有实质性竞争的业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人/本企业和本人/本企业有或将来设立的全资子公司、投资持有 51%股权以上的控股子公司和其他受本人/本企业控制的公司将不直接或间接从事任何与公司及其下属企业从事的业务相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的业务，亦不通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与公司及其下属企业相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的业务。

3、不向其他业务与公司或其下属企业相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司或其下属企业的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、如果未来本人/本企业或本人/本企业控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司或其下属企业存在同业竞争，本人/本企业将本着公司优先的原则与公司协商解决。

5、本人/本企业及受本人/本企业控制的企业如违反上述承诺而参与同业竞争，本人/本企业将承担由此给公司造成的全部直接和间接经济损失及相关的费用支出，并及时采取必要措施予以纠正补救。如公司有意收购受本人/本企业控制的公司涉及同业竞争的业务或资产，本人/本企业将无条件按市场公允价将相关业务或资产优先转让给公司。

6、如本人/本企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司从事的业务有竞争或可能有竞争，本人/本企业承诺将上述商业机会通知公司，在通知中所指定的合理期间，如公司或其下属企业作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将无条件放弃该商业机会，以确保公司及其全体股东利益和下属企业的利益不受损害。

7、本承诺函为不可撤销之承诺，除非本人/本企业不再直接或间接是公司的实际控制人（包括作为一致行动人），否则本承诺函持续有效。如出现因本人/本企业违反上述承诺与保证而导致公司或公司的其他股东权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

十一、其他承诺事项

（一）关于规范关联交易的承诺

1、发行人实际控制人王兵及其一致行动人关于规范关联交易承诺如下：

（1）不利用自身作为公司实际控制人及其一致行动人之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本人/本企业及本人/本企业控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身作为实际控制人及其一致行动人之地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和公司《公司章程》《关联交易管理制度》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本人/本企业保证，在本人/本企业作为实际控制人及其一致行动人期间，

公司在对待将来可能产生的与本人/本企业及本人/本企业控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守公司《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

2、发行人持股 5%以上的股东及其一致行动人关于规范关联交易承诺如下：

（1）不利用自身作为公司持股 5%以上股东之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本人/本企业及其控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身作为公司持股 5%以上股东之地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和公司《公司章程》《关联交易管理制度》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本人/本企业保证，在作为公司持股 5%以上股东期间，公司在对待将来可能产生的与本人/本企业及其控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守公司《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

3、发行人全体董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员关于规范关联交易承诺如下：

（1）不利用自身作为公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身作为公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及重庆臻宝科技股份有限公司《公司章程》《关联交易管理制度》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本人保证，在本人作为公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员期间，公司在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守重庆臻宝科技股份有限公司《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》及其他关联交易管理制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价方式确定交易价格。

（二）在审期间不进行现金分红的承诺

发行人关于在审期间不进行现金分红的承诺如下：

1、公司本次发行上市在审期间不进行现金分红，上市完成前的滚存未分配利润

由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

2、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。

附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

一、信息披露和投资者关系

为保护投资者依法享有的权利，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，结合公司实际情况制定了保护投资者权益的措施。具体如下：

（一）信息披露制度和流程

2025年5月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《重庆臻宝科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，对发行人信息披露的总体原则、管理和责任、具体程序、披露内容、保密制度等事项进行了详细规定，确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

2025年5月20日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《重庆臻宝科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，公司由董事会秘书担任投资者关系管理事务的主管负责人；董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司将严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规则及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司的了解，

促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、利润分配政策决策程序

1、公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议。

2、公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见并公开披露。

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东大会审议，公司可以采取网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

三、股东投票机制的建立情况

公司通过采用累积投票、网络投票、征集投票等方式，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。

（一）选举公司董事采取累积投票制

根据《公司章程（草案）》相关规定，董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投票制指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）中小投资者单独计票

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）法定事项采取网络投票方式召开股东大会

根据《公司章程（草案）》相关规定，股东大会除设置会场，以现场会议形式

召开外，公司还将提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知和补充通知中充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东大会审议，公司可以采取网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（四）征集投票权

根据《公司章程（草案）》相关规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

公司根据现行法律法规要求，按照法定程序审议修订《公司章程》，相应制定股东大会、董事会及监事会等议事规则，各机构运行规范。

一、股东大会制度的运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，《股东大会议事规则》针对股东大会的召开程序制定了详细规则。

自股份公司设立以来，相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会制度的建立健全及运行情况

（一）董事会的构成

公司董事会对股东大会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期 3 年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会均已制定工作细则，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。

（二）董事会及下设专门委员会的运作情况

1、董事会运行情况

公司建立了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式与条件、表决方

式等进行了明确规定。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。

自股份公司设立以来，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

2、专门委员会的运行情况

（1）战略委员会

战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议。公司第一届董事会第一次会议选举王兵、LIANSHENG CAO（曹炼生）、杨佐东为公司战略委员会委员。

（2）提名委员会

提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任，提名委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。公司第一届董事会第一次会议选举LIANSHENG CAO（曹炼生）、龙莉、王兵为公司提名委员会委员。

（3）审计委员会

审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。公司第一届董事会第一次会议选举张金若、龙莉、杨璐为公司审计委员会委员。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。公司第一届董事会第一次会议选举龙莉、张静、张金若为公司薪酬与考核委员会委员。

三、取消监事会前监事会制度的建立健全及运行情况

（一）监事会的建立健全

公司建立了《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式与条件、表决方式等进行了明确规定。

监事会由三名监事组成，包括一名职工代表监事，监事任期三年，任期届满，连选可以连任，监事会设主席一名。监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权，监事会规范运行，历次会议的召开及决议内容合法有效，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

（二）监事会的运作情况

股份公司设立以来，公司监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督，公司取消监事会前在任监事按照相关规定出席监事会会议并依法行使权利和履行义务，不存在管理层、监事会违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

四、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

为规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，公司于第一届董事会第一次会议审议通过《董事会秘书工作细则》。相关制度对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责权限以及董事

会办公室等作了明确规定，符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

根据《公司章程》及《董事会秘书工作细则》等规定，公司设董事会秘书一名，作为公司高级管理人员，对董事会负责。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》认真履行其职责，负责筹备董事会和股东大会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

附件四：审计委员会及其他专门委员会设置情况

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。截至本招股说明书签署日，各个委员会委员名单如下：

委员会	召集人委员	其他委员
战略委员会	王兵	LIANSHENG CAO（曹炼生）、杨佐东
提名委员会	LIANSHENG CAO（曹炼生）	龙莉、王兵
审计委员会	张金若	龙莉、杨璐
薪酬与考核委员会	龙莉	张静、张金若

附件五：募集资金具体运用情况

一、半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

（一）项目实施地点与时间进度安排

本项目拟在重庆市开展相关工作。

本项目建设期为4年，项目开展将按照土地购置、场地建造及装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
土地购置								
场地建造及装修								
设备购置及安装								
人员调配及培训								
投入生产								

注：T代表项目开始时点

（二）项目环境保护情况

本项目符合国家产业政策、园区规划和规划环评审查意见及三线一单要求，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施后，污染物可实现达标排放，环境风险可控，区域环境功能不会发生改变，环境影响在接受范围内。

二、臻宝科技研发中心建设项目

（一）项目实施地点与时间进度安排

本项目拟在重庆市开展相关工作。

本项目建设期为3年，项目开展将按照土地购置及建造装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
土地购置及建造装修						
设备购置及安装						

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
人员调配及培训						
产品技术研发						

注：T 代表项目开始时点

（二）项目环境保护情况

本项目符合国家产业政策、园区规划和规划环评审查意见及三线一单要求，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施后，污染物可实现达标排放，环境风险可控，区域环境功能不会发生改变，环境影响在接受范围内。

三、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

（一）项目实施地点与时间进度安排

本项目拟在上海市开展相关工作。

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地租赁、场地装修、软硬件购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
场地租赁						
场地装修						
软硬件购置安装及调试						
人员调配及培训						
产品技术研发						

注：T 代表项目开始时点

（二）项目环境保护情况

本项目符合国家产业政策、园区规划和规划环评审查意见及三线一单要求，落实各项污染防治措施和环境风险防范措施后，污染物可实现达标排放，环境风险可控，区域环境功能不会发生改变，环境影响在接受范围内。

附件六：子公司、参股公司简要情况

详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人子公司、参股公司及分公司情况”。

附件七：核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施 以及已触发履行条件承诺事项的履行情况

一、核心技术人员的重要承诺、未能履行承诺的约束措施

详见本招股说明书之“附件一：与投资者保护相关的承诺”。

二、核心技术人员已触发履行条件承诺事项的履行情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员不存在已触发履行条件承诺事项的情况。